

Panel PC 900

Anwenderhandbuch

Version: **1.00 (Dezember 2013)**

Best. Nr.: **MAPPC900-GER**

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehör

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Kapitel 1 Allgemeines.....	9
1 Handbuchhistorie.....	9
2 Sicherheitshinweise.....	10
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	10
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen.....	10
2.2.1 Verpackung.....	10
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung.....	10
2.3 Vorschriften und Maßnahmen.....	10
2.4 Transport und Lagerung.....	11
2.5 Montage.....	11
2.6 Betrieb.....	11
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile.....	11
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase.....	11
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme.....	12
2.7 Umweltgerechte Entsorgung.....	12
2.7.1 Werkstofftrennung.....	12
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen.....	13
4 Richtlinien.....	13
5 Übersicht.....	14
Kapitel 2 Technische Daten.....	17
1 Einleitung.....	17
1.1 Information zum Anwenderhandbuch.....	17
1.2 Beschreibung der einzelnen Module.....	17
1.2.1 Displayeinheiten.....	17
1.2.2 CPU Board & Systemeinheit.....	18
1.3 Aufbau / Konfiguration.....	19
1.3.1 Konfiguration.....	19
2 Gesamtgerät.....	22
2.1 Mechanische Eigenschaften.....	22
2.1.1 Abmessungen.....	22
2.1.2 Einbauzeichnungen.....	23
2.1.3 Luftzirkulationsabstände.....	24
2.1.4 Einbaulagen.....	25
2.1.5 Gewichtsangaben.....	26
2.2 Umwelt Eigenschaften.....	27
2.2.1 Temperaturangaben.....	27
2.2.2 Luftfeuchte.....	32
2.2.3 Vibration.....	33
2.2.4 Schock.....	33
2.2.5 Schutzart.....	33
2.3 Elektrische Eigenschaften.....	34
2.3.1 Spannungsversorgung +24 VDC.....	34
2.3.2 Optionale Spannungsversorgung VAC.....	34
2.3.3 Leistungskalkulation.....	35
2.3.4 Blockschaltbild.....	37
2.4 Geräteschnittstellen und Einschübe.....	38
2.4.1 Geräteschnittstellen Übersicht.....	38
2.4.2 Spannungsversorgung.....	40
2.4.3 Serielle Schnittstelle COM1.....	42
2.4.4 Serielle Schnittstelle COM2.....	42
2.4.5 Monitor / Panel Anschluss.....	43
2.4.6 Ethernet 1 (ETH1).....	45
2.4.7 Ethernet 2 (ETH2).....	45
2.4.8 USB Schnittstellen.....	46
2.4.9 CFast Slot.....	47
2.4.10 Audio.....	47

2.4.11 Status LEDs.....	48
2.4.12 Power Button.....	49
2.4.13 Reset Button.....	49
2.4.14 Batterie.....	50
2.4.15 Slide-in compact Slot.....	51
2.4.16 Slide-in Slot.....	51
2.4.17 Hauptspeicher.....	52
2.4.18 IF Option 1 Steckplatz.....	53
2.4.19 IF Option 2 Steckplatz.....	53
2.4.20 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe).....	54
3 Einzelkomponenten.....	55
3.1 Displayeinheiten.....	55
3.1.1 5AP923.1215-00.....	55
3.1.2 5AP923.1505-00.....	57
3.1.3 5AP923.1906-00.....	59
3.1.4 5AP933.156B-00.....	61
3.1.5 5AP933.185B-00.....	63
3.1.6 5AP933.215C-00.....	65
3.1.7 5AP933.240C-00.....	67
3.2 CPU Boards QM77.....	69
3.2.1 5PC901.TS77-0x.....	69
3.3 CPU Boards HM76.....	72
3.3.1 5PC901.TS77-0x.....	72
3.4 Systemeinheiten.....	75
3.4.1 5PC911.SX00-00.....	75
3.4.2 5PC911.SX00-01.....	76
3.5 Hauptspeicher.....	77
3.5.1 5MMDDR.xxxx-03.....	77
3.6 Buseinheiten.....	78
3.6.1 5AC902.BX0x-xx.....	78
3.7 Lüfter Kit.....	80
3.7.1 5AC902.FA00-00.....	80
3.7.2 5AC902.FA0X-00.....	81
3.8 Laufwerke.....	82
3.8.1 5AC901.CHDD-01.....	82
3.8.2 5AC901.CSSD-03.....	84
3.8.3 5AC901.CSSD-04.....	86
3.8.4 5AC901.CSSD-05.....	89
3.8.5 5MMSSD.0060-01.....	91
3.8.6 5MMSSD.0128-01.....	93
3.8.7 5MMSSD.0256-00.....	96
3.8.8 5AC901.CCFA-00.....	98
3.8.9 5AC901.SDVW-00.....	99
3.8.10 5AC901.SSCA-00.....	101
3.9 Interface Optionen.....	102
3.9.1 5AC901.I485-00.....	102
3.9.2 5AC901.ICAN-00.....	106
3.9.3 5AC901.ISRM-00.....	108
3.9.4 5AC901.IHDA-00.....	109
3.10 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).....	111
3.10.1 Was wird benötigt.....	111
3.10.2 5AC901.IUPS-00.....	112
3.10.3 5AC901.IUPS-01.....	114
3.10.4 5AC901.BUPS-00.....	116
3.10.5 5AC901.BUPS-01.....	119
3.10.6 5CAUPS.xxxx-01.....	122
3.11 Netzteil.....	124

3.11.1 5AC902.PS00-00.....	124
Kapitel 3 Inbetriebnahme.....	125
1 Montage.....	125
1.1 Montage Panel PC 900.....	125
1.2 CPU Board & Systemeinheit Tausch.....	128
1.3 AC Netzteil Einbau bzw. Tausch.....	130
1.4 Hauptspeicher Tausch.....	132
1.5 Montage Interface Option.....	134
1.6 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch.....	138
1.7 Lüfter Kit Tausch.....	140
1.8 Lüfterfilter Tausch.....	141
1.9 Buseinheit Montage.....	142
1.10 PCI / PCIe Karten Montage.....	144
1.11 Slide-in Laufwerkseinbau.....	147
1.12 Montage & Anschluss der USV Batterieeinheit.....	149
2 Anschluss an das Stromnetz.....	150
2.1 Montage des DC Netzkabels.....	150
2.1.1 Verdrahtung.....	150
2.2 Montage des AC Netzkabels.....	151
2.2.1 Verdrahtung.....	151
2.3 Anschluss der Spannungsversorgung an ein B&R Gerät.....	152
2.4 Erdungskonzept Funktionserde.....	153
3 Anschluss von Kabeln.....	154
4 Erstes Einschalten.....	155
4.1 Allgemeines vor dem Einschalten.....	155
4.2 Panel PC einschalten.....	155
5 Touchkalibrierung.....	156
5.1 Singletouch (analog resistiv).....	156
5.1.1 Windows 7 Professional / Ultimate.....	156
5.1.2 Windows Embedded Standard 7 Embedded / Premium.....	156
5.1.3 Windows XP Professional.....	156
5.1.4 Windows Embedded Standard 2009.....	156
5.2 Multitouch (PCT - projiziert kapazitiv).....	156
5.2.1 Windows 7 Professional / Ultimate.....	156
5.2.2 Windows Embedded Standard 7 Premium.....	156
6 Regelung der Displayhelligkeit.....	157
7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes mit dem internen RAID Controller.....	158
7.1 Create RAID Volume.....	159
7.2 Delete RAID Volume.....	160
7.3 Reset Disks to Non-RAID.....	161
7.4 Recovery Volume Options.....	162
Kapitel 4 Software.....	163
1 BIOS Optionen.....	163
1.1 Allgemeines.....	163
1.2 BIOS Setup und Startvorgang.....	163
1.2.1 BIOS Setup Tasten.....	164
1.3 Main.....	165
1.3.1 Platform Information.....	166
1.4 Advanced.....	167
1.4.1 Graphics Configuration.....	168
1.4.2 OEM Features.....	170
1.4.3 PCI Configuration.....	190
1.4.4 PCI Express Configuration.....	192
1.4.5 ACPI Settings.....	199
1.4.6 RTC Wake Settings.....	200

1.4.7 CPU Configuration.....	201
1.4.8 Chipset Configuration.....	204
1.4.9 SATA Configuration.....	205
1.4.10 Memory Configuration.....	208
1.4.11 USB Configuration.....	212
1.4.12 Serial Port Console Redirection.....	216
1.5 Boot.....	218
1.5.1 Boot Device Priority.....	219
1.5.2 Boot Configuration.....	220
1.6 Security.....	221
1.6.1 HDD User Password.....	222
1.7 Save & Exit.....	222
1.8 BIOS Defaulteinstellungen.....	224
1.8.1 Advanced.....	224
1.8.2 Boot.....	228
1.9 Ressourcenaufteilung.....	230
1.9.1 RAM-Adressbelegung.....	230
1.9.2 I/O-Adressbelegung.....	230
1.9.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode.....	230
1.9.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode.....	231
2 Upgradeinformationen.....	233
2.1 BIOS Upgrade.....	233
2.1.1 Was muss ich wissen?.....	233
2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS.....	234
2.2 Firmwareupgrade.....	235
2.2.1 Vorgangsweise.....	235
2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP.....	236
2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files.....	238
2.4.1 Was wird benötigt.....	238
2.4.2 Vorgangsweise.....	238
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?.....	238
2.5 So erstellen Sie einen bootfähigen Massenspeicher für B&R Upgrade Files.....	239
2.5.1 Was wird benötigt.....	239
2.5.2 Vorgangsweise.....	239
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?.....	239
3 Windows 7.....	240
3.1 Allgemeines.....	240
3.2 Bestelldaten.....	240
3.3 Übersicht.....	240
3.4 Installation.....	241
3.5 Treiber.....	241
3.6 Eigenheiten, Einschränkungen.....	241
4 Windows Embedded Standard 7.....	242
4.1 Allgemeines.....	242
4.2 Bestelldaten.....	242
4.3 Übersicht.....	242
4.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7).....	242
4.5 Installation.....	243
4.6 Treiber.....	243
4.6.1 Touch Screen Treiber.....	243
5 Windows XP Professional.....	244
5.1 Allgemeines.....	244
5.2 Bestelldaten.....	244
5.3 Übersicht.....	244
5.4 Installation.....	244
5.5 Treiber.....	244
6 Windows Embedded Standard 2009.....	246

6.1 Allgemeines.....	246
6.2 Bestelldaten.....	246
6.3 Übersicht.....	246
6.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009).....	246
6.5 Installation.....	247
6.6 Treiber.....	247
Kapitel 5 Normen und Zulassungen.....	248
1 Richtlinien und Erklärungen.....	248
1.1 CE- Kennzeichnung.....	248
1.2 EMV-Richtlinie.....	248
1.3 Niederspannungsrichtlinie.....	248
2 Zulassungen.....	249
2.1 UL Zulassung.....	249
2.2 UL Haz. Loc. Zulassung.....	249
2.3 GOST-R.....	249
Kapitel 6 Zubehör.....	250
1 Spannungsversorgungsstecker.....	250
1.1 0TB103.9x.....	250
1.1.1 Allgemeines.....	250
1.1.2 Bestelldaten.....	250
1.1.3 Technische Daten.....	250
1.2 0TB3103.8000.....	251
1.2.1 Allgemeines.....	251
1.2.2 Bestelldaten.....	251
1.2.3 Technische Daten.....	251
2 Ersatz CMOS Batterien.....	252
2.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000.....	252
2.1.1 Allgemeines.....	252
2.1.2 Bestelldaten.....	252
2.1.3 Technische Daten.....	252
3 CFast Karten.....	253
3.1 5CFAST.xxxx-00.....	253
3.1.1 Allgemeines.....	253
3.1.2 Bestelldaten.....	253
3.1.3 Technische Daten.....	253
3.1.4 Abmessungen.....	254
3.1.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	255
4 USB Memory Sticks.....	256
4.1 5MMUSB.xxxx-01.....	256
4.1.1 Allgemeines.....	256
4.1.2 Bestelldaten.....	256
4.1.3 Technische Daten.....	256
4.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	257
5 Kabel.....	258
5.1 DVI Kabel.....	258
5.1.1 5CADVI.0xxx-00.....	258
5.2 SDL Kabel.....	261
5.2.1 5CASDL.0xxx-00.....	261
5.3 SDL Kabel mit 45° Stecker.....	264
5.3.1 5CASDL.0xxx-01.....	264
5.4 SDL Kabel flex.....	267
5.4.1 5CASDL.0xxx-03.....	267
5.5 SDL Kabel flex mit Extender.....	270
5.5.1 5CASDL.0xx0-13.....	270
5.6 USB Kabel.....	274

5.6.1 5CAUSB.00xx-00.....	274
5.7 RS232 Kabel.....	275
5.7.1 9A0014.xx.....	275
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung.....	277
1 Batteriewechsel.....	277
1.1 Vorgehensweise.....	277
2 CFast Tausch.....	279
3 Reinigung.....	280
4 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer.....	281
4.1 Backlight.....	281
4.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlängert werden?.....	281
4.2 Image Sticking.....	281
4.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?.....	281
4.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?.....	281
5 Pixelfehler.....	281
Anhang A	282
1 Abkürzungen.....	282
2 Blickwinkel.....	282

Kapitel 1 • Allgemeines

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.00	19.12.2013	• Erste Version

Tabelle 1: Handbuchhistorie

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- **Elektrische Baugruppen mit Gehäuse**
... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- **Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse**
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubbiederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

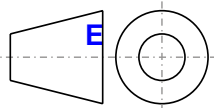
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	$\pm 0,1$ mm
über 6 bis 30 mm	$\pm 0,2$ mm
über 30 bis 120 mm	$\pm 0,3$ mm
über 120 bis 400 mm	$\pm 0,5$ mm
über 400 bis 1000 mm	$\pm 0,8$ mm

Tabelle 4: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
Batterien		
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	252
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	252
Buseinheiten		
5AC902.BX01-00	PPC900 Buseinheit 1 Slot - 1 PCI - 1 Slide-in	79
5AC902.BX01-01	PPC900 Buseinheit 1 Slot - 1 PCI Express x8 - 1 Slide-in	79
5AC902.BX02-00	PPC900 Buseinheit 2 Slot - 2 PCI - 1 Slide-in	79
5AC902.BX02-01	PPC900 Buseinheit 2 Slot - 1 PCI - 1 PCI Express x8 - 1 Slide-in	79
CFast Karten		
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte	253
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte	253
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte	253
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte	253
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte	253
CPU Boards		
5PC901.TS77-00	CPU Board Intel Core i7 3615QE 2,3 GHz - Quad Core - Chipset QM77	69
5PC901.TS77-01	CPU Board Intel Core i7 3612QE 2,1 GHz - Quad Core - Chipset QM77	69
5PC901.TS77-02	CPU Board Intel Core i7 3555LE 2,5 GHz -Dual Core -Chipset QM77	69
5PC901.TS77-03	CPU Board Intel Core i7 3517UE 1,7 GHz -Dual Core -Chipset QM77	69
5PC901.TS77-04	CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77	69
5PC901.TS77-05	CPU Board Intel Core i3 3120ME 2,4 GHz - Dual Core - Chipset QM77	69
5PC901.TS77-06	CPU Board Intel Core i3 3217UE 1,6 GHz - Dual Core - Chipset QM77	69
5PC901.TS77-07	CPU Board Intel Celeron 847E 1,1 GHz - Dual Core - Chipset HM76	72
5PC901.TS77-08	CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76	72
5PC901.TS77-09	CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76	72
5PC901.TS77-10	CPU Board Intel Celeron 1047UE 1,4 GHz - Dual Core - Chipset HM76	72
DVI Kabel		
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	258
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	258
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	258
Displayeinheiten		
5AP923.1215-00	Automation Panel 12,1" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	55
5AP923.1505-00	Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	57
5AP923.1906-00	Automation Panel 19,0" SXGA TFT - 1280 x 1024 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	59
5AP933.156B-00	Automation Panel 15,6" HD TFT - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	61
5AP933.185B-00	Automation Panel 18,5" HD TFT - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	63
5AP933.215C-00	Automation Panel 21,5" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	65
5AP933.240C-00	Automation Panel 24,0" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	67
Feldklemmen		
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	250
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	250
0TB3103.8000	Steckverbinder, 230 VAC, 3-polig female, Schraubklemme 4 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	251
Hauptspeicher		
5MMDDR.1024-03	SO-DIMM DDR3, 1024 MByte	77
5MMDDR.2048-03	SO-DIMM DDR3, 2048 MByte	77
5MMDDR.4096-03	SO-DIMM DDR3, 4096 MByte	77
5MMDDR.8192-03	SO-DIMM DDR3, 8192 MByte	77
Interface Optionen		
5AC901.I485-00	RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900	102
5AC901.ICAN-00	CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900	106
5AC901.IHDA-00	Audio Interface Option, Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT; zum Einbau in einen APC910	109
5AC901.ISRM-00	SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910 und PPC900	108
Laufwerke		
5AC901.CCFA-00	CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in compact Slot	98
5AC901.CHDD-01	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	82
5AC901.CSSD-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	84
5AC901.CSSD-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	86
5AC901.CSSD-05	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	89
5AC901.SDVW-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in	99
5AC901.SSCA-00	Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in compact Laufwerks in einem Slide-in Slot.	101
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	91
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	93

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	96
	Lüfter Kit	
5AC902.FA00-00	PPC900 Lüfter Kit - Für 5PC911.SX00-00	80
5AC902.FA0X-00	PPC900 Lüfter Kit - Für PPC900 Buseinheiten	81
	Netzteil	
5AC902.PS00-00	PPC900 Netzteil 85-264 VAC	124
	RS232 Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	275
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	275
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	275
	SDL Kabel	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	261
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	261
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	261
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	261
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	261
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	261
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	261
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	264
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	264
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	264
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	264
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	267
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	267
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	267
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	267
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	267
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	267
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	267
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	270
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	270
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	270
	Systemeinheiten	
5PC911.SX00-00	PPC900 Systemeinheit aktiv	75
5PC911.SX00-01	PPC900 Systemeinheit passiv	76
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	274
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	274
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	256
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	256
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC901.BUPS-00	Batterieeinheit 4,5 Ah; für USV 5AC901.IUPS-00.	116
5AC901.BUPS-01	Batterieeinheit 2,2 Ah; für USV 5AC901.IUPS-01.	119
5AC901.IUPS-00	USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900; für 4,5 Ah Batterie.	112
5AC901.IUPS-01	USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900; für 2,2 Ah Batterie.	114
5CAUPS.0005-01	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	122
5CAUPS.0010-01	USV Kabel 1 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	122
5CAUPS.0030-01	USV Kabel 3 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	122
	Windows 7 Professional/Ultimate	
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	240
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	240
5SWWI7.1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	240
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	240
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	240
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	240
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0741-ENG	Windows Embedded Standard 2009 - Englisch - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset	246
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1541-ENG	Windows Embedded Standard 7 SP1 - 32-Bit - Englisch - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	242
5SWWI7.1641-ENG	Windows Embedded Standard 7 SP1 - 64-Bit - Englisch - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	242
5SWWI7.1741-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 32-Bit - Multilanguage - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	242
5SWWI7.1841-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Multilanguage - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	242
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	244

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	244
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	244

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

1.1 Information zum Anwenderhandbuch

Dieses Anwenderhandbuch enthält alle nötigen Informationen zu einem funktionsfähigen Panel PC 900.

1.2 Beschreibung der einzelnen Module

1.2.1 Displayeinheiten

Die Displayeinheiten bilden die Basis für jedes Automation Panel 9x3 und Panel PC 900 System. Sie bestehen aus Display und Touch Screen. Es stehen unterschiedliche Displaydiagonalen und Touch Screen Technologien zur Auswahl. Die Displayeinheiten können ausschließlich als Gesamtgerät in Kombination mit einem Linkmodul (Automation Panel 9x3) oder CPU Board und Systemeinheit (Panel PC 900) betrieben werden.

Displayeinheiten mit Singletouch beginnen mit der Bestellnummer 5AP923.xxxx-xx, mit Multitouch mit der Bestellnummer 5AP933.xxxx-xx.



1.2.2 CPU Board & Systemeinheit

Auf den CPU Boards sind alle Schnittstellen des PPC900 integriert, des weiteren können Interface Optionen, Slide-in compact Laufwerke und CFast Karten gesteckt werden.

Die Systemeinheit besteht aus einem anthrazit-grau lackierten Gehäuse und dem Kühlkörper. Sie steht als passive Variante (ohne Lüfter Kit) und als aktive Variante (mit Lüfter Kit) zur Verfügung.

Wird ein CPU Board zusammen mit einer Systemeinheit, Hauptspeicher und Massenspeicher an eine Displayeinheit montiert so ergibt dies einen funktionsfähigen Panel PC 900. Der Panel PC 900 wird mit Hilfe von Halteklammern montiert.

Ein CPU Board und eine Systemeinheit ohne Displayeinheit ist nicht funktionsfähig.



1.3 Aufbau / Konfiguration

Es ist möglich das Automation Panel 9x3 und Panel PC 900 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustellen. Das Automation Panel 9x3 bzw. Panel PC 900 System ist so flexibel, dass ein Automation Panel in einen Panel PC bzw. ein Panel PC in ein Automation Panel umgebaut werden kann.

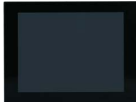




1.3.1 Konfiguration

Für den Betrieb als Panel PC 900 sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- Displayeinheit
- CPU Board
- Systemeinheit
- Hauptspeicher
- Lüfter Kit¹⁾
- Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CFast Karte oder Hard Disk) für das Betriebssystem
- Software

Es ist möglich den Panel PC 900 mit und ohne Lüfter Kit zu betreiben, dabei müssen die unterschiedlich zu verwendenden Gehäuse beachtet werden.






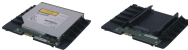



Beim Betrieb mit Lüfter Kit sind höhere Umgebungstemperaturen möglich als beim Betrieb ohne Lüfter Kit. Nähere Informationen dazu sind dem Abschnitt "Maximale Umgebungstemperatur Betrieb" auf Seite 28 zu entnehmen.

Konfiguration - Grundsysteem		
Displayeinheit	1 auswählen	
	5AP923.1215-00 12,1" XGA Singletouch 5AP923.1505-00 15,0" XGA Singletouch 5AP923.1906-00 19,0" SXGA Singletouch 5AP933.156B-00 15,6" HD Multitouch 5AP933.185B-00 18,5" HD Multitouch 5AP933.215C-00 21,5" FHD Multitouch 5AP933.240C-00 24,0" FHD Multitouch	
CPU Board - Systemeinheit - Lüfter Kit - Hauptspeicher		
CPU Board	1 auswählen	
	QM77 CPU Boards 5PC901.TS77-00 ¹⁾ 5PC901.TS77-04 5PC901.TS77-01 5PC901.TS77-05 5PC901.TS77-02 5PC901.TS77-06 5PC901.TS77-03	HM76 CPU Boards 5PC901.TS77-07 5PC901.TS77-08 5PC901.TS77-09 5PC901.TS77-10
Systemeinheit	1 auswählen	
	5PC911.SX00-00 System aktiv	5PC911.SX00-01 System passiv
Lüfter Kit	1 auswählen	
	5AC902.FA00-00	
Hauptspeicher	1 oder 2 auswählen	
	5MMDDR.1024-03 5MMDDR.2048-03	5MMDDR.4096-03 5MMDDR.8192-03

1) Das CPU Board 5PC901.TS77-00 kann ausschließlich mit der Systemeinheit 5PC911.SX00-00 betrieben werden.

Abbildung 1: Konfiguration Grundsysteem - Panel PC 900

¹⁾ Die Verwendung eines Lüfter Kit kann unter bestimmten Bedingungen erforderlich sein. Nähere Information sind dem Abschnitt "Maximale Umgebungstemperatur Betrieb" auf Seite 28 zu entnehmen.

Konfiguration - Zubehör, Software					
Netzteil	1 auswählen				
	5AC902.PS00-00				
Slide-in compact Laufwerke	1 auswählen				
	5AC901.CHDD-01 5AC901.CSSD-03 5AC901.CSSD-04		5AC901.CSSD-05 5AC901.CCFA-00		
IF Optionen	max. 2 auswählen ¹⁾				
	5AC901.I485-00 5AC901.ICAN-00		5AC901.IHDA-00 5AC901.ISRM-00		
USV	je 1 auswählen				
	USV Modul ²⁾ + Batterieereinheit + USV Kabel 5AC901.IUPS-00 + 5AC901.BUPS-00 5CAUPS.0005-01 5AC901.IUPS-01 + 5AC901.BUPS-01 5CAUPS.0010-01 5CAUPS.0030-01				
Buseinheit - Slide-in Laufwerk - Lüfter Kit					
Buseinheiten	1 auswählen				
	5AC902.BX01-00 Bus 1PCI 1SI 5AC902.BX01-01 Bus 1PCle.x8 1SI 5AC902.BX02-00 Bus 2PCI 1SI 5AC902.BX02-01 Bus 1PCI 1PCle.x8 1SI				
Slide-in Laufwerke	max. 1 auswählen				
	5AC901.SDVW-00 5AC901.SSCA-00				
Lüfter Kit ³⁾	max. 1 auswählen				
	5AC902.FA0X-00				
CFAST Karten	1 auswählen				
	5CFAST.2048-00 5CFAST.4096-00 5CFAST.8192-00		5CFAST.016G-00 5CFAST.032G-00		
USB Zubehör	1 auswählen				
	5MMUSB.2048-01 5MMUSB.4096-01				
Feldklemmen	1 auswählen				
	Spannungsversorgungsstecker DC 0TB103.9 0TB103.91		Spannungsversorgungsstecker AC 0TB3103.8000		

- 1) Beim Betreiben von IF Optionen sind gewisse Einschränkungen zu beachten. Nähere Informationen sind dem „Kapitel 2 Technische Daten“, Abschnitt „Geräteschnittstellen“ zu entnehmen.
- 2) Das USV Modul kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.
- 3) Wird eine aktive Systemeinheit verwendet, muss ein Lüfter Kit für die Buseinheit ausgewählt werden.

Abbildung 2: Konfiguration Zubehör - Panel PC 900

Konfigurationsmöglichkeiten

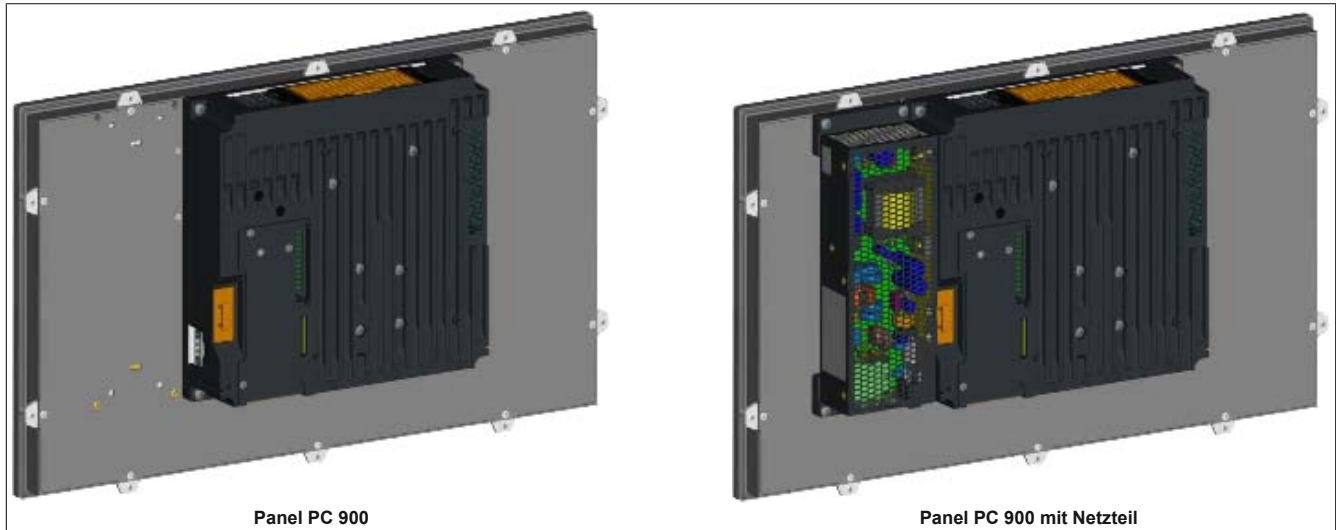


Abbildung 3: Panel PC 900 - ohne Buseinheit

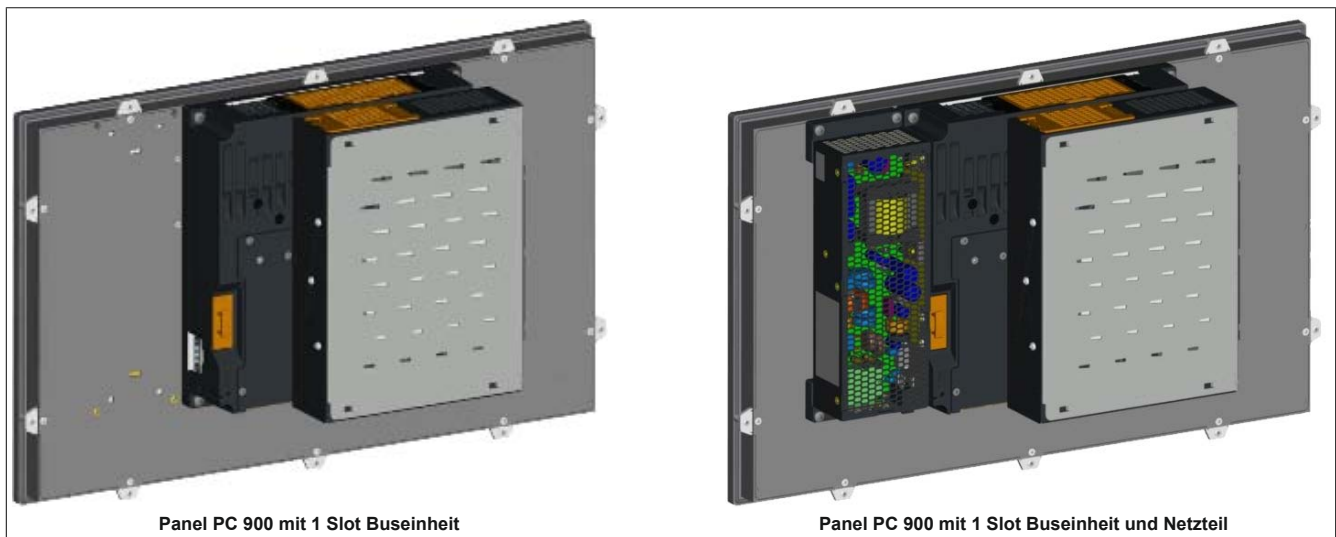


Abbildung 4: Panel PC 900 - mit 1 Slot Buseinheit

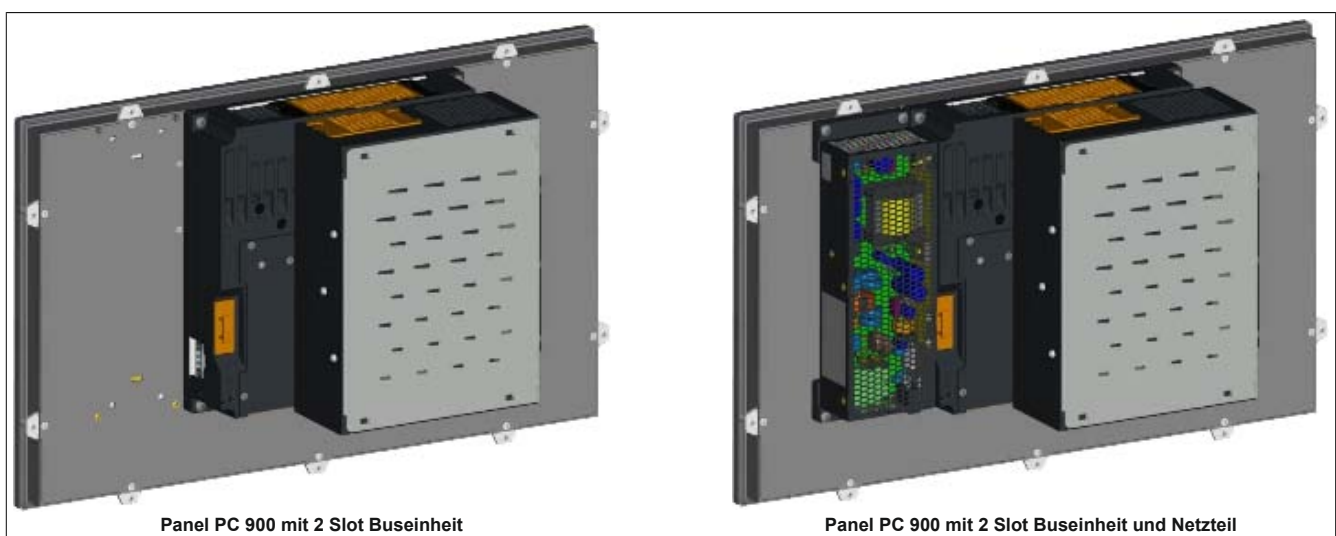


Abbildung 5: Panel PC 900 - mit 2 Slot Buseinheit

2 Gesamtgerät

2.1 Mechanische Eigenschaften

2.1.1 Abmessungen

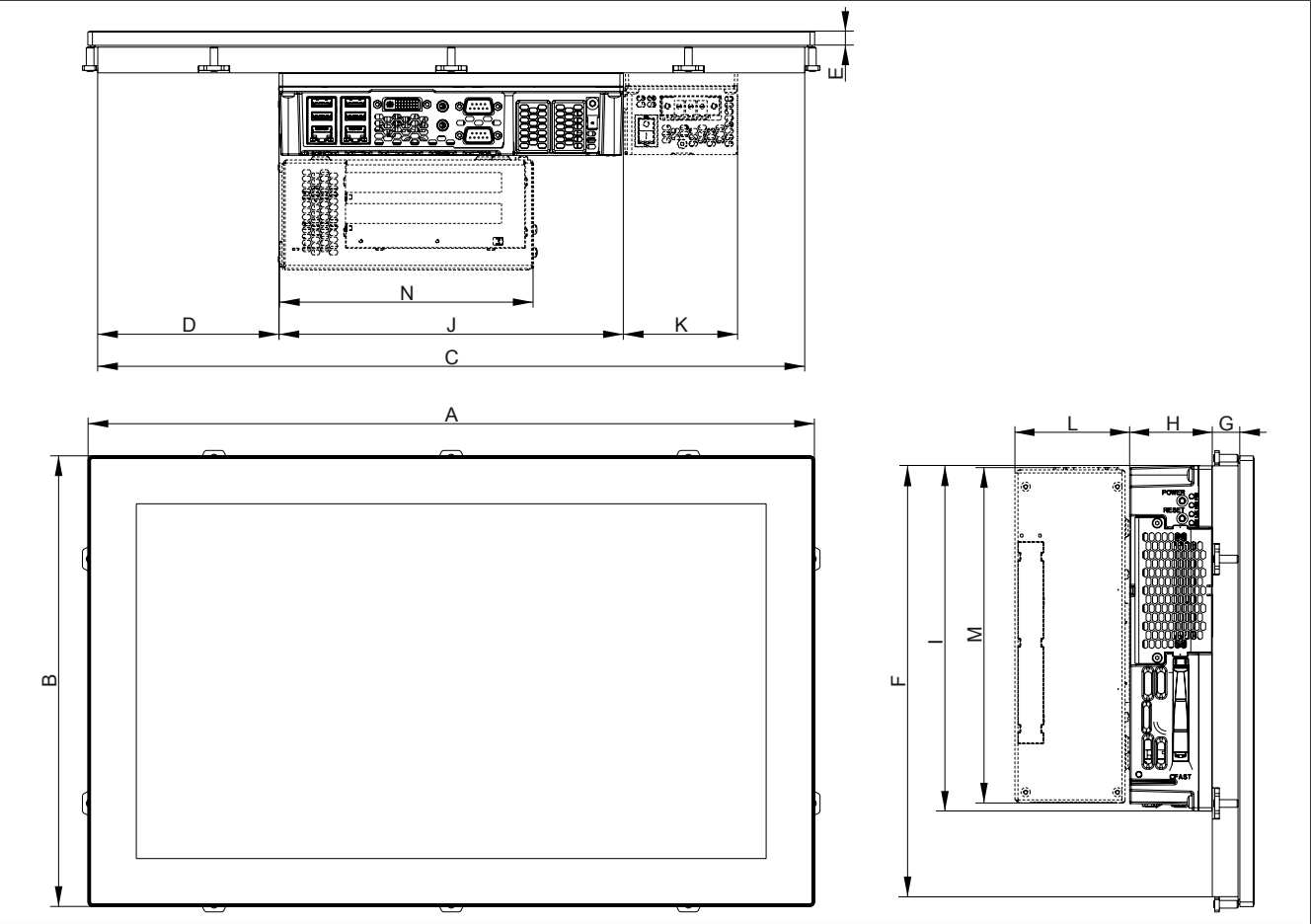


Abbildung 6: Abmessungen - Panel PC 900 + Netzteil + Buseinheiten

Alle Abmessungen in mm.

Displaytyp	Bestellnummer	A	B	C	D	E	F	G	
12" Singletouch	5AP923.1215-00	315	239	302	0	9	226	13,5	
15" Singletouch	5AP923.1505-00	370	288	357	36,5	9	275	14,5	
19" Singletouch	5AP923.1906-00	440	358	427	101	9	345	23	
15" wide Multitouch	5AP933.156B-00	414	258,5	401	57,5	9	245,5	20	
18" wide Multitouch	5AP933.185B-00	475	295	462	118,5	9	282	18	
21" wide Multitouch	5AP933.215C-00	541,5	333	528,5	151,75	9	320	18	
24" wide Multitouch	5AP933.240C-00	598,5	364	585,5	180,25	9	351	18	

Tabelle 5: Abmessungen - Displayeinheiten

Komponente	Bestellnummer	H	I	J	K	L	M	N	
CPU Board & Systemeinheit	5PC901.TS77-xx & 5PC911.SX00-xx	54	226	225	-	-	-	-	
Buseinheit 1 Slot	5AC902.BX01-xx	-	-	-	-	54,7	218	164	
Buseinheit 2 Slot	5AC902.BX02-xx	-	-	-	-	75	218	164	
Netzteil	5AC902.PS00-00	53,5	225,5	-	74,5	-	-	-	

Tabelle 6: Abmessungen - CPU Boards & Systemeinheiten, Buseinheiten und Netzteil

Information:

Auf Anfrage sind 3D Zeichnungen erhältlich oder über die B&R Homepage www.br-automation.com herunterzuladen.

2.1.2 Einbauzeichnungen

Information:

Beim Einbau des Panel PC 900 sind die Luftzirkulationsabstände sowie zusätzlicher Freiraum für die Bedienung und Wartung des Geräts zu berücksichtigen.

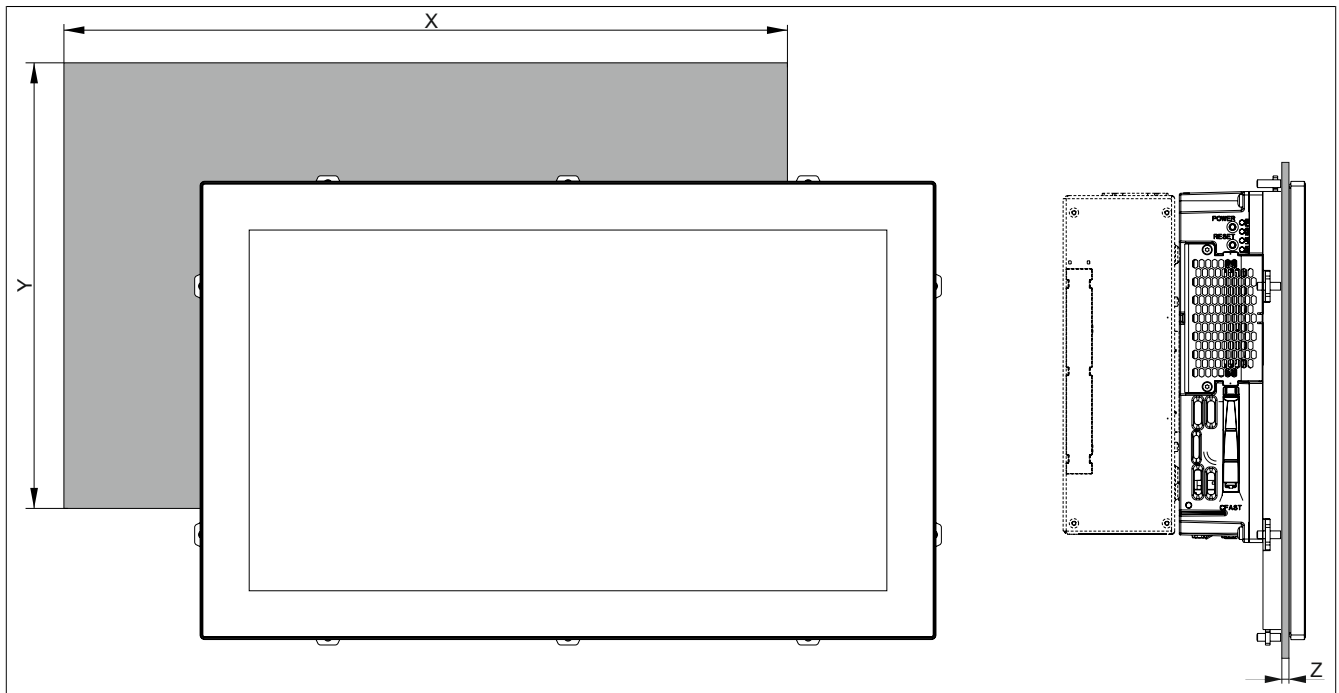


Abbildung 7: Einbauzeichnung - Panel PC 900 + Netzteil + Buseinheiten

Alle Abmessungen in mm.

Displaytyp	Bestellnummer	X	Y	Z min	Z max	Anzahl der Halteklammern	
12" Singletouch	5AP923.1215-00	304	228	1	6	10 Stück	
15" Singletouch	5AP923.1505-00	359	277	1	6	10 Stück	
19" Singletouch	5AP923.1906-00	429	347	1	6	12 Stück	
15" wide Multitouch	5AP933.156B-00	403	247,5	1	6	10 Stück	
18" wide Multitouch	5AP933.185B-00	464	284	1	6	10 Stück	
21" wide Multitouch	5AP933.215C-00	530,5	322	1	6	14 Stück	
24" wide Multitouch	5AP933.240C-00	587,5	353	1	6	14 Stück	

Tabelle 7: Einbauzeichnungen - Displayeinheiten

Das Maß "Z" beschreibt die Dicke des Wand- bzw. des Schaltschrankblechs.

Für das Anziehen bzw. Lösen der Schraube der Halteklammer wird ein Sechskant-Schraubendreher benötigt. Das maximale Anzugsmoment der Halteklammer beträgt 1 Nm.

2.1.3 Luftzirkulationsabstände

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rückseitig des Geräts ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist für sämtliche Varianten gültig.

Information:

Nachfolgende Abbildung und Tabelle zeigt ausschließlich die thermische Betrachtung des Gesamtgeräts. Wird für die Bedienung oder Wartung des Geräts zusätzlicher Platz benötigt, so ist dies bei der Montage zu berücksichtigen.

Der Lufteintritt bzw. Luftaustritt ist in nachfolgender Abbildung für aktive Panel PCs (mit Lüfter Kit) eingezeichnet. Bei passiven Panel PCs (ohne Lüfter Kit) steigt die warme Luft von unten nach oben, der Lufteintritt erfolgt somit an der Unterseite.

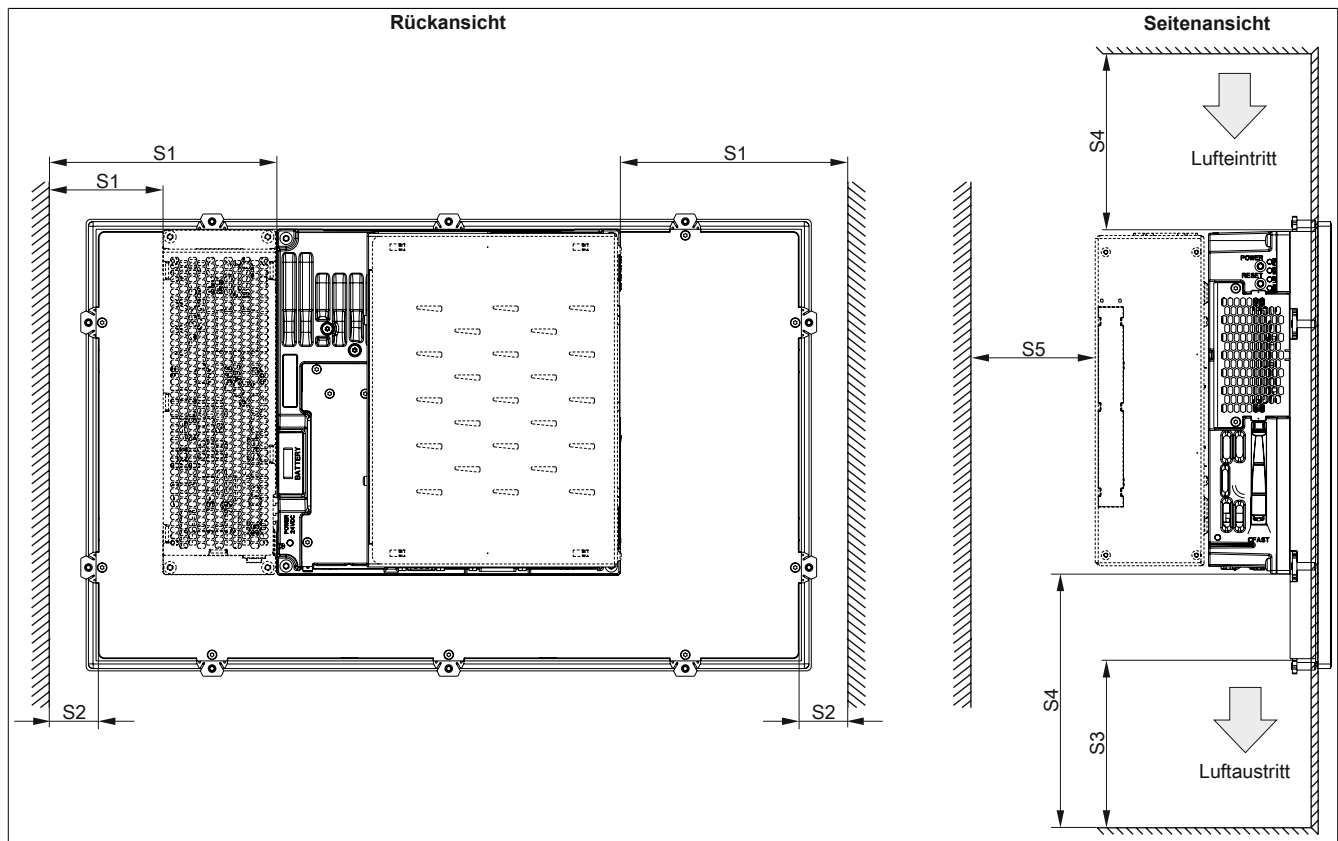


Abbildung 8: Abstände für die Luftzirkulation beim Panel PC 900

- S1: ≥ 20 mm
- S2: ≥ 20 mm
- S3: ≥ 50 mm
- S4: ≥ 100 mm
- S5: ≥ 50 mm

Vorsicht!

Die angegebenen Luftzirkulationsabstände gelten für den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifizierten Umgebungstemperatur. Die maximal spezifizierte Umgebungstemperatur darf nicht überschritten werden!

Können die angegebenen Luftzirkulationsabstände nicht eingehalten werden, sind die maximal spezifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" auf Seite 31) vom Anwender zu überwachen und bei Überschreiten dieser Werte entsprechende Maßnahmen zu setzen.

2.1.4 Einbaulagen

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen die spezifizierten Einbaulagen der Panel PC 900 Geräte. Ein PPC900 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

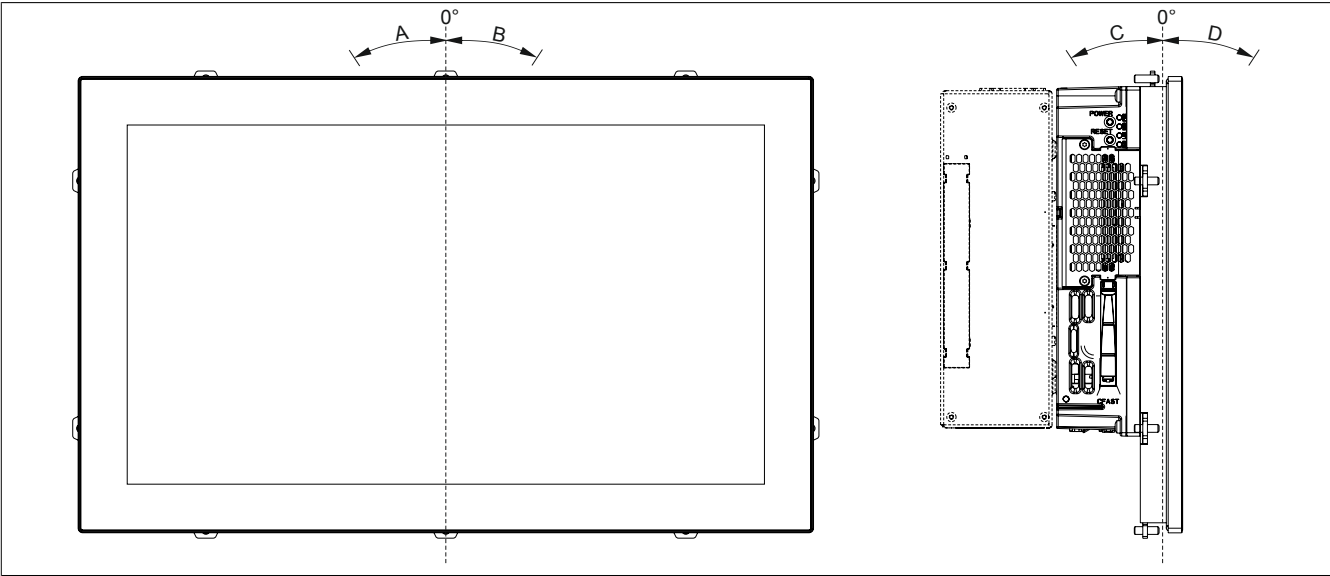


Abbildung 9: Einbaulage - Panel PC 900

Einbaulage		Einschränkung der Umgebungstemperatur ¹⁾	
0°	0°	-	
A	-90° (gegen Uhrzeigersinn)	-	
B	+90° (im Uhrzeigersinn)	5°C	
C, D	±180° (Schnittstellen oben)	-	
C	-45°	-	
D	+90° (Display nach unten)	5°C	

Tabelle 8: Einbaulagen im Betrieb mit und ohne Lüfter Kit

1) Die maximale Umgebungstemperatur muss um ... herabgesenkt werden.

Einbaulage	Einschränkung der Einbaulage mit der Einzelkomponente ¹⁾	
	5AC901.SDVW-00	
0°	0°	
A	-30°	
B	+30°	
C	-5°	
D	+30°	

Tabelle 9: Einbaulagen im Betrieb mit Einzelkomponenten mit Einschränkungen

1) Die Einbaulage darf max. ... betragen.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 24 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

2.1.5 Gewichtsangaben

Alle Gewichtsangaben in g (Gramm).

Displaytyp	Bestellnummer	Gewicht	
12" Singletouch	5AP923.1215-00	2200	
15" Singletouch	5AP923.1505-00	3700	
19" Singletouch	5AP923.1906-00	5800	
15" wide Multitouch	5AP933.156B-00	3850	
18" wide Multitouch	5AP933.185B-00	4850	
21" wide Multitouch	5AP933.215C-00	5400	
24" wide Multitouch	5AP933.240C-00	7800	

Tabelle 10: Gewicht - Displayeinheiten

Komponente	Bestellnummer	Gewicht	
CPU Boards	5PC901.TS77-xx	450	
Systemeinheiten	5PC911.SX00-00	3020	
	5PC911.SX00-01	3020	
Buseinheiten 1 Slot	5AC902.BX01-00	1020	
	5AC902.BX01-01	1020	
Buseinheiten 2 Slot	5AC902.BX02-00	1220	
	5AC902.BX02-01	1220	
Netzteil	5AC902.PS00-00	580	
Lüfter Kit	5AC902.FA00-00	70	
	5AC902.FA0X-00	36	
Slide-in compact Laufwerke	5AC901.CHDD-01	134	
	5AC901.CSSD-03	118	
	5AC901.CSSD-04	118	
	5AC901.CSSD-05	118	
Slide-in Laufwerke	5AC901.SDVW-00	400	
Interface Optionen	5AC901.I485-00	34	
	5AC901.ICAN-00	33	
	5AC901.ISRM-00	20	
	5AC901.IHDA-00	21	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	5AC901.IUPS-00	28	
	5AC901.IUPS-01	28	
	5AC901.BUPS-00	4600	
	5AC901.BUPS-01	2550	

Tabelle 11: Gewicht - CPU Boards & Systemeinheiten, Buseinheiten und Netzteil

2.2 Umwelt Eigenschaften

2.2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Möglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. in Abhängigkeit von Displayeinheit und Systemeinheit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Tabellen bedingt durch diese Komponenten, einen Überblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resultierenden, maximal möglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen für den Betrieb mit und ohne Lüfter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows höhere Umgebungstemperaturen erzielt werden können. Die diesbezügliche Prüfung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT V6.0 bzw. V7.1) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung
- BurnIn Testtool (BurnIn V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audioausgänge)
- Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

2.2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur Betrieb

Betrieb mit Lüfter Kit

Information:

Wird der Panel PC 900 mit Lüfter Kit betrieben muss die Systemeinheit 5PC911.SX00-00 verwendet werden.

		Betrieb mit Lüfter Kit mit Systemeinheit 5PC911.SX00-00										Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich	
		I7 3615QE	I7 3612QE	I7 3555LE	I7 3517UE	I5 3610ME	I3 3120ME	I3 3217UE	C 847E	C 827E	C 1020E			C 1047UE
Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.		5PC901.TS77-00	5PC901.TS77-01	5PC901.TS77-02	5PC901.TS77-03	5PC901.TS77-04	5PC901.TS77-05	5PC901.TS77-06	5PC901.TS77-07	5PC901.TS77-08	5PC901.TS77-09	5PC901.TS77-10		
Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.														
Maximale Umgebungstemperatur		50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?														
Displayeinheiten	5AP923.1215-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Display
	5AP923.1505-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AP923.1906-00	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP933.156B-00	✓	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP933.185B-00	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP933.215C-00	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP933.240C-00	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
Hauptspeicher	1x 5MMDDR.xxxx-03 gesteckt ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	2x 5MMDDR.xxxx-03 gesteckt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Slide-in compact Laufwerke	5AC901.CHDD-01	✓	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-
	5AC901.CSSD-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.CSSD-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.CSSD-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.CCFA-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Slide-in Laufwerke	5AC901.SDVW-00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	Slide-in Laufwerk
	5AC901.SSCA-00 ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Interface Optionen	5AC901.I485-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	5AC901.ICAN-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.IHDA-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.ISRM-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.IUPS-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.IUPS-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Buseinheiten	5AC902.BX01-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	5AC902.BX01-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC902.BX02-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC902.BX02-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Netzteil	5AC902.PS00-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
CFast Karten	5CFAST.2048-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	CFast Einschub
	5CFAST.4096-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5CFAST.8192-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5CFAST.016G-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5CFAST.032G-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	

1) Der Hauptspeicher muss im RAM Steckplatz 2 gesteckt sein.

2) Die max. Umgebungstemperatur ist vom verwendeten Slide-in compact Laufwerk abhängig.

Tabelle 12: Umgebungstemperatur mit Lüfter

Betrieb ohne Lüfter Kit

Information:

Bei einem Betrieb ohne Lüfter Kit ist die Verwendung des 5PC901.TS77-00 CPU Boards nicht möglich.

Wird der Panel PC 900 ohne Lüfter Kit betrieben muss die Systemeinheit 5PC911.SX00-01 verwendet werden.

		Betrieb ohne Lüfter Kit mit Systemeinheit 5PC911.SX00-01										Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich	
		I7 3615QE 5PC901.TS77-00	I7 3612QE 5PC901.TS77-01	I7 3555LE 5PC901.TS77-02	I7 3517UE 5PC901.TS77-03	I5 3610ME 5PC901.TS77-04	I3 3120ME 5PC901.TS77-05	I3 3217UE 5PC901.TS77-06	C 847E 5PC901.TS77-07	C 827E 5PC901.TS77-08	C 1020E 5PC901.TS77-09			C 1047UE 5PC901.TS77-10
Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.														
Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.														
Maximale Umgebungstemperatur		-	35	40	50	35	35	50	50	50	35	50		
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?														
Displayeinheiten	5AP923.1215-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Display
	5AP923.1505-00	-	✓	TBD	✓	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP923.1906-00	-	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP933.156B-00	-	TBD	TBD	45	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP933.185B-00	-	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
	5AP933.215C-00	-	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
5AP933.240C-00		-	TBD	TBD	35	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	-	
Hauptspeicher	1x 5MMDDR.xxxx-03 gesteckt ¹⁾	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	2x 5MMDDR.xxxx-03 gesteckt	-	30	35	45	30	30	45	45	45	30	45	-	
Slide-in compact Laufwerke	5AC901.CHDD-01	-	30 ³⁾	30 ³⁾	35 ³⁾	30 ³⁾	30 ³⁾	35 ³⁾	35 ³⁾	35 ³⁾	30 ³⁾	35 ³⁾	-	-
	5AC901.CSSD-03	-	✓	✓	40 ³⁾	✓	✓	40 ³⁾	40 ³⁾	40 ³⁾	✓	40 ³⁾	-	
	5AC901.CSSD-04	-	✓	✓	40 ³⁾	✓	✓	40 ³⁾	40 ³⁾	40 ³⁾	✓	40 ³⁾	-	
	5AC901.CSSD-05	-	✓	✓	40 ³⁾	✓	✓	40 ³⁾	40 ³⁾	40 ³⁾	✓	40 ³⁾	-	
	5AC901.CCFA-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Slide-in Laufwerke	5AC901.SDVW-00	-	✓	✓	40	✓	✓	40	40	40	✓	40	-	Slide-in Laufwerk
	5AC901.SSCA-00 ²⁾	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Interface Optionen	5AC901.I485-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	5AC901.ICAN-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.IHDA-00	-	✓	✓	40	✓	✓	40	40	40	✓	40	-	
	5AC901.ISRM-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.IUPS-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC901.IUPS-01	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Buseinheiten	5AC902.BX01-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	5AC902.BX01-01	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC902.BX02-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC902.BX02-01	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Netzteil	5AC902.PS00-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
CFast Karten	5CFAST.2048-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	CFast Einschub
	5CFAST.4096-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5CFAST.8192-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5CFAST.016G-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5CFAST.032G-00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	

1) Der Hauptspeicher muss im RAM Steckplatz 2 gesteckt sein.

2) Die max. Umgebungstemperatur ist vom verwendeten Slide-in compact Laufwerk abhängig.

3) Für Systeme mit einer Gesamt- Systemlast > 90 W muss die max. Umgebungstemperatur um 5°C herabgesetzt werden.

Tabelle 13: Umgebungstemperatur ohne Lüfter

2.2.1.1.1 Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur am Panel PC 900?

1. Auswahl der Systemeinheit (mit oder ohne Lüfter Kit).
2. Auswahl des CPU Boards.
3. Die Zeile „Maximale Umgebungstemperatur“ zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern ü. NN.

4. Sind im PPC900 System zusätzlich Laufwerke, Interface Optionen, usw. eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschränkung besteht.
5. Mögliche Einschränkungen können durch die Einbaulage des Panel PC 900 entstehen. Informationen dazu sind im Abschnitt "Einbaulagen" auf Seite 25 zu finden.

Ist bei der verbauten Komponente ein „✓“ (Häkchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. „45“, so darf die Umgebungstemperatur des gesamten PPC900 Systems diese nicht überschreiten.

2.2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur Betrieb

Die minimale Umgebungstemperatur im Betrieb liegt in Verbindung mit folgender Komponente bei +5°C: 5AC901.SDVW-00.

Wird keine der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur im Betrieb bei 0°C.

2.2.1.3 Umgebungstemperatur Lagerung und Transport

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die minimalen und maximalen Umgebungstemperaturen für die Lagerung und den Transport des Gesamtgeräts. Mögliche Einschränkungen können durch Einzelkomponenten gegeben sein.

Lagerung	Transport	
-20 bis 60°C mit 5AC901.BUPS-01: -15 bis 40°C	-20 bis 60°C mit 5AC901.BUPS-01: -15 bis 40°C	

Tabelle 14: Umgebungstemperatur Lagerung / Transport

2.2.1.4 Temperaturüberwachung

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen im PPC900. Die Position der Temperatursensoren ist der Abb. 10 "Temperatursensorpositionen - Panel PC 900" auf Seite 31 zu entnehmen. Die angegebenen Werte in Tab. 15 "Temperatursensorpositionen" auf Seite 31 stellen die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle dar. Beim Überschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgelöst. Die Temperaturen können im BIOS oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhältlichen Hard Disks für PPC900 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es können verschiedene Parameter, wie z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen ausgelesen werden.

2.2.1.5 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen im PPC900 an. Die Temperaturen²⁾ können im BIOS (Menüpunkt Advanced - OEM Features - System Board Features / CPU Board Features - Temperature Values) oder unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center³⁾ ausgelesen werden.

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielpprogramme verfügbar.



Abbildung 10: Temperatursensorpositionen - Panel PC 900

ADI Sensoren	Position	Messpunkt für	Messung	max. spezifiziert
Panel	A	Display	Temperatur des Displays (Sensor integriert auf der Displayeinheit).	5AP923.1215-00: 80°C
CPU Board	B	CPU	Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor).	95°C
System unit 1	C	Board	Temperatur des Boards (Sensor integriert am CPU Board).	95°C
System unit 2	D	Chipsatz	Temperatur der Chipsatz Umgebung (Sensor integriert am CPU Board).	85°C
System unit 3	E	Board Netzteil	Temperatur der Board Netzteil Umgebung (Sensor integriert am CPU Board).	95°C
System unit 4	F	CFast	Temperatur der CFast Umgebung (Sensor integriert am CPU Board).	85°C
Slide-in drive	G	Slide-in Laufwerk	Temperatur eines Slide-in Laufwerks 1 (Sensor integriert am Slide-in Laufwerk).	laufwerkabhängig
	H	Interface Option ¹⁾	Temperatur einer Interface Option (Sensor integriert an der Interface Option).	von IF Option abhängig

Tabelle 15: Temperatursensorpositionen

1) Aktuell ist auf Interface Optionen kein Temperatursensor integriert.

2.2.1.6 Lüfterregelung

Der MTCX überwacht mit Hilfe der Temperatursensoren ständig die Temperatur, in deren Abhängigkeit die Lüfter geregelt werden. Die Drehzahl ist von der gemessenen Temperatur abhängig. Die Grenzwerte können von der verwendeten MTCX Firmware Version abhängig sein.

Position	Messpunkt für	Einschalttemperatur	Max. Lüfterdrehzahl bei:
A	Display	5AP923.1215-00: 70°C	5AP923.1215-00: 86°C
B	CPU	65°C	81°C
C	Board Controller	70°C	86°C
D	Chipsatz	70°C	86°C
E	Board Netzteil	70°C	86°C
F	CFast	60°C	76°C
G	Slide-in Laufwerk 1	5AC901.SDVW-00: 44°C ; 5AC901.SSCA-00: 55°C	5AC901.SDVW-00: 60°C ; 5AC901.SSCA-00: 71°C
H	Interface Option ¹⁾	-	-

Tabelle 16: Temperatursensorpositionen

1) Aktuell ist auf Interface Optionen kein Temperatursensor integriert.

Ab der Einschalttemperatur wird mit minimaler Lüfterdrehzahl gestartet. Die maximale Lüfterdrehzahl wird bei Einschalttemperatur + 16°C erreicht. In diesem Bereich wird die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Temperatur geregelt.

Beispiel mit dem Slide-in Laufwerk 5AC901.SDVW-00: 44°C + 16°C = 60°C --> maximale Lüfterdrehzahl

Die Lüfter werden erst wieder ausgeschaltet, wenn die Bewertungstemperatur im Zeitraum von 4 Stunden (=Nachlaufzeit) mehr als 6°C unter der Einschalttemperatur liegt.

²⁾ Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

³⁾ Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2.2 Luftfeuchte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes von Bedeutung sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Displaytyp	Bestellnummer	Betrieb	Lagerung / Transport	
12" Singletouch	5AP923.1215-00	5 bis 90%	5 bis 90%	
15" Singletouch	5AP923.1505-00	8 bis 90%	8 bis 90%	
19" Singletouch	5AP923.1906-00	5 bis 90%	5 bis 90%	
15" wide Multitouch	5AP933.156B-00	5 bis 90%	5 bis 90%	
18" wide Multitouch	5AP933.185B-00	5 bis 90%	5 bis 90%	
21" wide Multitouch	5AP933.215C-00	10 bis 90%	10 bis 90%	
24" wide Multitouch	5AP933.240C-00	5 bis 90%	5 bis 90%	

Tabelle 17: Luftfeuchtigkeit - Displayeinheiten

Komponente	Bestellnummer	Betrieb	Lagerung / Transport	
CPU Board	5PC901.TS77-xx	10 bis 90%	5 bis 95%	
Systemeinheit	5PC911.SX00-xx	5 bis 95%	5 bis 95%	
Buseinheit 1 Slot	5AC902.BX01-xx	5 bis 95%	5 bis 95%	
Buseinheit 2 Slot	5AC902.BX02-xx	5 bis 95%	5 bis 95%	
Netzteil	5AC902.PS00-00	7 bis 90%	7 bis 90%	
Slide-in compact Laufwerke	5AC901.CHDD-01	5 bis 95%	5 bis 95%	
	5AC901.CSSD-03	8 bis 95%	8 bis 95%	
	5AC901.CSSD-04	8 bis 95%	8 bis 95%	
	5AC901.CSSD-05	8 bis 95%	8 bis 95%	
	5AC901.CCFA-00	5 bis 95%	5 bis 95%	
Slide-in Laufwerke	5AC901.SDVW-00	8 bis 80%	5 bis 95%	
Interface Optionen	5AC901.I485-00	5 bis 90%	5 bis 95%	
	5AC901.ICAN-00	5 bis 90%	5 bis 95%	
	5AC901.IHDA-00	5 bis 90%	5 bis 95%	
	5AC901.ISRM-00	5 bis 90%	5 bis 95%	
	5AC901.IUPS-00	5 bis 90%	5 bis 95%	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	5AC901.IUPS-01	5 bis 90%	5 bis 95%	
	5AC901.BUPS-00	5 bis 95%	5 bis 95%	
	5AC901.BUPS-01	25 bis 85%	25 bis 85%	

Tabelle 18: Luftfeuchtigkeit - CPU Boards & Systemeinheiten, Buseinheiten und Netzteil

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

2.2.3 Vibration

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die maximalen Vibrationsangaben des Gesamtgeräts. Mögliche Einschränkungen können durch Einzelkomponenten gegeben sein.

Panel PC	Betrieb		Lagerung	Transport
	dauerhaft	gelegentlich		
mit SSD Laufwerken und CFast Karten	9 bis 200 Hz: 1 g	9 bis 200 Hz: 1 g	TBD	TBD
mit Hard Disk Laufwerken	5 bis 500 Hz: 0,25 g	5 bis 500 Hz: 0,5 g	TBD	TBD
mit DVD-R/RW Laufwerken	-	5 bis 500 Hz: 0,2 g	TBD	TBD

Tabelle 19: Vibration

2.2.4 Schock

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die maximalen Schockangaben des Gesamtgeräts. Mögliche Einschränkungen können durch Einzelkomponenten gegeben sein.

Panel PC	Betrieb	Lagerung	Transport
mit SSD Laufwerken und CFast Karten	15 g, 11 ms	TBD	TBD
mit Hard Disk Laufwerken	400 g, 2 ms	TBD	TBD
mit DVD-R/RW Laufwerken	5 g, 11 ms	TBD	TBD

Tabelle 20: Schock

2.2.5 Schutzart

Unter folgenden Bedingungen bietet der Panel PC 900 frontseitig die Schutzart IP65, rückseitig die Schutzart IP20:

- Korrekte Montage des Panel PC 900 (siehe "Montage Panel PC 900" auf Seite 125)
- Montage aller Abdeckungen bzw. Komponenten an den Schnittstellen und Einschüben
- Einhaltung aller Umgebungsbedingungen

2.3 Elektrische Eigenschaften

2.3.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (15 A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.


Spannungsversorgung +24 VDC		
verpolungssicher		3-polige Buchse
Pin	Beschreibung	
1	+	
2	Funktionserde	
3	-	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
Feldklemmen		
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	

Tabelle 21: Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC

Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	24 VDC $\pm 25\%$	
Nennstrom	5,5 A	
Einschaltstrom	max. 60 A für < 300 μ s	
Galvanische Trennung	Ja	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Optional, mit 5AC901.IUPS-00 oder 5AC901.IUPS-01	

2.3.2 Optionale Spannungsversorgung VAC

Um den Panel PC mit einer VAC Spannungsversorgung zu betreiben muss das optionale Netzteil 5AC902.PS00-00 am Panel PC montiert sein.

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB3103.8000 bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle oder dem Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.


Spannungsversorgung Netzteil VAC		
verpolungssicher		3-polige Buchse
Pin	Beschreibung	
1	Schutzerde	
2	L	
3	N	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
Feldklemmen		
0TB3103.8000	Steckverbinder, 230 VAC, 3-polig female, Schraubklemme 4 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 22: Spannungsversorgungsanschluss Netzteil VAC

Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	100 bis 240 VAC	
Frequenz	45 bis 65 Hz	
Nennstrom	1,25 bis 2,5 A	
Einschaltstrom	< 20 A (bei Kaltstart, 100% Last und 100 VAC)	
Interne Sicherung	Ja	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Optional mit externer USV	

2.3.3 Leistungskalkulation

Um die Gesamtleistung des Panel PCs zu berechnen, muss die Leistungsangabe des verwendeten Displays (siehe "Leistungskalkulation - Displayeinheiten") in die Tabelle "Leistungskalkulation CPU Board" in die Zeile "Displayeinheit, Fixverbraucher" eingefügt werden.

Information:

Die maximale Gesamtleistung des Netzteils von 130 Watt darf nicht überschritten werden.

Information:				CPU Board										Vorliegen- des System		
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.				i7 3615QE 45 W CPU	i7 3612QE 35 W CPU	i7 3555LE 25 W CPU	i7 3517UE 17 W CPU	i5 3610ME 35 W CPU	i3 3120ME 35 W CPU	i3 3217UE 17 W CPU	C 847E 17 W CPU	C 827E 17 W CPU	C 1020E 35 W CPU	C 1047UE 17 W CPU	Werte in dieser Spalte Eintragen	
				5PC901.TS77-00	5PC901.TS77-01	5PC901.TS77-02	5PC901.TS77-03	5PC901.TS77-04	5PC901.TS77-05	5PC901.TS77-06	5PC901.TS77-07	5PC901.TS77-08	5PC901.TS77-09	5PC901.TS77-10		
Leistung Gesamtnetzteil (maximal)															130	
maximal möglich															130	
+12 V	Displayeinheit, Fixverbraucher ¹⁾															
	CPU Board, Fixverbraucher	50	40	30	22	40	40	22	22	22	40	22				
	Arbeitsspeicher 1024 MByte je 2 W, max. 2 Stück															
	Arbeitsspeicher 2048 MByte je 2,5 W, max. 2 Stück															
	Arbeitsspeicher 4096 MByte je 3 W, max. 2 Stück															
	Arbeitsspeicher 8192 MByte je 3,5 W, max. 2 Stück															
	Lüfter Kit, optional	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	USV IF Option 5AC901.IUPS-00 im Betrieb, optional	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
	USV IF Option 5AC901.IUPS-01 im Betrieb, optional	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ²⁾															
Leistungsangabe PCIe x8 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ²⁾																
Verbraucher ∑																
Gesamtnetzteil +12 V	maximal möglich bei +5 V															50
	Displayeinheit, Fixverbraucher ¹⁾															
	CPU Board, Fixverbraucher	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	Slide-in compact Laufwerk (HDD / SSD)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	Slide-in Laufwerk (DVD / ...)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	4x USB Peripherie, je max. 5 W															
	Interface Option, optional ³⁾ max. 2 steckbar															
	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ²⁾															
	maximal möglich bei -12 V															1.2
	-12 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit) ²⁾														
Verbraucher -12 V ∑																
Verbraucher +5 V ∑																
3V3	maximal möglich bei 3V3															33
	Displayeinheit, Fixverbraucher ¹⁾															
	CPU Board, Fixverbraucher	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
	CFast Karte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Interface Option, optional ³⁾															
	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit) ²⁾															
	Leistungsangabe PCIe x8 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ²⁾															
Verbraucher 3V3 ∑																
Verbraucher Gesamtnetzteil ∑																

1) Die Leistungsangaben für die Displayeinheiten sind untenstehender Tabelle zu entnehmen.

2) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

3) Die Leistungsangaben für die Interface Optionen sind untenstehender Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 23: Leistungskalkulation CPU Board

Die Werte dieser Tabelle müssen, abhängig von der verwendeten Displayeinheit, in die Leistungskalkulationstabelle eingetragen werden um die Gesamtleistung des Gesamtgeräts zu ermitteln.

Displaytyp	Bestellnummer	+5 V	3V3	+12 V
12" Singletouch	5AP923.1215-00	-	4,20 W	7,20 W
15" Singletouch	5AP923.1505-00	-	3,55 W	6,00 W
19" Singletouch	5AP923.1906-00	8,00 W	-	22,40 W
15" wide Multitouch	5AP933.156B-00	3,35 W	-	10,50 W
18" wide Multitouch	5AP933.185B-00	6,10 W	-	10,80 W
21" wide Multitouch	5AP933.215C-00	7,40 W	-	18,30 W
24" wide Multitouch	5AP933.240C-00	6,35 W	-	24,00 W

Tabelle 24: Leistungskalkulation - Displayeinheiten

Die Werte dieser Tabelle müssen, wenn eine bzw. mehrere dieser Optionen in der Systemeinheit verbaut sind, in die Leistungskalkulationstabelle eingetragen werden um die Gesamtleistung des Gesamtgeräts zu ermitteln.

Komponente	Bestellnummer	+5 V	3V3	+12 V
Interface Option				
RS232/422/485 IF Option	5AC901.I485-00	1 W	-	-
CAN IF Option	5AC901.ICAN-00	1 W	-	-
Audio IF Option	5AC901.IHDA-00	0,2 W	0,2 W	-
SRAM IF Option	5AC901.ISRM-00	-	2 W	-
USV IF Option	5AC901.IUPS-00 im Standby	-	-	0,1 W
USV IF Option	5AC901.IUPS-01 im Standby	-	-	0,1 W

Tabelle 25: Leistungskalkulation Interface Optionen

2.3.4 Blockschaltbild

Das nachfolgende Blockschaltbild zeigt den vereinfachten Aufbau des Panel PC 900 Gesamtgeräts ohne Displayeinheit.

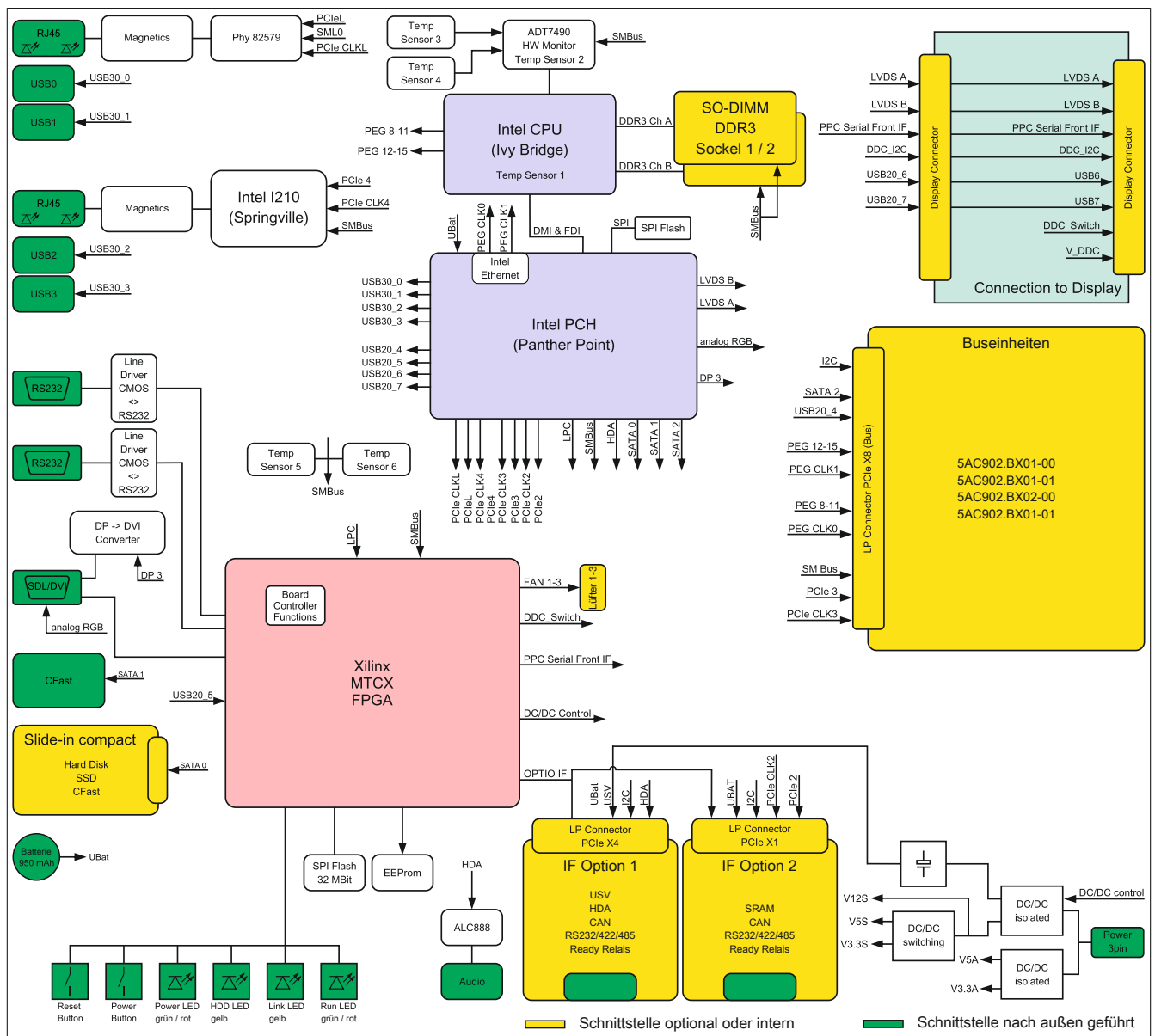


Abbildung 11: Blockschaltbild Panel PC 900

2.4 Geräteschnittstellen und Einschübe

2.4.1 Geräteschnittstellen Übersicht

Die Schnittstellen befinden sich an der Unterseite des Panel PC 900.

Folgende Abbildung zeigt die Schnittstellen am Panel PC 900 mit montierter Buseinheit und AC Netzteil.

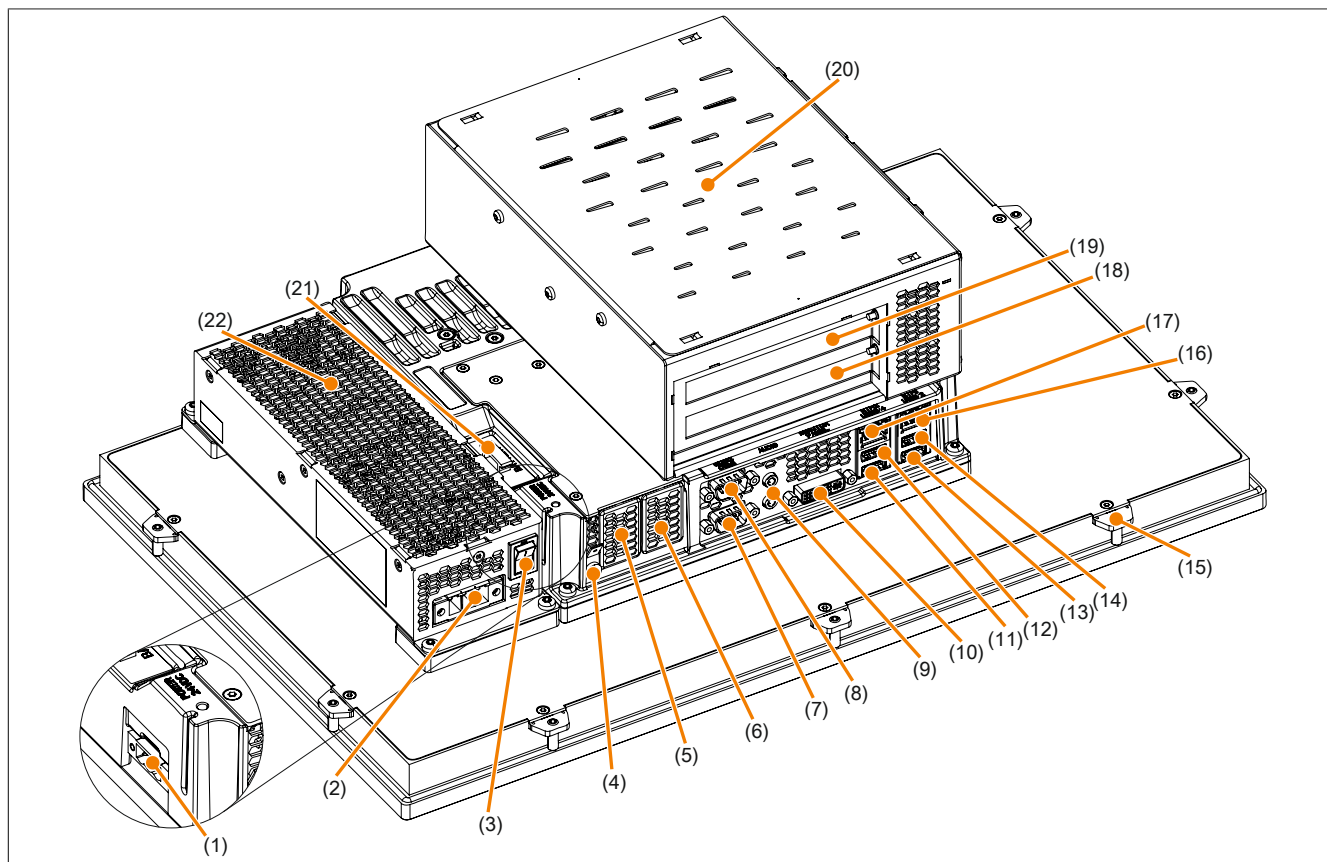


Abbildung 12: Geräteschnittstellen Übersicht unten

Nr.	Schnittstellenbezeichnung		Nr.	Schnittstellenbezeichnung	
1	Power 24 VDC	"Spannungsversorgung +24 VDC"	12	USB4	"USB Schnittstellen"
2	Power 230 VAC	"Optionale Spannungsversorgung VAC "	13	USB1	"USB Schnittstellen"
3	Ein/Aus- Schalter	"Ein/Aus- Schalter"	14	USB2	"USB Schnittstellen"
4	Funktionserdeanschluss	"Erdung"	15	Halteklammer	
5	IF Option 1	"IF Option 1 Steckplatz"	16	ETH1 (Ethernet1)	"Ethernet 1 (ETH1)"
6	IF Option 2	"IF Option 2 Steckplatz"	17	ETH2 (Ethernet2)	"Ethernet 2 (ETH2)"
7	COM 1	"Serielle Schnittstelle COM1"	18	Card Slot 1	"Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)"
8	COM 2	"Serielle Schnittstelle COM2"	19	Card Slot 2	"Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)"
9	Audio	"Audio"	20	Optionale Buseinheit	
10	Monitor / Panel	"Monitor / Panel Anschluss"	21	Batterie	"Batterie"
11	USB3	"USB Schnittstellen"	22	Optionales AC Netzteil	

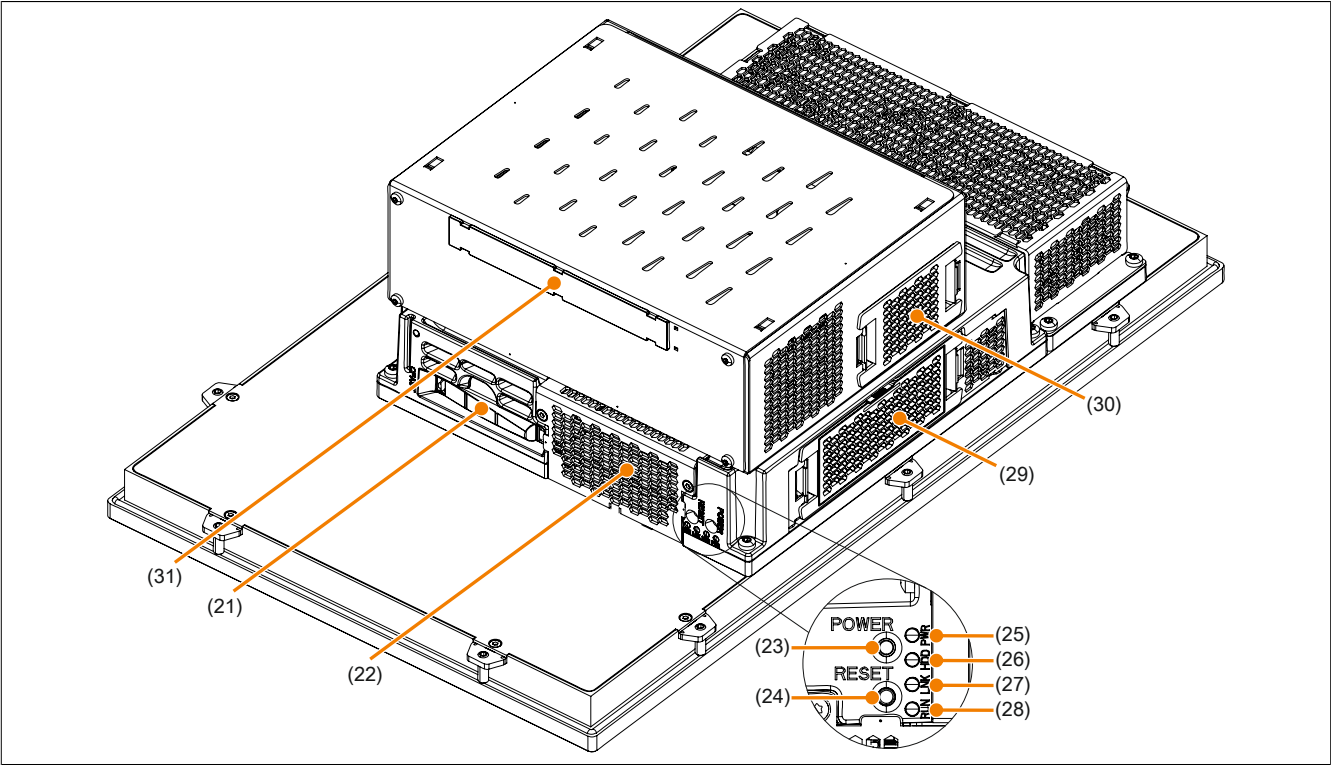


Abbildung 13: Geräteschnittstellen Übersicht seitlich

Nr.	Schnittstellenbezeichnung		Nr.	Schnittstellenbezeichnung	
21	CFast	"CFast Slot"	27	LINK LED	"Status LEDs"
22	Hauptspeicher und Slide-in compact Laufwerk	"Hauptspeicher" Slide-in compact Slot	28	RUN LED	"Status LEDs"
23	Power Button	"Power Button"	29	Lüfter Kit Systemeinheit	
24	Reset Button	"Reset Button"	30	Lüfter Kit Buseinheit	
25	Power LED	"Status LEDs"	31	Slide-in Laufwerk Buseinheit	"Slide-in Slot"
26	HDD LED	"Status LEDs"			

2.4.2 Spannungsversorgung

Es ist möglich den Panel PC mit 24 VDC oder optional mit 100~240 VAC zu betreiben. Für die AC-Stromversorgung wird das Netzteil 5AC902.PS00-00 benötigt.

Informationen zum Einbau bzw. Tausch des Netzteils sind im Abschnitt "AC Netzteil Einbau bzw. Tausch" auf Seite 130 zu finden.

Gefahr!

- Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Komponenten des Geräts entnommen und Zubehör, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt werden.
- Das Netzkabel vom Gerät und von der Spannungsversorgung entfernen.
- Bevor das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, müssen alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehör, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt sein.

2.4.2.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (15 A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.


Spannungsversorgung +24 VDC		
verpolungssicher		3-polige Buchse
Pin	Beschreibung	
1	+	
2	Funktionserde	
3	-	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Feldklemmen	
	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	
	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	
0TB103.9		
0TB103.91		

Tabelle 26: Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC

Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	24 VDC $\pm 25\%$	
Nennstrom	5,5 A	
Einschaltstrom	max. 60 A für $< 300 \mu s$	
Galvanische Trennung	Ja	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Optional, mit 5AC901.IUPS-00 oder 5AC901.IUPS-01	

2.4.2.1.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist möglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu empfehlen, den größt möglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die Panel PC Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.



Abbildung 14: Erdungsanschluss

An dem Erdungsanschluss kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschranks oder der Anlage in der das Gerät eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich gewählt werden.

2.4.2.2 Optionale Spannungsversorgung VAC

Um den Panel PC mit einer VAC Spannungsversorgung zu betreiben muss das optionale Netzteil 5AC902.PS00-00 am Panel PC montiert sein.

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. OTB3103.8000 bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle oder dem Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfall zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung Netzteil VAC	
verpolungssicher	
Pin	Beschreibung
1	Schutzerde
2	L
3	N
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Feldklemmen
OTB3103.8000	Steckverbinder, 230 VAC, 3-polig female, Schraubklemme 4 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch

3-polige Buchse

Spannungsversorgung
100~240 VAC




Tabelle 27: Spannungsversorgungsanschluss Netzteil VAC

Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	100 bis 240 VAC	
Frequenz	45 bis 65 Hz	
Nennstrom	1,25 bis 2,5 A	
Einschaltstrom	< 20 A (bei Kaltstart, 100% Last und 100 VAC)	
Interne Sicherung	Ja	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Optional mit externer USV	

2.4.2.2.1 Ein/Aus- Schalter

Mit dem Ein/Aus- Schalter kann der Panel PC ein- und ausgeschaltet werden, dieser befindet sich am 100 ~ 240 VAC Netzteil.


Ein/Aus- Schalter		
Schalterstellung	Beschreibung	
o	Der Panel PC ist ausgeschaltet.	
I	Der Panel PC ist eingeschaltet.	

Tabelle 28: Ein/Aus- Schalter

2.4.3 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstelle COM1 ¹⁾	
	RS232
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s
Buslänge	max. 15 m
Pin	Belegung
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

9-poliger DSUB Stecker

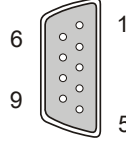


Tabelle 29: Pinbelegung COM1

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.4.4 Serielle Schnittstelle COM2

Serielle Schnittstelle COM2 ¹⁾		
	RS232	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 m	
Pin	Belegung	
1	DCD	
2	RXD	
3	TXD	
4	DTR	
5	GND	
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	

9-poliger DSUB Stecker

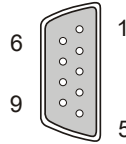


Tabelle 30: Pinbelegung COM2

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.4.5 Monitor / Panel Anschluss

Monitor / Panel Anschluss - RGB / SDL (Smart Display Link) / DVI		
Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosignale beim Monitor / Panel Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwendeten CPU Boards.		
CPU Board	Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten	
5PC901.TS77-00	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-01	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-02	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-03	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-04	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-05	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-06	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-07	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-08	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-09	RGB, DVI, SDL	
5PC901.TS77-10	RGB, DVI, SDL	

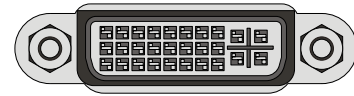


Tabelle 31: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegeräte am Monitor / Panel Anschluss wird seitens der Hardware und der Grafiktreiber der freigegebenen Betriebssysteme für Servicezwecke unterstützt. Die spezifizierten Steckzyklen des Monitor / Panel Steckers sind 100 Steckzyklen.

Information:

Wird ein Anzeigegerät mit Touch Screen am Monitor / Panel Anschluss während dem Betrieb ab- und wieder angesteckt (hot-plugging) kann eine Neukalibrierung des Touch Screens nötig sein.

Information:

Bei der RGB- Schnittstelle handelt es sich um ein analoges Signal, die mögliche Leitungslänge ist von der Auflösung sowie den herrschenden Umwelteinflüssen abhängig. Daher wird der Einsatz dieser Schnittstelle nur für Servicezwecke empfohlen.

2.4.5.1 USB Übertragung im SDL- und DVI- Betrieb

Information:

Im SDL- Betrieb ist die USB Übertragungsgeschwindigkeit auf USB 1.1 begrenzt.

Im DVI- Betrieb hängt die maximale USB Übertragungsgeschwindigkeit von der USB Schnittstelle und vom USB-Hub des Anzeigegerätes ab.

2.4.5.2 Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	ANALOG RED	Analog Red
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	ANALOG GREEN	Analog Green
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	ANALOG BLUE	Analog Blue
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	ANALOG HORZ SYNC	Analog Horizontal Synchronization

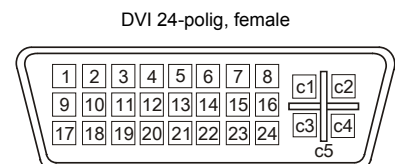


Tabelle 32: Pinbelegung DVI Anschluss

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung
14	+5 V Power ¹⁾	+5V Power Supply	C5	ANALOG GND	Analog ground (Return for R, G and B signals)
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground			

Tabelle 32: Pinbelegung DVI Anschluss

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

2.4.5.3 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung						
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	HD 1366 x 768	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	5CASDL.0250-00	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	5CASDL.0250-03	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 33: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

2.4.5.4 Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI Kabels:

DVI Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung						
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	HD 1366 x 768	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00
5	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00

Tabelle 34: Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die maximale Kabellänge bei der DVI Übertragung ist aufgrund der USB Spezifikation auf 5 m begrenzt.

2.4.6 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

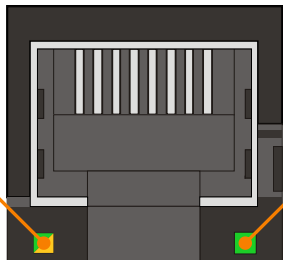
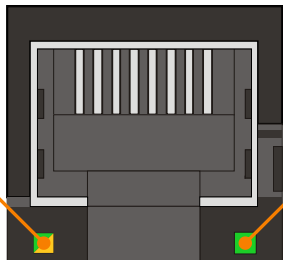
Ethernet 1 Anschluss (ETH1 ¹⁾)			
Controller	Intel® 82579V		RJ45 twisted pair (10BaseT/100BaseT), female 1 
Verkabelung	S/STP (Cat5e)		
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s ²⁾		
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)		
Speed LED	Ein	Aus	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ³⁾	
Orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	Ein	Aus	
Grün	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	

Tabelle 35: Ethernet Anschluss (ETH1)

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Ethernet Controller ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

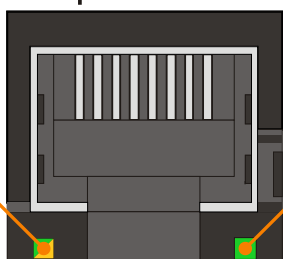
2.4.7 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2 ¹⁾)			
Controller	Intel® I210		
Verkabelung	S/STP (Cat5e)		
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s ²⁾		
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)		
Speed LED	Ein	Aus	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ³⁾	
Orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	Ein	Aus	
Grün	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	

RJ45 twisted pair (10BaseT/100BaseT), female

1



Speed LED

Link LED

Tabelle 36: Ethernet Anschluss (ETH2)

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Ethernet Controller ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.4.8 USB Schnittstellen

Die Panel PC Geräte verfügen über einen USB 3.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 4 USB 3.0 Schnittstellen nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1, USB2, USB3, USB4

An der Unterseite des Panel PC stehen 4 USB 3.0 Schnittstellen zur Verfügung.

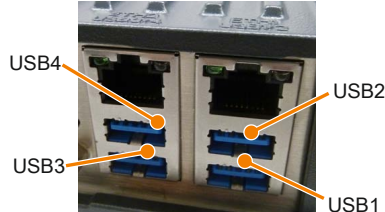
Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4) ¹⁾		
Typ	USB 3.0	
Ausführung	Typ A	
Übertragungsgeschwindigkeit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s) ²⁾	
Strombelastbarkeit ³⁾		
USB1, USB2 USB3, USB4	max. 1 A max. 1 A	
Kabellänge		
USB 2.0 USB 3.0	max. 5 m (ohne Hub) max. 3 m (ohne Hub)	

Tabelle 37: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Die Kompatibilität zu Super Speed hängt vom verwendeten Betriebssystem ab.
- 3) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien „USB Strombegrenzungsschalter“ (max. 1 A) abgesichert.

2.4.9 CFast Slot

Der Panel PC bietet seitlich einen einfach zugänglichen CFast Slot, so dass die CFast Karte auch als Wechsel-speichermedium zum Datentransfer oder für Upgrades genutzt werden kann.

Dieser CFast Slot ist intern über SATA 1 mit dem Chipset verbunden und in der Version SATA III (SATA 6 Gbit/s) ausgeführt.

CFast Slot	
Anschluss	SATA 1
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
CFast Karten	
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte




Tabelle 38: CFast Slot

Warnung!

An- und Abstecken der CFast Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.4.10 Audio

Der MIC und Line IN Port haben einen gemeinsamen Anschluss. Der Line OUT Port hat einen eigenen Anschluss. Beim Anschluss eines Geräts an einen Audio-Port wird dies vom Treiber erkannt und die Anschlüsse können vom Benutzer konfiguriert werden.


MIC, Line IN, Line OUT		
Controller	Realtek RTL888	
MIC	Anschluss eines Mono Mikrofon über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line IN	Einspeisung eines Stereo Line In Signals über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line OUT	Anschluss eines Stereo Wiedergabegerätes (z.B. Verstärker) über einen 3,5 mm Klinkenstecker.	
		3,5 mm Klinkenanschluss, female

Tabelle 39: Audio

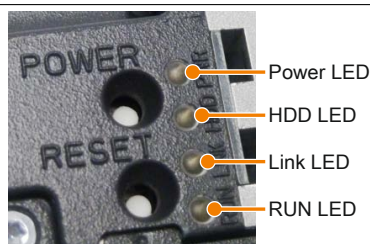
Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.4.11 Status LEDs

Die Status LEDs befinden sich von vorne betrachtet seitlich rechts des Panel PC.



Für die Status LEDs wird folgender Zeitraster verwendet:

Kästchenbreite: 250 ms

Intervall- Wiederkehr: 500 ms; 2 Kästchen entsprechen somit einem Intervall

LED	Farbe	Status	Bedeutung	LED-Anzeige
Power	Grün	Ein	Spannungsversorgung OK	
		Blinkend	Das Gerät ist hochgefahren, der Batteriestatus ist "BAD".	
		Information: Nähere Informationen siehe "Batterie" auf Seite 50.		
	Rot	Ein	Das System befindet sich im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)	
		Blinkend	Der MTCX läuft, der Batteriestatus ist "BAD". Das System befindet sich im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk).	
	Rot-Grün	Blinkend	Fehlerhafter oder unvollständiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA Update, Batteriestatus OK, Spannungsversorgung OK	
			Fehlerhafter oder unvollständiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA Update, Batteriestatus OK, Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)	
			Fehlerhafter oder unvollständiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA Update, Batteriestatus BAD, Spannungsversorgung OK	
			Fehlerhafter oder unvollständiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA Update, Batteriestatus BAD, Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)	
			Information: Ein Update ist erneut auszuführen.	
	Gelb	Ein	Spannungsversorgung nicht OK; das System läuft im USV Betrieb.	
HDD	Gelb	Ein	Signalisiert einen Laufwerkszugriff (HDD, CFast)	
Link	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Panel Stecker an.	
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.	
Run	Grün	Blinkend	Automation Runtime wird hochgefahren Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.	
		Ein	Applikation läuft Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.	
	Rot	Ein	Applikation in Service Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.	

Tabelle 40: Daten Status LEDs

2.4.12 Power Button

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstützung besitzt der Power Button verschiedenste Funktionalitäten.

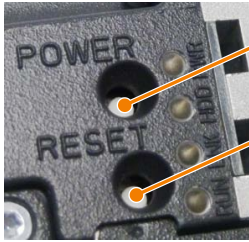
Power Button	
<p>Der Power Button kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber- spitze) betätigt werden.</p> <p>Der Power Button verhält sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit ATX Netzteil:</p> <p>kurzes Drücken ... Panel PC einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und Pa- nel PC ausschalten.</p> <p>langes Drücken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfahren den Panel PC aus (Da- tenverlust möglich!).</p> <p>Beim Drücken des Power Buttons wird der MTCX Prozessor nicht resettet.</p>	

Tabelle 41: Power Button

2.4.13 Reset Button

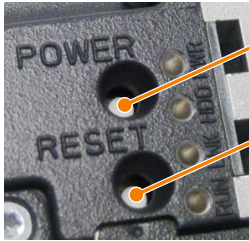
Reset Button	
<p>Der Reset-Button kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber- spitze) betätigt werden.</p> <p>Wenn der Reset Button betätigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgelöst. Der Panel PC startet neu (Kaltstart).</p> <p>Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resettet.</p>	

Tabelle 42: Reset Button

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.4.14 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) sicher und befindet sich auf der Rückseite des Panel PC. Die Batterie ist in einer Batteriehalterung montiert und kann somit sehr einfach getauscht werden.

Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens 4 Jahre (bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Ist eine SRAM Interface Option verbaut, so beträgt die Lebensdauer 2½ Jahre). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

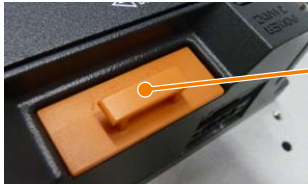
Batterie		
Batterie Typ Tauschbar Lebensdauer	Renata 950 mAh Ja, von außen zugänglich 4 Jahre ¹⁾	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 43: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced -> OEM Features -> System Board Features -> Voltage Values) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 44: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.4.15 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern über SATA 0 mit dem Chipset verbunden und in der Version SATA III (SATA 6 Gbit/s) ausgeführt.

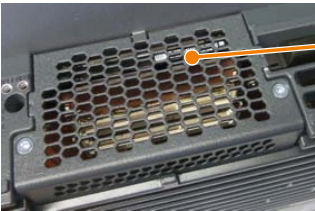
Slide-in compact Slot		
Anschluss	SATA 0	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Laufwerke	
5AC901.CHDD-01	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC901.CSSD-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC901.CSSD-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC901.CSSD-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC901.CCFA-00	CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in compact Slot	

Tabelle 45: Slide-in compact Slot

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau eines Slide-in compact Laufwerks sind dem Abschnitt "Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch" auf Seite 138 zu entnehmen.

2.4.16 Slide-in Slot

Der Slide-in Slot ist auf der Buseinheit integriert. Intern ist er über SATA 2 und USB mit dem Chipset verbunden und in der Version SATA II (SATA 3 Gbit/s) ausgeführt.


Slide-in Slot		
Anschluss	SATA 2 und USB	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Laufwerke	
5AC901.SCFA-00	CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in Slot	
5AC901.SDVW-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in	

Tabelle 46: Slide-in Slot

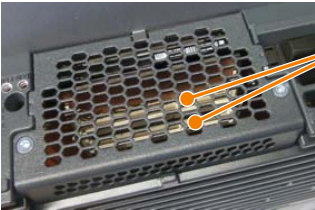
Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau eines Slide-in Laufwerks sind dem Abschnitt "Slide-in Laufwerkseinbau" auf Seite 147 zu entnehmen.

2.4.17 Hauptspeicher

Der Panel PC 900 bietet 2 Steckplätze für DDR3 Hauptspeicher.

Hauptspeicher Einschub	
Geschwindigkeit	DDR3-1600 (PC3-12800)
Bestellnummer	Kurzbeschreibung Hauptspeicher
5MMDDR.1024-03	SO-DIMM DDR3, 1024 MByte
5MMDDR.2048-03	SO-DIMM DDR3, 2048 MByte
5MMDDR.4096-03	SO-DIMM DDR3, 4096 MByte
5MMDDR.8192-03	SO-DIMM DDR3, 8192 MByte



Hauptspeicher

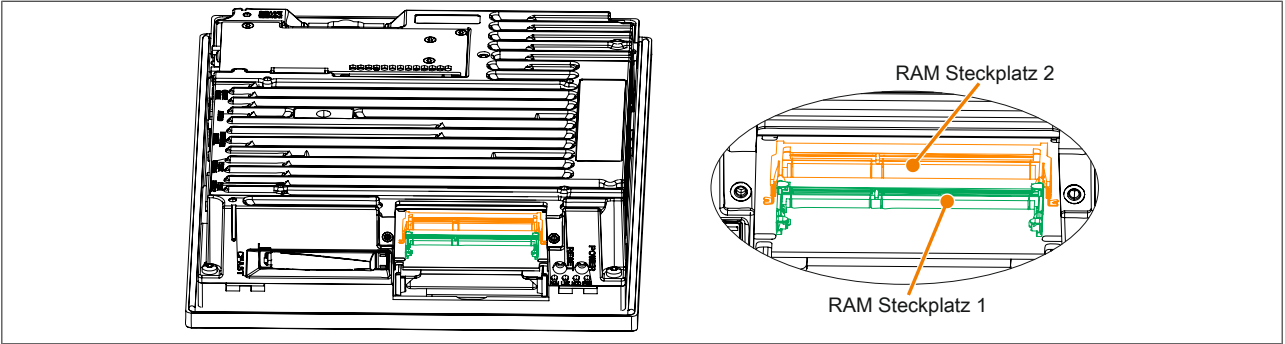
Tabelle 47: Hauptspeicher Einschub

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau eines Hauptspeichers sind dem Abschnitt "Hauptspeicher Tausch" auf Seite 132 zu entnehmen.

Vorsicht!

Wird nur ein Hauptspeicher verwendet, muss dieser im RAM Steckplatz 2 montiert werden.

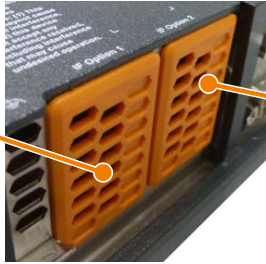


2.4.18 IF Option 1 Steckplatz

Die Panel PC Systemeinheiten besitzen 2 Steckplätze für Interface Optionen.

In folgender Tabelle sind die Interface Optionen, welche im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden können, aufgelistet.

IF Option 1 Steckplatz	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
Interface Option	
5AC901.I485-00 ¹⁾	RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910
5AC901.ICAN-00 ¹⁾²⁾	CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910
5AC901.IHDA-00	Audio Interface Option, Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT; zum Einbau in einen APC910
5AC901.IUPS-00 ³⁾	USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910; für 4,5 Ah Batterie.
5AC901.IUPS-01 ⁴⁾	USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910; für 2,2 Ah Batterie.



IF Option 1

IF Option 2

Tabelle 48: IF Option 1 Steckplatz

- 1) Beim gleichzeitigen Betrieb der IF Optionen 5AC901.I458-00 und 5AC901.ICAN-00, ist die 5AC901.ICAN-00 im IF Option 1 Steckplatz und die 5AC901.I485-00 im IF Option 2 Steckplatz zu montieren.
- 2) Der gleichzeitige Betrieb von 2 Interface Optionen 5AC901.ICAN im IF Option 1 und IF Option 2 Steckplatz ist nicht möglich.
- 3) Die USV IF Option 5AC901.IUPS-00 darf ausschließlich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 betrieben werden!
- 4) Die USV IF Option 5AC901.IUPS-01 darf ausschließlich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 betrieben werden!

Information:

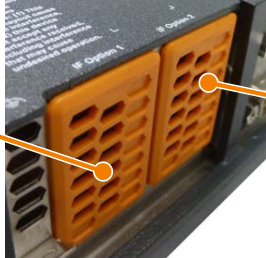
Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Interface Option sind dem Abschnitt "Montage Interface Option" auf Seite 134 zu entnehmen.

2.4.19 IF Option 2 Steckplatz

Die Panel PC Systemeinheiten besitzen 2 Steckplätze für Interface Optionen.

In folgender Tabelle sind die Interface Optionen, welche im IF Option 2 Steckplatz betrieben werden können, aufgelistet.

IF Option 2 Steckplatz	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
Interface Option	
5AC901.I485-00 ¹⁾	RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910
5AC901.ICAN-00 ¹⁾²⁾	CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910
5AC901.ISRM-00	SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910



IF Option 1

IF Option 2

Tabelle 49: IF Option 2 Steckplatz

- 1) Beim gleichzeitigen Betrieb der IF Optionen 5AC901.I458-00 und 5AC901.ICAN-00, ist die 5AC901.ICAN-00 im IF Option 1 Steckplatz und die 5AC901.I485-00 im IF Option 2 Steckplatz zu montieren.
- 2) Der gleichzeitige Betrieb von 2 Interface Optionen 5AC901.ICAN im IF Option 1 und IF Option 2 Steckplatz ist nicht möglich.

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Interface Option sind dem Abschnitt "Montage Interface Option" auf Seite 134 zu entnehmen.

2.4.20 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)

Ist am Panel PC 900 eine Buseinheit montiert, können je nach Variante der Buseinheit Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCIe) half-size Karten gesteckt werden. Diese dürfen die nachfolgenden Abmessungen nicht überschreiten.

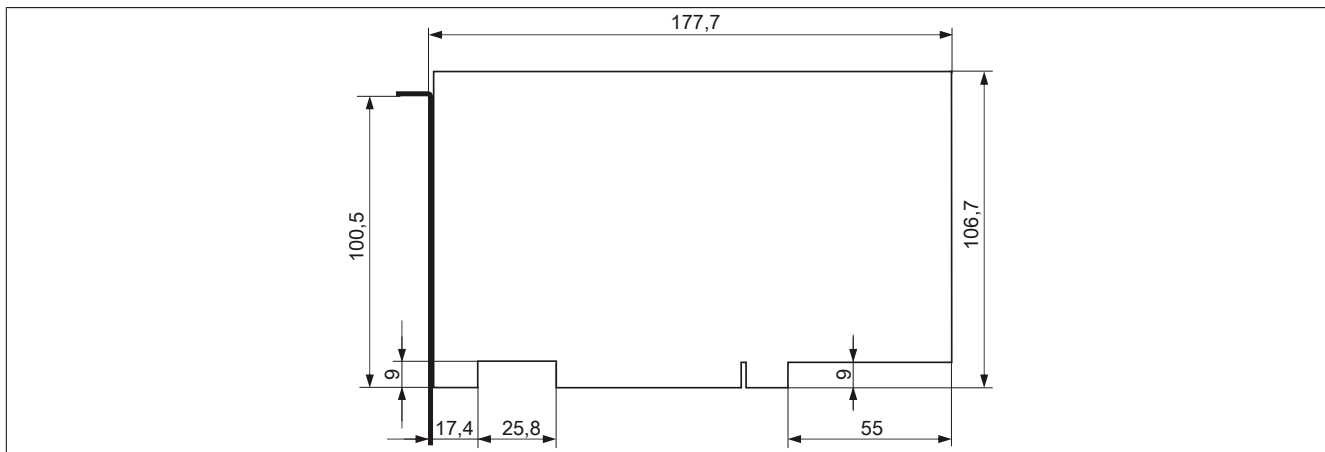


Abbildung 15: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte

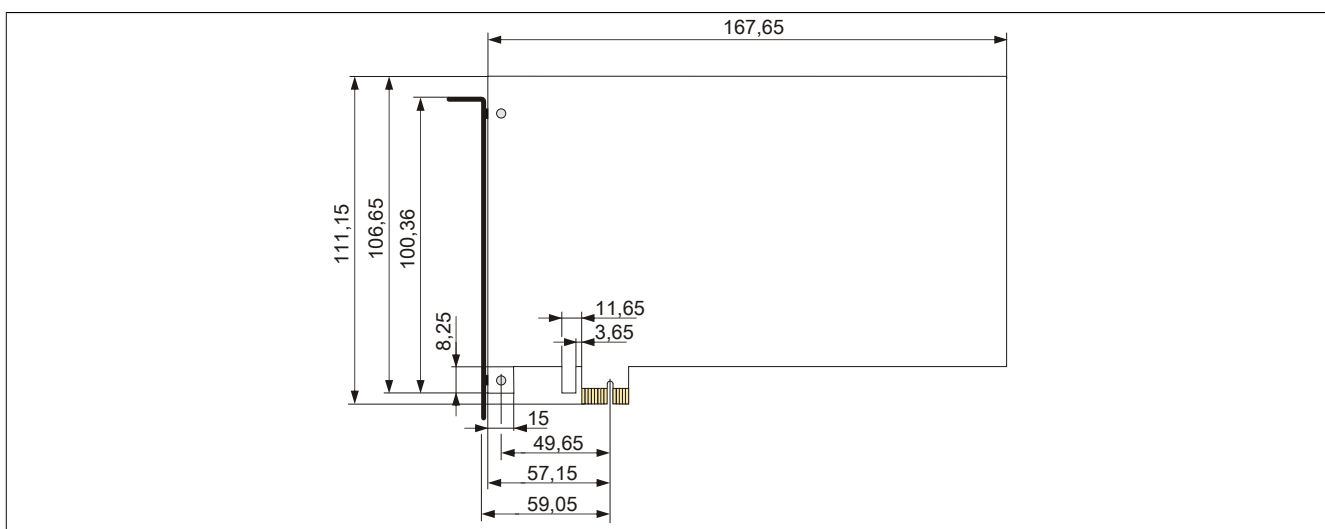


Abbildung 16: Abmessungen Standard half-size PCIe Karte

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer PCI / PCIe Karte sind dem Abschnitt "PCI / PCIe Karten Montage" auf Seite 144 zu entnehmen.

3 Einzelkomponenten

3.1 Displayeinheiten

3.1.1 5AP923.1215-00

3.1.1.1 Allgemeines

- Displayeinheit für AP9x3 oder PPC900
- 12" TFT XGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Schwarze Aluminium- Front
- Schutzart IP65 (frontseitig)

3.1.1.2 Bestelldaten

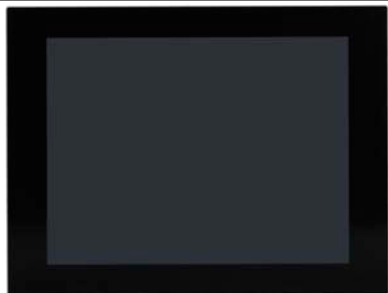
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Displayeinheiten	
5AP923.1215-00	Automation Panel 12,1" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	

Tabelle 50: 5AP923.1215-00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AP923.1215-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
Display	
Typ	TFT Farbe
Diagonale	12,1"
Farben	16,2 Mio.
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	500 cd/m ²
Half Brightness Time ²⁾	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Typ	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Trägersrahmen	Aluminium, lackiert
Design	schwarz
Dichtung	3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen	
Breite	315 mm
Höhe	239 mm
Gewicht	2200 g

Tabelle 51: 5AP923.1215-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%igen Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

3.1.1.4 Abmessungen

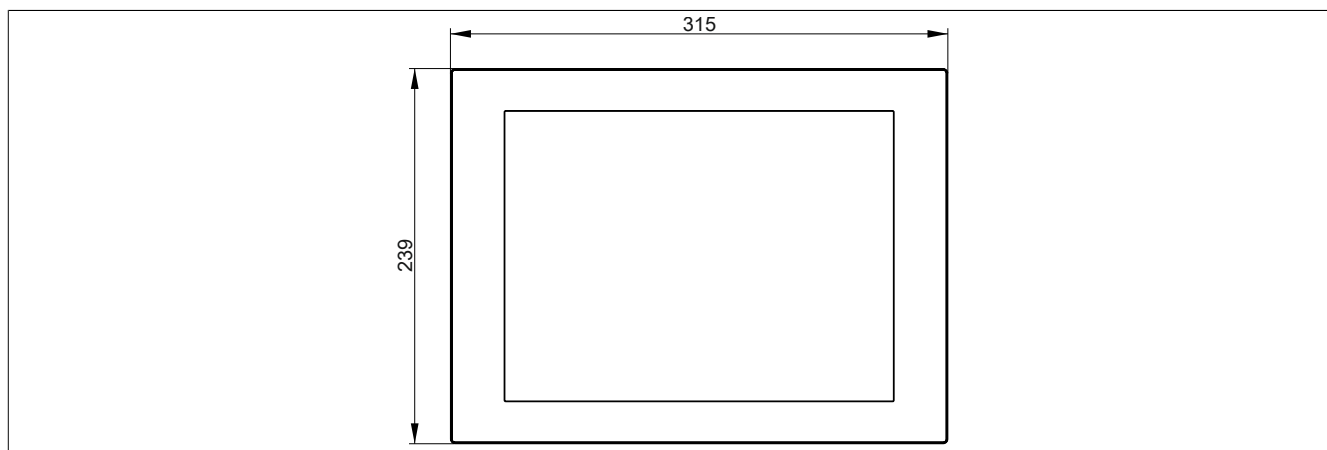


Abbildung 17: 5AP23.1215-00 - Abmessungen

3.1.1.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

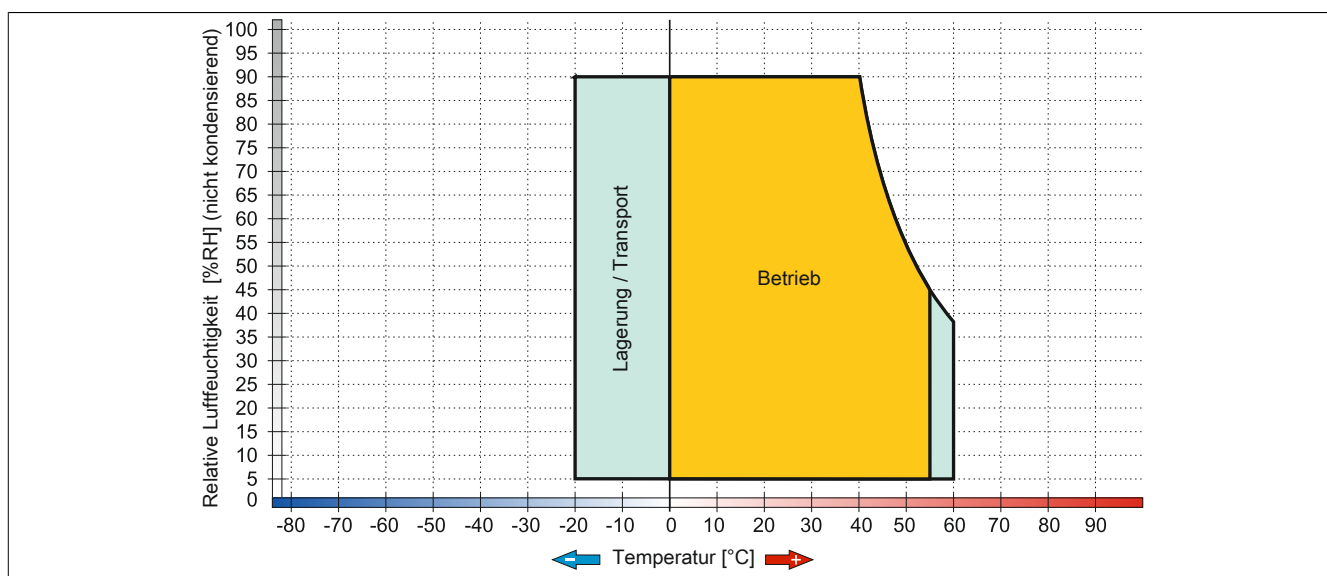


Abbildung 18: 5AP923.1215-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.1.2 5AP923.1505-00

3.1.2.1 Allgemeines

- Displayeinheit für AP9x3 oder PPC900
- 15" TFT XGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Schwarze Aluminium- Front
- Schutzart IP65 (frontseitig)

3.1.2.2 Bestelldaten

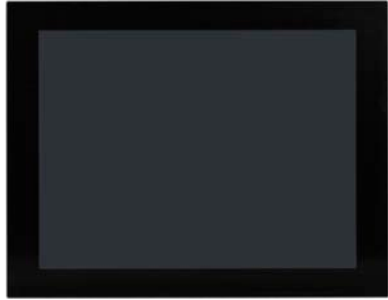
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Displayeinheiten	
5AP923.1505-00	Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	

Tabelle 52: 5AP923.1505-00 - Bestelldaten

3.1.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AP923.1505-00
Allgemeines	
Zertifizierungen GOST-R	Ja
Display	
Typ	TFT Farbe
Diagonale	15"
Farben	16,2 Mio.
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel horizontal vertikal	Richtung R / Richtung L = 80° Richtung U / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung Art Helligkeit Half Brightness Time ¹⁾	LED 350 cd/m² 50.000 h
Touch Screen ²⁾ Typ Technologie Controller Transmissionsgrad	AMT analog, resistiv B&R, seriell, 12 Bit 81% ±3%
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägersrahmen Design Dichtung	Aluminium, lackiert schwarz 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen Breite Höhe	370 mm 288 mm
Gewicht	3700 g

Tabelle 53: 5AP923.1505-00 - Technische Daten

- 1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%igen Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
 2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

3.1.2.4 Abmessungen

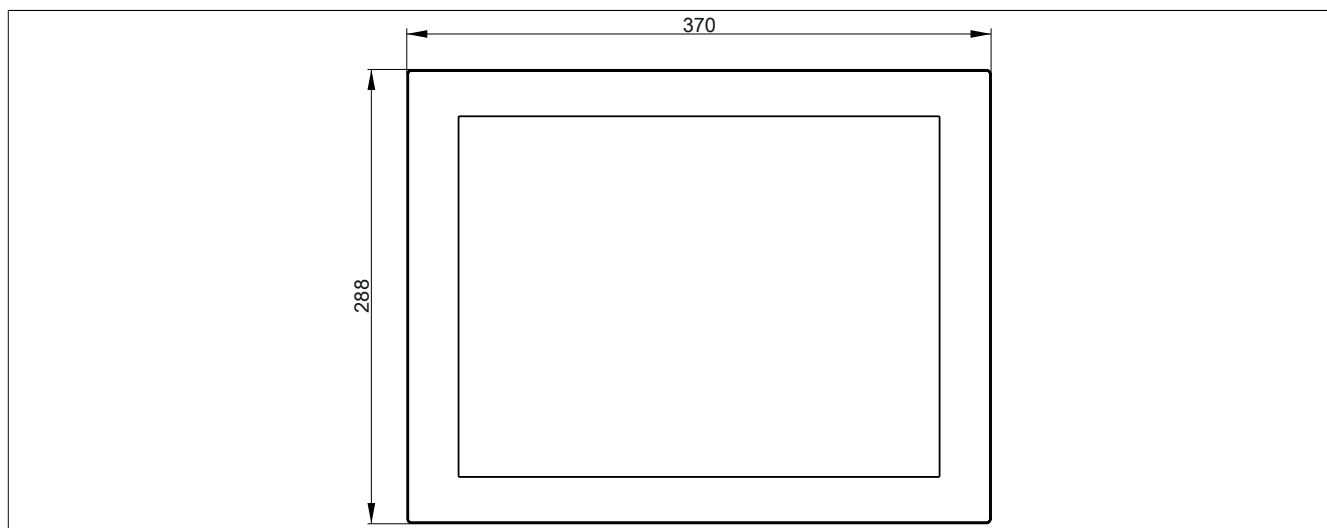


Abbildung 19: 5AP23.1505-00 - Abmessungen

3.1.2.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

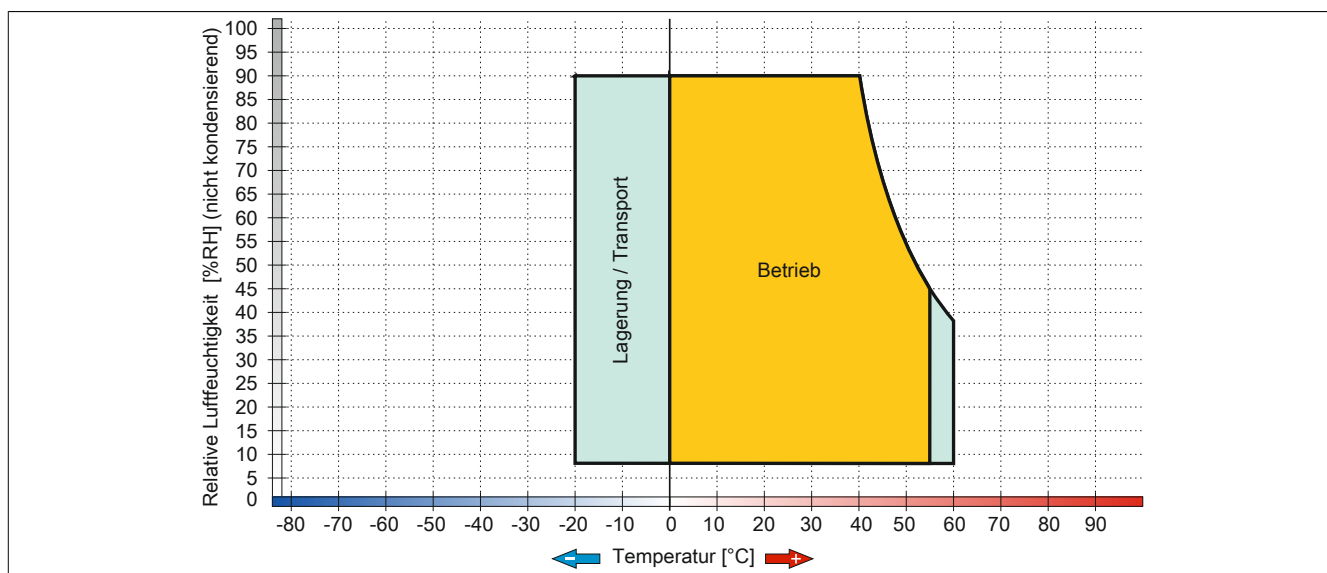


Abbildung 20: 5AP923.1505-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.1.3 5AP923.1906-00

3.1.3.1 Allgemeines

- Displayeinheit für AP9x3 oder PPC900
- 19" TFT SXGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Schwarze Aluminium- Front
- Schutzart IP65 (frontseitig)

3.1.3.2 Bestelldaten

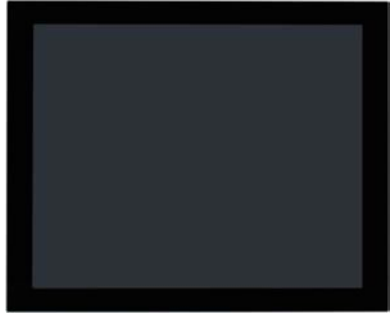
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Displayeinheiten	
5AP923.1906-00	Automation Panel 19,0" SXGA TFT - 1280 x 1024 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	

Tabelle 54: 5AP923.1906-00 - Bestelldaten

3.1.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AP923.1906-00
Display	
Typ	TFT Farbe
Diagonale	19"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	SXGA, 1280×1024 Bildpunkte
Kontrast	2000:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 89°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	300 cd/m²
Half Brightness Time ¹⁾	50.000 h
Touch Screen ²⁾	
Typ	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	81% ±3%
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Trägersrahmen	Aluminium, lackiert
Design	schwarz
Dichtung	3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen	
Breite	440 mm
Höhe	358 mm
Gewicht	5800 g

Tabelle 55: 5AP923.1906-00 - Technische Daten

- 1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%igen Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
 2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

3.1.3.4 Abmessungen

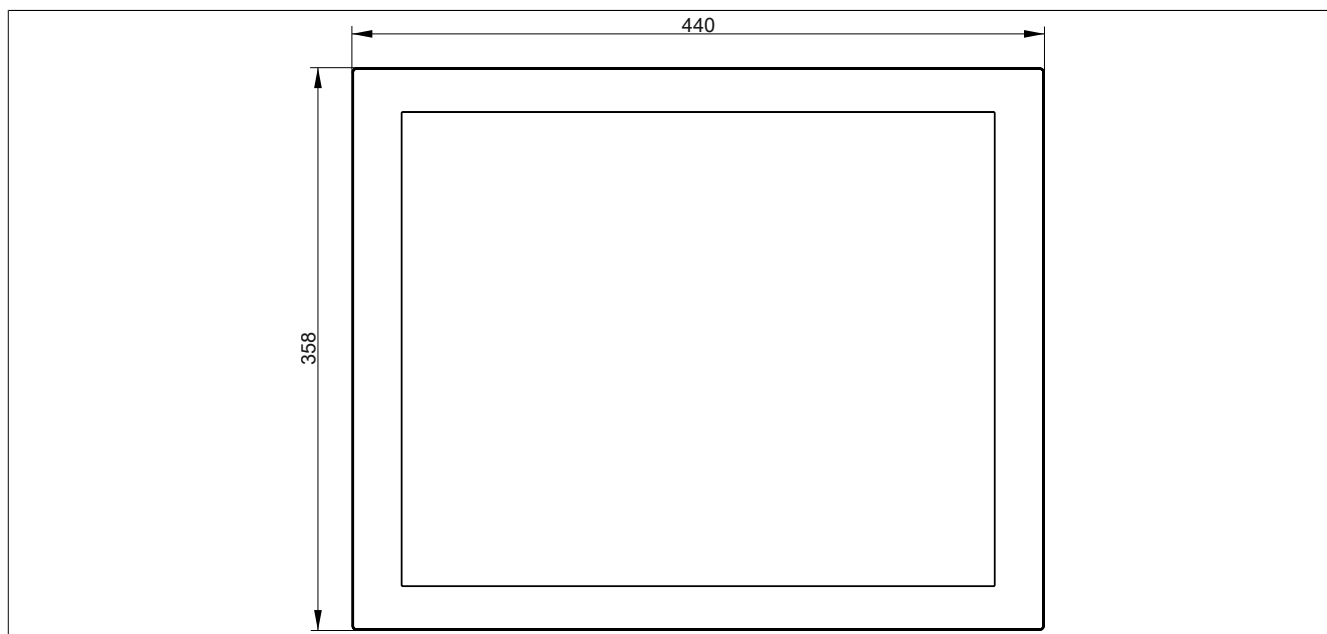


Abbildung 21: 5AP23.1906-00 - Abmessungen

3.1.3.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

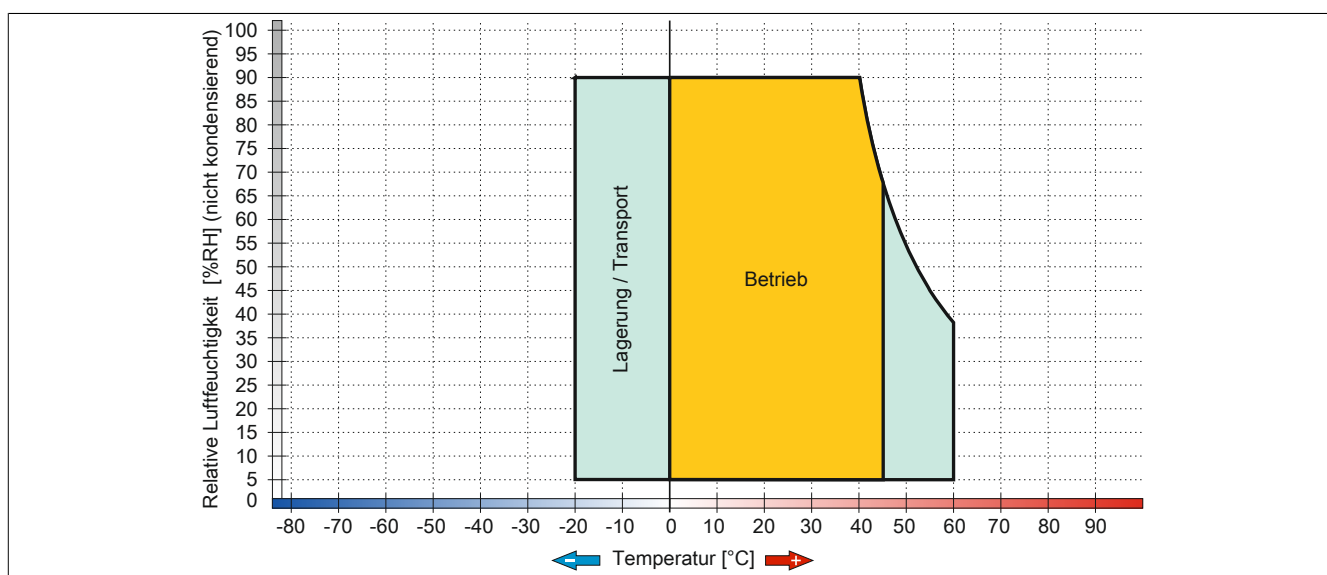


Abbildung 22: 5AP923.1906-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.1.4 5AP933.156B-00

3.1.4.1 Allgemeines

- Displayeinheit für AP9x3 oder PPC900
- 15,6" TFT HD color Display
- Multitouch (PCT)
- Schwarze Aluminium- Front
- Schutzart IP65 (frontseitig)

3.1.4.2 Bestelldaten

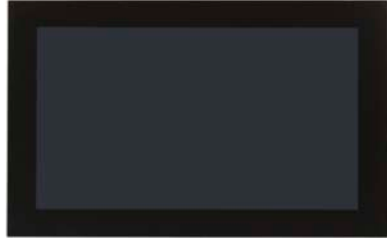
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Displayeinheiten	
5AP933.156B-00	Automation Panel 15,6" HD TFT - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	

Tabelle 56: 5AP933.156B-00 - Bestelldaten

3.1.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AP933.156B-00
Allgemeines	
Zertifizierungen GOST-R	Ja
Display	
Typ	TFT Farbe
Diagonale	15,6"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	HD, 1366×768 Bildpunkte
Kontrast	500:1
Blickwinkel horizontal vertikal	Richtung R / Richtung L = 85° Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung Art Helligkeit Half Brightness Time ¹⁾	LED 300 cd/m² 50.000 h
Touch Screen ²⁾ Typ Technologie Controller Transmissionsgrad	3M Projected Capacitive Touch (PCT) 3M 88% ±2%
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägerahmen Design Dichtung	Aluminium, lackiert schwarz 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen Breite Höhe	414 mm 258,5 mm
Gewicht	3850 g

Tabelle 57: 5AP933.156B-00 - Technische Daten

1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%igen Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

3.1.4.4 Abmessungen

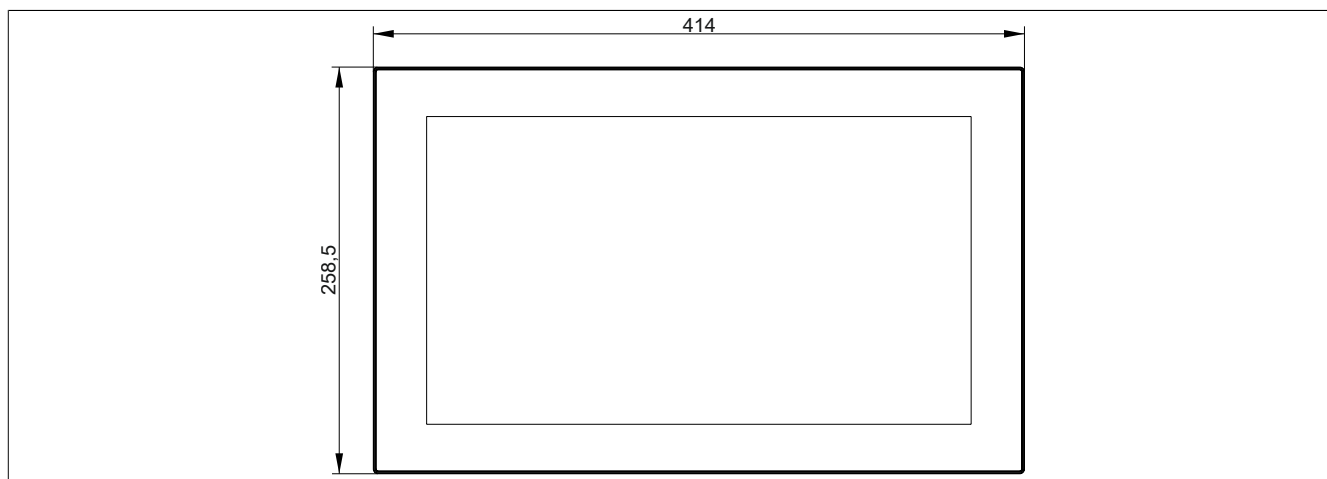


Abbildung 23: 5AP933.156B-00 - Abmessungen

3.1.4.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

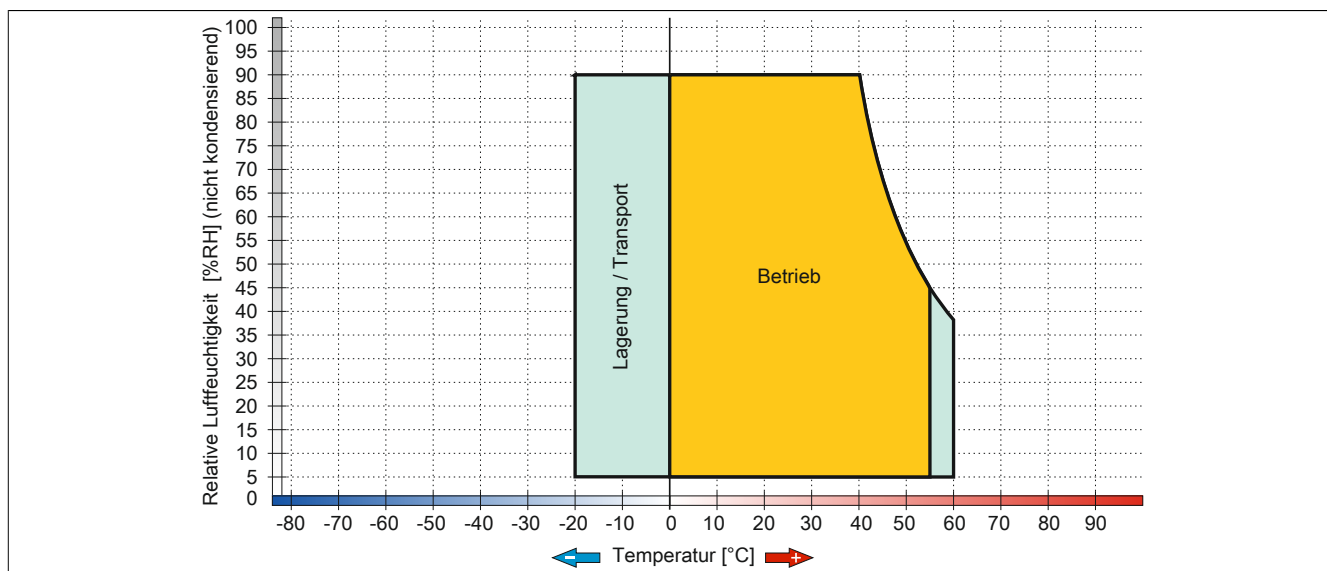


Abbildung 24: 5AP933.156B-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.1.5 5AP933.185B-00

3.1.5.1 Allgemeines

- Displayeinheit für AP9x3 oder PPC900
- 18,5" TFT HD color Display
- Multitouch (PCT)
- Schwarze Aluminium- Front
- Schutzart IP65 (frontseitig)

3.1.5.2 Bestelldaten

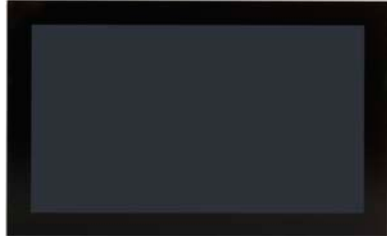
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Displayeinheiten	
5AP933.185B-00	Automation Panel 18,5" HD TFT - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	

Tabelle 58: 5AP933.185B-00 - Bestelldaten

3.1.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AP933.185B-00
Allgemeines	
Zertifizierungen GOST-R	Ja
Display	
Typ	TFT Farbe
Diagonale	18,5"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	HD, 1366×768 Bildpunkte
Kontrast	1000:1
Blickwinkel horizontal vertikal	Richtung R / Richtung L = 170° Richtung U / Richtung D = 160°
Hintergrundbeleuchtung Art Helligkeit Half Brightness Time ¹⁾	LED 300 cd/m ² 50.000 h
Touch Screen ²⁾ Typ Technologie Controller Transmissionsgrad	3M Projected Capacitive Touch (PCT) 3M 88% ±2%
Mechanische Eigenschaften	
Front Träggerahmen Design Dichtung	Aluminium, lackiert schwarz 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen Breite Höhe	475 mm 295 mm
Gewicht	4850 g

Tabelle 59: 5AP933.185B-00 - Technische Daten

1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%igen Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

3.1.5.4 Abmessungen

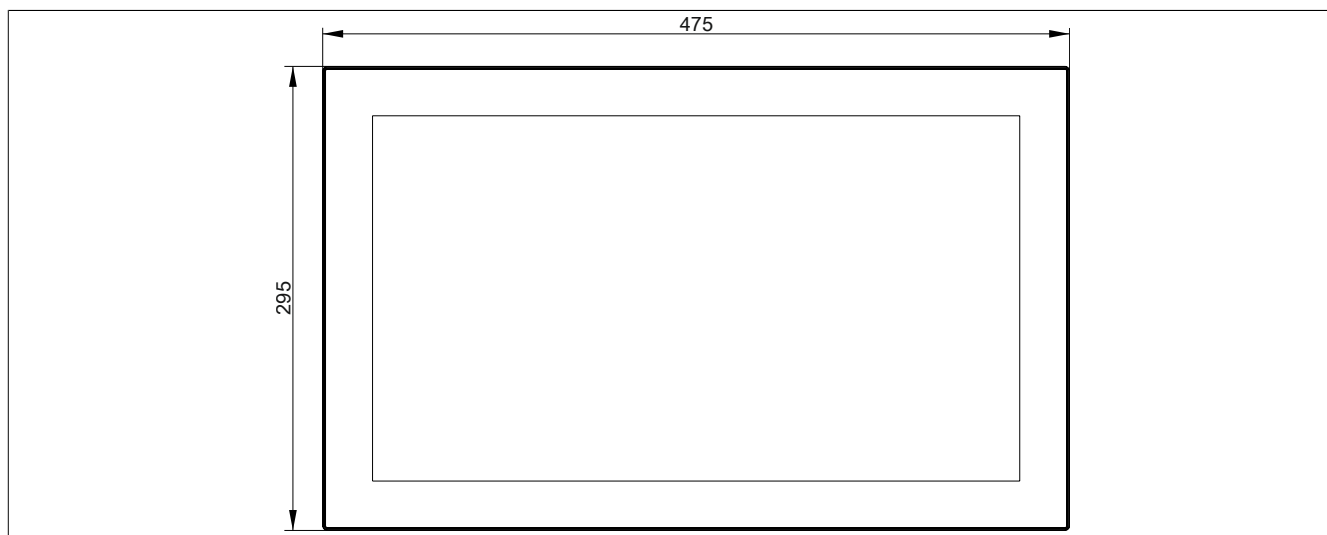


Abbildung 25: 5AP933.185B-00 - Abmessungen

3.1.5.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

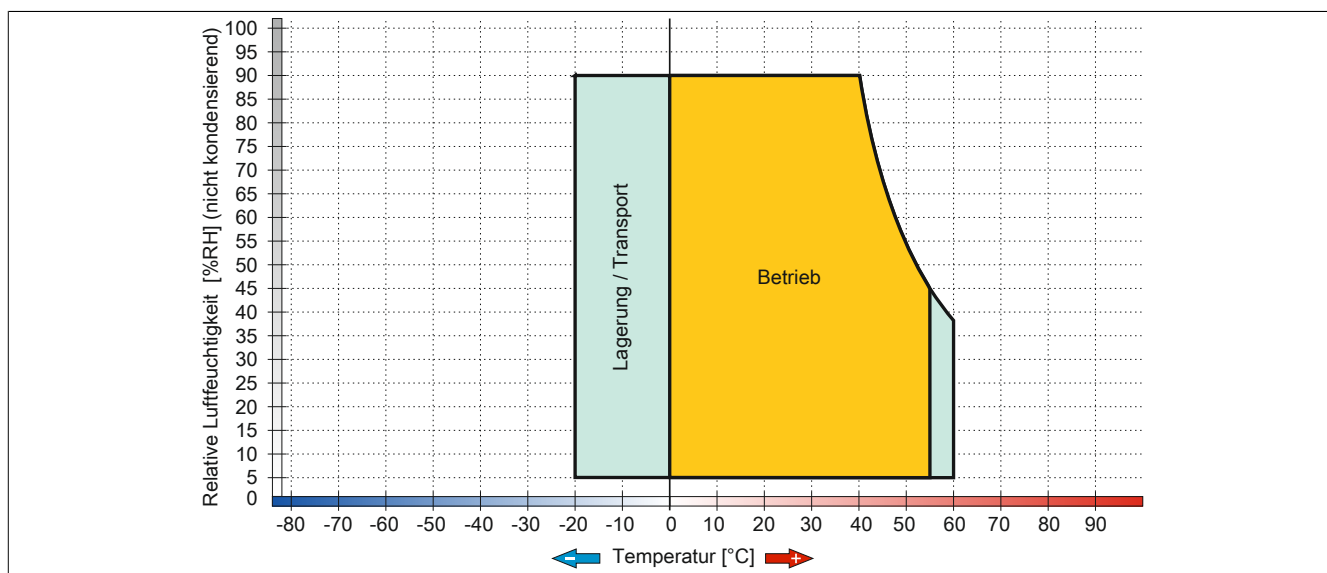


Abbildung 26: 5AP933.185B-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.1.6 5AP933.215C-00

3.1.6.1 Allgemeines

- Displayeinheit für AP9x3 oder PPC900
- 21,5" TFT FHD color Display
- Multitouch (PCT)
- Schwarze Aluminium- Front
- Schutzart IP65 (frontseitig)

3.1.6.2 Bestelldaten

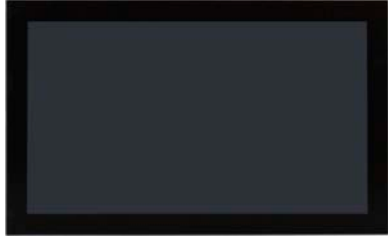
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Displayeinheiten	
5AP933.215C-00	Automation Panel 21,5" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	

Tabelle 60: 5AP933.215C-00 - Bestelldaten

3.1.6.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AP933.215C-00
Allgemeines	
Zertifizierungen GOST-R	Ja
Display	
Typ	TFT Farbe
Diagonale	21,46"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	FHD, 1920×1080 Bildpunkte
Kontrast	1000:1
Blickwinkel horizontal vertikal	Richtung R / Richtung L = 178° Richtung U / Richtung D = 178°
Hintergrundbeleuchtung Art Helligkeit Half Brightness Time ¹⁾	LED 250 cd/m² 30.000 h
Touch Screen ²⁾ Typ Technologie Controller Transmissionsgrad	3M Projected Capacitive Touch (PCT) 3M 88% ±2%
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägerahmen Design Dichtung	Aluminium, lackiert schwarz 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen Breite Höhe	541,5 mm 333 mm
Gewicht	5400 g

Tabelle 61: 5AP933.215C-00 - Technische Daten

- 1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%igen Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
 2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

3.1.6.4 Abmessungen

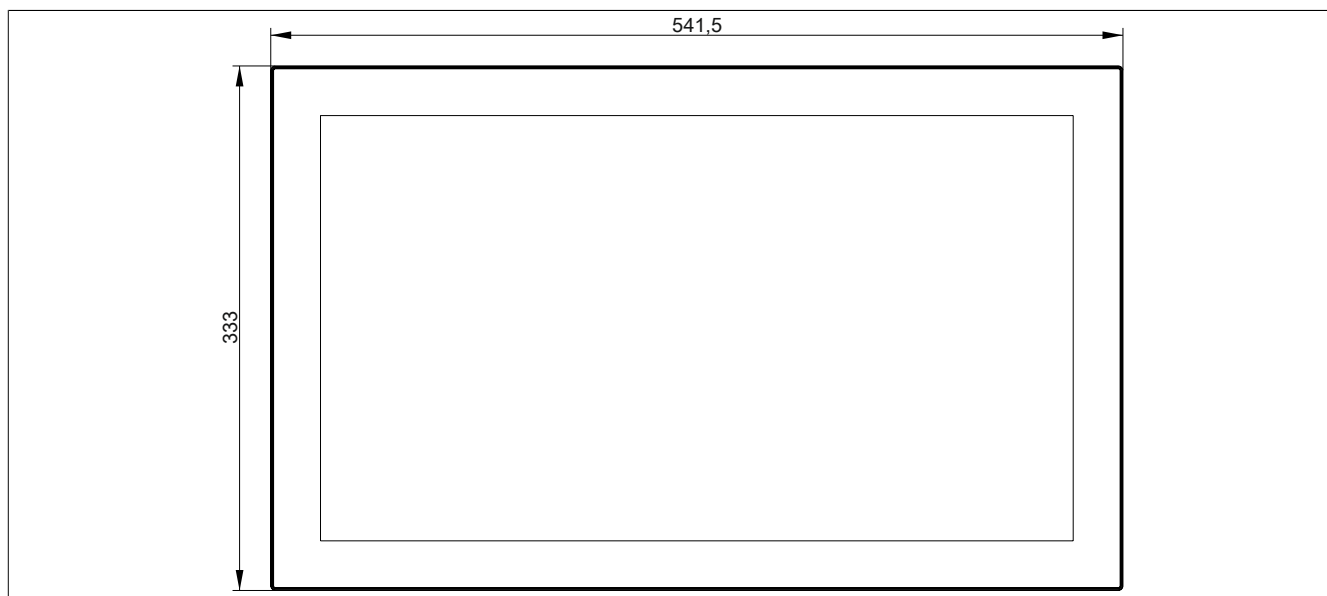


Abbildung 27: 5AP933.215C-00 - Abmessungen

3.1.6.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

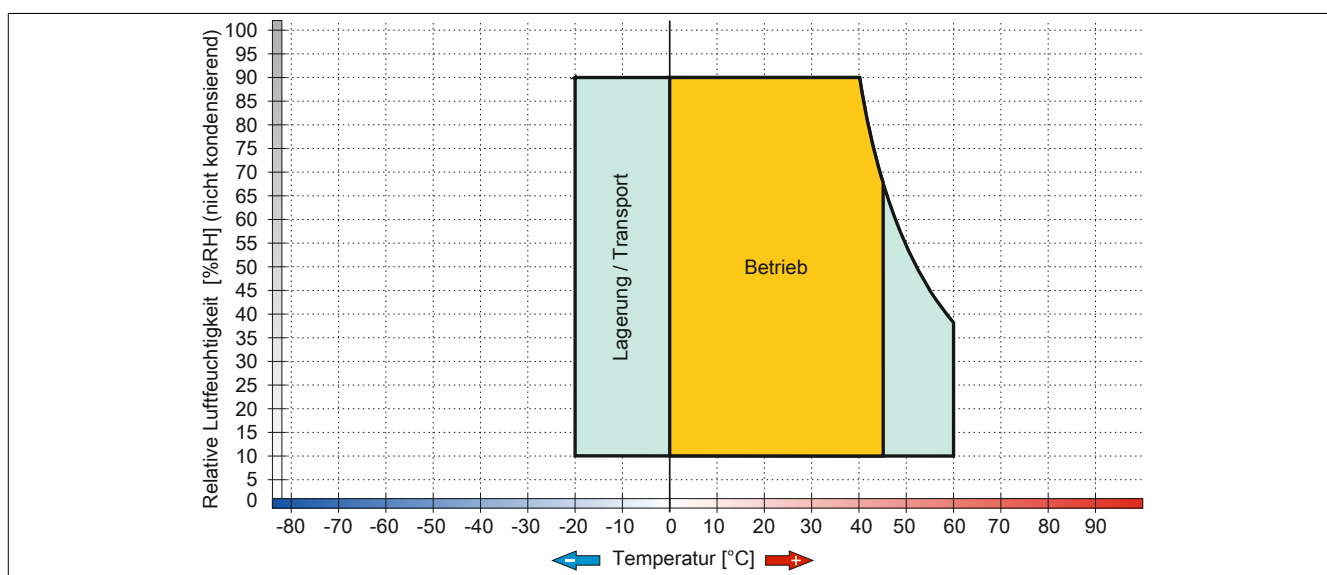


Abbildung 28: 5AP933.215C-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.1.7 5AP933.240C-00

3.1.7.1 Allgemeines

- Displayeinheit für AP9x3 oder PPC900
- 24" TFT FHD color Display
- Multitouch (PCT)
- Schwarze Aluminium- Front
- Schutzart IP65 (frontseitig)

3.1.7.2 Bestelldaten

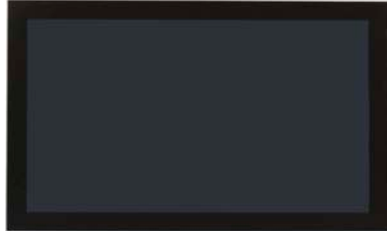
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Displayeinheiten	
5AP933.240C-00	Automation Panel 24,0" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schutzart IP65 (frontseitig)	

Tabelle 62: 5AP933.240C-00 - Bestelldaten

3.1.7.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AP933.240C-00
Display	
Typ	TFT Farbe
Diagonale	24,0"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	FHD, 1920×1080 Bildpunkte
Kontrast	5000:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 89°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	300 cd/m²
Half Brightness Time ¹⁾	50.000 h
Touch Screen ²⁾	
Typ	3M
Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT)
Controller	3M
Transmissionsgrad	88% ±2%
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Trägerahmen	Aluminium, lackiert
Design	schwarz
Dichtung	3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen	
Breite	598,5 mm
Höhe	364 mm
Gewicht	ca. 7800 g

Tabelle 63: 5AP933.240C-00 - Technische Daten

1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%igen Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

3.1.7.4 Abmessungen

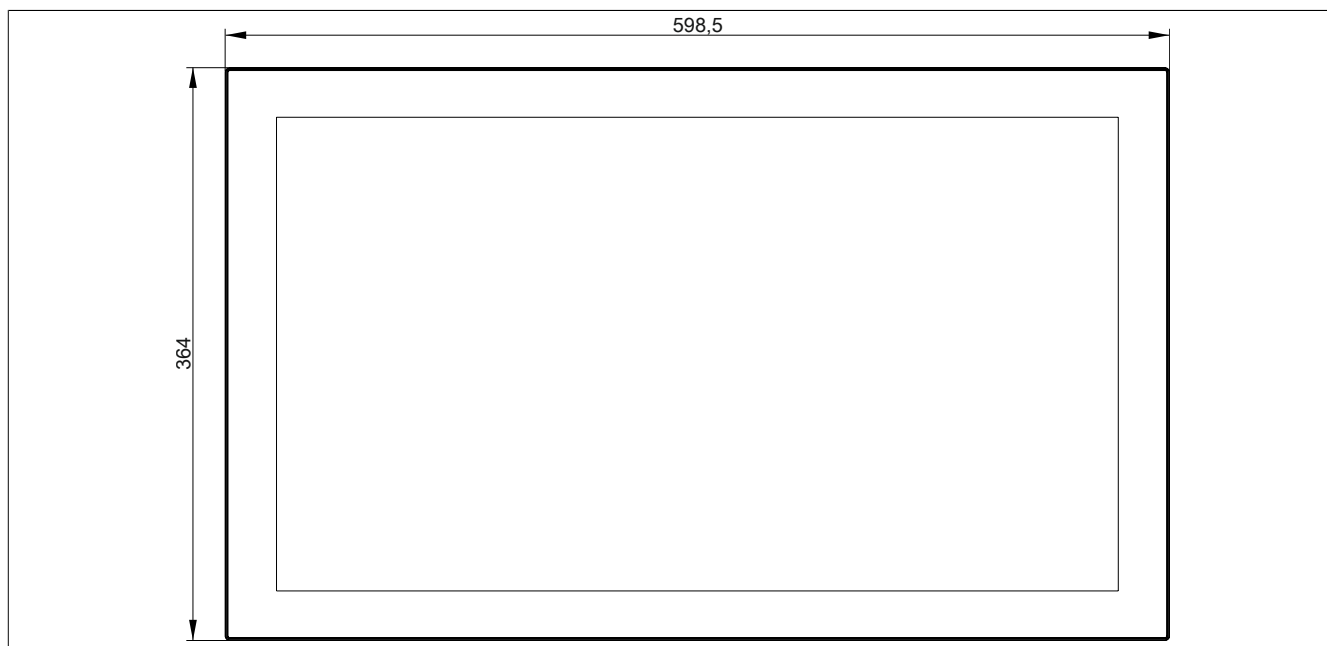


Abbildung 29: 5AP933.240C-00 - Abmessungen

3.1.7.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

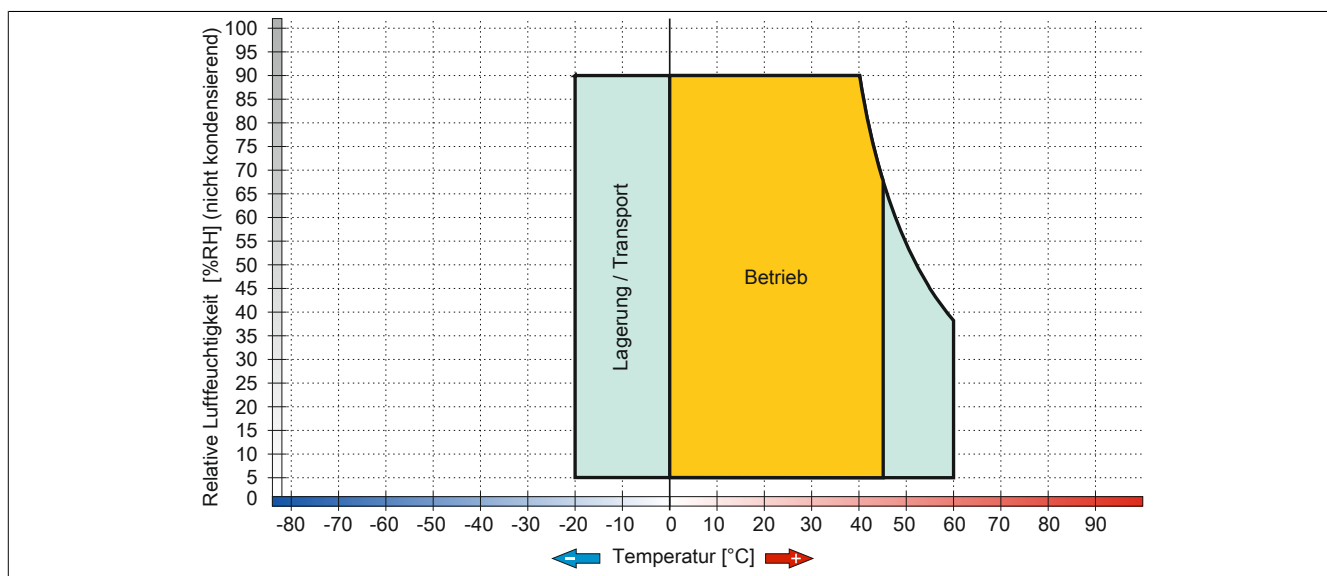


Abbildung 30: 5AP933.240C-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.2 CPU Boards QM77

3.2.1 5PC901.TS77-0x

3.2.1.1 Allgemeines

- Intel® Core™ i Prozessoren
- Intel® QM77 Chipsatz
- 2x DDR3 Speichersockel
- Intel® HD Graphics 4000
- AMI BIOS (UEFI)

Information:

Bei Verwendung des 5PC901.TS77-00 CPU Boards ist der Betrieb ausschließlich mit der Systemeinheit mit Lüfter Kit (aktiv, 5PC911.SX00-00) möglich.

3.2.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PC901.TS77-00	CPU Board Intel Core i7 3615QE 2,3 GHz - Quad Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-01	CPU Board Intel Core i7 3612QE 2,1 GHz - Quad Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-02	CPU Board Intel Core i7 3555LE 2,5 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-03	CPU Board Intel Core i7 3517UE 1,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-04	CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-05	CPU Board Intel Core i3 3120ME 2,4 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-06	CPU Board Intel Core i3 3217UE 1,6 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.1024-03	SO-DIMM DDR3, 1024 MByte	
5MMDDR.2048-03	SO-DIMM DDR3, 2048 MByte	
5MMDDR.4096-03	SO-DIMM DDR3, 4096 MByte	
5MMDDR.8192-03	SO-DIMM DDR3, 8192 MByte	

Tabelle 64: 5PC901.TS77-00, 5PC901.TS77-01, 5PC901.TS77-02, 5PC901.TS77-03, 5PC901.TS77-04, 5PC901.TS77-05, 5PC901.TS77-06 - Bestelldaten

3.2.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC901. TS77-00	5PC901. TS77-01	5PC901. TS77-02	5PC901. TS77-03	5PC901. TS77-04	5PC901. TS77-05	5PC901. TS77-06
Allgemeines							
Kühlung	Passiv über Kühlkörper						
LEDs	Power, HDD, Link, Run						
B&R ID-Code	\$DF8A	\$DF8B	\$DF8C	\$DF8D	\$DF8E	\$DF8F	\$DF90
Batterie	Renata 950 mAh 4 Jahre ¹⁾ Ja, auf der Rückseite des Panel PC Lithium Ionen						
Typ							
Lebensdauer							
tauschbar							
Ausführung							
Power-Taster	Ja						
Reset-Taster	Ja						
Summer	Ja						
Zertifizierungen	Ja Ja Ja ²⁾ Ja						
CE							
cULus							
cULus HazLoc Class 1 Division 2							
GOST-R							
Controller							
Boot-Loader	BIOS						

Tabelle 65: 5PC901.TS77-00, 5PC901.TS77-01, 5PC901.TS77-02, 5PC901.TS77-03, 5PC901.TS77-04, 5PC901.TS77-05, 5PC901.TS77-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC901. TS77-00	5PC901. TS77-01	5PC901. TS77-02	5PC901. TS77-03	5PC901. TS77-04	5PC901. TS77-05	5PC901. TS77-06
Prozessor							
Typ	Intel® Core™ i7-3615QE	Intel® Core™ i7-3612QE	Intel® Core™ i7-3555LE	Intel® Core™ i7-3517UE	Intel® Core™ i5-3610ME	Intel® Core™ i3-3120ME	Intel® Core™ i3-3217UE
Taktfrequenz	2300 MHz	2100 MHz	2500 MHz	1700 MHz	2700 MHz	2400 MHz	1600 MHz
Anzahl der Kerne	4	4	2	2	2	2	2
Architektur				22 nm			
Intel® Smart Cache	6 MByte	6 MByte	4 MByte	4 MByte	3 MByte	3 MByte	3 MByte
Externer Bus				DMI, 5 GT/s			
Intel® 64 Architecture				Ja			
Intel® Turbo Boost Technology	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	Nein	Nein
Intel® Hyper-Threading Technology				Ja			
Intel® Virtualization Technology (VT-x)				Ja			
Enhanced Intel SpeedStep® Tech- nology				Ja			
Chipsatz	Intel® QM77						
Echtzeituhr							
Genauigkeit	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag ³⁾						
batteriegepuffert	Ja						
Power Fail Logik							
Controller	MTCX ⁴⁾						
Pufferzeit	10 ms						
Speichersockel							
Anzahl der Speicherkanäle	2						
Typ	DDR3						
Größe	max. 16 GByte						
max. Speicherbandbreite	25,6 GByte/s						
Grafik							
Controller	Intel® HD Graphics 4000						
max. dynamische Grafikfrequenz	900 MHz						
Farbtiefe	max. 32 Bit						
Auflösung							
DVI	Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)						
RGB	350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)						
Massenspeicherverwaltung	3x SATA						
Power Management	ACPI 4.0 mit Batterie Support						
Schnittstellen							
COM1							
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt						
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker						
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO						
max. Baudrate	115 kBit/s						
COM2							
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt						
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker						
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO						
max. Baudrate	115 kBit/s						
CFast Slot							
Anzahl	1						
Typ	SATA III (SATA 6 Gbit/s)						
USB							
Anzahl	4						
Typ	USB 3.0 (unterseitig)						
Ausführung	Typ A						
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s) ⁵⁾						
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A						
Ethernet							
Anzahl	2						
Ausführung	geschirmter RJ45 Port						
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s						
max. Baudrate	1 GBit/s						
Panel / Monitor Schnittstelle							
Ausführung	DVI-I Buchse						
Typ	SDL/DVI/Monitor						
Audio							
Typ	HDA						
Controller	Realtek RTL888						
Eingänge	Mikrofon, Line In						
Ausgänge	Line Out						
Einschübe							
Slide-in compact Laufwerke							
Anzahl	1						
Typ	SATA III (SATA 6 Gbit/s)						
Interface Option	2						

Tabelle 65: 5PC901.TS77-00, 5PC901.TS77-01, 5PC901.TS77-02, 5PC901.TS77-03,
5PC901.TS77-04, 5PC901.TS77-05, 5PC901.TS77-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC901. TS77-00	5PC901. TS77-01	5PC901. TS77-02	5PC901. TS77-03	5PC901. TS77-04	5PC901. TS77-05	5PC901. TS77-06
Add-on USV Steckplatz	Ja ⁶⁾						
Einschub für Lüfter Kit	Ja						
Elektrische Eigenschaften							
Nennspannung	24 VDC ±25%						
Nennstrom	5,5 A						
Einschaltstrom	max. 60 A für < 300 µs						
Galvanische Trennung	Ja						
Umgebungsbedingungen							
Meereshöhe Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁷⁾						
Mechanische Eigenschaften							
Gewicht	ca. 450 g						

Tabelle 65: 5PC901.TS77-00, 5PC901.TS77-01, 5PC901.TS77-02, 5PC901.TS77-03,
5PC901.TS77-04, 5PC901.TS77-05, 5PC901.TS77-06 - Technische Daten

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist eine SRAM Interface Option verbaut, so beträgt die Lebensdauer 2½ Jahre.
- 2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 3) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).
- 4) Maintenance Controller Extended
- 5) Eine Super Speed Übertragungsrate (5 GBit/s) ist nur mit USB 3.0 möglich.
- 6) Das USV Modul kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.
- 7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

3.3 CPU Boards HM76

3.3.1 5PC901.TS77-0x

3.3.1.1 Allgemeines

- Intel® Celeron® Prozessoren
- Intel® HM76 Chipsatz
- 2x DDR3 Speichersockel
- Intel® HD Graphics 2000 / 2500
- AMI BIOS (UEFI)

3.3.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	<div>Abbildung</div> 
	CPU Boards	
5PC901.TS77-07	CPU Board Intel Celeron 847E 1,1 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-08	CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-09	CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-10	CPU Board Intel Celeron 1047UE 1,4 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.1024-03	SO-DIMM DDR3, 1024 MByte	
5MMDDR.2048-03	SO-DIMM DDR3, 2048 MByte	
5MMDDR.4096-03	SO-DIMM DDR3, 4096 MByte	
5MMDDR.8192-03	SO-DIMM DDR3, 8192 MByte	

Tabelle 66: 5PC901.TS77-07, 5PC901.TS77-08, 5PC901.TS77-09, 5PC901.TS77-10 - Bestelldaten

3.3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC901.TS77-07	5PC901.TS77-08	5PC901.TS77-09	5PC901.TS77-10
Allgemeines				
Kühlung	Passiv über Kühlkörper			
LEDs	Power, HDD, Link, Run			
B&R ID-Code	\$DFCD	\$DFCE	\$E18E	\$E1AD
Batterie	Renata 950 mAh 4 Jahre ¹⁾ Ja, auf der Rückseite des Panel PC Lithium Ionen			
Typ				
Lebensdauer				
tauschbar				
Ausführung				
Power-Taster	Ja			
Reset-Taster	Ja			
Summer	Ja			
Zertifizierungen	Ja Ja Ja ²⁾ Ja			
CE				
cULus				
cULus HazLoc Class 1 Division 2				
GOST-R				
Controller				
Boot-Loader	BIOS			
Prozessor				
Typ	Intel® Celeron® 847E	Intel® Celeron® 827E	Intel® Celeron® 1020E	Intel® Celeron® 1047UE
Taktfrequenz	1100 MHz	1400 MHz	2200 MHz	1400 MHz
Anzahl der Kerne	2	1	2	2
Architektur	32 nm	32 nm	22 nm	22 nm
Intel® Smart Cache	2 MByte	1,5 MByte	2 MByte	2 MByte
Externer Bus	DMI, 5 GT/s			
Intel® 64 Architecture	Ja			
Intel® Turbo Boost Technology	Nein			
Intel® Hyper-Threading Technology	Nein			
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja			
Enhanced Intel SpeedStep® Technology	Ja			
Chipsatz	Intel® HM76			

Tabelle 67: 5PC901.TS77-07, 5PC901.TS77-08, 5PC901.TS77-09, 5PC901.TS77-10 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC901.TS77-07	5PC901.TS77-08	5PC901.TS77-09	5PC901.TS77-10
Echtzeituhr Genauigkeit batteriegepuffert	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag ³⁾ Ja			
Power Fail Logik Controller Pufferzeit	MTCX ⁴⁾ 10 ms			
Speichersockel Anzahl der Speicherkanäle Typ Größe max. Speicherbandbreite	2 DDR3 max. 16 GByte 21,3 GByte/s 21,3 GByte/s 25,6 GByte/s 25,6 GByte/s			
Grafik Controller max. dynamische Grafikfrequenz Farbtiefe Auflösung DVI RGB	Intel® HD Graphics 2000 800 MHz	Intel® HD Graphics 2000 800 MHz	Intel® HD Graphics 2500 1 GHz max. 32 Bit	Intel® HD Graphics 2500 900 MHz
Massenspeicherverwaltung	Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA) 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) 3x SATA			
Power Management	ACPI 4.0 mit Batterie Support			
Schnittstellen				
COM1 Typ Ausführung UART max. Baudrate	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt 9-poliger DSUB Stecker 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO 115 kBit/s			
COM2 Typ Ausführung UART max. Baudrate	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt 9-poliger DSUB Stecker 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO 115 kBit/s			
CFast Slot Anzahl Typ	1 SATA III (SATA 6 Gbit/s)			
USB Anzahl Typ Ausführung Übertragungsrate Strombelastbarkeit	4 USB 3.0 (unterseitig) Typ A Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s) ⁵⁾ je Anschluss max. 1 A			
Ethernet Anzahl Ausführung Übertragungsrate max. Baudrate	2 geschirmter RJ45 Port 10/100/1000 MBit/s 1 GBit/s			
Panel / Monitor Schnittstelle Ausführung Typ	DVI-I Buchse SDL/DVI/Monitor			
Audio Typ Controller Eingänge Ausgänge	HDA Realtek RTL888 Mikrofon, Line In Line Out			
Einschübe				
Slide-in compact Laufwerke Anzahl Typ	1 SATA III (SATA 6 Gbit/s)			
Interface Option	2			
Add-on USV Steckplatz	Ja ⁶⁾			
Einschub für Lüfter Kit	Ja			
Elektrische Eigenschaften				
Nennspannung	24 VDC ±25%			
Nennstrom	5,5 A			
Einschaltstrom	max. 60 A für < 300 µs			
Galvanische Trennung	Ja			
Umgebungsbedingungen				
Meereshöhe Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁷⁾			
Mechanische Eigenschaften				
Gewicht	ca. 450 g			

Tabelle 67: 5PC901.TS77-07, 5PC901.TS77-08, 5PC901.TS77-09, 5PC901.TS77-10 - Technische Daten

- Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist eine SRAM Interface Option verbaut, so beträgt die Lebensdauer 2½ Jahre.
- Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).

- 4) Maintenance Controller Extended
- 5) Eine Super Speed Übertragungsrate (5 GBit/s) ist nur mit USB 3.0 möglich.
- 6) Das USV Modul kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.
- 7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

3.4 Systemeinheiten

3.4.1 5PC911.SX00-00

3.4.1.1 Allgemeines

Die aktive Panel PC 900 Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Kühlkörper. Für den Betrieb ist zusätzlich ein Lüfter Kit erforderlich. In die Systemeinheit werden CPU Board, Hauptspeicher, Lüfter Kit, IF Optionen und Slide-in compact Laufwerk eingebaut.

Der Lüfter Kit 5AC902.FA00-00 ist im Lieferumfang der Systemeinheit nicht enthalten und muss extra bestellt werden.

3.4.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC911.SX00-00	PPC900 Systemeinheit aktiv	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PC901.TS77-00	CPU Board Intel Core i7 3615QE 2,3 GHz - Quad Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-01	CPU Board Intel Core i7 3612QE 2,1 GHz - Quad Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-02	CPU Board Intel Core i7 3555LE 2,5 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-03	CPU Board Intel Core i7 3517UE 1,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-04	CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-05	CPU Board Intel Core i3 3120ME 2,4 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-06	CPU Board Intel Core i3 3217UE 1,6 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-07	CPU Board Intel Celeron 847E 1,1 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-08	CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-09	CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-10	CPU Board Intel Celeron 1047UE 1,4 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
	Lüfter Kit	
5AC902.FA00-00	PPC900 Lüfter Kit - Für 5PC911.SX00-00	

Tabelle 68: 5PC911.SX00-00 - Bestelldaten

3.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC911.SX00-00
Allgemeines	
Kühlung	Aktiv über Lüfter Kit Passiv über Kühlkörper
Zertifizierungen	
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium, Leichtmetall- Druckguss
Lackierung	Anthrazit
Abmessungen	
Breite	225 mm
Höhe	226 mm
Tiefe	54 mm
Gewicht	ca. 3020 g

Tabelle 69: 5PC911.SX00-00 - Technische Daten

3.4.2 5PC911.SX00-01

3.4.2.1 Allgemeines

Die passive Panel PC 900 Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Kühlkörper. In die Systemeinheit werden CPU Board, Hauptspeicher, I/F Optionen und Slide-in compact Laufwerk eingebaut.

3.4.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	<div>Abbildung</div> 
	Systemeinheiten	
5PC911.SX00-01	PPC900 Systemeinheit passiv	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PC901.TS77-01	CPU Board Intel Core i7 3612QE 2,1 GHz - Quad Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-02	CPU Board Intel Core i7 3555LE 2,5 GHZ -Dual Core -Chipset QM77	
5PC901.TS77-03	CPU Board Intel Core i7 3517UE 1,7 GHz -Dual Core -Chipset QM77	
5PC901.TS77-04	CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-05	CPU Board Intel Core i3 3120ME 2,4 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-06	CPU Board Intel Core i3 3217UE 1,6 GHz - Dual Core - Chipset QM77	
5PC901.TS77-07	CPU Board Intel Celeron 847E 1,1 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-08	CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-09	CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76	
5PC901.TS77-10	CPU Board Intel Celeron 1047UE 1,4 GHz - Dual Core - Chipset HM76	

Tabelle 70: 5PC911.SX00-01 - Bestelldaten

3.4.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC911.SX00-01
Allgemeines	
Kühlung	Passiv über Kühlkörper
Zertifizierungen	
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium, Leichtmetall- Druckguss
Lackierung	Anthrazit
Abmessungen	
Breite	225 mm
Höhe	226 mm
Tiefe	54 mm
Gewicht	ca. 3020 g

Tabelle 71: 5PC911.SX00-01 - Technische Daten

3.5 Hauptspeicher

3.5.1 5MMDDR.xxxx-03

3.5.1.1 Allgemeines

Diese 204-poligen DDR3 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 1600 MHz und sind mit einer Speichergröße von 1 GByte bis 8 GByte verfügbar.

Werden zwei gleich große (z.B. 2 GByte) Hauptspeicher in das CPU Board gesteckt, so wird die Dual-Channel Memory Technologie unterstützt. Werden zwei ungleich große (z.B. 2 GByte und 4 GByte) Hauptspeicher gesteckt, so wird diese Technologie nicht unterstützt.

Werden bei einem 32-Bit Betriebssystem zwei z.B. 2 GByte Module oder ein 4 GByte Modul gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar, bei einem 64-Bit Betriebssystem sind maximal 16 GByte Hauptspeicher verwendbar.

3.5.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Hauptspeicher	
5MMDDR.1024-03	SO-DIMM DDR3, 1024 MByte	
5MMDDR.2048-03	SO-DIMM DDR3, 2048 MByte	
5MMDDR.4096-03	SO-DIMM DDR3, 4096 MByte	
5MMDDR.8192-03	SO-DIMM DDR3, 8192 MByte	

Tabelle 72: 5MMDDR.1024-03, 5MMDDR.2048-03, 5MMDDR.4096-03, 5MMDDR.8192-03 - Bestelldaten

3.5.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMDDR.1024-03	5MMDDR.2048-03	5MMDDR.4096-03	5MMDDR.8192-03
Allgemeines				
Typ	SO-DIMM DDR3 SDRAM			
Speichergröße	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte
Bauart	204 Pin			
Organisation	128M x 64 Bit	256M x 64 Bit	512M x 64 Bit	1024M x 64 Bit
Geschwindigkeit	DDR3-1600 (PC3-12800)			
Zertifizierungen				
CE	Ja			
cULus	Ja			
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾			
GOST-R	Ja			
GL	Ja ¹⁾			

Tabelle 73: 5MMDDR.1024-03, 5MMDDR.2048-03, 5MMDDR.4096-03, 5MMDDR.8192-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.6 Buseinheiten

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Buseinheit sind im Abschnitt "Buseinheit Montage" auf Seite 142 zu entnehmen.

Beim Tausch bzw. Einbau einer Buseinheit ist es notwendig, im BIOS die Setup Defaults zu laden (siehe "Save & Exit" auf Seite 222).

3.6.1 5AC902.BX0x-xx

3.6.1.1 Allgemeines

Die Buseinheiten bestehen aus Gehäuse und Bus. Sie können an der Panel PC 900 Systemeinheit erweitert werden.

Es stehen verschiedene Ausführungen mit PCI und PCIe Slots zur Verfügung, desweiteren befindet sich auf jeder Buseinheit ein Slide-in Laufwerkseinschub und ein Lüfter Kit.

Der Lüfter Kit ist im Lieferumfang der Buseinheit nicht enthalten und muss extra bestellt werden. Wird eine aktive Systemeinheit (5PC911.SX00-00) verwendet, muss ein Lüfter Kit in der Buseinheit konfiguriert sein.

1 Slot Buseinheiten

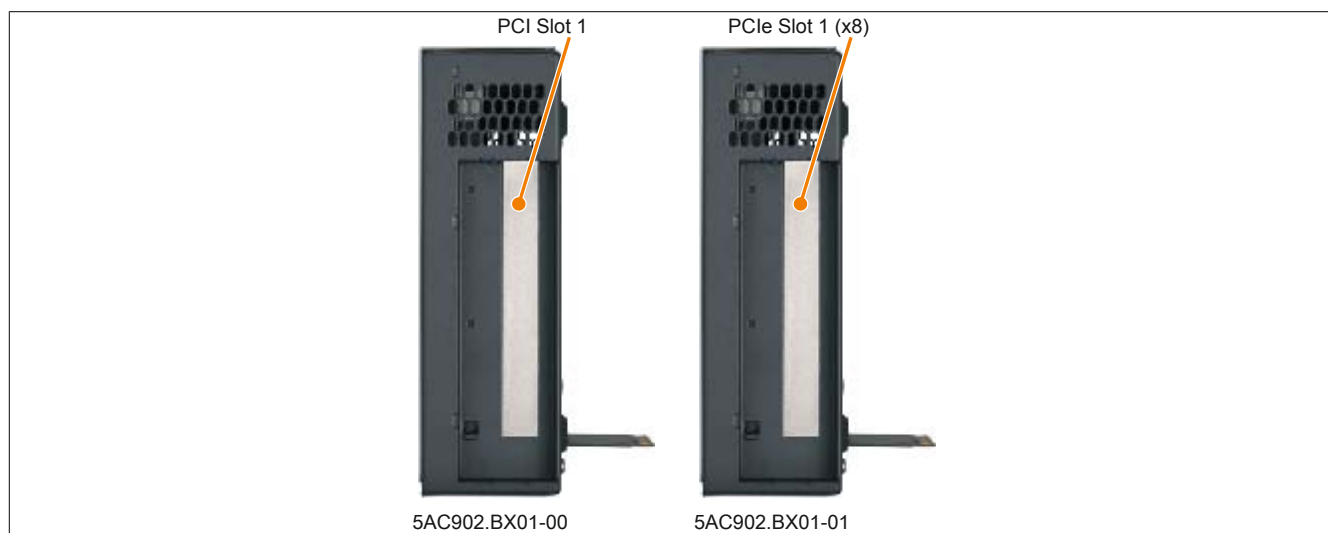


Abbildung 31: 1 Slot Buseinheiten

2 Slot Buseinheiten

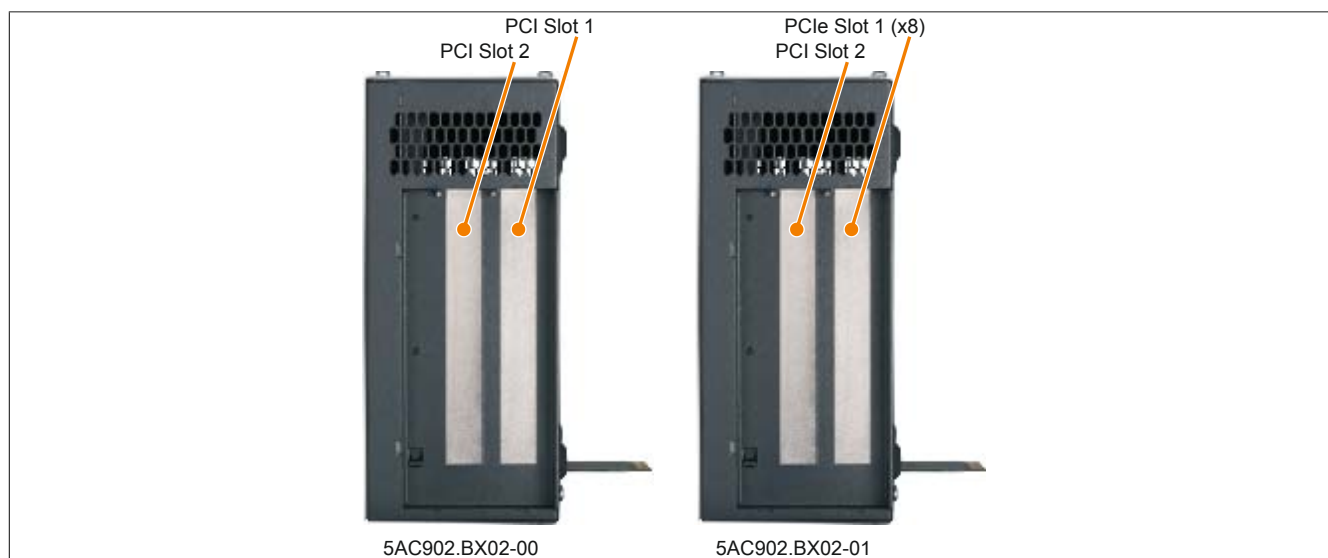


Abbildung 32: 2 Slot Buseinheiten

3.6.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Buseinheiten	
5AC902.BX01-00	PPC900 Buseinheit 1 Slot - 1 PCI - 1 Slide-in	
5AC902.BX01-01	PPC900 Buseinheit 1 Slot - 1 PCI Express x8 - 1 Slide-in	
5AC902.BX02-00	PPC900 Buseinheit 2 Slot - 2 PCI - 1 Slide-in	
5AC902.BX02-01	PPC900 Buseinheit 2 Slot - 1 PCI - 1 PCI Express x8 - 1 Slide-in	
	Optionales Zubehör	
	Lüfter Kit	
5AC902.FA0X-00	PPC900 Lüfter Kit - Für PPC900 Buseinheiten	

Tabelle 74: 5AC902.BX01-00, 5AC902.BX01-01, 5AC902.BX02-00, 5AC902.BX02-01 - Bestelldaten

3.6.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC902.BX01-00	5AC902.BX01-01	5AC902.BX02-00	5AC902.BX02-01
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE			Ja	
cULus			Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2			Ja ¹⁾	
GOST-R			Ja	
Einschübe				
PCI Slots				
Anzahl	1	-	2	1
Typ	32 Bit	-	32 Bit	32 Bit
Ausführung	PCI half-size	-	PCI half-size	PCI half-size
Standard	2.2	-	2.2	2.2
Bus Speed	33 MHz	-	33 MHz	33 MHz
PCIe to PCI Bridge	Ja	-	Ja	Ja
PCIe Slots				
Anzahl	-	1	-	1
Ausführung	-	PCIe half-size	-	PCIe half-size
Standard	-	1.0a	-	1.0a
Bus Speed	-	x8 (2 GByte/s)	-	x8 (2 GByte/s)
Slide-in Laufwerke	1			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Breite	164 mm			
Höhe	218 mm			
Tiefe	54,7 mm	54,7 mm	75 mm	75 mm
Gewicht	ca. 1020 g	ca. 1020 g	ca. 1220 g	ca. 1220 g

Tabelle 75: 5AC902.BX01-00, 5AC902.BX01-01, 5AC902.BX02-00, 5AC902.BX02-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Information:

Die PCIe Slots sind per default im BIOS auf Gen1 limitiert. Die PCIe Gen kann aber im BIOS (Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings) konfiguriert werden.

3.7 Lüfter Kit

Information:

Die Lüfterfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in angemessenem Abstand kontrolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht werden. Informationen zum Tausch der Lüfterfilter sind dem Abschnitt "Lüfterfilter Tausch" auf Seite 141 zu entnehmen.

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau des Lüfter Kit sind dem Abschnitt "Lüfter Kit Tausch" auf Seite 140 zu entnehmen.

3.7.1 5AC902.FA00-00

3.7.1.1 Allgemeines

Im Lüfter Kit sind 2 Lüfter verbaut die zur besseren Wärmeableitung der aktiven PPC900 Systemeinheit 5PC911.SX00-00 dienen.

- 2 verbaute Lüfter zur verbesserten Wärmeableitung der Systemeinheit
- einfacher Ein-/ Ausbau

Der Lüfter Kit 5AC902.FA00-00 ist im Lieferumfang der Systemeinheit nicht enthalten und muss extra bestellt werden.

3.7.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5AC902.FA00-00	PPC900 Lüfter Kit - Für 5PC911.SX00-00	
	Optionales Zubehör	
5AC902.FI00-00	PPC900 Filter Kit Systemeinheit	

Tabelle 76: 5AC902.FA00-00 - Bestelldaten

3.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC902.FA00-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	2
Drehzahl	max. 9500 ±10% rpm
Geräuschpegel	40,2 dB(A) ¹⁾
Lebensdauer	70000 Stunden bei 40°C
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ²⁾
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 70 g

Tabelle 77: 5AC902.FA00-00 - Technische Daten

1) Bei maximaler Lüfterdrehzahl.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.7.2 5AC902.FA0X-00

3.7.2.1 Allgemeines

Im Lüfter Kit ist ein Lüfter verbaut der zur besseren Wärmeableitung einer PPC900 Buseinheit dient.

- 1 verbauter Lüfter zur verbesserten Wärmeableitung der Buseinheit
- einfacher Ein-/ Ausbau

Der Lüfter Kit ist im Lieferumfang der Buseinheit nicht enthalten und muss extra bestellt werden. Wird eine aktive Systemeinheit (5PC911.SX00-00) verwendet, muss ein Lüfter Kit in der Buseinheit konfiguriert sein.

3.7.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	Image not found for 5AC902.FA0X-00!
5AC902.FA0X-00	PPC900 Lüfter Kit - Für PPC900 Buseinheiten	
	Optionales Zubehör	
5AC902.FI0X-00	PPC900 Filter Kit Buseinheit	

Tabelle 78: 5AC902.FA0X-00 - Bestelldaten

3.7.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC902.FA0X-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	1
Drehzahl	max. 9500 ±10% rpm
Geräuschpegel	40,2 dB(A) ¹⁾
Lebensdauer	70000 Stunden bei 40°C
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ²⁾
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 36 g

Tabelle 79: 5AC902.FA0X-00 - Technische Daten

1) Bei maximaler Lüfterdrehzahl.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.8 Laufwerke

3.8.1 5AC901.CHDD-01

3.8.1.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

- 500 GByte Hard Disk
- Slide-in compact
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

3.8.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC901.CHDD-01	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 80: 5AC901.CHDD-01 - Bestelldaten

3.8.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.CHDD-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 0,2\%$
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH ²⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ³⁾	
Betrieb ⁴⁾	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden ⁵⁾	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C

Tabelle 81: 5AC901.CHDD-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.CHDD-01
Luftfeuchtigkeit ⁶⁾	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁷⁾
Abmessungen	
Breite	10 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 81: 5AC901.CHDD-01 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.
- 7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

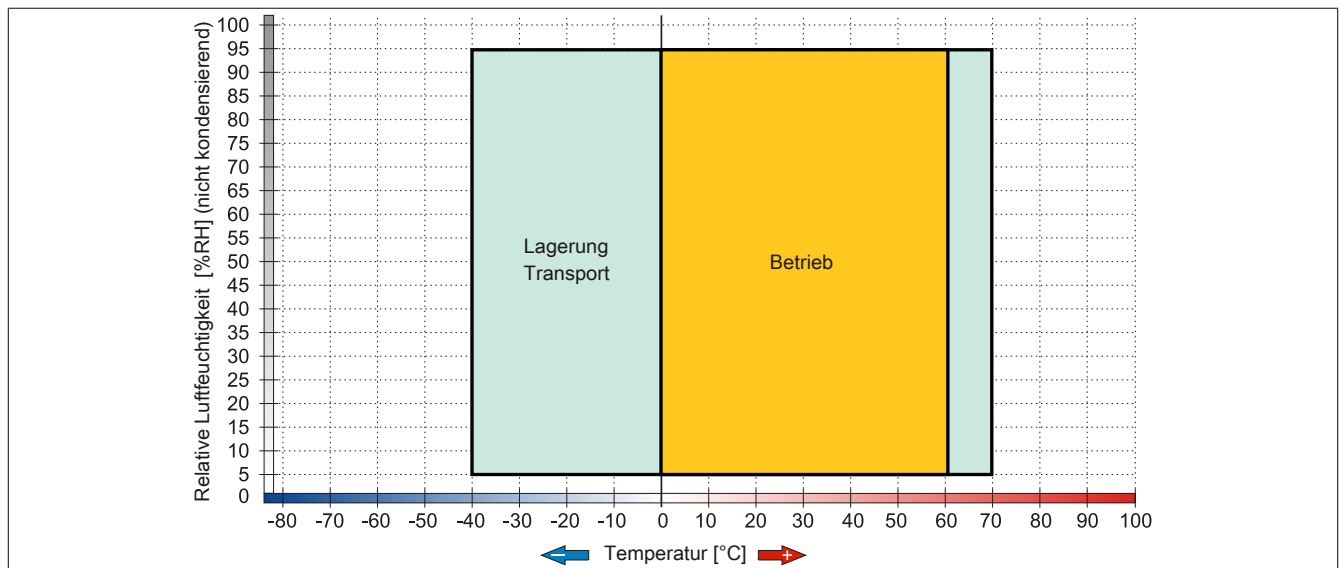


Abbildung 33: 5AC901.CHDD-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.2 5AC901.CSSD-03

3.8.2.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

- 60 GByte Solid State Drive
- MLC-Flash
- S.M.A.R.T. Support
- Slide-in compact
- SATA 3.0 kompatibel

3.8.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC901.CSSD-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 82: 5AC901.CSSD-03 - Bestelldaten

3.8.2.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.CSSD-03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	max. 60.000 (random)
4k schreiben	max. 25.000 (random)
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	35 TBW ³⁾
MLC-Flash	Ja

Tabelle 83: 5AC901.CSSD-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5AC901.CSSD-03
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-40 bis 95°C	
Transport	-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix ⁴⁾	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	118 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST	

Tabelle 83: 5AC901.CSSD-03 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written
- 4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

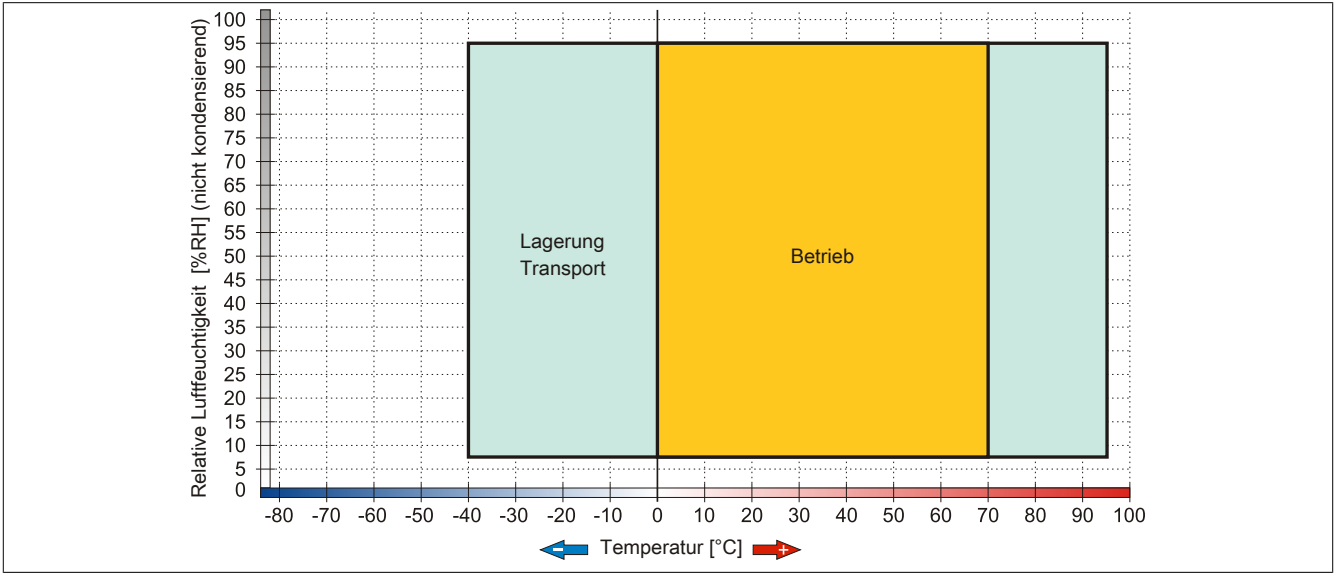


Abbildung 34: 5AC901.CSSD-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.3 5AC901.CSSD-04

3.8.3.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

- 128 GByte Solid State Drive
- MLC-Flash
- S.M.A.R.T. Support
- Slide-in compact
- SATA 3.0 kompatibel

3.8.3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC901.CSSD-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 84: 5AC901.CSSD-04 - Bestelldaten

3.8.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.CSSD-04		
Revision	C0	D0	E0
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
cULus		Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2		Ja ¹⁾	
GOST-R		Ja	
Solid State Drive			
Kapazität	128 GByte		
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen		
MTBF	1.500.000 Stunden		
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Schnittstelle	SATA		
Wartung	keine		
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s		
kontinuierliches Schreiben	max. 450 MByte/s		
IOPS ²⁾			
4k lesen	max. 80.000 (random)	max. 85.000 (random)	
4k schreiben		max. 35.000 (random)	
Endurance			
garantierte Datenmenge			
garantiert	74 TBW ³⁾		
MLC-Flash	Ja		

Tabelle 85: 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5AC901.CSSD-04	
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C		-30 bis 85°C
Lagerung			-40 bis 95°C
Transport			-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb			8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung			8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport			8 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration			
Betrieb			10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung			10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport			10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock			
Betrieb			1500 g, 0,5 ms
Lagerung			1500 g, 0,5 ms
Transport			1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe			
Betrieb			-300 bis 12.192 m
Lagerung			-300 bis 12.192 m
Transport			-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften			
Montage	fix ⁴⁾		
Abmessungen			
Breite			13 mm
Höhe			98 mm
Tiefe			105 mm
Gewicht	118 g		
Herstellerinformation			
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNH128GBST	THNSNJ128WBST	THNSNJ128WCST

Tabelle 85: 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written
- 4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

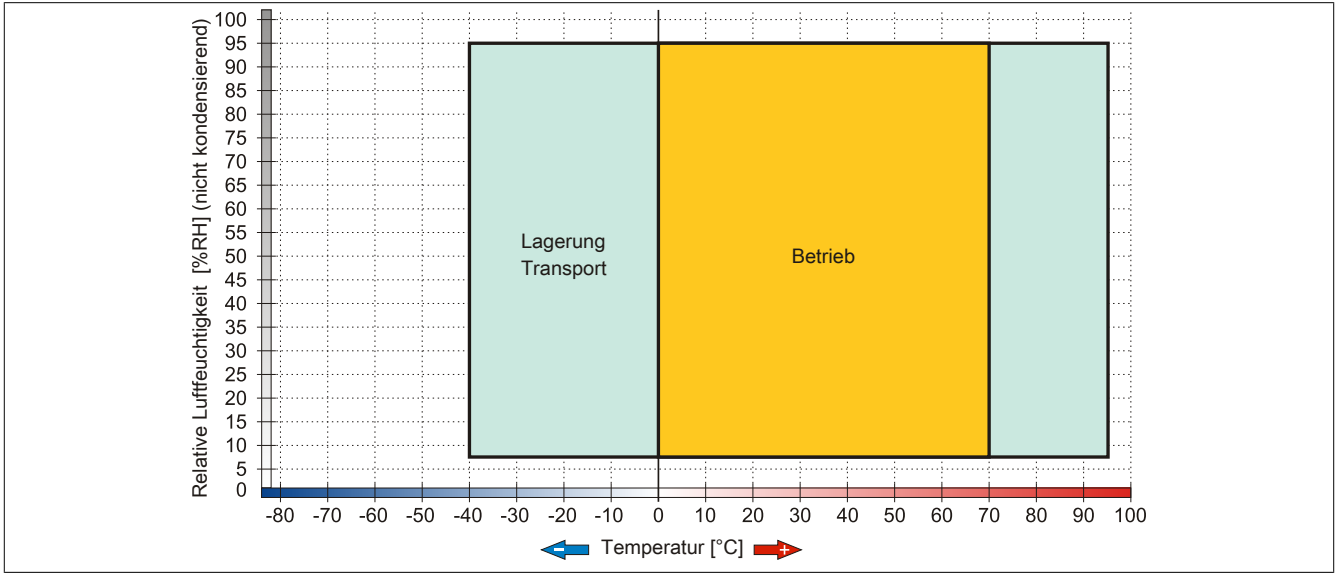


Abbildung 35: 5AC901.CSSD-04 Rev. ≤ C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

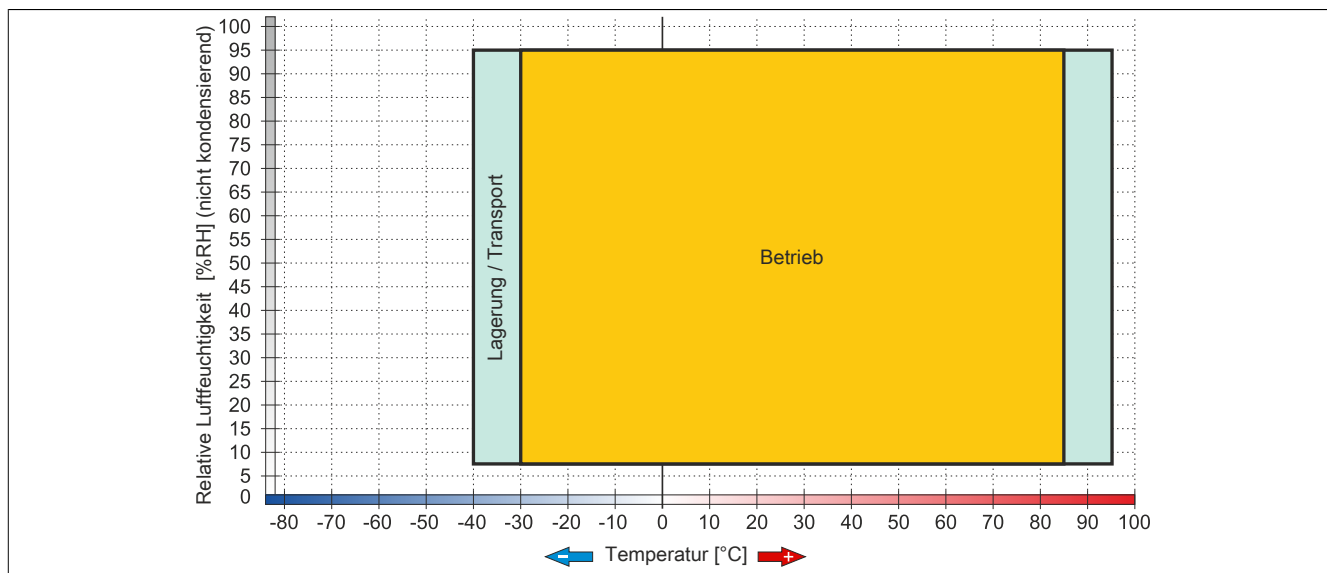


Abbildung 36: 5AC901.CSSD-04 Rev. ≥ D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.4 5AC901.CSSD-05

3.8.4.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

- 256 GByte Solid State Drive
- MLC-Flash
- S.M.A.R.T. Support
- Slide-in compact
- SATA 3.0 kompatibel

3.8.4.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC901.CSSD-05	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	

Tabelle 86: 5AC901.CSSD-05 - Bestelldaten

3.8.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörtel alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.CSSD-05
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	256 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 460 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	max. 90.000 (random)
4k schreiben	max. 35.000 (random)
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	148 TBW ³⁾
MLC-Flash	Ja

Tabelle 87: 5AC901.CSSD-05 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.CSSD-05
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁴⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Toshiba
Herstellerbezeichnung	THNSNJ256WCST

Tabelle 87: 5AC901.CSSD-05 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written
- 4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

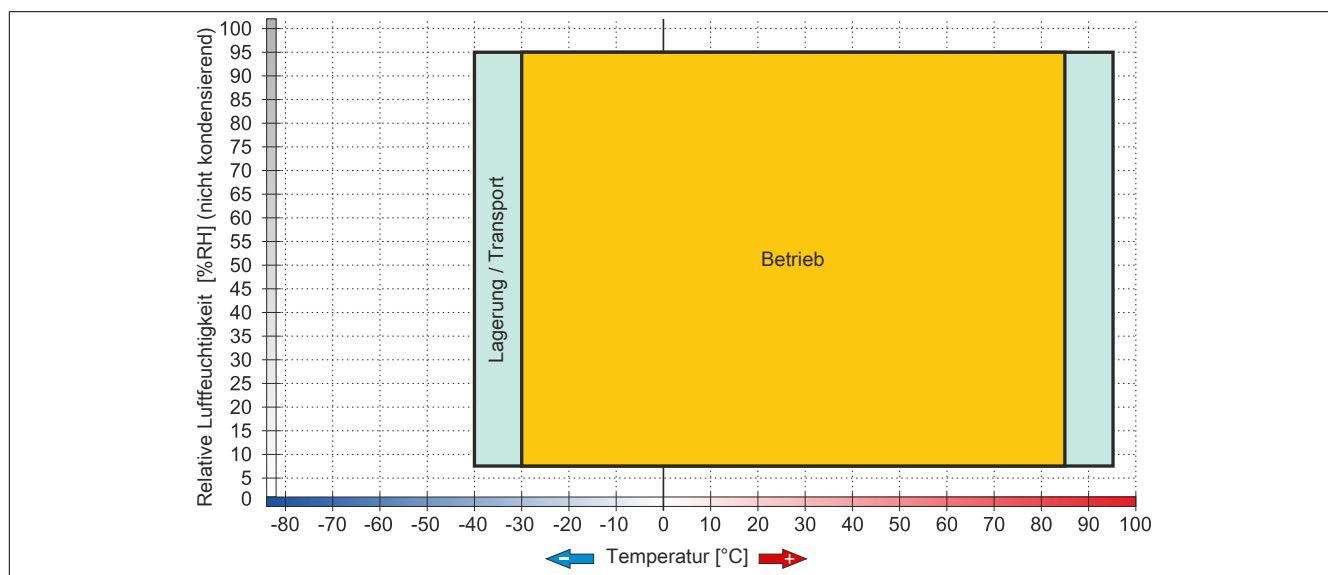


Abbildung 37: 5AC901.CSSD-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.5 5MMSSD.0060-01

3.8.5.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.8.5.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 88: 5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten

3.8.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	max. 60.000 (random)
4k schreiben	max. 25.000 (random)
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	35 TBW ³⁾
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C

Tabelle 89: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Toshiba
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST

Tabelle 89: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written

3.8.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

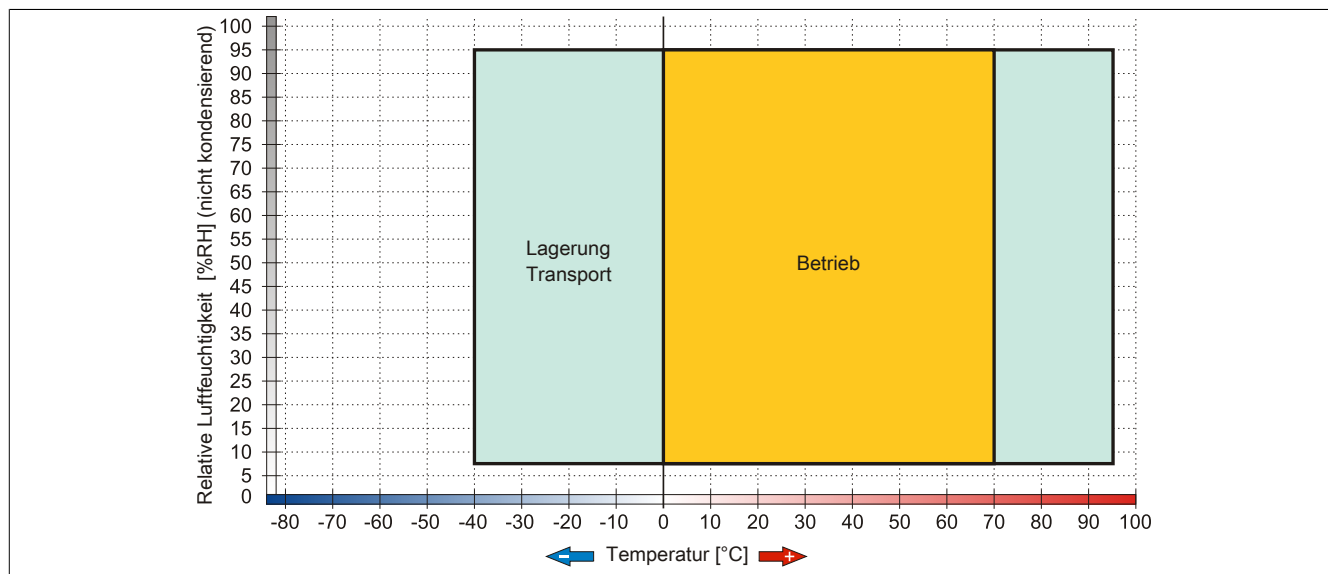


Abbildung 38: 5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.6 5MMSSD.0128-01

3.8.6.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.8.6.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 90: 5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten

3.8.6.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0128-01	
Revision	C0	D0
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾	
GOST-R	Ja	
Solid State Drive		
Kapazität	128 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.500.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s	
kontinuierliches Schreiben	max. 450 MByte/s	
IOPS ²⁾		
4k lesen	max. 80.000 (random)	max. 85.000 (random)
4k schreiben	max. 35.000 (random)	
Endurance		
garantierte Datenmenge		
garantiert	74 TBW ³⁾	
MLC-Flash	Ja	
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando	

Tabelle 91: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5MMSSD.0128-01	
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C		-30 bis 85°C
Lagerung		-40 bis 95°C	
Transport		-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb		8 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung		8 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport		8 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration			
Betrieb		10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung		10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport		10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock			
Betrieb		1500 g, 0,5 ms	
Lagerung		1500 g, 0,5 ms	
Transport		1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe			
Betrieb		-300 bis 12.192 m	
Lagerung		-300 bis 12.192 m	
Transport		-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Breite	9,5 mm		7 mm
Höhe		69 mm	
Tiefe		100 mm	
Gewicht		78 g	
Herstellerinformation			
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNH128GBST	THNSNJ128WCST	

Tabelle 91: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written

3.8.6.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

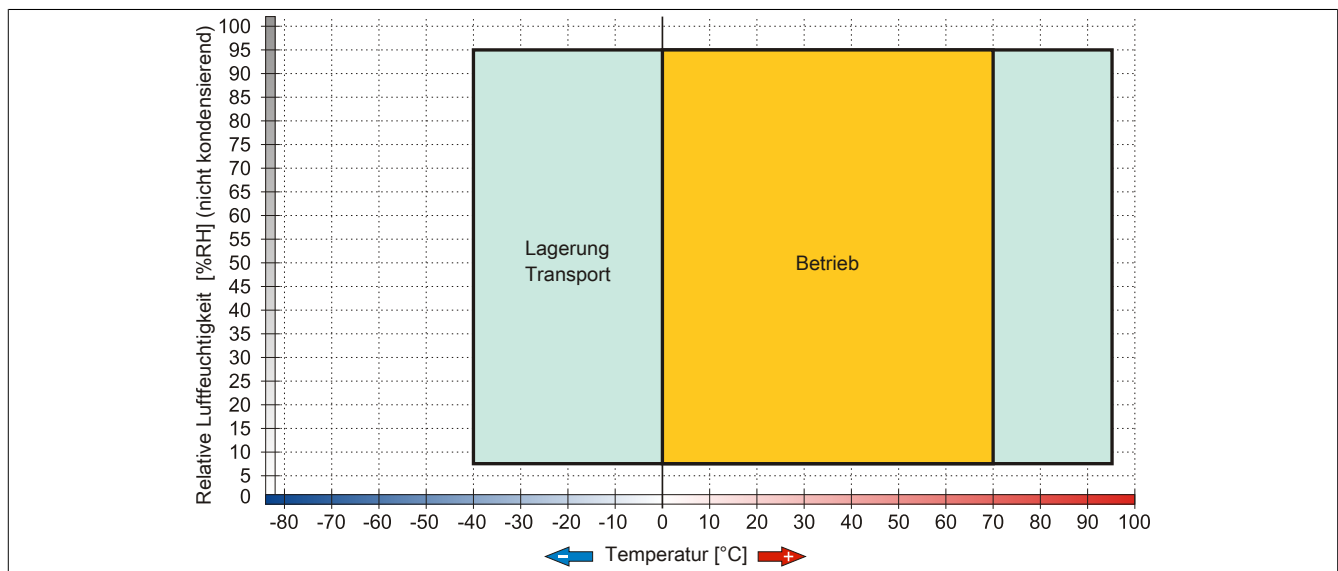


Abbildung 39: 5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≤ C0

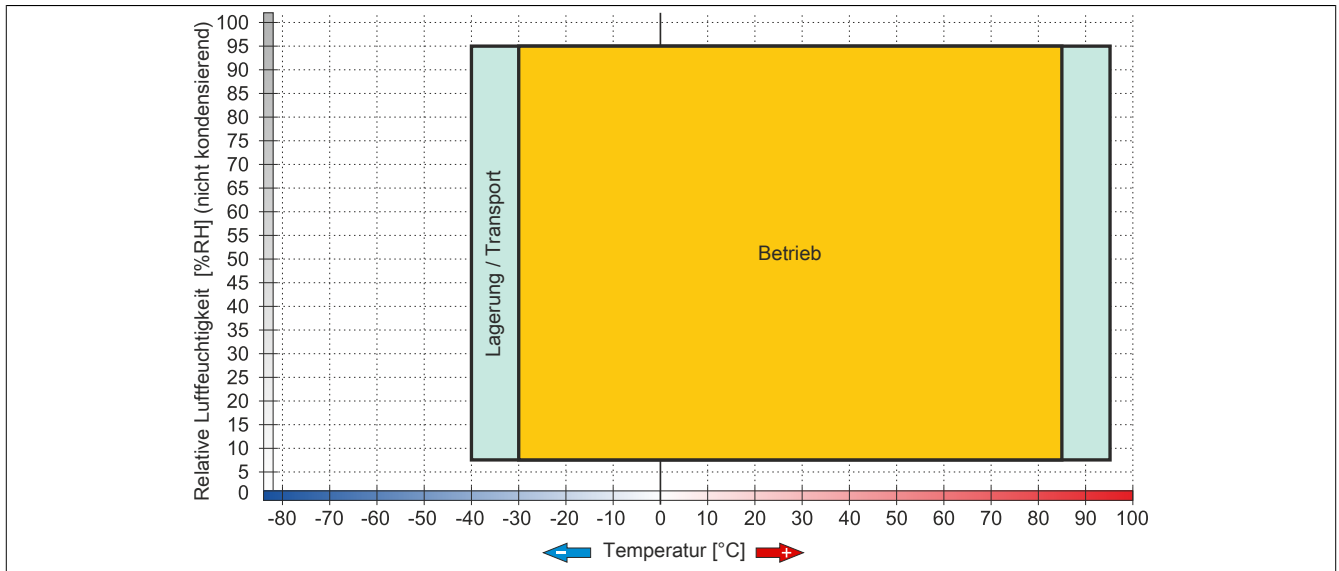


Abbildung 40: 5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≥ D0

3.8.7 5MMSSD.0256-00

3.8.7.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-05 bzw. 5AC901.CSSD-05
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.8.7.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	

Tabelle 92: 5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten

3.8.7.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0256-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
Solid State Drive	
Kapazität	256 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 460 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	max. 90.000 (random)
4k schreiben	max. 35.000 (random)
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	148 TBW ³⁾
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 93: 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0256-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	7 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Toshiba
Herstellerbezeichnung	THNSNJ256WCST

Tabelle 93: 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written

3.8.7.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

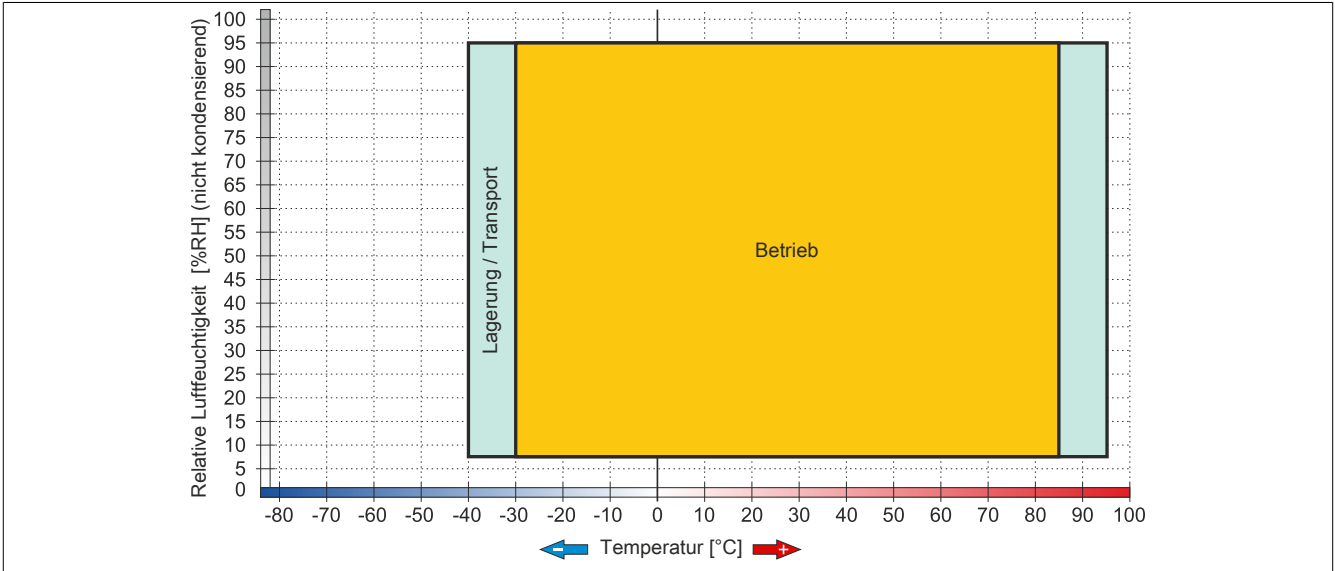


Abbildung 41: 5MMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.8 5AC901.CCFA-00

3.8.8.1 Allgemeines

Der CFast Adapter ist ein Slide-in compact Adapter, in welchen man eine CFast Karte stecken und somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Der CFast Adapter kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

- CFast Steckplatz
- Slide-in compact

3.8.8.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC901.CCFA-00	CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in compact Slot	
	Optionales Zubehör	
	CFast Karten	
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte	
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte	
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte	
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte	
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte	

Tabelle 94: 5AC901.CCFA-00 - Bestelldaten

3.8.8.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.CCFA-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
GL	Ja ¹⁾
Schnittstellen	
CFast Slot	
Anzahl	1
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	abhängig von der gesteckten CFast Karte
Lagerung	abhängig von der gesteckten CFast Karte
Transport	abhängig von der gesteckten CFast Karte
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	abhängig von der gesteckten CFast Karte
Lagerung	abhängig von der gesteckten CFast Karte
Transport	abhängig von der gesteckten CFast Karte

Tabelle 95: 5AC901.CCFA-00 - Technische Daten

¹⁾ Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.8.9 5AC901.SDVW-00

3.8.9.1 Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten und PPC900 Buseinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

- DVD-R/RW, DVD+R/RW Laufwerk
- Slide-in

3.8.9.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
Laufwerke		
5AC901.SDVW-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in	

Tabelle 96: 5AC901.SDVW-00 - Bestelldaten

3.8.9.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.SDVW-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5160 rpm \pm 1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GByte, 2,6 GByte) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	SATA
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	durchschnittlich 140 ms (24x)
DVD	durchschnittlich 150 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW, DVD-RAM
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x

Tabelle 97: 5AC901.SDVW-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.SDVW-00
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW	24x, 16x, 10x und 4x
DVD+R	8x, 4x und 2,4x
DVD+R (Double Layer)	6x, 4x und 2,4x
DVD+RW	4x und 2x
DVD-R	8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer)	6x, 4x und 2x
DVD-RAM ²⁾	5x, 3x und 2x
DVD-RW	6x, 4x und 2x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ³⁾	
Betrieb	5 bis 55°C ⁴⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,2g
Lagerung	5 bis 500 Hz: 2g
Transport	5 bis 500 Hz: 2g
Schock	
Betrieb	bei max. 5 g und 11 ms Dauer
Lagerung	bei max. 60 g und 11 ms Dauer
Transport	bei max. 200 g und 2 ms Dauer bei max. 60 g und 11 ms Dauer bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	400 g

Tabelle 97: 5AC901.SDVW-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Unterstützung der RAM Funktion durch die Brennsoftware „Nero“ (Best. Nr. 5SWUT1.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.
- 3) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.
- 4) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

3.8.9.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

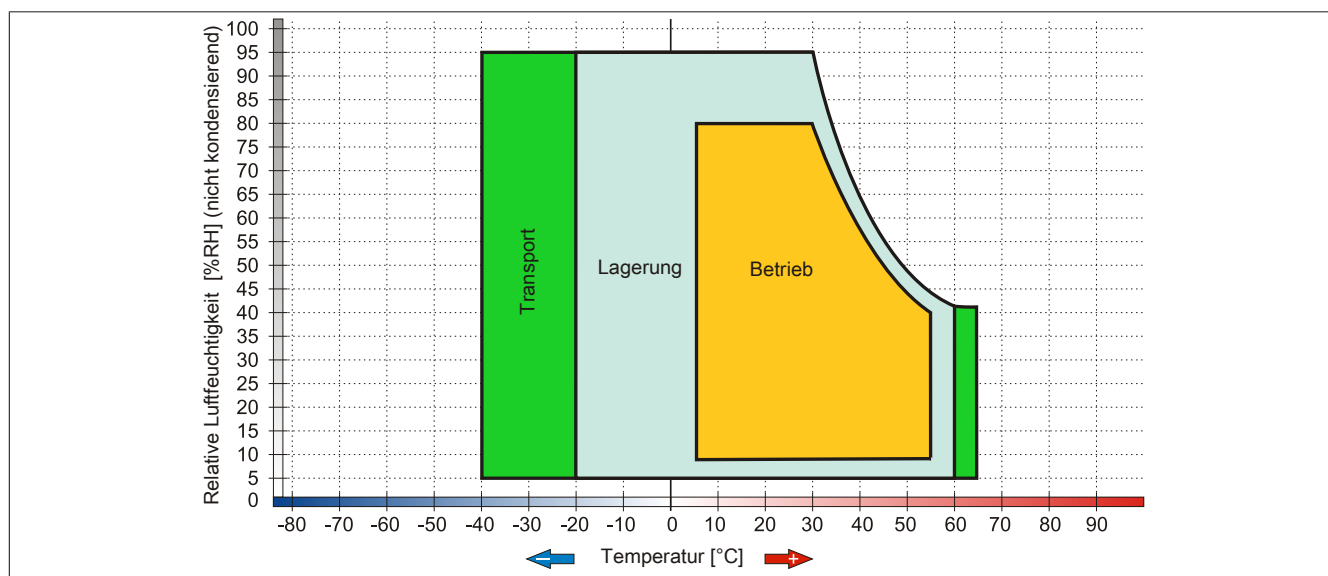


Abbildung 42: 5AC901.SDVW-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.10 5AC901.SSCA-00

3.8.10.1 Allgemeines

Der Slide-in compact Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man ein Slide-in compact Laufwerk stecken und somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Der Slide-in compact Adapter kann in APC910 Systemeinheiten und PPC900 Buseinheiten verwendet werden.

- Slide-in compact Steckplatz
- Slide-in

3.8.10.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Laufwerke	
5AC901.SSCA-00	Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in compact Laufwerks in einem Slide-in Slot.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5AC901.CCFA-00	CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in compact Slot	
5AC901.CHDD-01	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC901.CSSD-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact	
5AC901.CSSD-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC901.CSSD-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC901.CSSD-05	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	

Tabelle 98: 5AC901.SSCA-00 - Bestelldaten

3.8.10.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörtel alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.SSCA-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Einschübe	
Slide-in compact Laufwerke	1
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Lagerung	abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Transport	abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Lagerung	abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Transport	abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk

Tabelle 99: 5AC901.SSCA-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.9 Interface Optionen

Information:

Es ist darauf zu achten, dass nicht jede Interface Option in den Interface Slot 1 und 2 gesteckt werden kann. Genauere Informationen sind im Abschnitt "IF Option 1 Steckplatz" auf Seite 53 und "IF Option 2 Steckplatz" auf Seite 53 zu finden.

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Interface Option sind dem Abschnitt "Montage Interface Option" auf Seite 134 zu entnehmen.

Abhängig von der verwendeten IF-Option kann es nach dem Tausch bzw. Einbau notwendig sein, im BIOS die Setup Defaults zu laden (siehe "Save & Exit" auf Seite 222).

3.9.1 5AC901.I485-00

3.9.1.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.I485-00 verfügt über eine RS232/422/485 Schnittstelle. Die Auswahl der Betriebsart (RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschaltung.

- 1x RS232/422/485 Schnittstelle
- einbaukompatibel in APC910 und PPC900

3.9.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	
5AC901.I485-00	RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900	

Tabelle 100: 5AC901.I485-00 - Bestelldaten

3.9.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.I485-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$D84A
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
GL	Ja ¹⁾
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232/422/485, galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	1 W

Tabelle 101: 5AC901.I485-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.I485-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C ²⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 34 g

Tabelle 101: 5AC901.I485-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
 2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.9.1.3.1 Serielle Schnittstelle COM

Serielle Schnittstelle COM		
	RS232	RS422/485
Typ	RS232 nicht modemfähig; galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 m	max. 1200 m
Pin	Belegung RS232	Belegung RS422
1	n.c.	TXD\
2	RXD	n.c.
3	TXD	n.c.
4	n.c.	TXD
5	GND	GND
6	n.c.	RXD\
7	RTS	n.c.
8	CTS	n.c.
9	n.c.	RXD

9-poliger DSUB Stecker

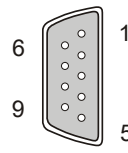


Tabelle 102: Pinbelegung COM

3.9.1.3.2 Buslänge und Kabeltyp RS232

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung	Übertragungsrate
≤ 15 m	typ. 64 kBit/s
≤ 10 m	typ. 115 kBit/s
≤ 5 m	typ. 115 kBit/s

Tabelle 103: RS232 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,16 mm ² (26AWG), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 104: RS232 Kabel Anforderungen

3.9.1.3.3 Buslänge und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung	Übertragungsrate
1200 m	typ. 115 kBit/s

Tabelle 105: RS422 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS422 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 106: RS422 Kabel Anforderungen

3.9.1.3.4 Betrieb als RS485-Schnittstelle

Für den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu sind die Pins wie abgebildet zu verbinden.

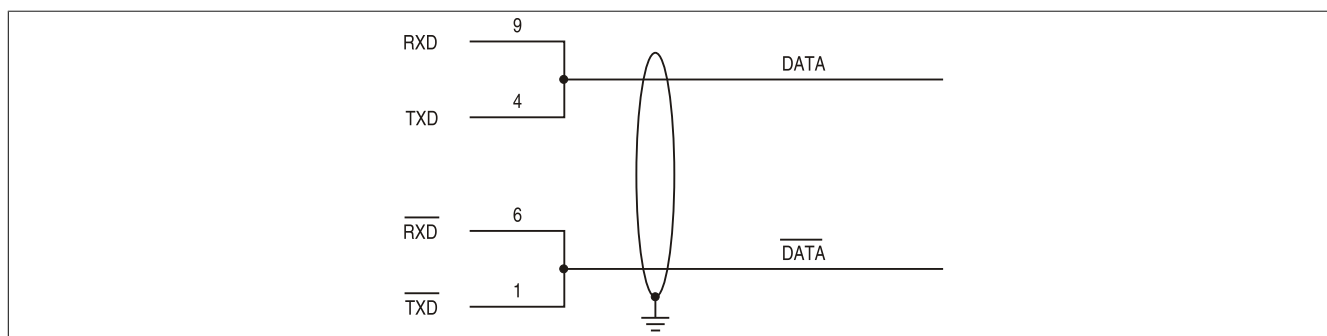


Abbildung 43: RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

Das Schalten der RTS Leitung muss für jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durchgeführt werden, es gibt keine automatische Rückschaltung. Dies kann nicht in Windows konfiguriert werden.

Bei großen Leitungslängen kann es durch den Spannungsabfall zu größeren Potentialdifferenzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann durch mitführen der Masseleitung verbessert werden.

3.9.1.3.5 Buslänge und Kabeltyp RS485

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung	Übertragungsrate
1200 m	typ. 115 kBit/s

Tabelle 107: RS485 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie

Tabelle 108: RS485 Kabel Anforderungen

RS485 Kabel	Eigenschaft
Groundleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinn-te Cu-Litze PE ≤ 59 Ω/km
Außenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinn-ten Cu-Drähten

Tabelle 108: RS485 Kabel Anforderungen

3.9.1.3.6 Abschlusswiderstand

An der IF Option ist bereits ein Abschlusswiderstand für die Serielle Schnittstelle integriert. Mit einem Schalter wird der Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet, dazu ist es allerdings nötig die Systemeinheit zu öffnen. Ein aktivierter Abschlusswiderstand wird durch eine gelb leuchtende LED angezeigt.

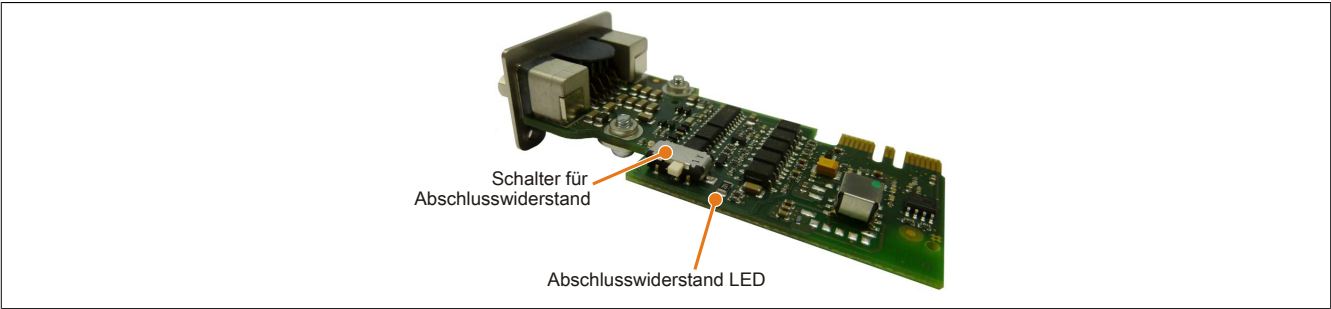


Abbildung 44: 5AC901.l485-00 - Abschlusswiderstand

3.9.2 5AC901.ICAN-00

3.9.2.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.ICAN-00 verfügt über eine CAN Master Schnittstelle.

- 1x CAN Master Schnittstelle
- einbaukompatibel in APC910 und PPC900

Der gleichzeitige Betrieb von 2 Interface Optionen 5AC901.ICAN im IF Option 1 und IF Option 2 Steckplatz ist nicht möglich.

3.9.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	
5AC901.ICAN-00	CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900	

Tabelle 109: 5AC901.ICAN-00 - Bestelldaten

3.9.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.ICAN-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$D84B
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Schnittstellen	
CAN	
Anzahl	1
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
Übertragungsrate	max. 500 kBit/s
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	1 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C ²⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 33 g

Tabelle 110: 5AC901.ICAN-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
 2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.9.2.3.1 CAN Schnittstelle

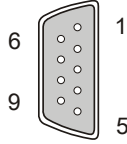
CAN Bus		<p>9-poliger DSUB Stecker</p> 
Typ	potenzialgetrennt	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 500 kBit/s	
Buslänge	max. 1000 Meter	
Pin	Belegung	
1	n.c.	
2	CAN LOW	
3	GND	
4	n.c.	
5	n.c.	
6	Reserviert	
7	CAN HIGH	
8	n.c.	
9	n.c.	

Tabelle 111: 5AC901.ICAN-00 - CAN Pinbelegung

3.9.2.3.2 Abschlusswiderstand

An der IF Option ist bereits ein Abschlusswiderstand für die CAN Schnittstelle integriert. Mit einem Schalter wird der Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet, dazu ist es allerdings nötig die Systemeinheit zu öffnen. Ein aktivierter Abschlusswiderstand wird durch eine gelb leuchtende LED angezeigt.

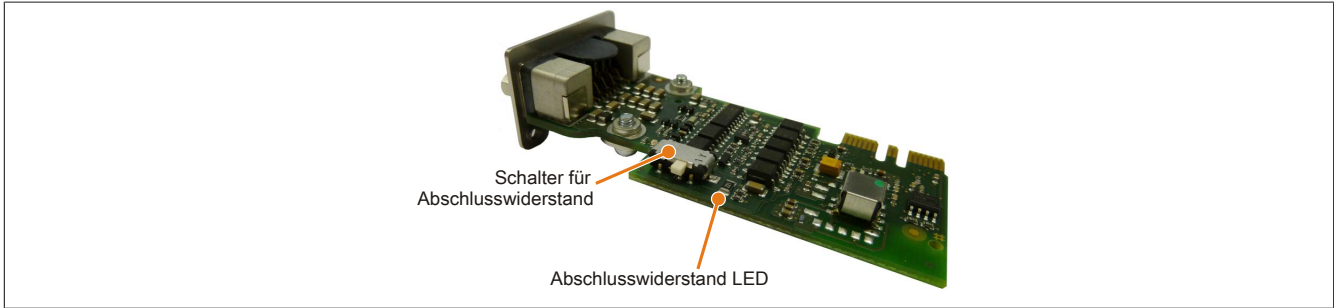


Abbildung 45: 5AC901.ICAN-00 - Abschlusswiderstand

3.9.3 5AC901.ISRM-00

3.9.3.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.ISRM-00 verfügt über 2 MByte SRAM.

- 2 MByte SRAM
- einbaukompatibel in APC910 und PPC900

Die SRAM Interface Option 5AC901.ISRM-00 kann nur im IF Option 2 Steckplatz betrieben werden.

Information:

Beim Schreiben, Lesen sowie beim Zugriff auf das SRAM werden "not-aligned-Zugriffe" vom AVLON-Bus (interner Bus im PCI Express Core) nicht unterstützt.

3.9.3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung Interface Optionen	Abbildung
5AC901.ISRM-00	SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910 und PPC900	

Tabelle 112: 5AC901.ISRM-00 - Bestelldaten

3.9.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.ISRM-00
Allgemeines	
Anbindung im System	über PCI Express Bus
B&R ID-Code	\$D850
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Controller	
SRAM	
Größe	2 MByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	512 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	2 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C ²⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 20 g

Tabelle 113: 5AC901.ISRM-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.9.4 5AC901.IHDA-00

3.9.4.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.IHDA-00 verfügt über einen HDA Soundchip bei dem die Kanäle MIC, Line IN und Line OUT von außen zugänglich sind.

- 1x MIC
- 1x Line IN
- 1x Line OUT
- einbaukompatibel in APC910 und PPC900

Die Interface Option 5AC901.IHDA-00 kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

3.9.4.2 Bestelldaten

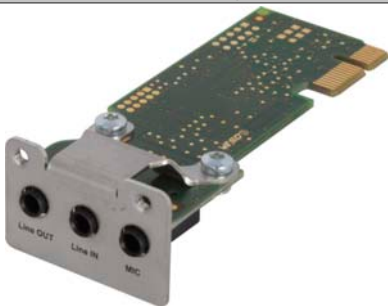
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	
5AC901.IHDA-00	Audio Interface Option, Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT; zum Einbau in einen APC910	

Tabelle 114: 5AC901.IHDA-00 - Bestelldaten

3.9.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöriteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.IHDA-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$D84E
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
GL	Ja ¹⁾
Schnittstellen	
Audio	
Typ	HDA Sound
Controller	Realtek ALC 662
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,4 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C ²⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 21 g

Tabelle 115: 5AC901.IHDA-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
 2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.9.4.3.1 MIC, Line IN, Line OUT

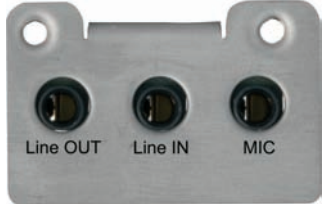
MIC, Line IN, Line OUT		
Controller	Realtek ALC 662	3,5 mm Klinkenanschluss, female 
MIC	Anschluss eines Mono Mikrofon über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line IN	Einspeisung eines Stereo Line In Signals über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line OUT	Anschluss eines Stereo Wiedergabegerätes (z.B. Verstärker) über einen 3,5 mm Klinkenstecker.	

Tabelle 116: MIC, Line IN, Line OUT

Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.10 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Der B&R Industrie PC sorgt mit der optionalen integrierten USV dafür, dass das PC System auch nach einem Spannungsausfall Schreibvorgänge zu Ende führen kann. Erkennt die USV einen Spannungsausfall wird unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Alle laufenden Programme werden durch die USV Software korrekt beendet. Inkonsistente Daten sind damit ausgeschlossen (funktioniert nur wenn die USV bereits konfiguriert wurde und der Treiber aktiviert ist).

Information:

- Das Panel / der Monitor wird von der USV nicht gepuffert und fällt somit bei einem Stromausfall aus.
- Genauere Informationen zur Unterbrechungsfreien Stromversorgung können im USV-Anwenderhandbuch (der externen USV) nachgelesen werden. Dieses kann von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Durch die Integration der Ladeschaltung in das Gehäuse des B&R Industrie PC, reduziert sich die Installation auf das Anschließen des Verbindungskabels zur Batterieeinheit die neben dem PC montiert wird.

Bei der Konstruktion der Batterieeinheit wurde auf die Wartungsfreundlichkeit besonderer Wert gelegt. Die Batterien sind frontseitig optimal zugänglich und im Servicefall in wenigen Augenblicken getauscht.

3.10.1 Was wird benötigt

- Eine passende Systemeinheit
- USV IF Option 5AC901.IUPS-00 bzw. 5AC901.IUPS-01
- Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 bzw. 5AC901.BUPS-01
- USV Verbindungskabel 0,5 Meter (5CAUPS.0005-01), 1 Meter (5CAUPS.0010-01) oder 3 Meter (5CAUPS.0030-01)
- Parametrierung der B&R USV mittels ADI Control Center

Warnung!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 darf ausschließlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-00 betrieben werden!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 darf ausschließlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-01 betrieben werden!

Information:

Informationen zur Montage und zum Anschluss an die USV IF Option sind dem Abschnitt "Montage & Anschluss der USV Batterieeinheit" auf Seite 149 zu entnehmen.

3.10.2 5AC901.IUPS-00

3.10.2.1 Allgemeines

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-00 ermöglicht in Kombination mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 ein gesichertes Abschalten des B&R Industrie PC ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.

Die USV Interface Option 5AC901.IUPS-00 kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

Warnung!

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-00 darf ausschließlich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 betrieben werden!

Information:

Befindet sich das System im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk) lädt die interne USV Interface Option die angeschlossene Batterieeinheit. Bei diesem Vorgang sind die internen Versorgungen des Systems aktiv. Dadurch ist die Ausführung diverser Aktionen möglich (z.B. lässt sich die Schublade des eingebauten Slide-in DVD-Laufwerks öffnen).

3.10.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC901.IUPS-00	USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900; für 4,5 Ah Batterie.	
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC901.BUPS-00	Batterieeinheit 4,5 Ah; für USV 5AC901.IUPS-00.	
5CAUPS.0005-01	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0010-01	USV Kabel 1 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0030-01	USV Kabel 3 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	

Tabelle 117: 5AC901.IUPS-00 - Bestelldaten

3.10.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.IUPS-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$D851
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	max. 30 Watt bei 1,0 A
Tiefentladeschutz	Ja
kurzschlussfest	Ja ²⁾
Ladekennndaten Batterie	
Ladestrom	typ. 1 A
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C ³⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C

Tabelle 118: 5AC901.IUPS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.IUPS-00
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 28 g

Tabelle 118: 5AC901.IUPS-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) Die Interface Option ist kurzschlussfest. Diese Angabe gilt nicht für die angeschlossene Batterieinheit.
- 3) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.10.2.3.1 USV Schnittstelle

USV Schnittstelle	
Pin	Belegung
1	Temperatursensor
2	Temperatursensor
3	-
4	+

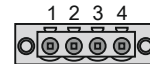


Tabelle 119: 5AC901.IUPS-00 / -01 - Pinbelegung

3.10.2.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Abschnitt "Montage Interface Option" auf Seite 134 zu finden.

3.10.3 5AC901.IUPS-01

3.10.3.1 Allgemeines

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-01 ermöglicht in Kombination mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 ein gesichertes Abschalten des B&R Industrie PC ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.

Die USV Interface Option 5AC901.IUPS-01 kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

Warnung!

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-01 darf ausschließlich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 betrieben werden!

Information:

Befindet sich das System im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk) lädt die interne USV Interface Option die angeschlossene Batterieeinheit. Bei diesem Vorgang sind die internen Versorgungen des Systems aktiv. Dadurch ist die Ausführung diverser Aktionen möglich (z.B. lässt sich die Schublade des eingebauten Slide-in DVD-Laufwerks öffnen).

3.10.3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC901.IUPS-01	USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900; für 2,2 Ah Batterie.	
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC901.BUPS-01	Batterieeinheit 2,2 Ah; für USV 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0005-01	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0010-01	USV Kabel 1 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0030-01	USV Kabel 3 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	

Tabelle 120: 5AC901.IUPS-01 - Bestelldaten

3.10.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC901.IUPS-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$DF84
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	max. 25 Watt bei 0,9 A
Tiefentladeschutz	Ja
kurzschlussfest	Ja ²⁾
Ladekennndaten Batterie	
Ladestrom	typ. 0,88 A
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C ³⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C

Tabelle 121: 5AC901.IUPS-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.IUPS-01
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 28 g

Tabelle 121: 5AC901.IUPS-01 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) Die Interface Option ist kurzschlussfest. Diese Angabe gilt nicht für die angeschlossene Batterieinheit.
- 3) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.10.3.3.1 USV Schnittstelle

USV Schnittstelle	
Pin	Belegung
1	Temperatursensor
2	Temperatursensor
3	-
4	+

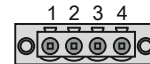


Tabelle 122: 5AC901.IUPS-00 / -01 - Pinbelegung

3.10.3.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Abschnitt "Montage Interface Option" auf Seite 134 zu finden.

3.10.4 5AC901.BUPS-00

3.10.4.1 Allgemeines

- Batterieeinheit für USV IF Option 5AC901.IUPS-00
- Single Cell Akku
- 2 Hawker Cyclon 12 V 4,5 Ah Akkus in Serie geschaltet
- Nennspannung 24 V
- Kapazität 4,5 Ah

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) erneuert werden.

Warnung!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 darf ausschließlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-00 betrieben werden!

3.10.4.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC901.BUPS-00	Batterieeinheit 4,5 Ah; für USV 5AC901.IUPS-00.	
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5CAUPS.0005-01	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0010-01	USV Kabel 1 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0030-01	USV Kabel 3 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	

Tabelle 123: 5AC901.BUPS-00 - Bestelldaten

3.10.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.BUPS-00
Allgemeines	
Batterie	
Typ	Hawker Cyclon 12 V 4,5 Ah; zwei Akkumulatoren in Serie geschaltet
Lebensdauer	bis zu 15 Jahre ¹⁾
Ausführung	Single Cell
Temperatursensor	NTC Widerstand
Wartungsintervall bei Lagerung	alle 6 Monate 1 mal laden
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ²⁾
GOST-R	Ja
Ladedauer bei Low Battery	typ. 7 Stunden
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 V
Kapazität	4,5 Ah
Sicherung	Ja
Ladekennndaten Batterie	
Ladestrom ³⁾	typ. 1 A
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-30 bis 60°C ⁴⁾
Lagerung	-65 bis 80°C
Transport	-65 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m

Tabelle 124: 5AC901.BUPS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.BUPS-00
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	223,2 mm
Höhe	78,2 mm
Tiefe	145 mm
Gewicht	ca. 4600 g

Tabelle 124: 5AC901.BUPS-00 - Technische Daten

- 1) Abhängig von der Umgebungstemperatur und den Lade- und Entladezyklen.
- 2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 3) Maximaler Ladestrom.
- 4) Wird die minimale bzw. maximale Temperatur unter- bzw. überschritten, ist die Pufferbereitschaft der Batterieeinheit nicht mehr gegeben. Die Batterieeinheit wird auch nicht mehr geladen, da dies zu einer Beschädigung der Batterie führen kann.

3.10.4.4 Abmessungen

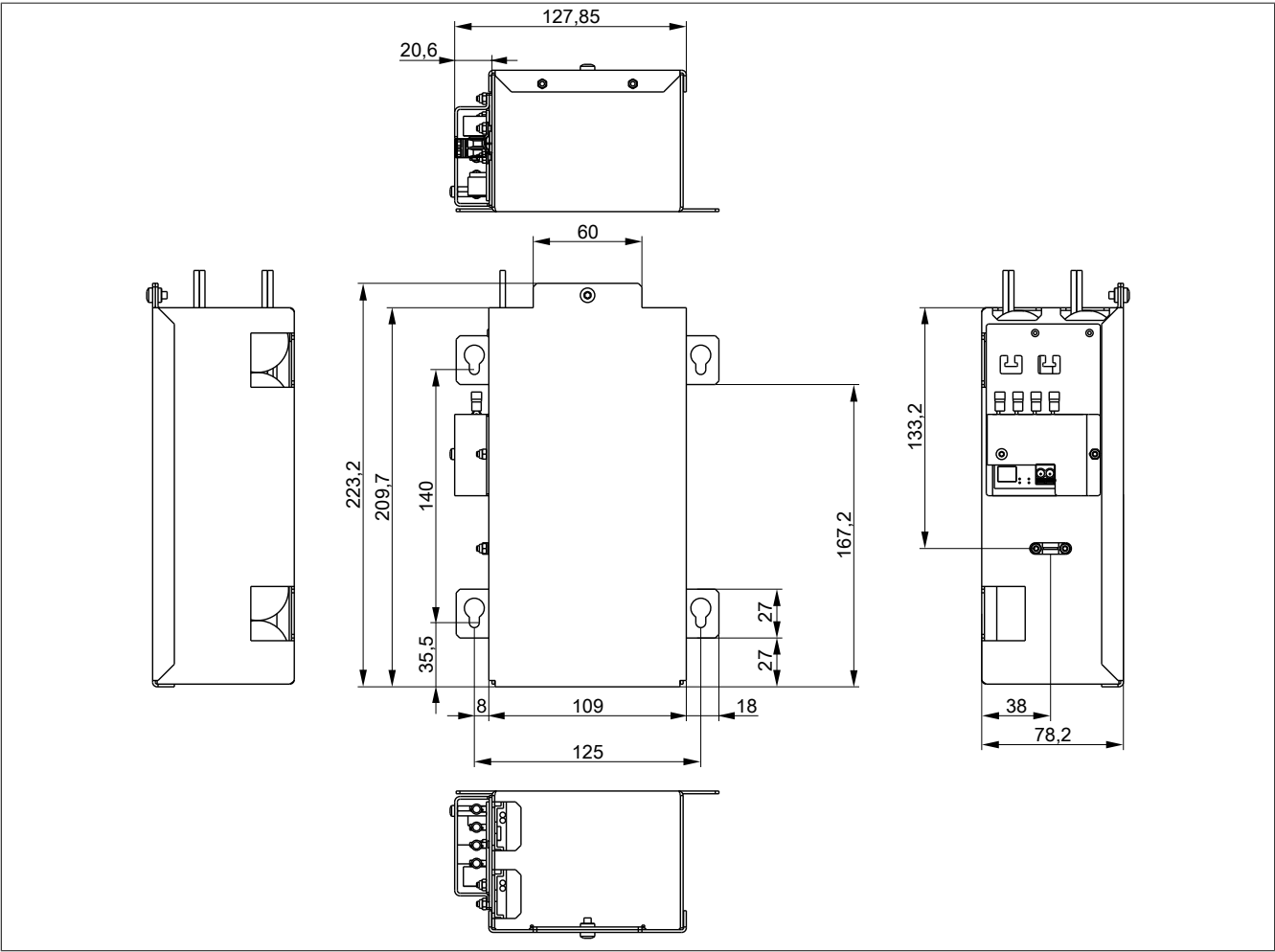


Abbildung 46: 5AC901.BUPS-00 - Abmessungen

3.10.4.5 Bohrschablone

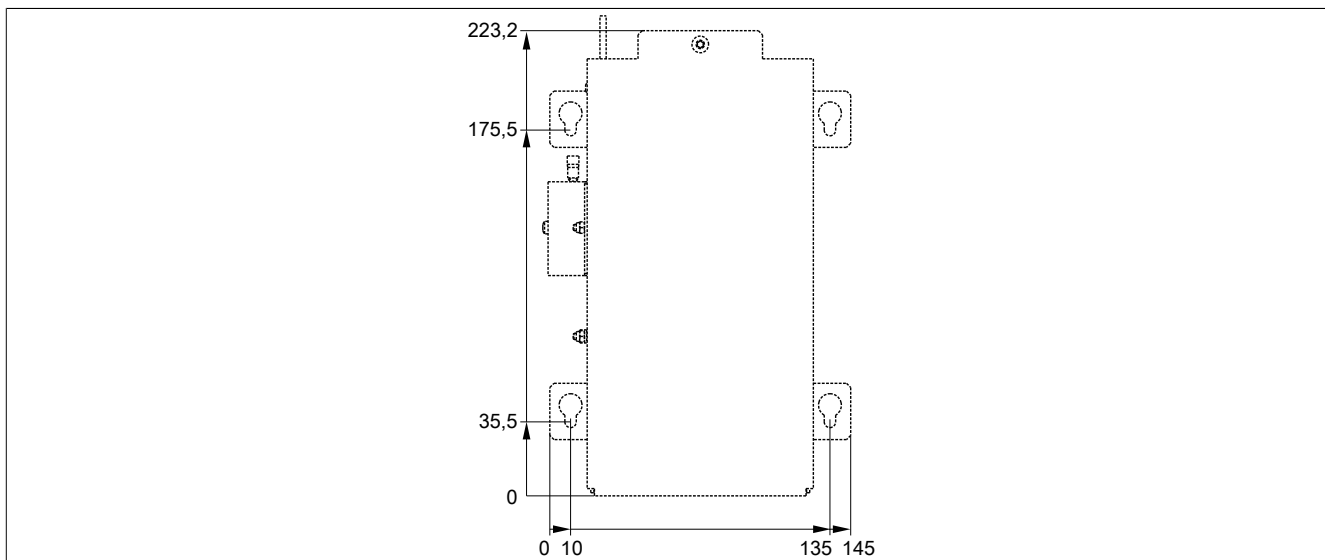


Abbildung 47: 5AC901.BUPS-00 - Bohrschablone

3.10.4.6 Montage

Informationen zur Montage und zum Anschluss an die USV IF Option sind dem Abschnitt "Montage & Anschluss der USV Batterieeinheit" auf Seite 149 zu entnehmen.

3.10.4.7 Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung und Gebrauch

Bei Verschütten oder Auslaufen:

Das weitere Auslaufen von Flüssigkeit muss verhindert werden. Kleinere Austritte müssen mit trockenem Sand, Erde und Vermiculit gebunden werden. Es dürfen keine brennbaren Materialien verwendet werden. Wenn möglich die Säure mit Soda, Natron, Kalk, etc. neutralisieren. Es müssen säurebeständige Kleider, Schuhe, Handschuhe sowie säurebeständiger Gesichtsschutz getragen werden. Das Entsorgen von unneutralisierter Säure in die Kanalisation ist verboten!

Abfallentsorgung:

Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren müssen einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden. Neutralisierter Schlamm muss in geschlossenen Behältern gelagert und nach den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen gelagert und entsorgt werden. Große mit Wasser verdünnte Austritte müssen nach der Neutralisation und Prüfung nach den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen entsorgt werden.

Handhabung und Lagerung:

- in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen mit undurchlässigen Oberflächen und angemessener Sicherheitshülle im Falle von auslaufender Flüssigkeit lagern
- vor widrigen Witterungsbedingungen und getrennt von unverträglichen Materialien lagern und transportieren
- es muss sich eine ausreichende Wasserversorgung in der näheren Umgebung befinden
- Schäden an den Containern, in denen die Batterien und Akkumulatoren gelagert und transportiert werden sind zu vermeiden
- vor Feuer, Funken und Hitze fern halten

3.10.5 5AC901.BUPS-01

3.10.5.1 Allgemeines

- Batterieeinheit für USV IF Option 5AC901.IUPS-01
- Wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- 2 Panasonic 12 V 2,2 Ah Akkus in Serie geschaltet
- Nennspannung 24 V
- Kapazität 2,2 Ah

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) erneuert werden.

Warnung!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 darf ausschließlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-01 betrieben werden!

3.10.5.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC901.BUPS-01	Batterieeinheit 2,2 Ah; für USV 5AC901.IUPS-01.	
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5CAUPS.0005-01	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0010-01	USV Kabel 1 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0030-01	USV Kabel 3 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	

Tabelle 125: 5AC901.BUPS-01 - Bestelldaten

3.10.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.BUPS-01
Allgemeines	
Batterie	
Typ	Panasonic 12 V 2,2 Ah; zwei Akkumulatoren in Serie geschaltet
Lebensdauer	bis zu 5 Jahre ¹⁾
Ausführung	Wartungsfreier Blei-Gel-Akkumulator
Temperatursensor	NTC Widerstand
Wartungsintervall bei Lagerung	alle 6 Monate 1 mal laden
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ²⁾
GOST-R	Ja
Ladedauer bei Low Battery	typ. 5 Stunden
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 V
Kapazität	2,2 Ah
Sicherung	ja
Ladekenndaten Batterie	
Ladestrom ³⁾	typ. 0,88 A
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 40°C ⁴⁾
Lagerung	-15 bis 40°C
Transport	-15 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	25 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung	25 bis 85%, nicht kondensierend
Transport	25 bis 85%, nicht kondensierend
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m

Tabelle 126: 5AC901.BUPS-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC901.BUPS-01
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	188 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	ca. 2550 g

Tabelle 126: 5AC901.BUPS-01 - Technische Daten

- 1) Abhängig von der Umgebungstemperatur und den Lade- und Entladezyklen.
- 2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 3) Maximaler Ladestrom.
- 4) Wird die minimale bzw. maximale Temperatur unter- bzw. überschritten, ist die Pufferbereitschaft der Batterieeinheit nicht mehr gegeben. Die Batterieeinheit wird auch nicht mehr geladen, da dies zu einer Beschädigung der Batterie führen kann.

3.10.5.4 Abmessungen

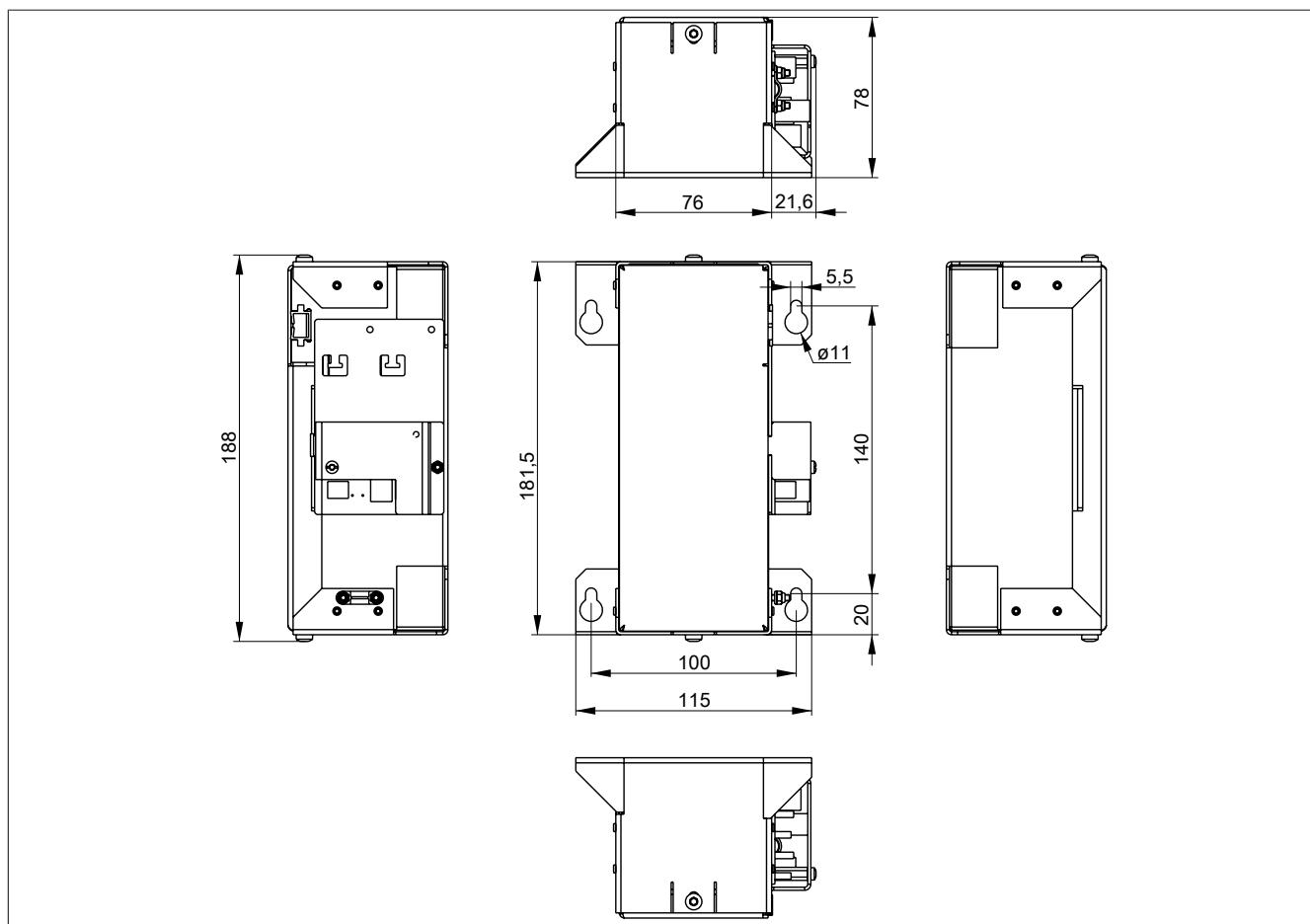


Abbildung 48: 5AC901.BUPS-01 - Abmessungen

3.10.5.5 Bohrschablone

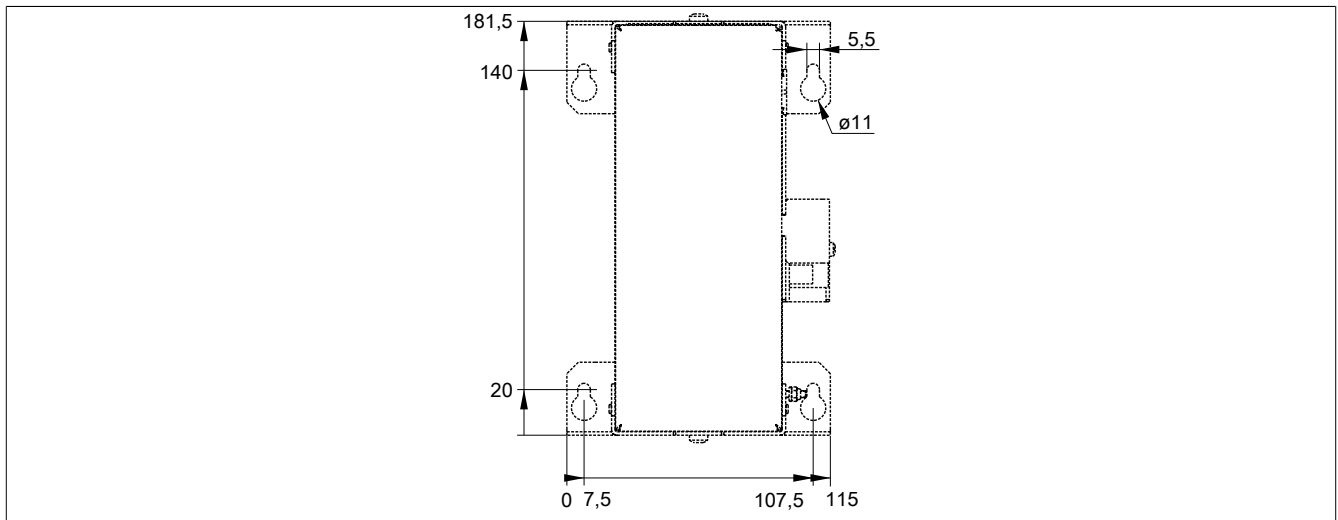


Abbildung 49: 5AC901.BUPS-01 - Bohrschablone

3.10.5.6 Montage

Informationen zur Montage und zum Anschluss an die USV IF Option sind dem Abschnitt "Montage & Anschluss der USV Batterieeinheit" auf Seite 149 zu entnehmen.

3.10.5.7 Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung und Gebrauch

Bei Verschütten oder Auslaufen:

Das weitere Auslaufen von Flüssigkeit muss verhindert werden. Kleinere Austritte müssen mit trockenem Sand, Erde und Vermiculit gebunden werden. Es dürfen keine brennbaren Materialien verwendet werden. Wenn möglich die Säure mit Soda, Natron, Kalk, etc. neutralisieren. Es müssen säurebeständige Kleider, Schuhe, Handschuhe sowie säurebeständiger Gesichtsschutz getragen werden. Das Entsorgen von unneutralisierter Säure in die Kanalisation ist verboten!

Abfallentsorgung:

Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren müssen einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden. Neutralisierter Schlamm muss in geschlossenen Behältern gelagert und nach den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen gelagert und entsorgt werden. Große mit Wasser verdünnte Austritte müssen nach der Neutralisation und Prüfung nach den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen entsorgt werden.

Handhabung und Lagerung:

- in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen mit undurchlässigen Oberflächen und angemessener Sicherheitshülle im Falle von auslaufender Flüssigkeit lagern
- vor widrigen Witterungsbedingungen und getrennt von unverträglichen Materialien lagern und transportieren
- es muss sich eine ausreichende Wasserversorgung in der näheren Umgebung befinden
- Schäden an den Containern, in denen die Batterien und Akkumulatoren gelagert und transportiert werden sind zu vermeiden
- vor Feuer, Funken und Hitze fern halten

3.10.6 5CAUPS.xxxx-01

3.10.6.1 Allgemeines

Das USV Verbindungskabel stellt die Verbindung zwischen der USV Interface Option und der Batterieeinheit her.

3.10.6.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5CAUPS.0005-01	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0010-01	USV Kabel 1 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	
5CAUPS.0030-01	USV Kabel 3 m; für USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01.	

Tabelle 127: 5CAUPS.0005-01, 5CAUPS.0010-01, 5CAUPS.0030-01 - Bestelldaten

3.10.6.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAUPS.0005-01		5CAUPS.0010-01	5CAUPS.0030-01
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	Ja			
cULus	Ja			
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾			
GOST-R	Ja			
Kabelaufbau				
Drahtquerschnitt	2x 0,5 mm ² (AWG 20) 2x 2,5 mm ² (AWG 13)			
Leiterwiderstand	bei 0,5 mm ² max. 39 Ω/km bei 2,5 mm ² max. 7,98 Ω/km ²⁾			
Außenmantel				
Material	thermoplastischer Kunststoff auf PVC Basis			
Farbe	fenstergrau (ähnlich RAL 7040)			
Steckverbindung				
Typ	Schraubklemme 4-polig ³⁾			
Elektrische Eigenschaften				
Betriebsspannung	max. 30 VDC			
Betriebsspitzenspannung	typ. 30 VDC			
Prüfspannung	1500 V			
Ader/Ader				
Strombelastbarkeit	10 A bei 20°C			
Umgebungsbedingungen				
Temperatur				
bewegt	-5 bis 70°C			
ruhend	-30 bis 70°C			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Länge	0,5 m	1 m	3 m	
Durchmesser		7 mm		
Biegeradius	10x Leitungsdurchmesser			
bewegt	5x Leitungsdurchmesser			
feste Verlegung				
Gewicht	ca. 55 g	ca. 100 g	ca. 250 g	

Tabelle 128: 5CAUPS.0005-01, 5CAUPS.0010-01, 5CAUPS.0030-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.

3) Anzugsdrehmoment: min. 0,4 Nm; max. 0,5 Nm

Information:

Die maximale Länge des USV Verbindungskables ist abhängig von:

- Leistung
- Spannungsabfall
- Drahtquerschnitt
- Fühlerleitung

3.10.6.4 Montage

Informationen zum Anschließen des Kabels an die Batterieeinheit sind dem Abschnitt "Montage & Anschluss der USV Batterieeinheit" auf Seite 149 zu entnehmen.

3.11 Netzteil

3.11.1 5AC902.PS00-00

3.11.1.1 Allgemeines

Das AC Netzteil kann optional an den Panel PC erweitert werden um ihn mit 100~240 VAC zu betreiben.

3.11.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Netzteil	
5AC902.PS00-00	PPC900 Netzteil 85-264 VAC	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB3103.8000	Steckverbinder, 230 VAC, 3-polig female, Schraubklemme 4 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 129: 5AC902.PS00-00 - Bestelldaten

3.11.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC902.PS00-00
Allgemeines	
Power-Taster	Ja
Zertifizierungen	
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Eingang	
Eingangsnennspannung	100 bis 240 VAC
Frequenz	45 bis 65 Hz
Einschaltstrom	< 20 A (bei Kaltstart, 100% Last und 100 VAC)
Netzausfallüberbrückung	> 10 ms (bei 100 VAC und 230 VAC)
Interne Sicherung	Ja
Ausgang	
Nennspannung	24 VDC ±10%
Ausgangsstrom 0 bis 55°C	5,5 A ²⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Stahlblech
Lackierung	Anthrazit
Abmessungen	
Breite	73,5 mm
Höhe	225,5 mm
Tiefe	53,5 mm
Gewicht	580 g

Tabelle 130: 5AC902.PS00-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Bei 0 bis 55°C Umgebungstemperatur und Nominalspannung.

3.11.1.4 Montage

Informationen zur Montage des Netzteils sind dem Abschnitt "AC Netzteil Einbau bzw. Tausch" auf Seite 130 zu entnehmen.

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Gefahr!

- Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Komponenten des Geräts entnommen und Zubehör, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt werden.
- Das Netzkabel vom Gerät und von der Spannungsversorgung entfernen.
- Bevor das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, müssen alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehör, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt sein.

1.1 Montage Panel PC 900

Der Panel PC 900 wird mithilfe von Halteklammern im Einbauausschnitt montiert. Die Anzahl der Halteklammern ist von der Displayeinheit abhängig.

Einbauhinweise

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- Beim Einbau in ein geschlossenes Gehäuse, muss ausreichend Volumen zur Luftumwälzung vorhanden sein.
- Das Gerät muss auf planer, sauberer und gratfreier Oberfläche montiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.
- Das Gerät muss so montiert werden, dass Reflexionen auf dem Bildschirm weitestgehend vermieden werden.
- Das Gerät muss so montiert werden, dass es vom Anwender optimal einsehbar ist.

Die Materialstärke der Wand bzw. des Schaltschrankblechs muss mindestens 1 mm und darf maximal 6 mm betragen.

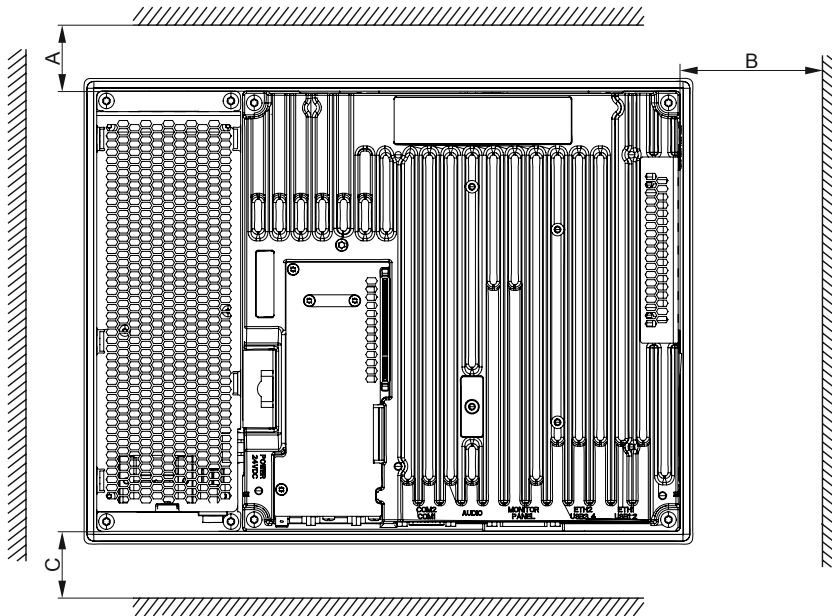
Für das Anziehen bzw. Lösen der Schraube der Halteklammer wird ein Sechskant-Schraubendreher benötigt. Das maximale Anzugsmoment der Halteklammer beträgt 1 Nm.

Das Gerät muss an einer planen, sauberen und gratfreien Oberfläche montiert werden da Unebenheiten beim Anziehen der Schrauben zu Beschädigungen des Displays und zum Eindringen von Staub und Wasser führen können.

Information:

Um den Panel PC 900 an der Rückseite uneingeschränkt bedienen und warten zu können, müssen Freiräume an den Seiten (A, B, C in der Abbildung unten) des PPC eingehalten werden. Die Freiräume sind abhängig von der Konfiguration des Panel PC 900 sowie dem Bedien-/ Servicepersonal.

- Der Freiraum "A" ist notwendig für den Tausch des Lüfter Kit und des Lüfterfilters.
- Der Freiraum "B" ist notwendig für den Zugang zu den Status LEDs, den Power- und Reset-Button, den CFast Slot, das Slide-in compact Laufwerk sowie für das Slide-in DVD Laufwerk.
- Der Freiraum "C" ist notwendig für das An-/Abstecken von Kabeln sowie für die Einhaltung des Biegeradius der Kabel.



Vorgehensweise

1. Kontrollieren ob die mitgelieferten Befestigungsschrauben in den Halteklammern verschraubt sind. Ist dies nicht der Fall, so müssen die Befestigungsschrauben in die Halteklammern mit einem Sechskant-Schraubendreher geschraubt werden. Die Befestigungsschrauben dürfen nur soweit eingeschraubt werden, dass diese nicht über die Halteklammer hinausragen.

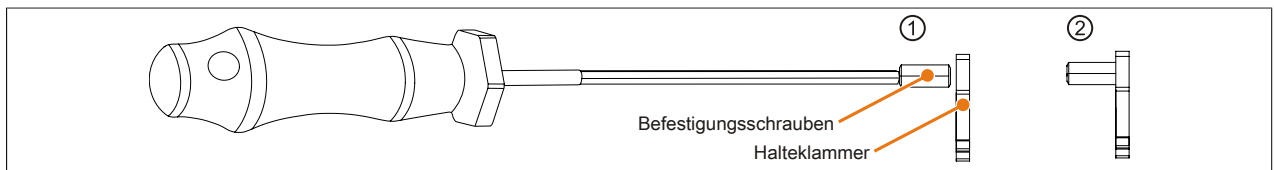


Abbildung 50: Halteklammern vorbereiten

2. Das Gerät frontseitig in den vorbereiteten, gratfreien und planen Einbuausschnitt einsetzen. Die Maße für den Einbuausschnitt sind dem Abschnitt "Einbauzeichnungen" auf Seite 23 zu entnehmen.

3. Die Halteklammern am Gerät montieren. Dazu alle Halteklammern in die Aussparungen (mit orangenen Kreisen markiert) am Gerät einsetzen. Die Anzahl der Halteklammern kann abhängig von der Displayeinheit variieren, die genaue Anzahl ist der Abb. 7 "Einbauzeichnung - Panel PC 900 + Netzteil + Buseinheiten" auf Seite 23 zu entnehmen.

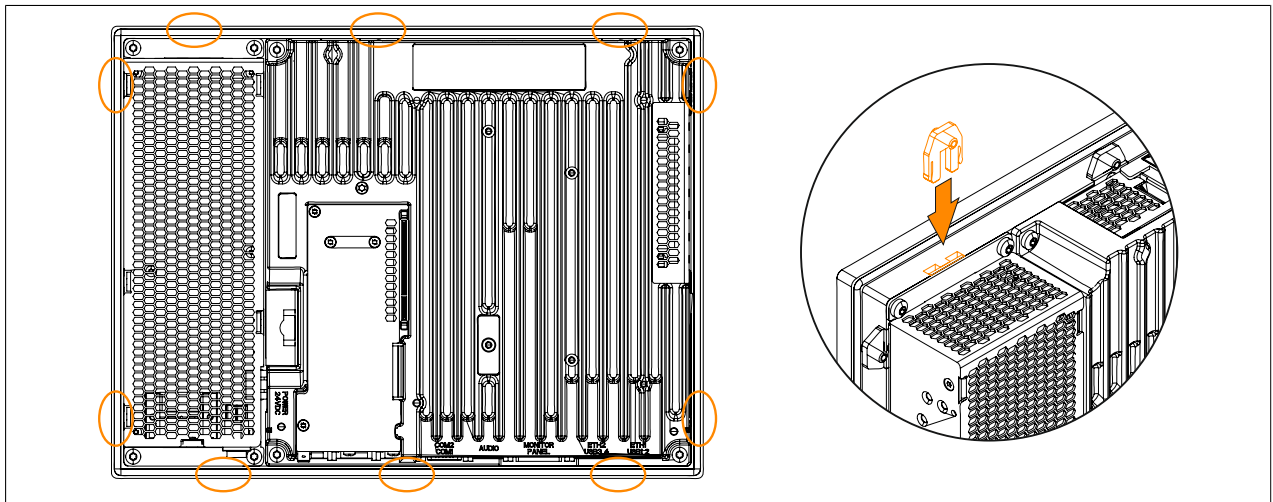


Abbildung 51: Halteklammern einsetzen (Symbolfoto)

4. Die Halteklammern nun durch wechselweises Festziehen der Befestigungsschrauben mit einem Sechskant-Schraubendreher an der Wand bzw. dem Schaltschrankblech fixieren. Das Anzugsmoment zur optimalen Abdichtung sollte max. 1 Nm betragen.

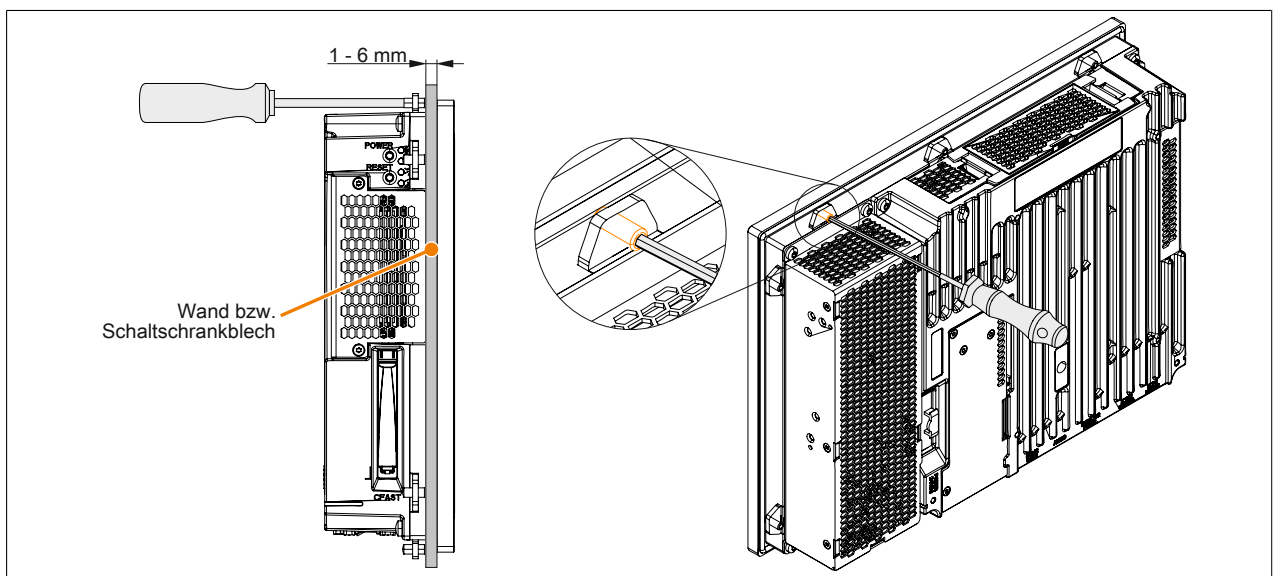


Abbildung 52: Halteklammern festschrauben

1.2 CPU Board & Systemeinheit Tausch

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.

Information:

Ist eine Buseinheit am Panel PC montiert muss diese zuerst entfernt werden.

3. Die in der nachfolgenden Abbildung markierten 4 Torxschrauben (T20) und 2 Torxschrauben (T10) müssen gelöst werden.

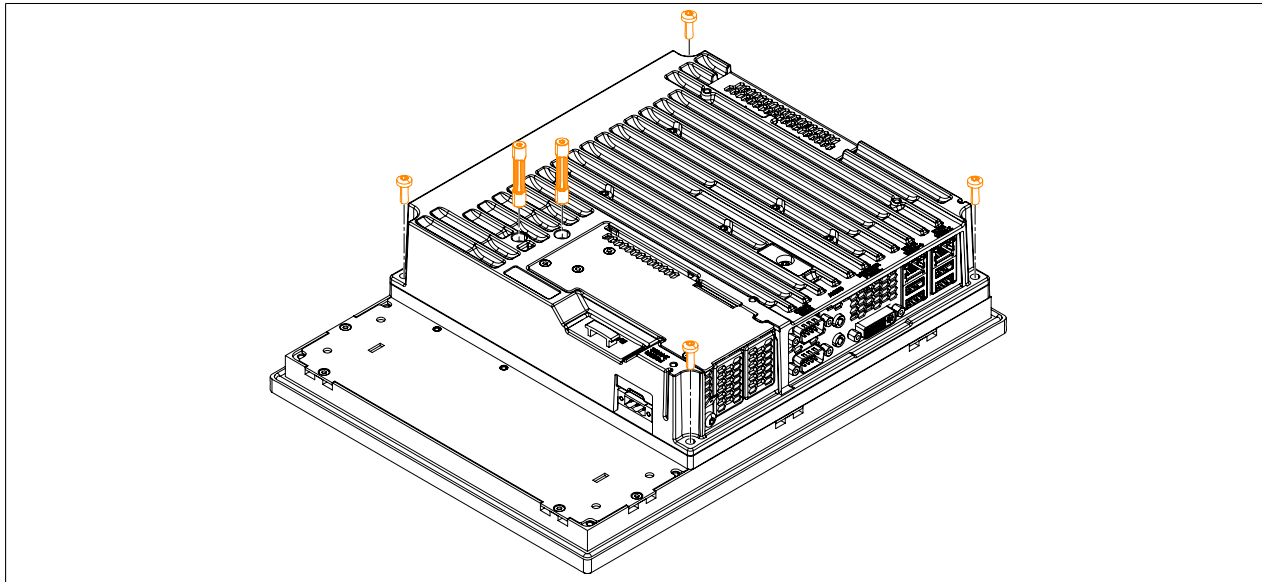


Abbildung 53: Torxschrauben der Systemeinheit lösen

4. Die Systemeinheit mit dem installierten CPU Board entfernen.

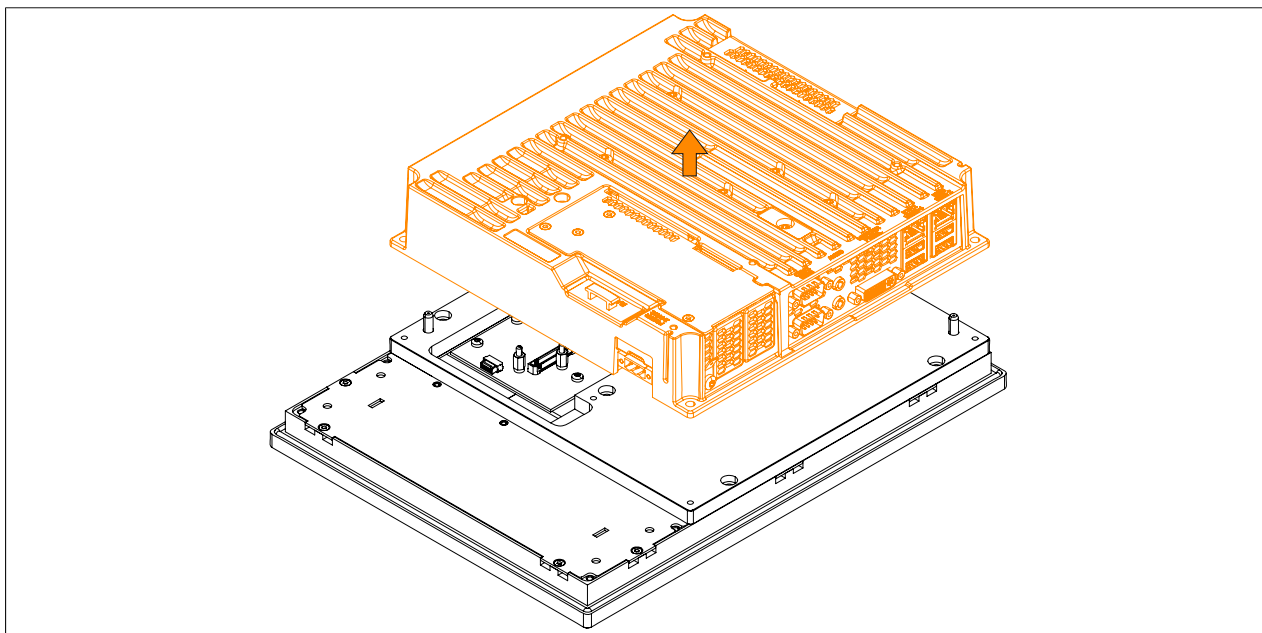


Abbildung 54: Systemeinheit & CPU Board entfernen

5. Es kann nun eine andere Systemeinheit mit bereits vormontiertem CPU Board an der Displayeinheit montiert werden. Die Montage funktioniert in umgekehrter Reihenfolge, das max. Anzugsmoment der Torxschrauben T10 beträgt 0,5 Nm, das der Torxschrauben T20 beträgt 1,2 Nm.
Es ist darauf zu achten, dass die Systemeinheit richtig montiert wird. Der Stecker für den Displayanschluss muss vorsichtig in die Buchse an der Displayeinheit gesteckt werden!

6. Wird der Panel PC 900 in ein Automation Panel 9x3 umgebaut, muss auch die Montageplatte entfernt werden. Dazu die 5 markierten Torxschrauben (T20) lösen.

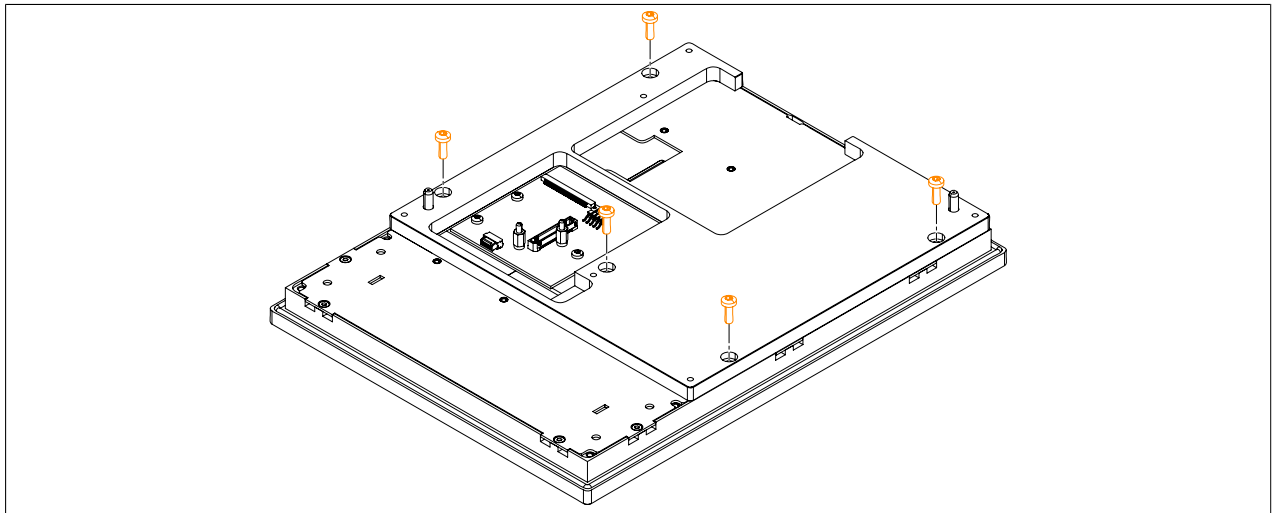


Abbildung 55: Torxschrauben der Montageplatte lösen

7. Die Montageplatte von der Displayeinheit entfernen.

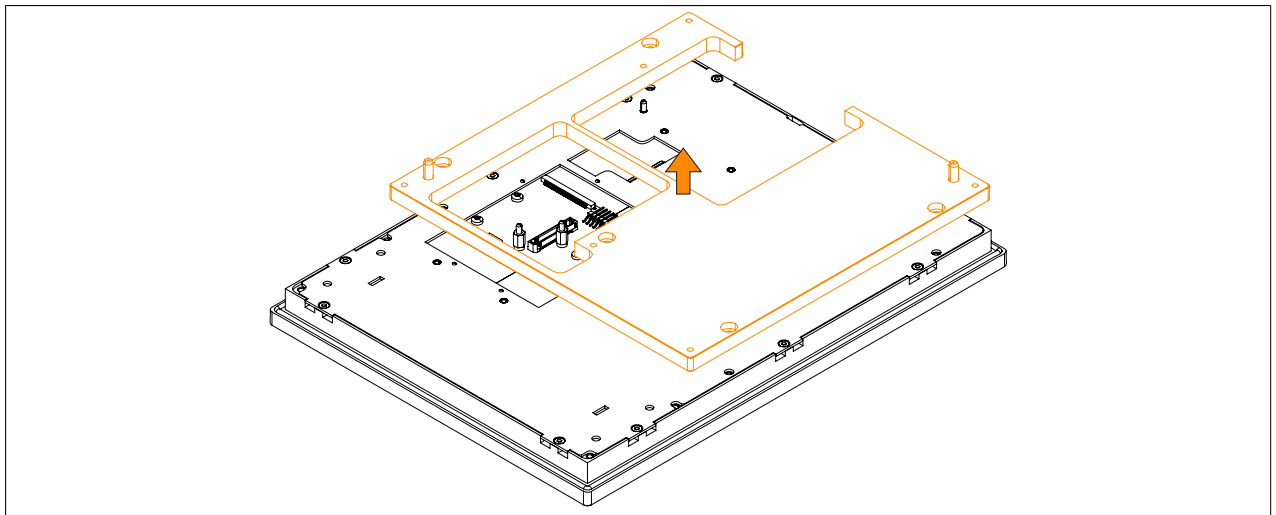


Abbildung 56: Montageplatte entfernen

8. Die Montage der Montageplatte funktioniert in umgekehrter Reihenfolge, das max. Anzugsmoment beträgt 1,2 Nm.
Es ist darauf zu achten, dass die Montageplatte richtig montiert wird.

1.3 AC Netzteil Einbau bzw. Tausch

1. Der Ein/Aus- Schalter muss auf Schalterstellung "0" (Aus) gestellt sein. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Den Panel PC aus dem Schaltschrank ausbauen: dabei in umgekehrter Reihenfolge wie in Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125 beschrieben vorgehen.
4. Den Panel PC auf eine saubere und plane Fläche legen.
5. Die in der nachfolgenden Abbildung markierten Torxschrauben (T20) müssen gelöst werden.

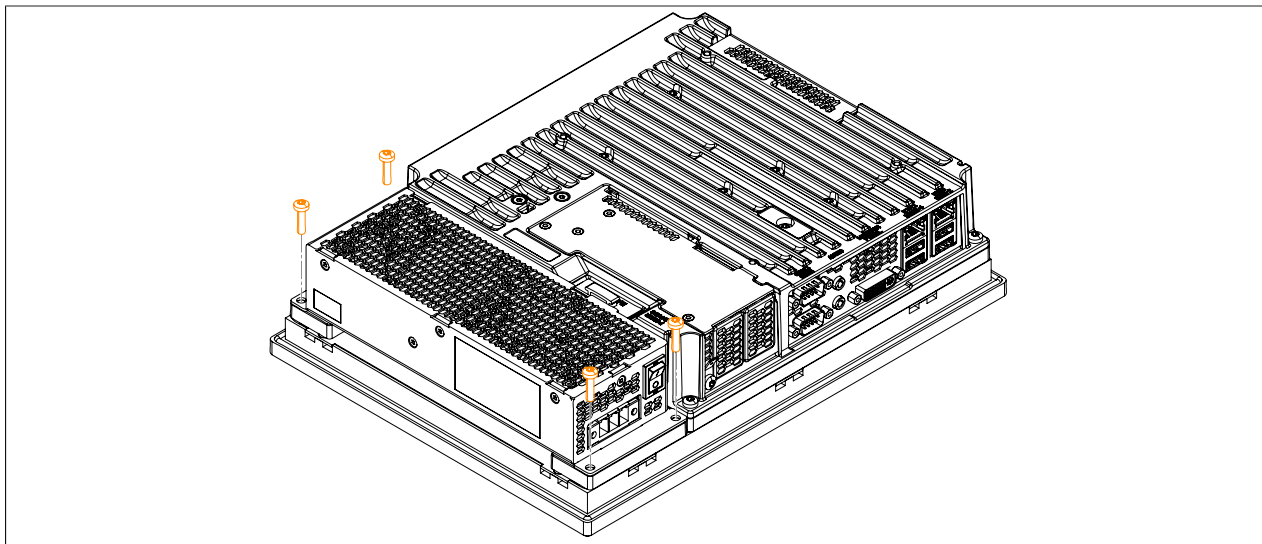


Abbildung 57: Schrauben entfernen

6. Das AC Netzteil kann nun parallel zum Panel PC in der dargestellten Pfeilrichtung entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Versorgungsstecker nicht beschädigt wird.

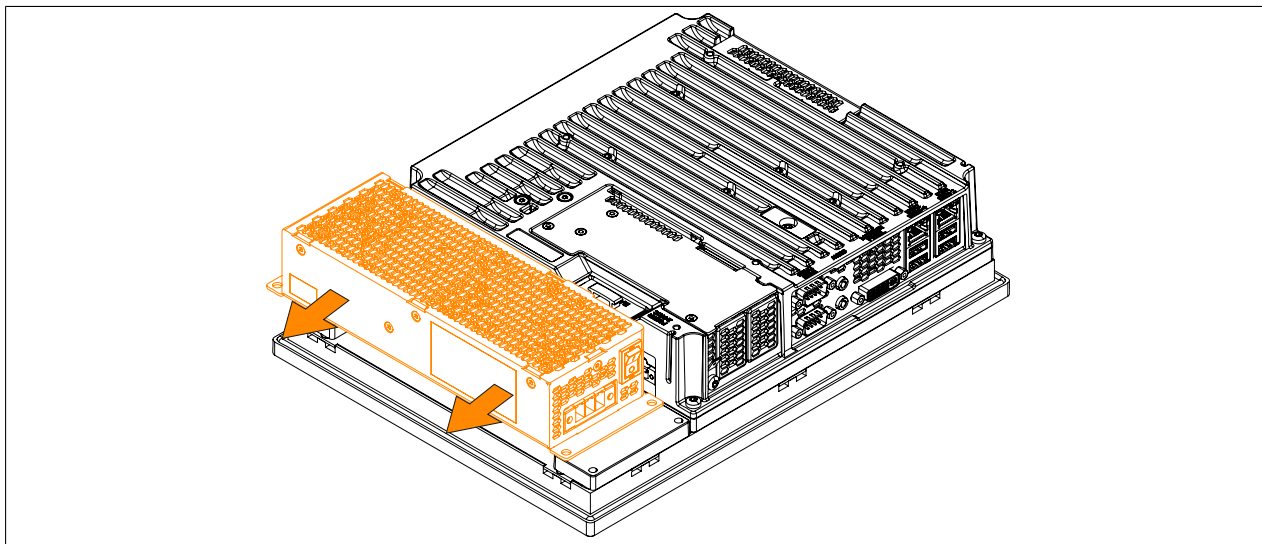


Abbildung 58: AC Netzteil tauschen

7. Wird ein AC Netzteil nicht getauscht sondern zum ersten Mal montiert, so müssen zuerst die beiden Montageplatten montiert werden. Dabei die Montageplatten leicht geneigt in die je 3 Buchsen führen. Die Montageplatten sind beim Lieferumfang des AC Netzteils enthalten.

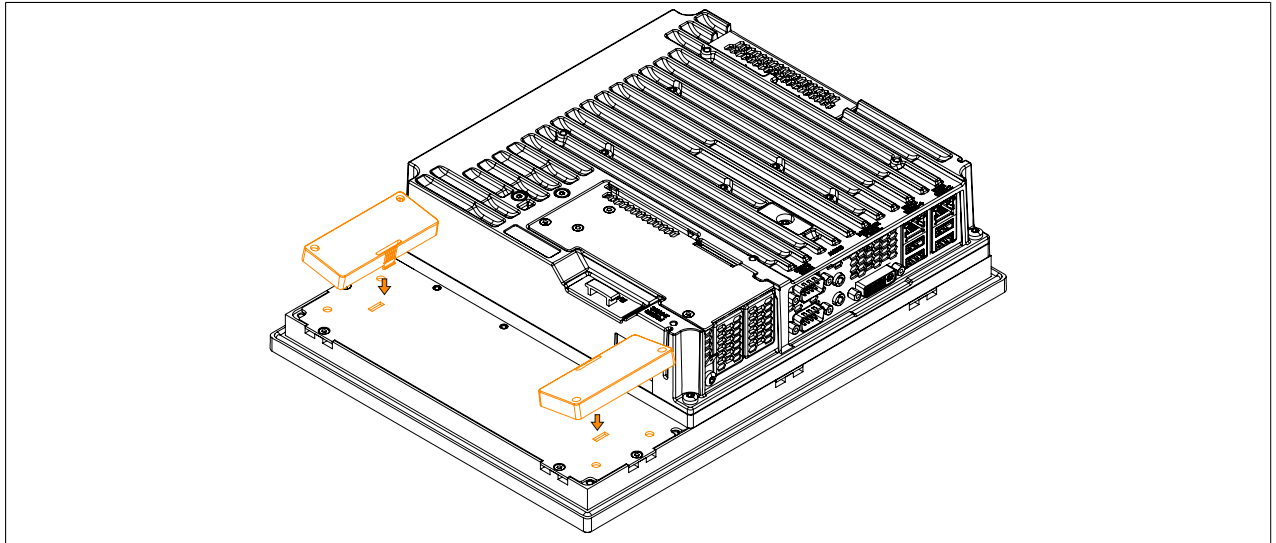


Abbildung 59: Montageplatte montieren

8. Wird ein AC Netzteil wieder am Panel PC montiert, muss dieses parallel zum Panel PC ausgerichtet werden. Es ist auf das anstecken des Netzteilsteckers an die Panel PC Buchse zu achten.
9. Anschließend kann das AC Netzteil mit den 4 Torxschrauben (T20) wieder befestigt werden (max. Anzugsmoment 1,2 Nm). Dabei ist auf eine parallele Ausrichtung des Gehäuses zu achten. Der Stecker des Netzteils muss in die Buchse des Panel PC einrasten. Es darf kein erhöhter Druck bzw. mechanische Belastung auf der Steckverbindung entstehen.

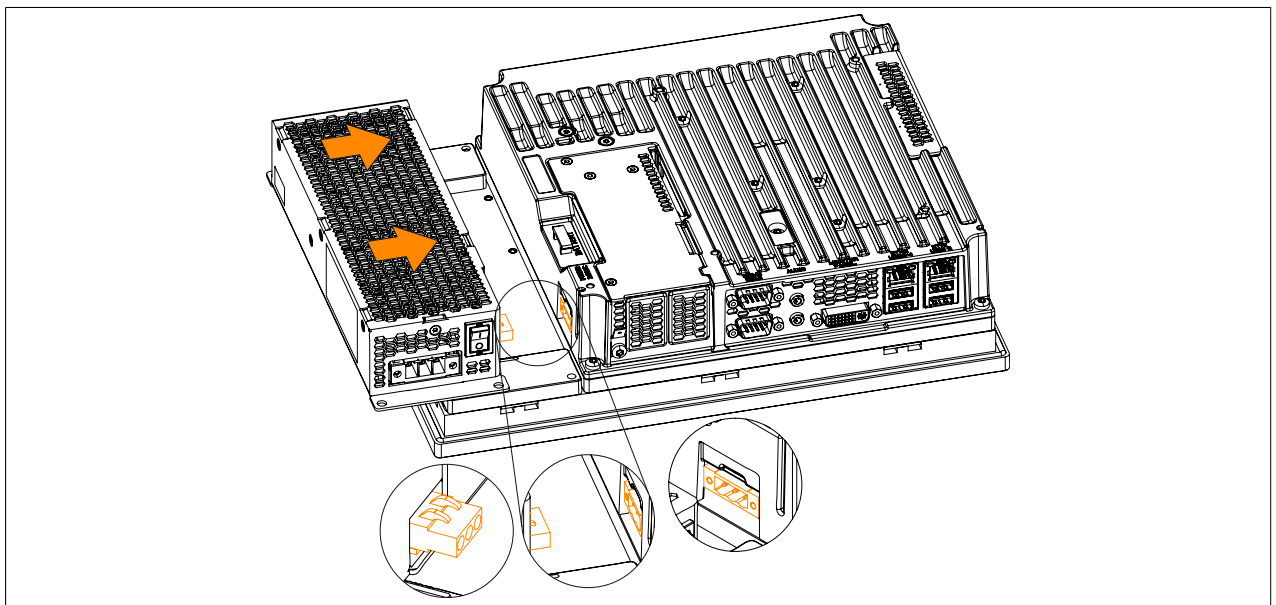


Abbildung 60: AC Netzteil montieren

10. Der Panel PC kann nun wieder in den Schaltschrank eingebaut werden, siehe dazu Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125.

1.4 Hauptspeicher Tausch

Information:

Der Panel PC besitzt 2 Steckplätze für Hauptspeicher. Einsetzbar sind ausschließlich folgende B&R Hauptspeicher:

- 5MMDDR.1024-03, 5MMDDR.2048-03, 5MMDDR.4096-03, 5MMDDR.8192-03

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Den Panel PC aus dem Schaltschrank ausbauen: dabei in umgekehrter Reihenfolge wie in Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125 beschrieben vorgehen.
4. Den Panel PC auf eine saubere und plane Fläche legen.
5. Die in der nachfolgenden Abbildung markierten Torxschrauben (T10) müssen gelöst werden.

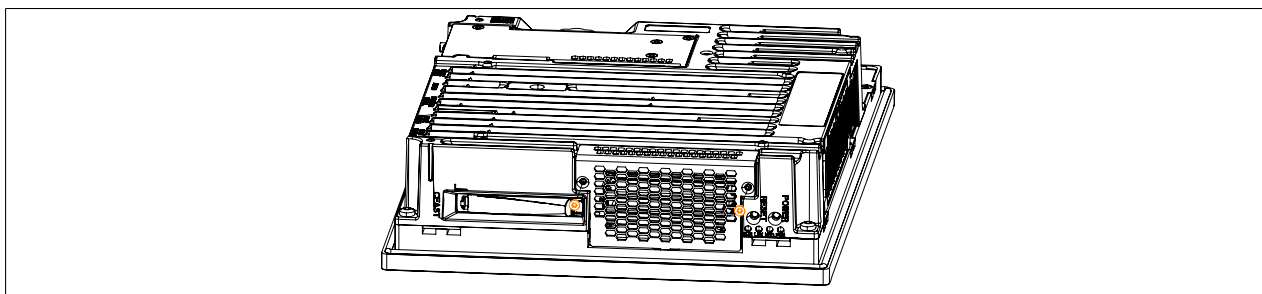


Abbildung 61: Torxschrauben lösen

6. Das Abdeckblech nach vorne kippen und durch Schieben nach oben entfernen.

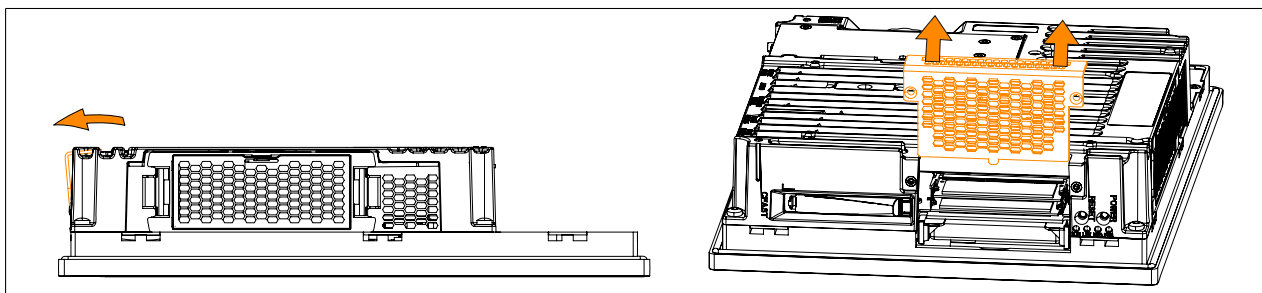


Abbildung 62: Abdeckblech entfernen

Information:

Der untere Hauptspeicher kann nur getauscht werden, wenn zuvor der obere entfernt wurde.

7. Die Hauptspeicher können nun getauscht werden. Dazu sind die beiden Befestigungsklammern vorsichtig nach außen zu drücken und der Hauptspeicher durch ziehen nach vorne zu entnehmen.

8. Wird wieder ein Hauptspeicher gesteckt ist vor dem Einsetzen auf die Aussparung an der Steckerseite des Hauptspeichers und die Nut beim Steckplatz zu achten. Den Hauptspeicher nun vorsichtig mit Druck in den Steckplatz drücken bis die Befestigungsklammern einrasten.

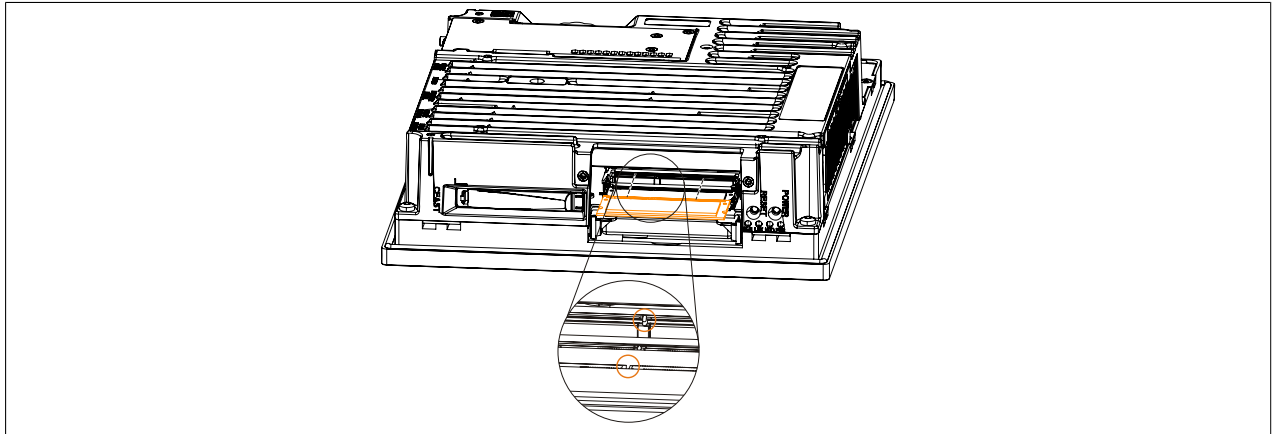
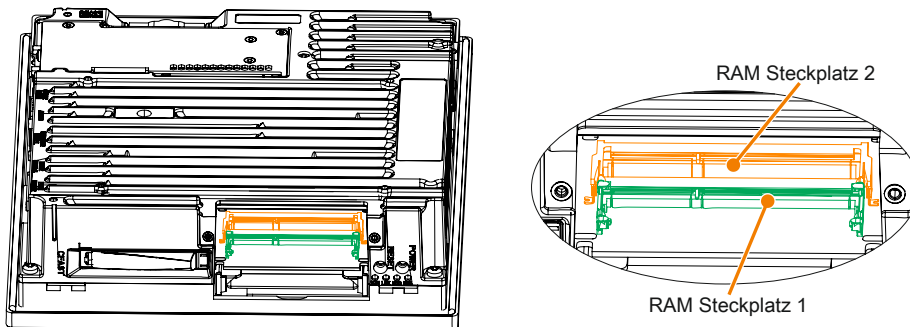


Abbildung 63: Hauptspeicher tauschen

Vorsicht!

Wird nur ein Hauptspeicher verwendet, muss dieser im RAM Steckplatz 2 montiert werden.



9. Das Abdeckblech kann nun in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert werden. Das max. Anzugsmoment der Torxschrauben T10 beträgt 0,5 Nm.
10. Der Panel PC kann nun wieder in den Schaltschrank eingebaut werden, siehe dazu Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125.

1.5 Montage Interface Option

Information:

Es ist darauf zu achten, dass nicht jede Interface Option in den Interface Slot 1 und 2 gesteckt werden kann. Genauere Informationen sind im Abschnitt "IF Option 1 Steckplatz" auf Seite 53 und "IF Option 2 Steckplatz" auf Seite 53 zu finden.

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.

Information:

Ist eine Buseinheit am Panel PC montiert muss diese zuerst entfernt werden.

3. Die in der nachfolgenden Abbildung mit ① markierten Torxschrauben (T10) müssen gelöst werden. Die mit ② markierten Torxschrauben sind nur zu lösen wenn bereits eine IF Option gesteckt ist.

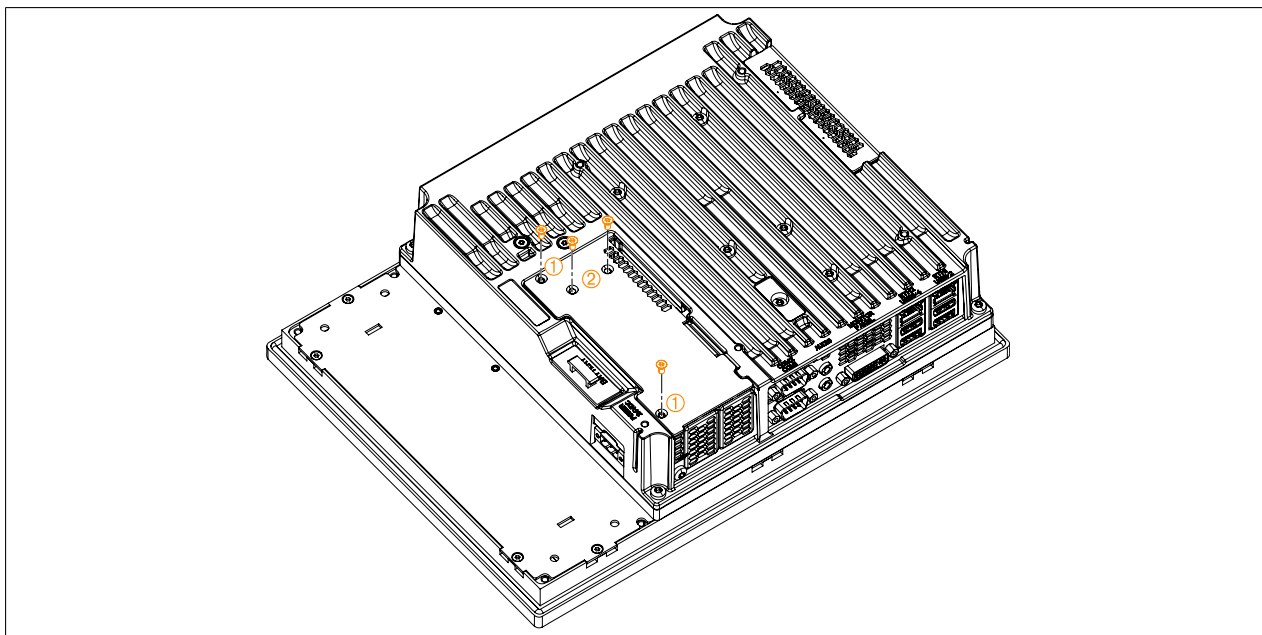


Abbildung 64: Torxschrauben des Abdeckblechs lösen

4. Das Abdeckblech schräg nach oben klappen und entfernen.

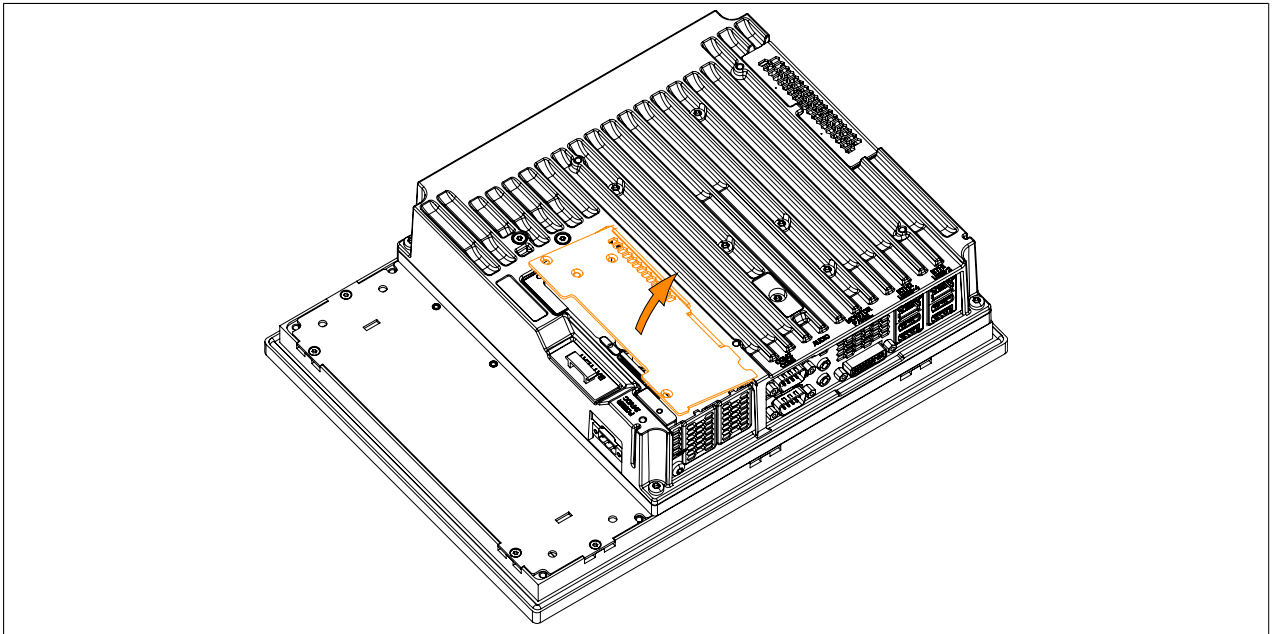


Abbildung 65: Abdeckblech entfernen

5. Die Blindabdeckung durch Schieben nach oben bzw. die gesteckte IF Option entfernen.

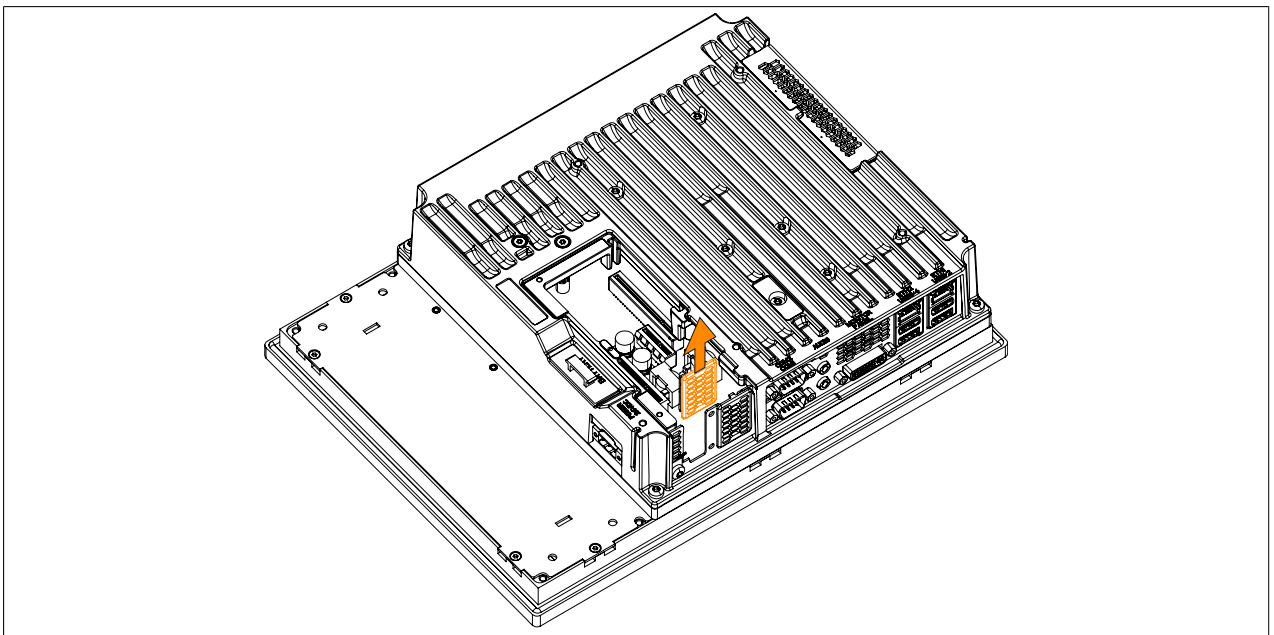


Abbildung 66: Torxschrauben und Blindabdeckung entfernen

6. Die Interface Option in den Slot stecken und mit 2 Torxschrauben (T10) am Panel PC montieren (max. Anzugsmoment 0,5 Nm).

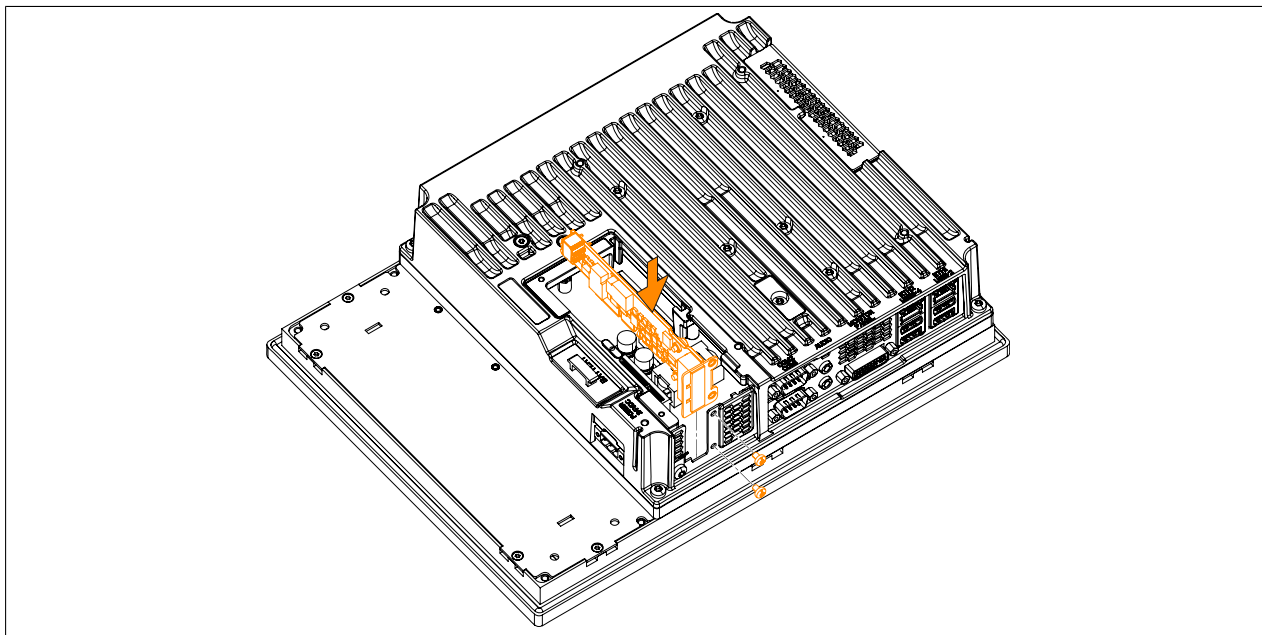


Abbildung 67: Interface Option einbauen und fixieren

7. Das Abdeckblech wieder montieren.

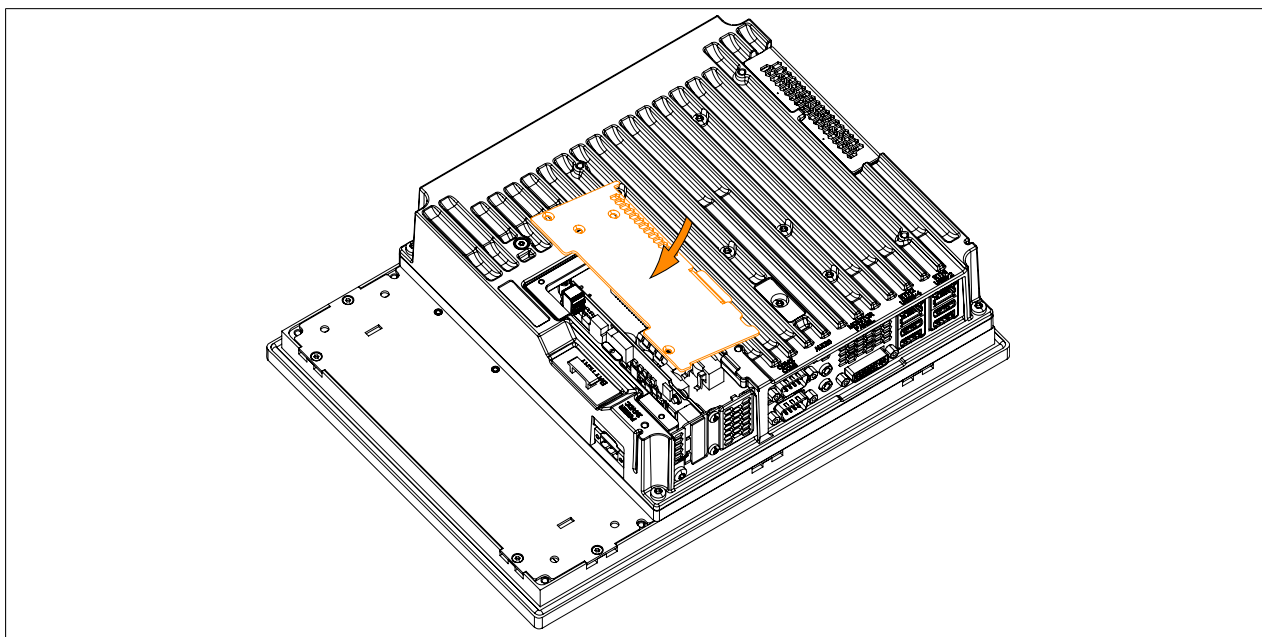


Abbildung 68: Abdeckblech montieren

8. Das Abdeckblech mit den zuvor gelösten Torxschrauben (T10) am B&R Industrie PC befestigen. Die mit ② markierten Torxschrauben sind nur zu befestigen wenn eine IF Option gesteckt ist (max. Anzugsmoment 0,5 Nm).

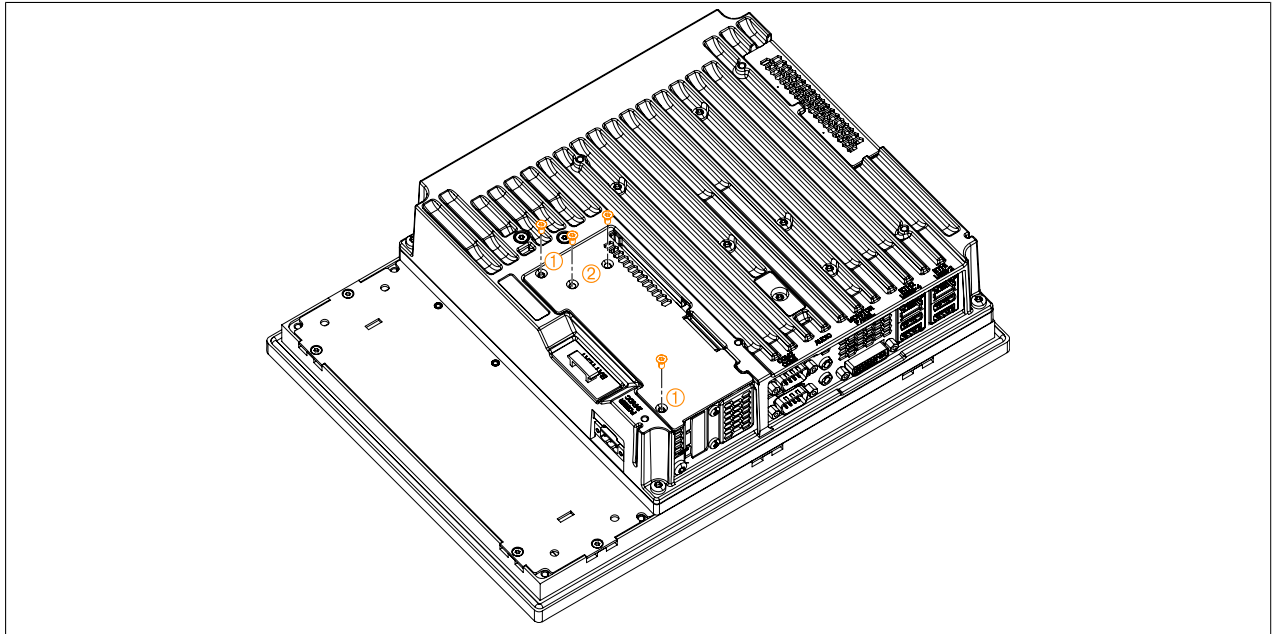


Abbildung 69: Abdeckblech mit Torxschrauben fixieren

9. Nach der erfolgreichen Montage der Interface Option muss diese im BIOS aktiviert werden. Dazu beim Systemstart das BIOS aufrufen, die BIOS Defaultwerte laden und die Einstellungen speichern. Informationen dazu siehe "Save & Exit" auf Seite 222.

1.6 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Information:

Ein Wechsel des Slide-in compact Laufwerks ohne Ausbau des PPC aus dem Schaltschrank ist nur bis zu einer Materialstärke des Schaltschranks von maximal 5,5 mm möglich. Die Schritte 3, 4 und 11 sind nur nötig, wenn der Panel PC ausgebaut wird.

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Den Panel PC aus dem Schaltschrank ausbauen: dabei in umgekehrter Reihenfolge wie in Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125 beschrieben vorgehen.
4. Den Panel PC auf eine saubere und plane Fläche legen.
5. Die in der nachfolgenden Abbildung markierten Torxschrauben (T10) müssen gelöst werden.

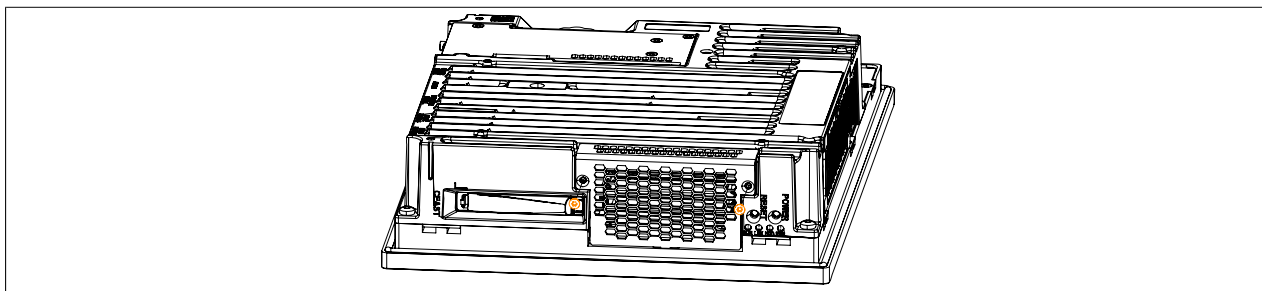


Abbildung 70: Torxschrauben lösen

6. Das Abdeckblech nach vorne kippen und durch Schieben nach oben entfernen.

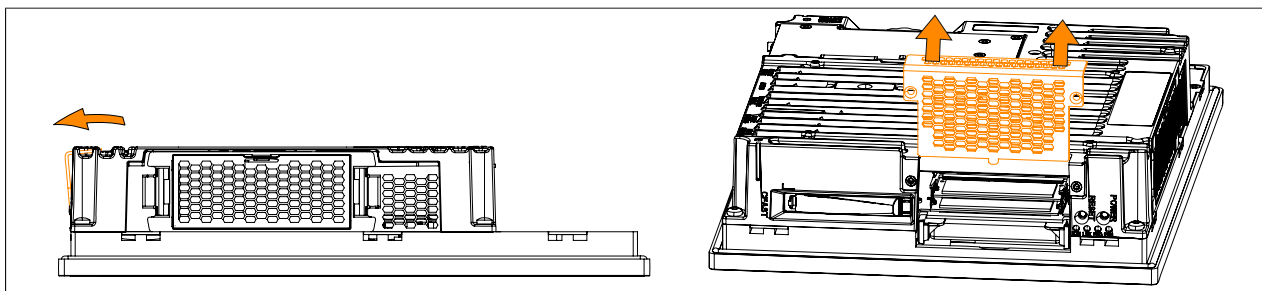


Abbildung 71: Abdeckblech entfernen

7. Den Ausziehstreifen (Kunststoff- Lasche), welcher am Slide-in compact Laufwerk befestigt ist, lösen.

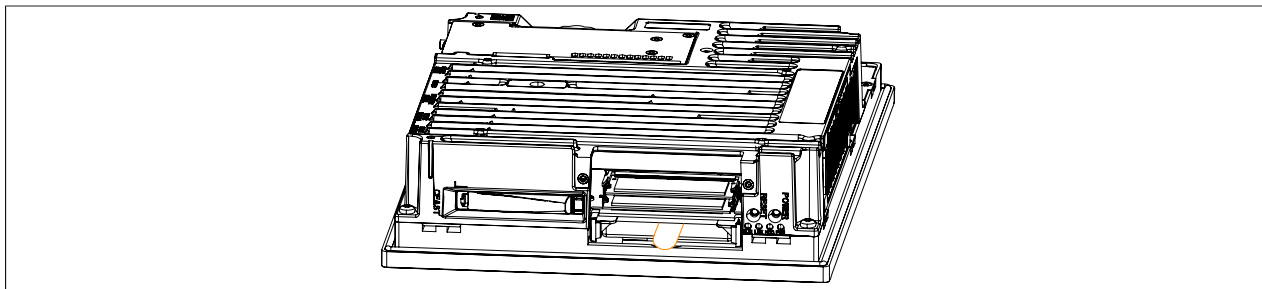


Abbildung 72: Lasche am Slide-in compact Laufwerk lösen

8. Das Slide-in compact Laufwerk mittels Ausziehstreifen durch kräftiges Ziehen entfernen.

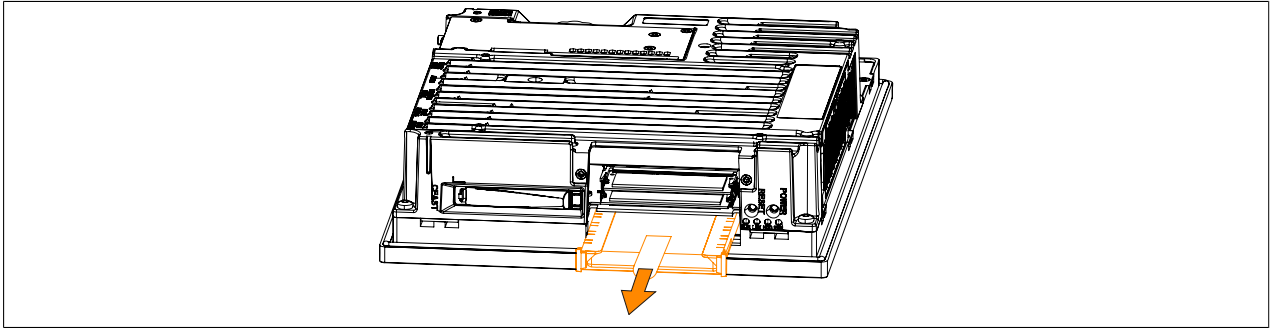


Abbildung 73: Slide-in compact Laufwerk entfernen

9. Wird wieder ein Slide-in compact Laufwerk eingebaut, muss auf das Einführen in die Führungsschiene geachtet werden. Die Ausziehlasche wieder zwischen Laufwerk und Rahmen stecken (Position wie vor dem Lösen der Ausziehlasche).
10. Das Abdeckblech kann nun in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert werden.
11. Der Panel PC kann nun wieder in den Schaltschrank eingebaut werden, siehe dazu Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125.

1.7 Lüfter Kit Tausch

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Die markierten Verriegelungen nach innen drücken ① und den Lüfter Kit gleichzeitig durch Ziehen nach vorne entfernen ②.

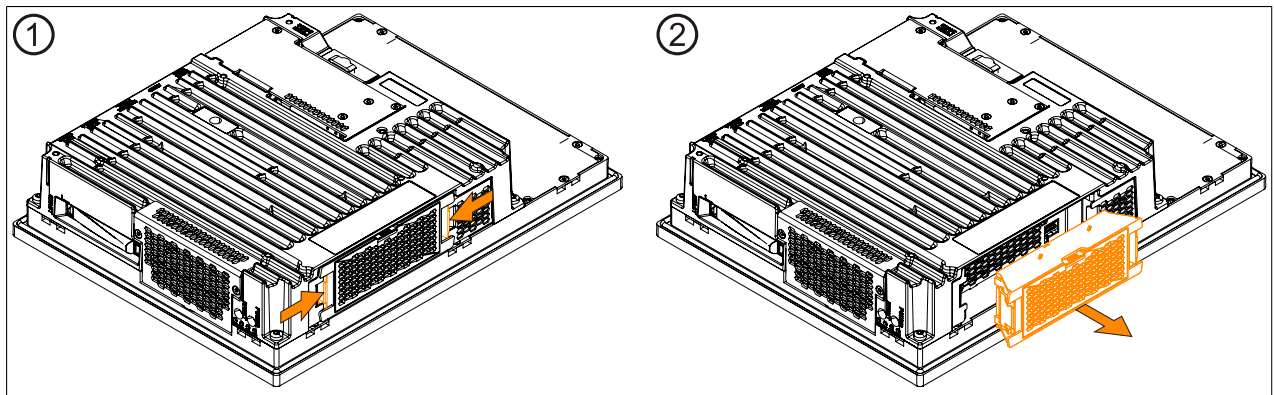


Abbildung 74: Verriegelung nach innen drücken

4. Ein Lüfter Kit kann nun wieder montiert werden. Dazu den Lüfter Kit parallel zum Panel PC ausrichten und in die Verriegelung drücken. Dabei auf die korrekte Steckrichtung des Lüfter Kit achten.
5. Wurde ein Lüfter Kit montiert, war vorher aber kein Lüfter Kit im Gerät verbaut, muss dieser erst programmiert werden. Dabei ist nach der Anleitung "Lüfter Kit Daten programmieren" vorzugehen. Wurde ein Lüfter Kit ersatzlos aus dem Gerät entfernt, müssen die Daten gelöscht werden. Dabei ist nach der Anleitung "Lüfter Kit Daten löschen" vorzugehen.

Information:

Wird ein Lüfter Kit ausgetauscht, wird die falsche Seriennummer angezeigt. Um die richtige Seriennummer anzuzeigen, müssen die Lüfter Kit Daten gelöscht und neu programmiert werden.

6. Nach dem programmieren des Lüfter Kit müssen die BIOS Defaultwerte geladen und die Einstellungen gespeichert werden. Informationen dazu siehe "Save & Exit" auf Seite 222.

Lüfter Kit Daten programmieren

Information:

Wurde ein Lüfter Kit montiert, war vorher aber kein Lüfter Kit im Gerät verbaut, muss dieser erst programmiert werden.

1. Den B&R Industrie PC hochfahren und in der Kommandozeile folgenden Aufruf eingeben:
`mtxcsvc i fanfset` - mit diesem Aufruf wird kontrolliert ob der Lüfter Kit bereits programmiert ist.
2. Ist der Lüfter Kit noch nicht programmiert muss dieser über folgenden Aufruf programmiert werden:
`mtxcsvc u fanfset "fn"` - statt "fn" muss der Pfad der Datei und der Dateiname angegeben werden.

Lüfter Kit Daten löschen

Information:

Wurde ein Lüfter Kit ersatzlos aus dem Gerät entfernt, müssen die Daten gelöscht werden.

1. Den B&R Industrie PC hochfahren und in der Kommandozeile folgenden Aufruf eingeben:
`mtxcsvc i fanfset` - mit diesem Aufruf wird kontrolliert ob der Lüfter Kit bereits programmiert ist.
2. Da bereits ein Lüfter Kit installiert war, müssen erst dessen Daten gelöscht werden. Dies erfolgt mit dem Aufruf:
`mtxcsvc d fanfset` - mit diesem Aufruf werden die Daten des vorher installierten Lüfter Kit gelöscht.

1.8 Lüfterfilter Tausch

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Die markierte Verriegelung nach unten drücken ① und den Filterdeckel gleichzeitig durch Ziehen nach vorne entfernen ②.

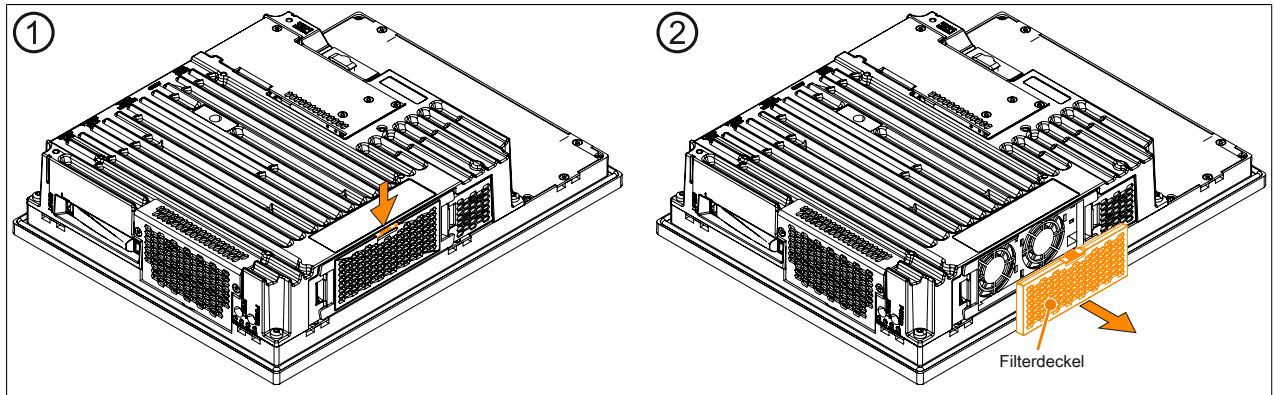


Abbildung 75: Filterdeckel entfernen

4. Den neuen Filterdeckel in umgekehrter Reihenfolge in den Lüfter Kit einbauen.

1.9 Buseinheit Montage

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Den Panel PC aus dem Schaltschrank ausbauen: dabei in umgekehrter Reihenfolge wie in Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125 beschrieben vorgehen.
4. Den Panel PC auf eine saubere und plane Fläche legen.
5. Die 2 bzw. 4 Torxschrauben (T10) müssen gelöst werden. Die Seitenabdeckung ist durch Schieben nach vorne zu entfernen.

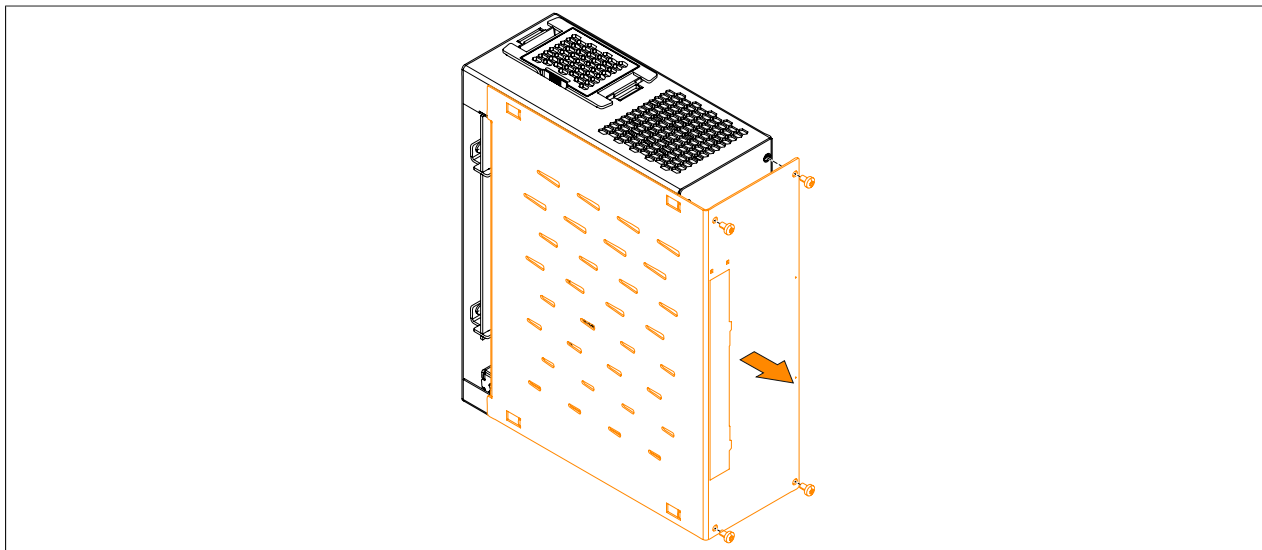


Abbildung 76: Torxschrauben lösen und Seitenabdeckung entfernen

6. Die Buseinheit an der Systemeinheit mit den 4 mitgelieferten Torxschrauben (T20) montieren (Anzugsmoment ca. 1,2 Nm).

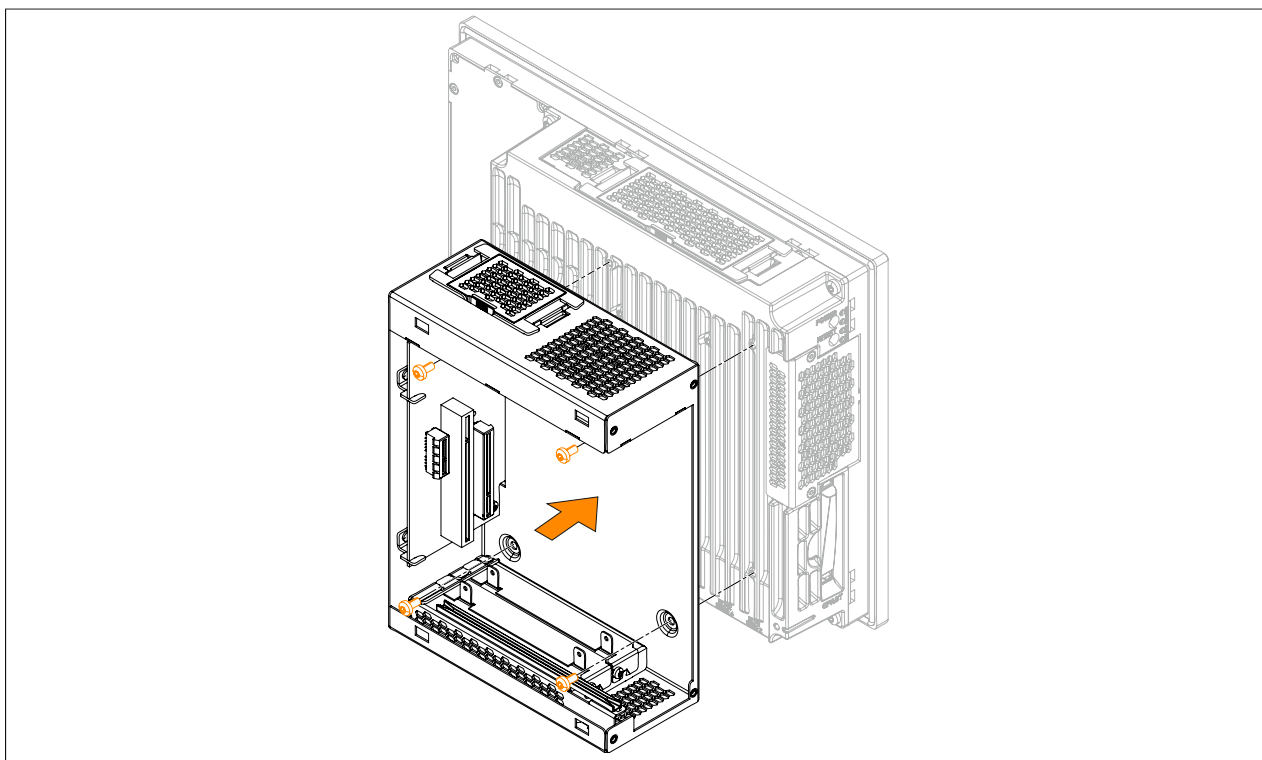


Abbildung 77: Buseinheit an der Systemeinheit montieren

7. Die Seitenabdeckung nun mit den 4 markierten Torxschrauben (T10) (2 wurden gelöst, 2 werden mitgeliefert) an der Buseinheit montieren (Anzugsmoment ca. 0,5 Nm).

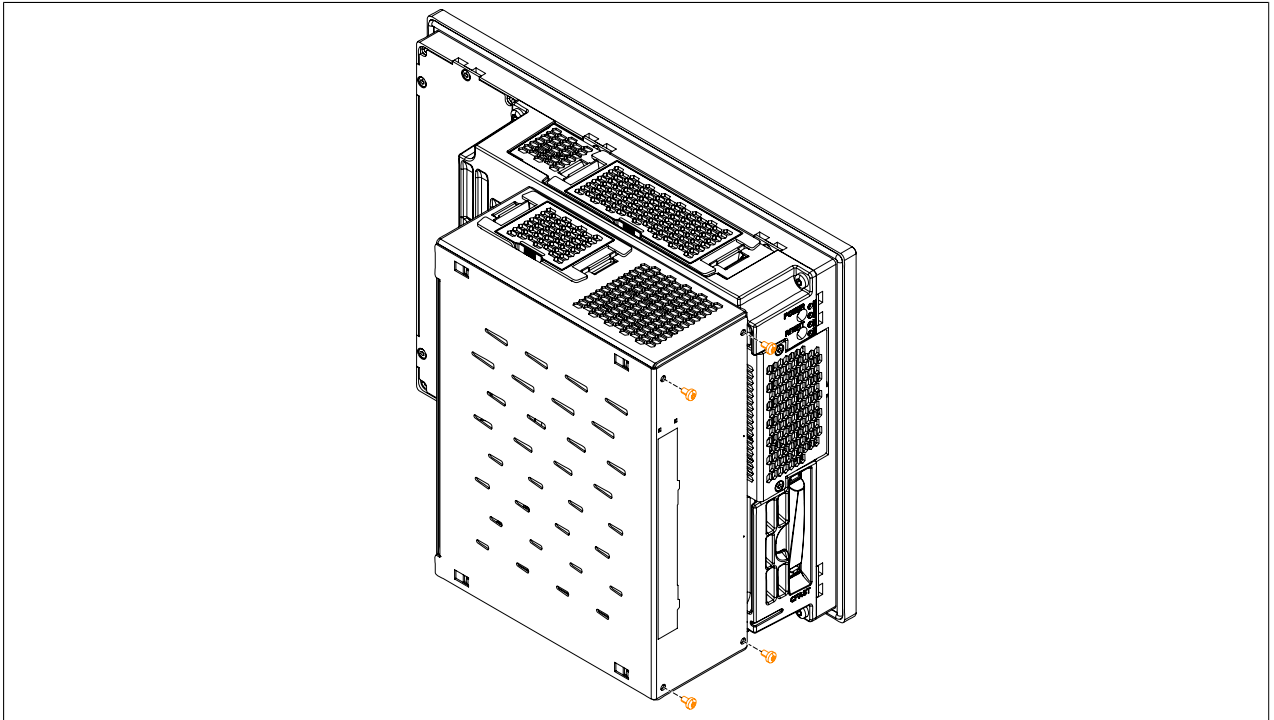


Abbildung 78: Seitenabdeckung montieren

8. Der Panel PC kann nun wieder in den Schaltschrank eingebaut werden, siehe dazu Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125.
9. Nach der erfolgreichen Montage der Buseinheit muss diese im BIOS aktiviert werden. Dazu beim Systemstart das BIOS aufrufen, die BIOS Defaultwerte laden und die Einstellungen speichern. Informationen dazu siehe "Save & Exit" auf Seite 222.

1.10 PCI / PCIe Karten Montage

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Den Panel PC aus dem Schaltschrank ausbauen: dabei in umgekehrter Reihenfolge wie in Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125.
4. Den Panel PC auf eine saubere und plane Fläche legen.
5. Die in der nachfolgenden Abbildung markierten Torxschrauben (T10) müssen gelöst werden. Die Seitenabdeckung ist durch Schieben nach vorne zu entfernen.

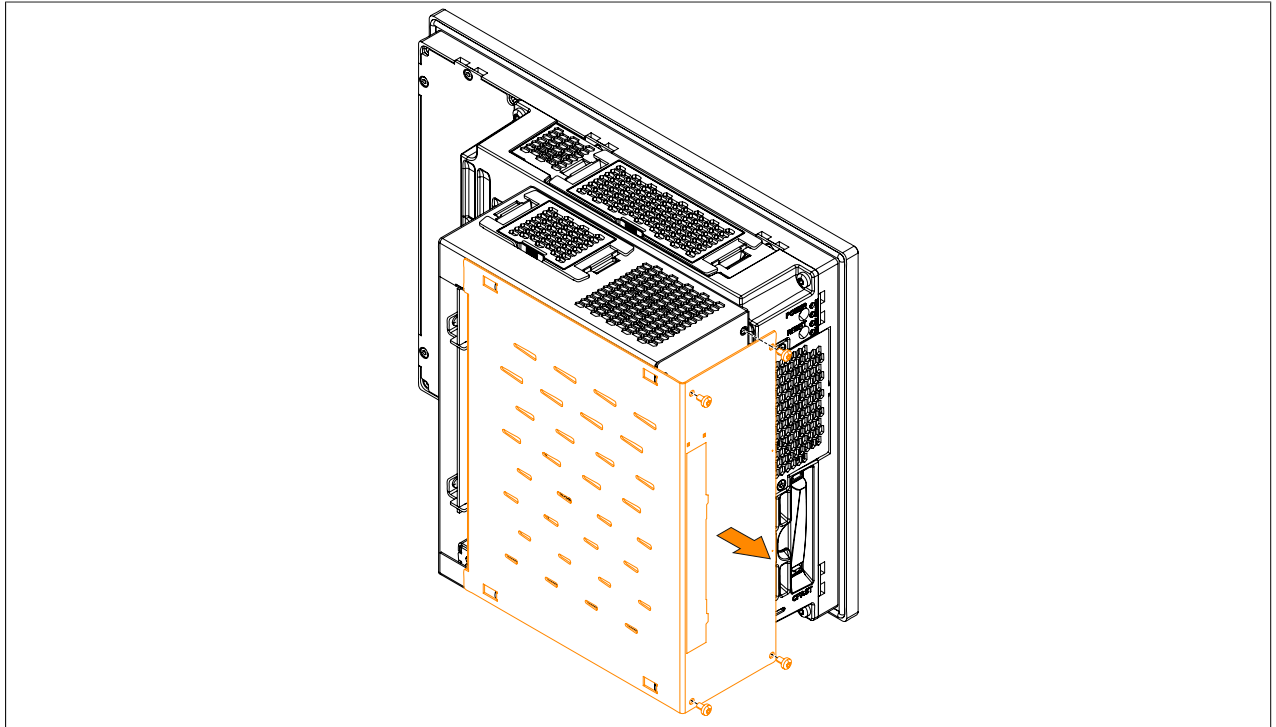


Abbildung 79: Torxschrauben lösen und Seitenabdeckung entfernen

6. Die PCI Blindabdeckung von der Buseinheit entfernen. Dazu den markierten Torxschrauben (T10) lösen und die Blindabdeckung entfernen.

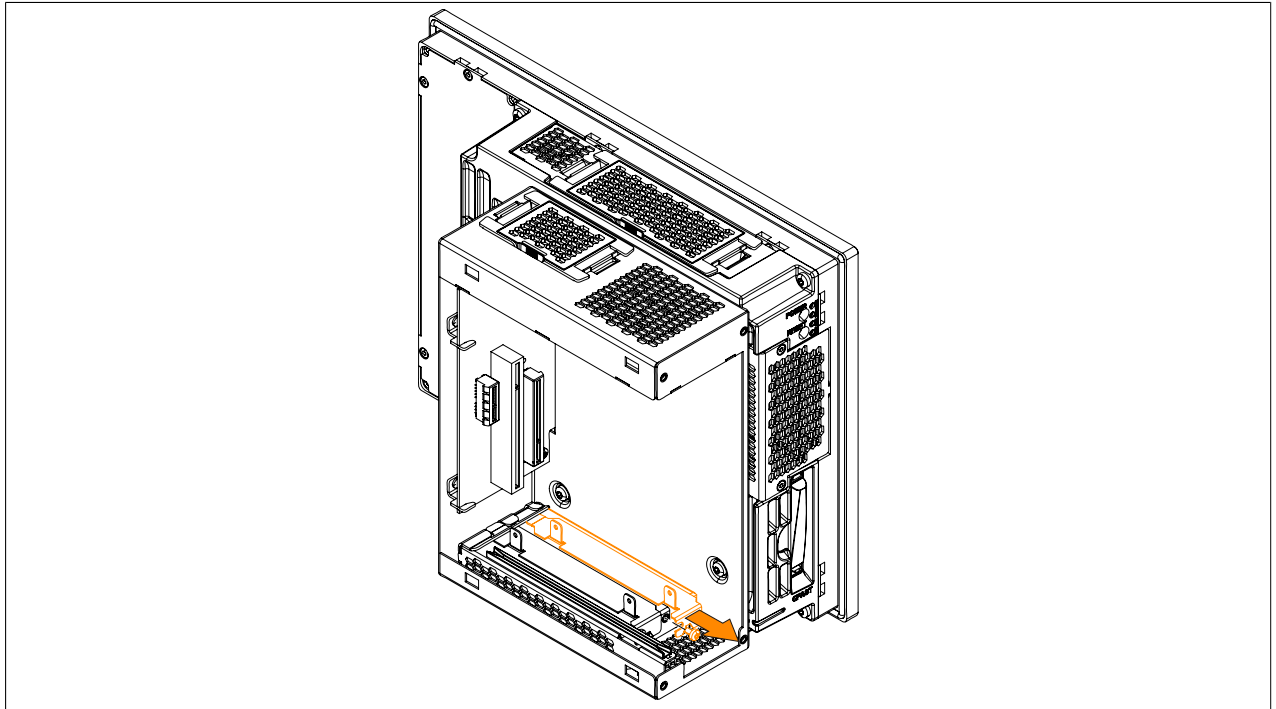


Abbildung 80: Torxschrauben lösen und Blindabdeckung entfernen

7. Die PCI bzw. PCIe Karte in die Buseinheit einbauen. Es muss auf das Einführen der PCI bzw. PCIe Karte in die obere schwarze Führungsschiene in der Buseinheit geachtet werden. Die PCI bzw. PCIe Karte mit dem markierten (vorhin gelösten) Torxschrauben (T10) befestigen (max. Anzugsmoment 0,5 Nm). Eine Beschreibung und Belegung der Buseinheiten ist im Abschnitt "Buseinheiten" auf Seite 78 zu finden.

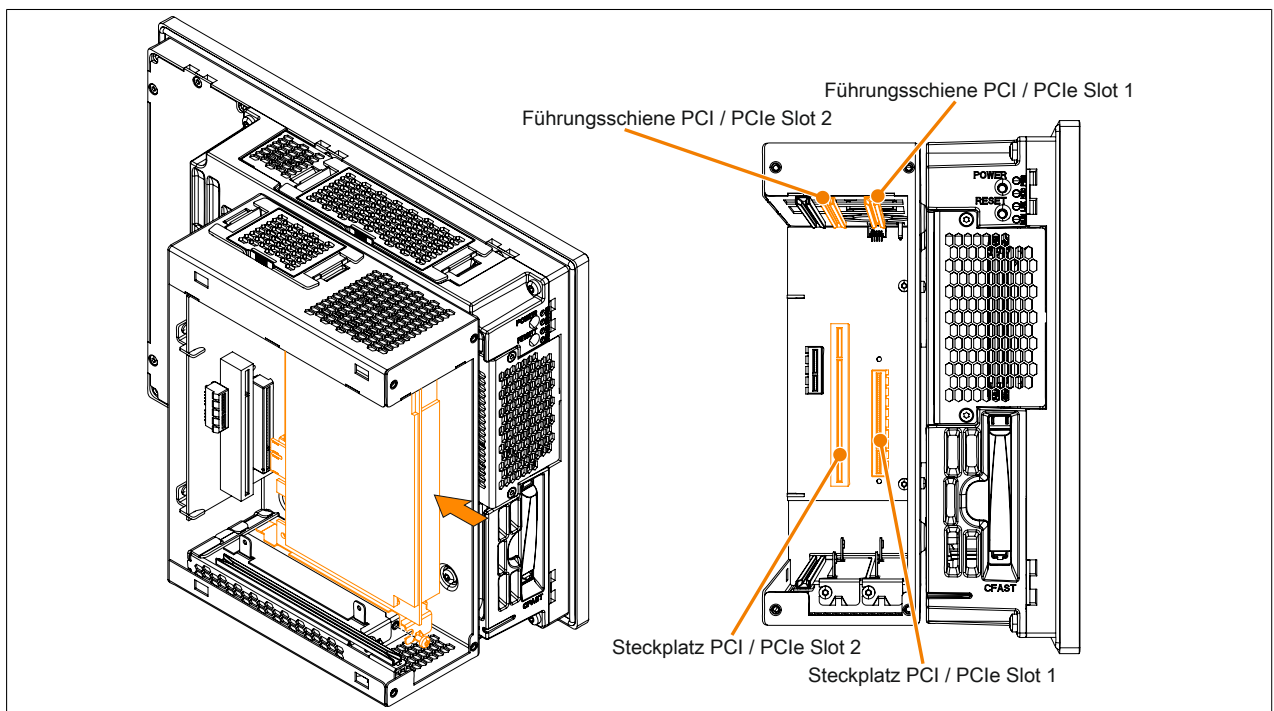


Abbildung 81: PCI / PCIe Karte in die Buseinheit einbauen

8. Die Seitenabdeckung mit den 4 markierten Torxschrauben (T10) an der Buseinheit montieren (max. Anzugsmoment 0,5 Nm).

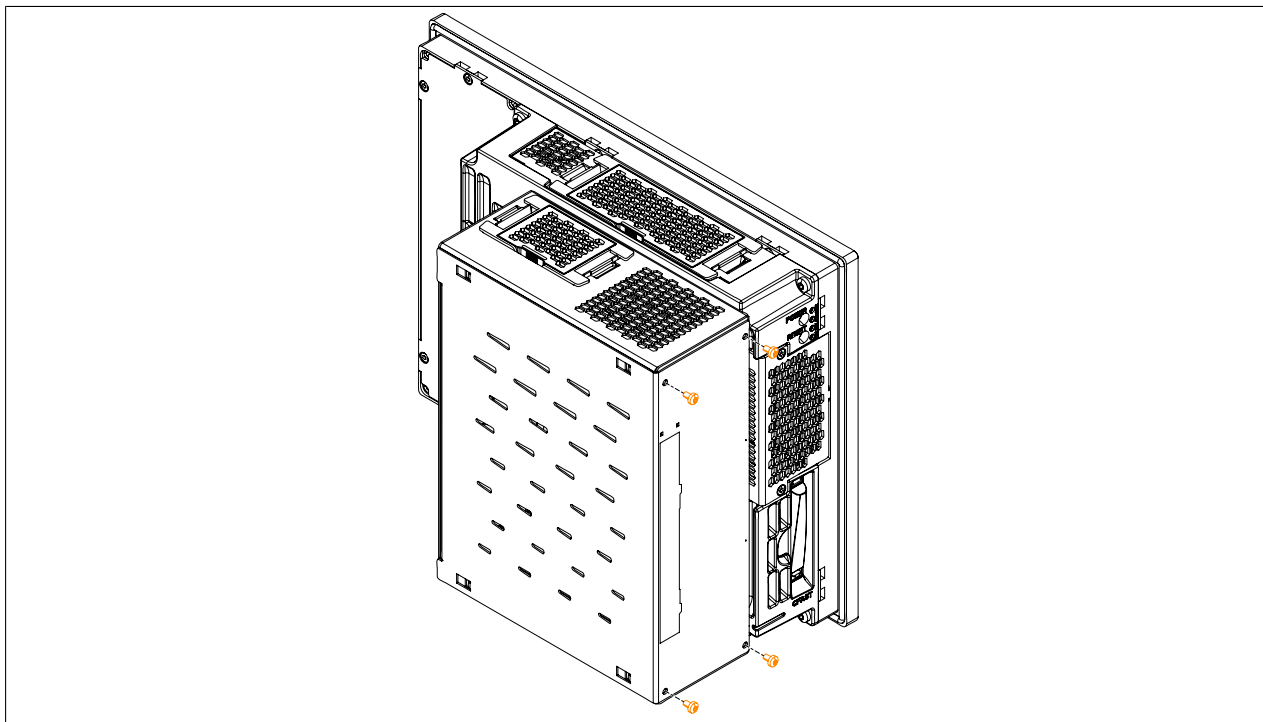


Abbildung 82: Seitenabdeckung montieren

9. Der Panel PC kann nun wieder in den Schaltschrank eingebaut werden, siehe dazu Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125.

1.11 Slide-in Laufwerkseinbau

1. Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Den Panel PC aus dem Schaltschrank ausbauen: dabei in umgekehrter Reihenfolge wie in Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125 beschrieben vorgehen.
4. Den Panel PC auf eine saubere und plane Fläche legen.
5. Die in der nachfolgenden Abbildung markierten Torxschrauben (T10) müssen gelöst werden. Die Seitenabdeckung ist durch Schieben nach vorne zu entfernen.

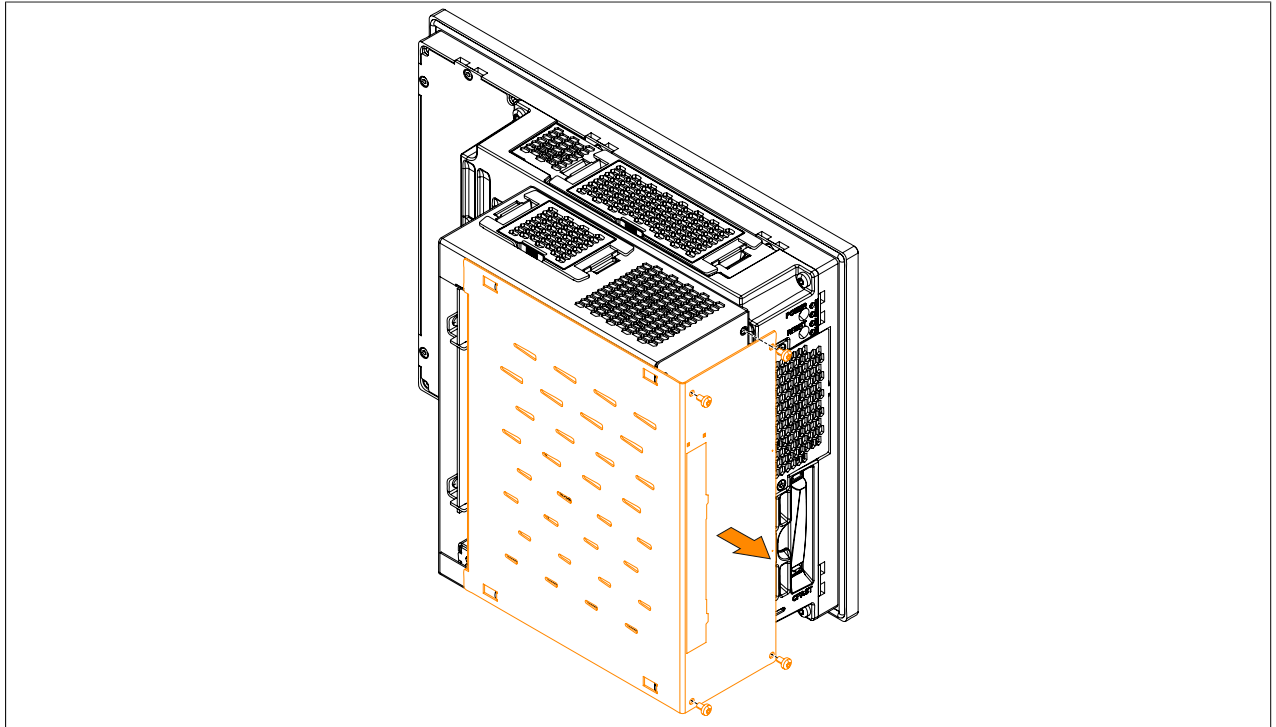


Abbildung 83: Torxschrauben lösen und Seitenabdeckung entfernen

6. Die Slide-in Blindabdeckung von der Seitenabdeckung entfernen. Dazu die 6 markierten Einrasthaken nach innen drücken und die Blindabdeckung entfernen.

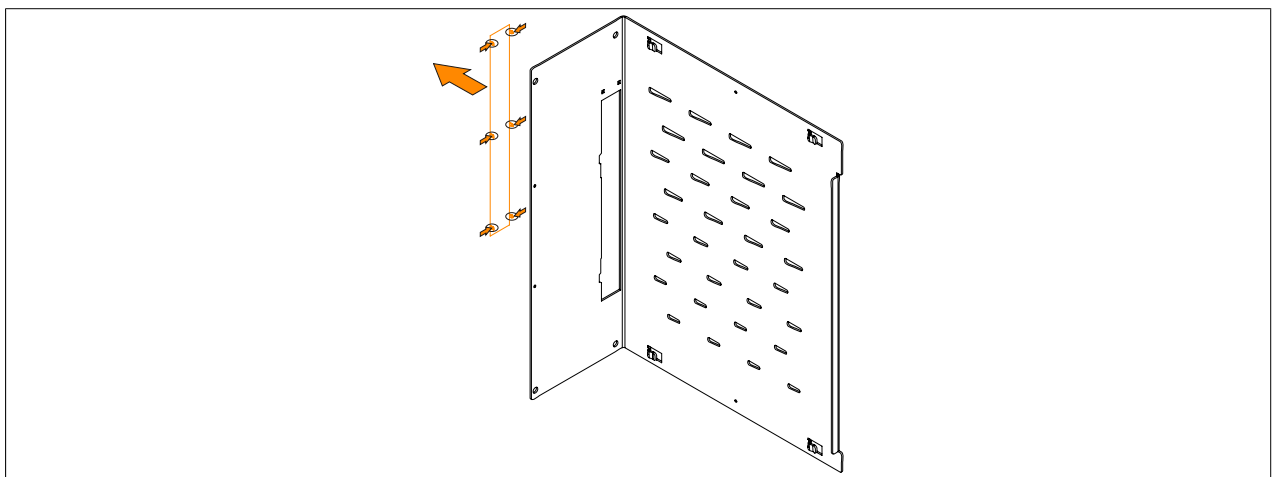


Abbildung 84: Slide-in Blindabdeckung von der Seitenabdeckung entfernen

7. Das Slide-in Laufwerk in die Buseinheit einbauen. Es muss auf das Einführen des Slide-in Laufwerks in die obere und untere schwarze Führungsschiene in der Buseinheit geachtet werden.

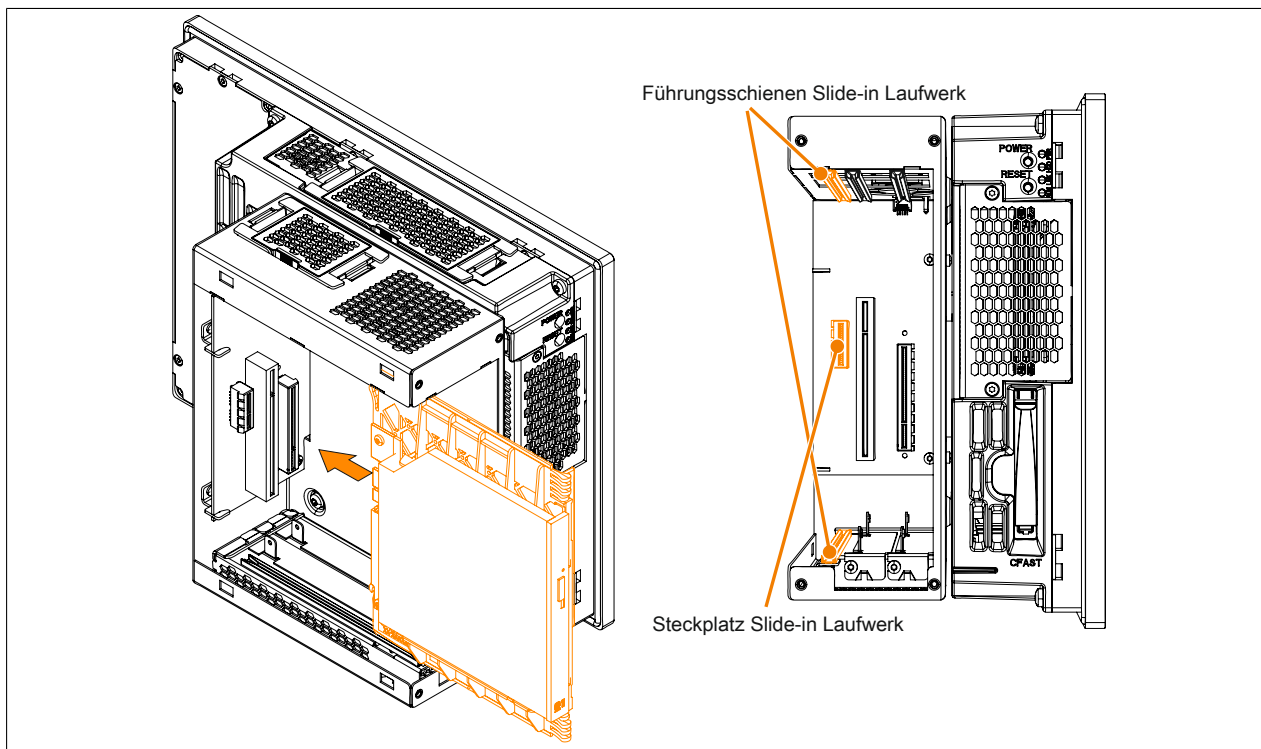


Abbildung 85: Slide-in Laufwerk in die Buseinheit einbauen

8. Die Seitenabdeckung mit den 4 markierten Torxschrauben (T10) an der Buseinheit montieren (max. Anzugsmoment 0,5 Nm).

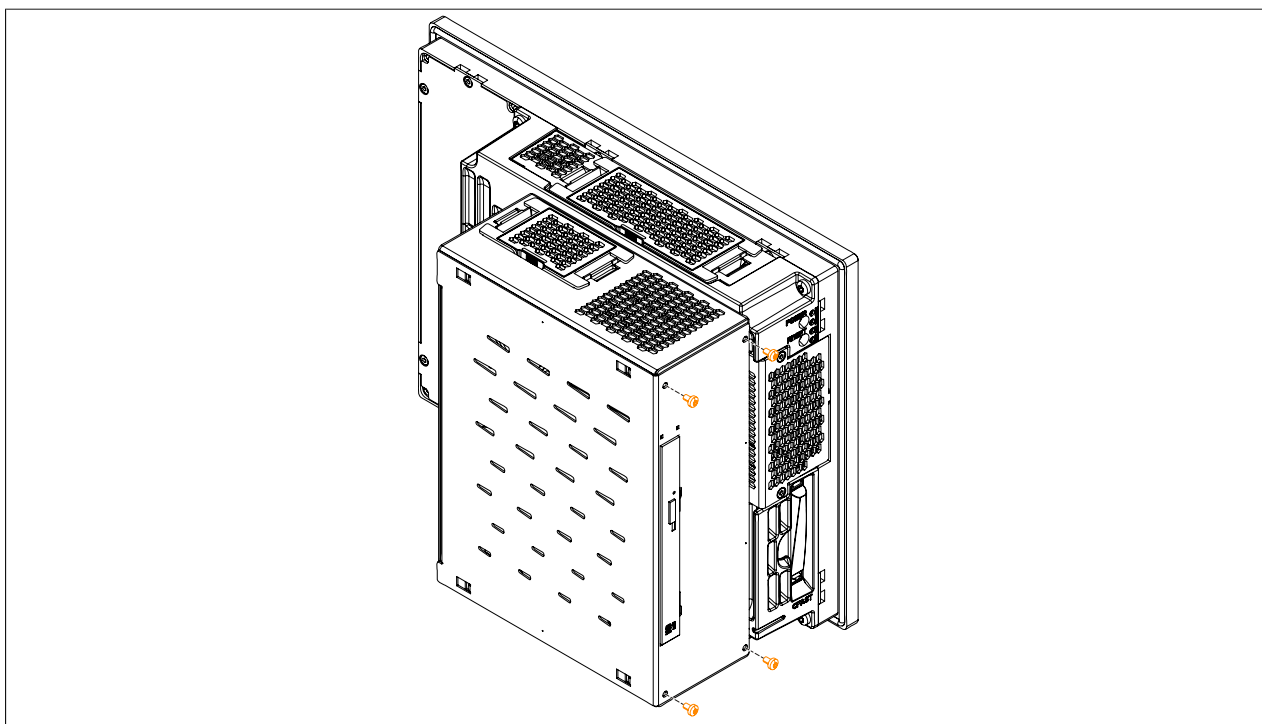


Abbildung 86: Seitenabdeckung montieren

9. Der Panel PC kann nun wieder in den Schaltschrank eingebaut werden, siehe dazu Abschnitt "Montage Panel PC 900" auf Seite 125.

1.12 Montage & Anschluss der USV Batterieeinheit

Warnung!

Die USV Batterieeinheit darf nicht geöffnet werden!

1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
2. Die Batterieeinheit montieren. Die Bohrschablone ist den Technischen Daten der jeweiligen USV Batterieeinheit zu entnehmen. Der Abstand zwischen Batterieeinheit und B&R Industrie PC muss so gewählt werden, dass diese mit dem USV Kabel (0,5 m, 1 m oder 3 m) miteinander verbunden werden können.
Für die Montage werden 4 M5 Schrauben, 4 Beilagscheiben sowie eine Schraubensicherung benötigt (min. Anzugsmoment 1,3 Nm; Einschraubtiefe nach geltenden DIN Vorschriften und entsprechend der Anwendung). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Das USV Kabel an die Batterie anschließen. Dabei die roten und schwarzen Leiter an der Spannungsversorgung (orange Schraubklemme) anschließen. Auf die richtige Anschlussklemme achten (roter Leiter auf +; schwarzer Leiter auf -)!
Den weißen und braunen Leiter am Temperatursensor (grüne Schraubklemme) anschließen (weißer Leiter auf 1; brauner Leiter auf 2).

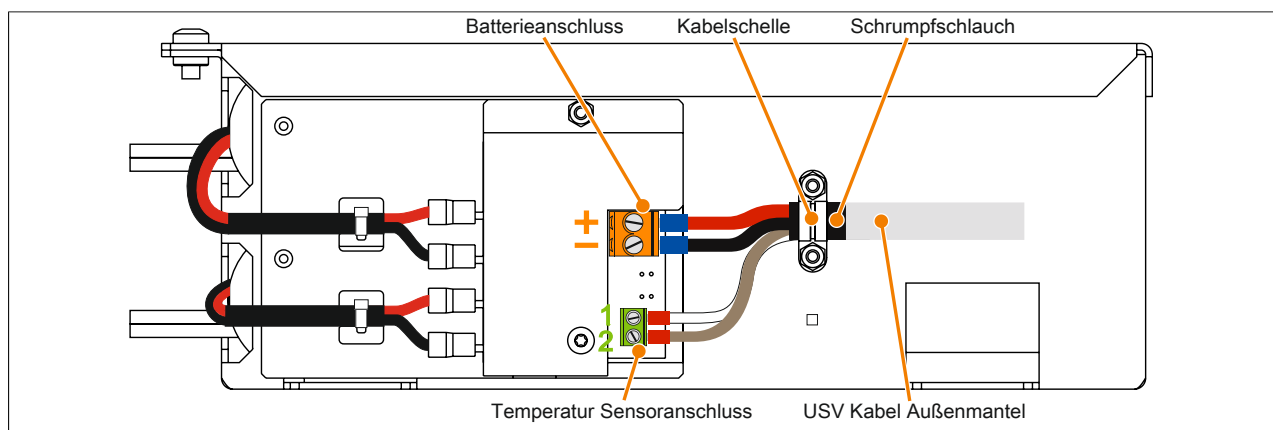


Abbildung 87: Anschluss des USV Kabels an die Batterie

4. Die angeschlossenen Leiter an den Schraubklemmen mit einem Schraubendreher festziehen (Anzugsmoment max. 0,4 Nm).
5. Die beiden Muttern (M3) der Kabelschelle lösen und das USV Kabel durchführen.
6. Das USV Kabel mit der Kabelschelle fixieren. Die vorhin entfernten Muttern wechselweise an der Kabelschelle festziehen (Anzugsmoment max. 0,35 Nm).
7. Die 4-polige Schraubklemme an der USV IF Option anstecken und die zwei Schrauben mit einem Schraubendreher (Anzugsmoment max. 0,4 Nm) festziehen.

2 Anschluss an das Stromnetz

Gefahr!

- Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Komponenten des Geräts entnommen und Zubehör, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt werden.
- Das Netzkabel vom Gerät und von der Spannungsversorgung entfernen.
- Bevor das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, müssen alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehör, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt sein.

2.1 Montage des DC Netzkabels

Gefahr!

Die gesamte Spannungsversorgung zum B&R Industrie PC bzw. B&R Automation Panel muss unterbrochen sein. Vor dem Anschluss des DC Netzkabels muss überprüft werden, ob dieses von der Spannungsquelle (z.B. Netzteil) getrennt wurde.

2.1.1 Verdrahtung

Das DC Netzkabel ist wie in unten gezeigter Abbildung an die Feldklemme (Spannungsversorgungsstecker) zu montieren. Es sind Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² und einer Aderendhülse zu verwenden.

Montage der Schraubklemme 0TB103.9

Die Leiter mit den Aderendhülsen wie in der unten gezeigten Grafik in den Anschlusskontakten ② befestigen und die Schraubklemmen ① mit einem Schraubendreher (mit einem Anzugsmoment von max. 0,4 Nm) festziehen.

Bei der Verdrahtung ist auf die Pinbelegung des Spannungsversorgungsanschlusses am Gerät zu achten!

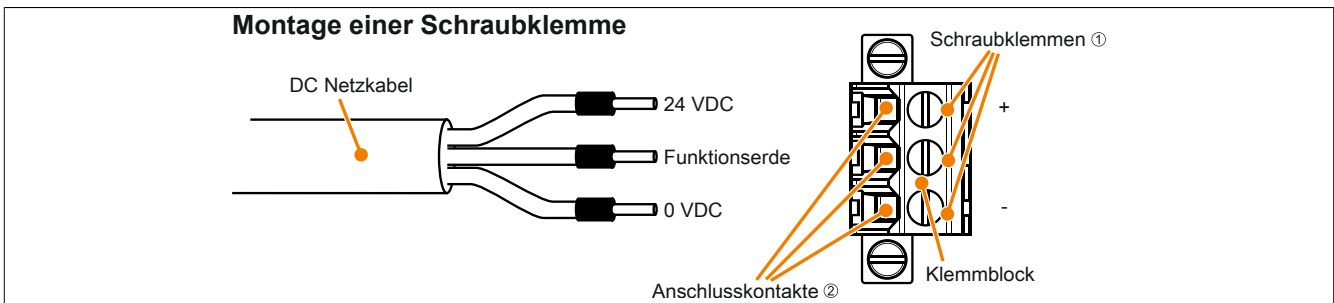


Abbildung 88: Montage einer Schraubklemme

Montage der Federzugklemme 0TB103.91

Einen Schraubendreher in die Federzugklemmen ① stecken und die Leiter mit den Aderendhülsen wie in der unten gezeigten Grafik in den Anschlusskontakten ② befestigen. Anschlusskontakt durch Entfernen des Schraubendrehers schließen.

Bei der Verdrahtung ist auf die Pinbelegung des Spannungsversorgungsanschlusses am Gerät zu achten!

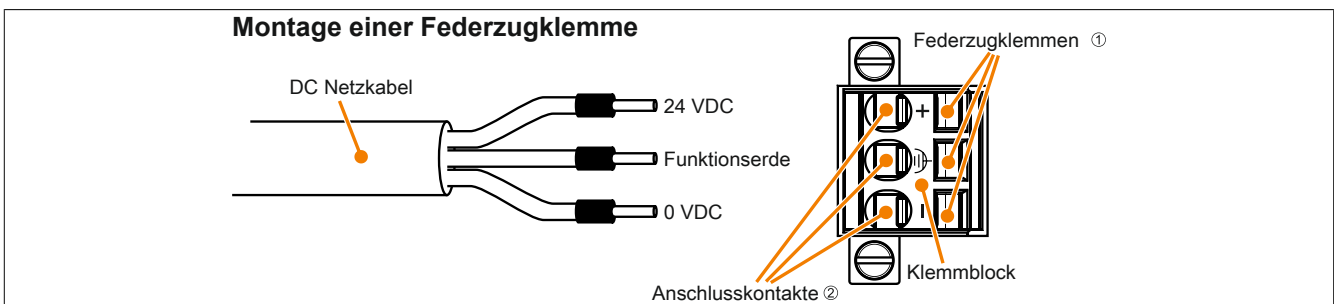


Abbildung 89: Montage einer Federzugklemme

2.2 Montage des AC Netzkabels

Gefahr!

Die gesamte Spannungsversorgung zum B&R Industrie PC bzw. B&R Automation Panel muss unterbrochen sein. Vor dem Anschluss des AC Netzkabels muss überprüft werden, ob dieses von der Spannungsquelle (z.B. Netzteil) getrennt wurde.

2.2.1 Verdrahtung

Das AC Netzkabel ist wie in unten gezeigter Abbildung an die Feldklemme (Spannungsversorgungsstecker) zu montieren. Es sind Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 4 mm² und einer Aderendhülse zu verwenden.

Montage der Schraubklemme 0TB3103.8000

Die Leiter mit den Aderendhülsen wie in der unten gezeigten Grafik in den Anschlusskontakten ② befestigen und die Schraubklemmen (befinden sich auf der Oberseite der Schraubklemme) mit einem Schraubendreher (mit einem Anzugsmoment von max. 0,6 Nm) festziehen.

Bei der Verdrahtung ist auf die Pinbelegung des Spannungsversorgungsanschlusses am Gerät zu achten!

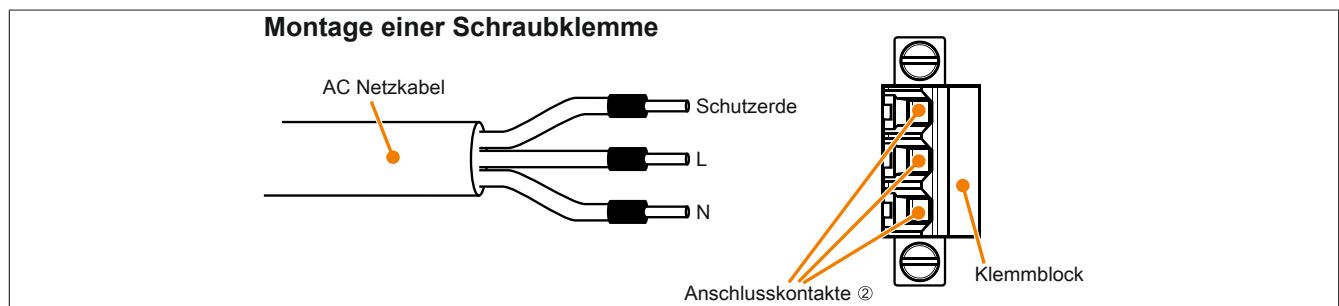


Abbildung 90: Montage einer Schraubklemme

2.3 Anschluss der Spannungsversorgung an ein B&R Gerät

Gefahr!

Die gesamte Spannungsversorgung zum B&R Gerät muss unterbrochen sein. Vor dem Anschluss des Netzkabels muss überprüft werden, ob dieses von der Spannungsquelle (z.B. Netzteil) getrennt wurde.

1. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
2. Den Spannungsversorgungsstecker am B&R Gerät anschließen und die Befestigungsschrauben anziehen (max. Anzugsmoment 0,5 Nm).

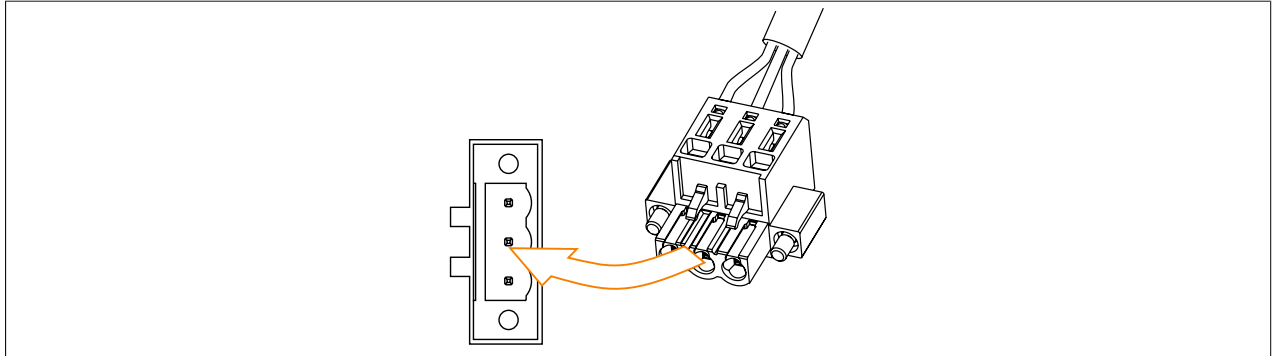


Abbildung 91: Spannungsversorgungsstecker an ein B&R Gerät anschließen (Symbolbild)

2.4 Erdungskonzept Funktionserde


Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutzmaßnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Störfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Störungsableitung und nicht als Berührungsschutz für Personen.

Die Funktionserde des Gerätes besitzt 2 Anschlüsse:

- Spannungsversorgung
- Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Störungen zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf möglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
- Ausführung der Kabel mit mind. 2,5 mm² pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhülse an der Feldklemme 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm² pro Anschluss möglich.
- Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerät angeschlossenen Datenkabel sind mit geschirmten Leitungen auszuführen.

Die Funktionserde ist am B&R Gerät mit folgendem Symbol gekennzeichnet: 

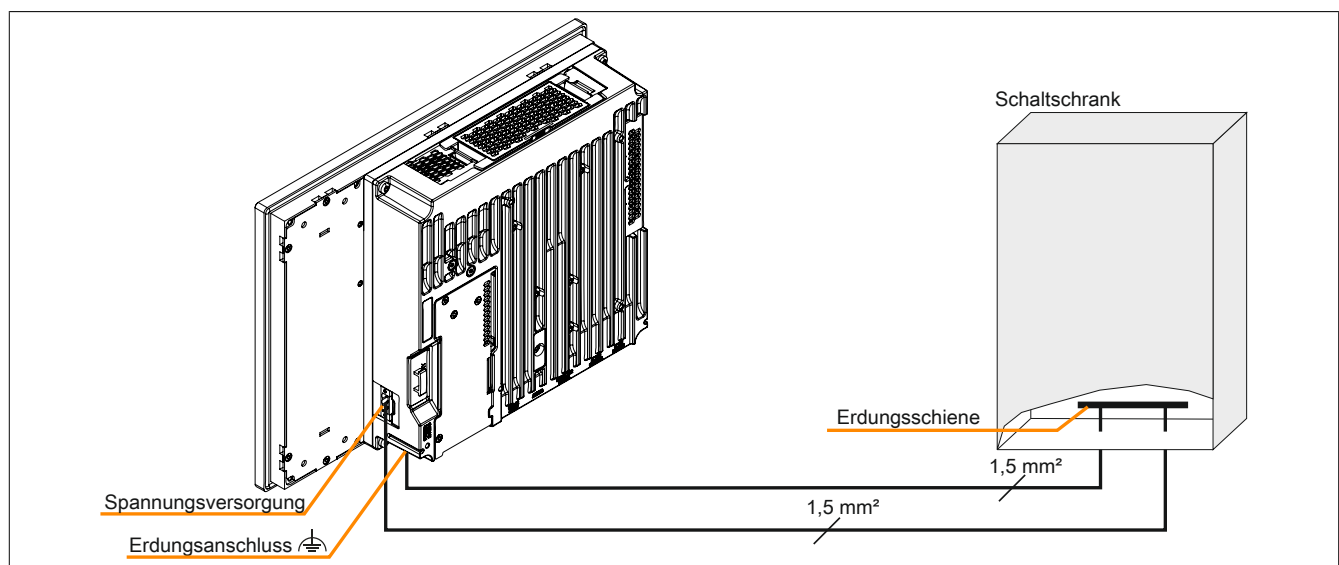


Abbildung 92: Erdungskonzept Panel PC 900

3 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.

Information:

Das maximale Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben beträgt 0,5 Nm.

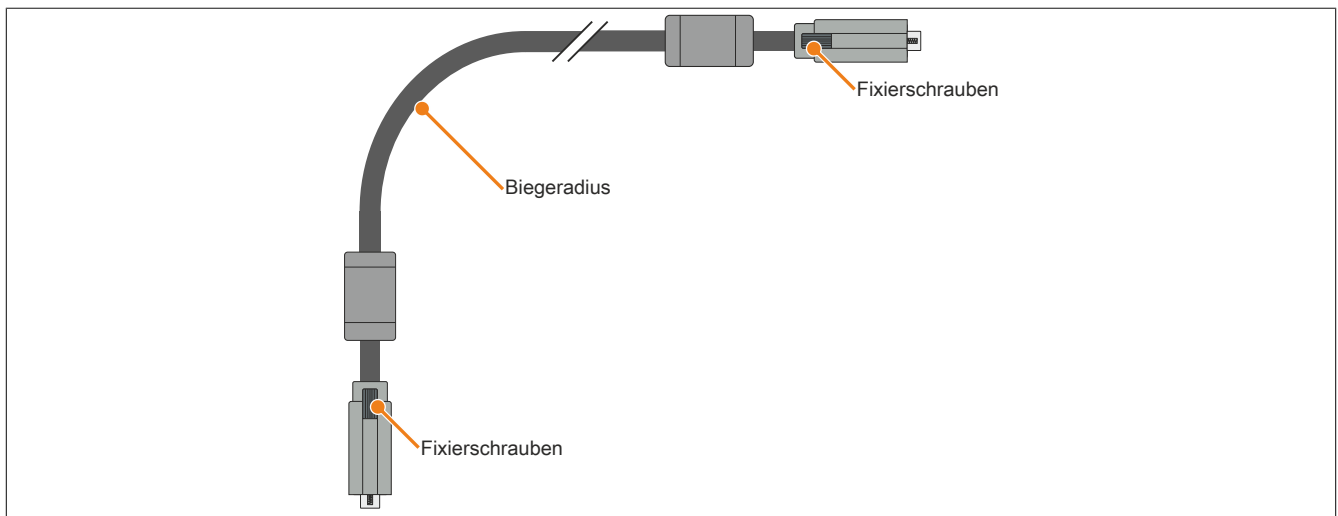


Abbildung 93: Biegeradius Kabelanschluss

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist dem Automation Panel 800 bzw. dem Automation Panel 900 Anwenderhandbuch, welches in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden kann, zu entnehmen.

4 Erstes Einschalten

4.1 Allgemeines vor dem Einschalten

Checkliste

Bevor das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, müssen folgende Punkte überprüft werden:

- Werden die Einbauhinweise eingehalten, wie in "Montage" auf Seite 125 beschrieben.
- Werden die zulässigen Umgebungsbedingungen und Umweltbedingungen für das Gerät berücksichtigt?
- Ist die Stromversorgung richtig angeschlossen und wurden die Werte überprüft?
- Ist das Erdungskabel am Erdungsanschluss korrekt angeschlossen?
- Bevor zusätzliche Hardware (z.B. eine PCI- Karte) installiert wird, muss das Gerät zuvor in Betrieb genommen worden sein.

Vorsicht!

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es langsam der Raumtemperatur angepasst werden! Es darf nicht direkter Wärmestrahlung ausgesetzt werden.

Beim Transport bei niedrigen Temperaturen oder großen Temperaturschwankungen darf sich keine Feuchtigkeit in oder am Gerät niederschlagen.

Voraussetzungen

Folgende Punkte müssen vor dem ersten Einschalten erfüllt sein:

- Das Erdungskabel ist angeschlossen.
- Alle Verbindungskabel sind korrekt angeschlossen.
- Eine USB- Tastatur und eine USB- Maus sind angeschlossen (optional).

4.2 Panel PC einschalten

Vorgehensweise

1. Die Stromversorgung anschließen und einschalten (z.B. Netzteil).
2. Das Gerät durch Betätigen des Power Tasters (DC- Stromversorgung) bzw. des Ein/Aus- Schalters am optionalen Netzteil (AC- Stromversorgung) einschalten.
3. Das Gerät ist in Betrieb und bootet, die Power LED leuchtet.

5 Touchkalibrierung

Die B&R Touch Screen Geräte sind mit einem B&R Touch Controller, welcher eine Hardware Kalibrierung unterstützt, ausgestattet. D.h. diese Geräte sind bereits ab Werk vorkalibriert (pre calibration). Diese Eigenschaft bringt gerade im Ersatzteillfall große Vorteile, da bei einem Gerätetausch (identies Modell / Typ) in der Regel eine neuerliche Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um beste Resultate zu erzielen und den Touch Screen an die Bedürfnisse des Benutzers wieder anzupassen, empfehlen wir dennoch diesen zu kalibrieren.

5.1 Singletouch (analog resistiv)

5.1.1 Windows 7 Professional / Ultimate

Nach der Installation von Windows 7 auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.2 Windows Embedded Standard 7 Embedded / Premium

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert.

Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel 800/900/9x3 nachträglich angeschlossen, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.3 Windows XP Professional

Nach der Installation von Windows XP Professional auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.4 Windows Embedded Standard 2009

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows Embedded Standard 2009 auf einem Panel PC oder Power Panel wird der passende Touch Treiber automatisch installiert.

Auf allen anderen Geräten muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

5.2 Multitouch (PCT - projiziert kapazitiv)

5.2.1 Windows 7 Professional / Ultimate

Während der Installation von Windows 7 auf dem Gerät werden die Microsoft Multitouch- Treiber mitinstalliert. Das Gerät ist nach der erfolgreichen Windows 7 Installation sofort betriebsbereit.

5.2.2 Windows Embedded Standard 7 Premium

Während der Installation von Windows Embedded Standard 7 Premium auf dem Gerät werden die Microsoft Multitouch- Treiber mitinstalliert. Das Gerät ist nach der erfolgreichen Windows Embedded Standard 7 Premium Installation sofort betriebsbereit.

6 Regelung der Displayhelligkeit

1. In der Systemsteuerung das Control Center öffnen.
2. Die Registerkarte Display wählen.
3. Ein Panel aus der Liste auswählen. Nur das lokale Display (PP Link) und angeschlossene Panels werden in der Liste angezeigt.
4. Einstellen der gewünschten Helligkeit über den Schieberegler.

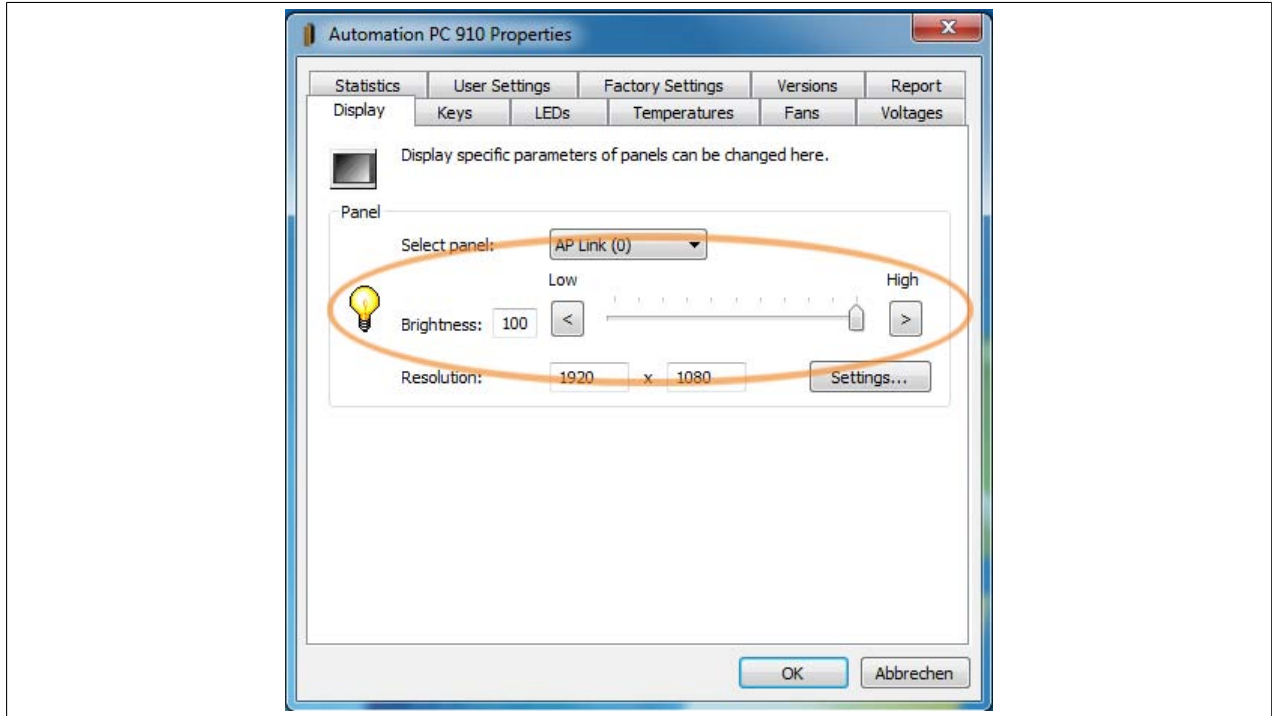


Abbildung 94: Displayhelligkeit regeln

Information:

Die geänderten Einstellungen werden zwar Online angezeigt, aber nur dann im System gemerkt (und nach einem Neustart des Systems verwendet), wenn das Control Center mit **OK** beendet wird.

Die eingestellte Helligkeit ist unabhängig von dem im BIOS Setup eingestellten Wert, d.h. bis Windows gebootet ist, wird der im BIOS eingestellte Wert verwendet. Der vom BIOS eingestellte Wert wird nur beim ersten Aufruf des Control Center übernommen.

7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes mit dem internen RAID Controller

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist für den internen RAID Controller des QM77 Chipsatz gültig. Der HM76 Chipsatz bietet keine RAID Unterstützung.

Information:

B&R empfiehlt im SATA RAID Verbund ausschließlich die Verwendung des selben Laufwerk- Typs (Hard Disk mit Hard Disk im Verbund; SSD mit SSD im Verbund; CFast mit CFast im Verbund).

Vorsicht!

Wird ein RAID Verbund mit SSDs (mit MLC- Technologie) verwendet, ist auf die maximale Anzahl möglicher Schreibzyklen zu achten.

Um einen SATA RAID Verbund zu erstellen und in das „Configuration Utility“ zu gelangen muss im BIOS die Einstellung *SATA Mode Selection* im Menü "Advanced - SATA Configuration" auf *RAID* gesetzt werden.

Für die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des „Configuration Utility“ einzusteigen. Nach dem POST <Strg+I> Drücken um das RAID BIOS aufzurufen.

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.6.0.1624
Copyright(C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

RAID Volumes:
ID Name      Level      Strip      Size      Status      Bootable
0 Mirror     RAID1 (Mirror)  N/A       465.8GB    Normal      Yes

Pyhsical Devices:
ID Device    Model      Serial #      Size      Type/Status (Vol ID)
0 WDC        WD500LUCT-6  WD-WX21AB2X6150  465.7GB    Member Disk (0)
2 WDC        WD500LUCT-6  WD-WX21AB2X6150  465.7GB    Member Disk (0)

Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility..
```

Abbildung 95: Configuration Utility - Boot

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.6.0.1624
Copyright(C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume      4. Recovery Volume Options
2. Delete RAID Volume     5. Acceleration Options
3. Reset Disks to Non-RAID 6. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
ID Name      Level      Strip      Size      Status      Bootable
0 Mirror     RAID1 (Mirror)  N/A       465.8GB    Normal      Yes

Pyhsical Devices:
ID Device    Model      Serial #      Size      Type/Status (Vol ID)
0 WDC        WD500LUCT-6  WD-WX21AB2X6150  465.7GB    Member Disk (0)
2 WDC        WD500LUCT-6  WD-WX21AB2P6063  465.7GB    Member Disk (0)

[↑↓]-Select      [ESC]-Exit      [ENTER]-Select Menu
```

Abbildung 96: Configuration Utility - Übersicht

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
Cursor ↑	Zum vorherigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Enter	Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermenüs.
ESC	Rücksprung zum vorherigen Menü.
Ctrl+E	Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 131: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

7.1 Create RAID Volume

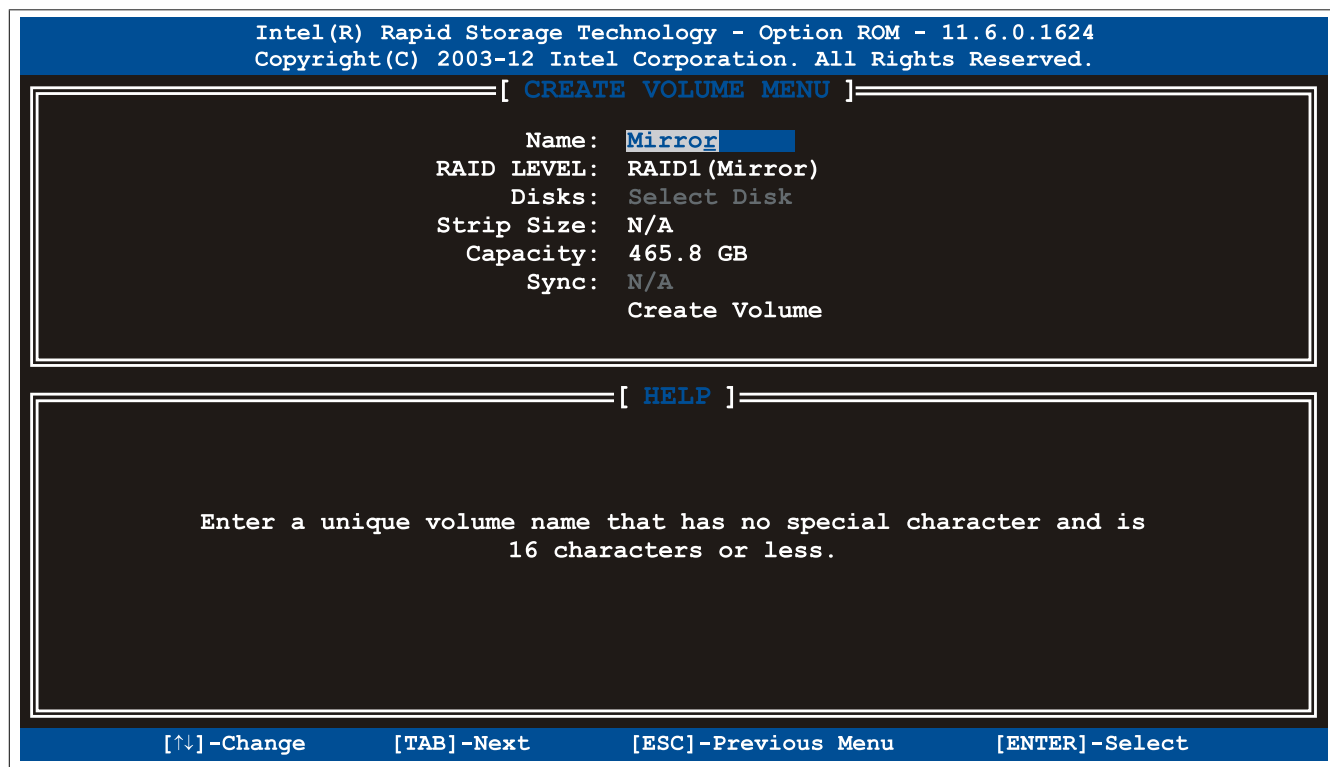


Abbildung 97: Configuration Utility - Create RAID Volume

Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Name	Option zum Eingeben des RAID-Namen.	Name mit bis zu 16 Zeichen	RAID-Name wird vergeben.
RAID Level	Option zum Einstellen des RAID Level.	RAID0(Stripes)	Ein RAID0 wird erstellt.
		RAID1(Mirror)	Ein RAID1 wird erstellt.
		Recovery	Ein Recovery RAID wird erstellt.
Disks ¹⁾	Auswahl der gesteckten Hard Disks als Master und Recovery.	Master, Recovery	Die Festplatten werden als Master oder Recovery definiert.
Strip Size ²⁾	Option zum Einstellen der Größe der Datenblöcke.	4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 128KB	Größe des Datenblocks wird eingestellt.
Capacity	Option zum Einstellen der Kapazität des RAID.		Die Speichergröße des RAID wird eingestellt.
Sync ³⁾	Option zum Einstellen der Synchronisation des RAID.	N/A	-
		Continuous	Das RAID wird automatisch synchronisiert.
		On Request	Das RAID wird manuell synchronisiert.
Create Volume	Das RAID Volume wird erzeugt.	-	Das RAID Volume wird erzeugt.

Tabelle 132: Configuration Utility - Create RAID Volume

- 1) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *RAID Level* auf *Recovery* eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *RAID Level* auf *RAID0(Stripe)* eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *RAID Level* auf *Recovery* eingestellt ist.

7.2 Delete RAID Volume

Über das Menü „Delete RAID Volume“ kann das RAID- Laufwerk formatiert werden und die Laufwerke werden zu non-RAID. Dazu muss das zu löschende Laufwerk ausgewählt und mit gelöscht werden.

Information:

Wird diese Option ausgeführt, werden alle Daten am Laufwerk gelöscht, inklusive dem Betriebssystem.

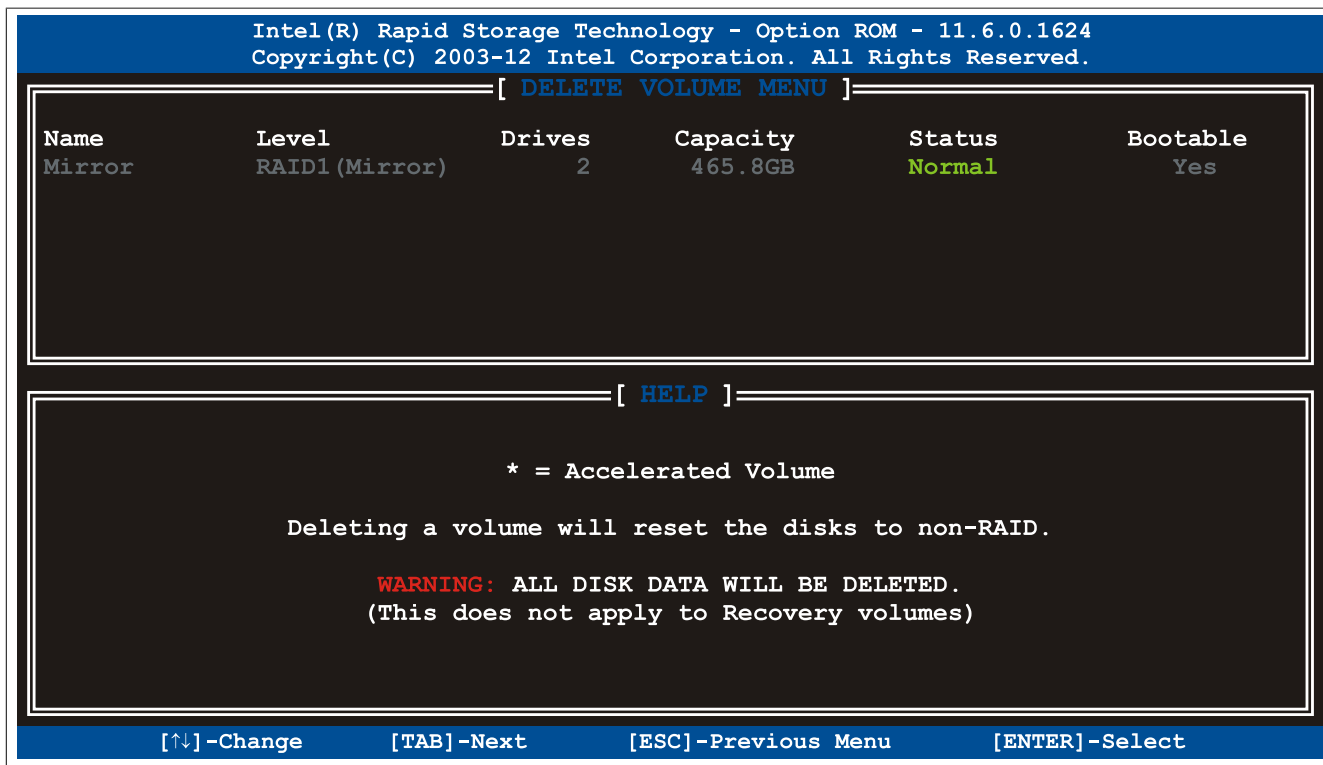


Abbildung 98: Configuration Utility - Delete RAID Volume

7.3 Reset Disks to Non-RAID

Über das Menü „Reset Disks to Non-RAID“ kann ein bestehender RAID Verbund aufgelöst werden. Dazu das RAID auswählen welches gelöscht werden soll und mit <SPACE> löschen und mit <ENTER> bestätigen.

Information:

Wird der RAID Verbund gelöscht, werden auch alle Daten am Laufwerk gelöscht.

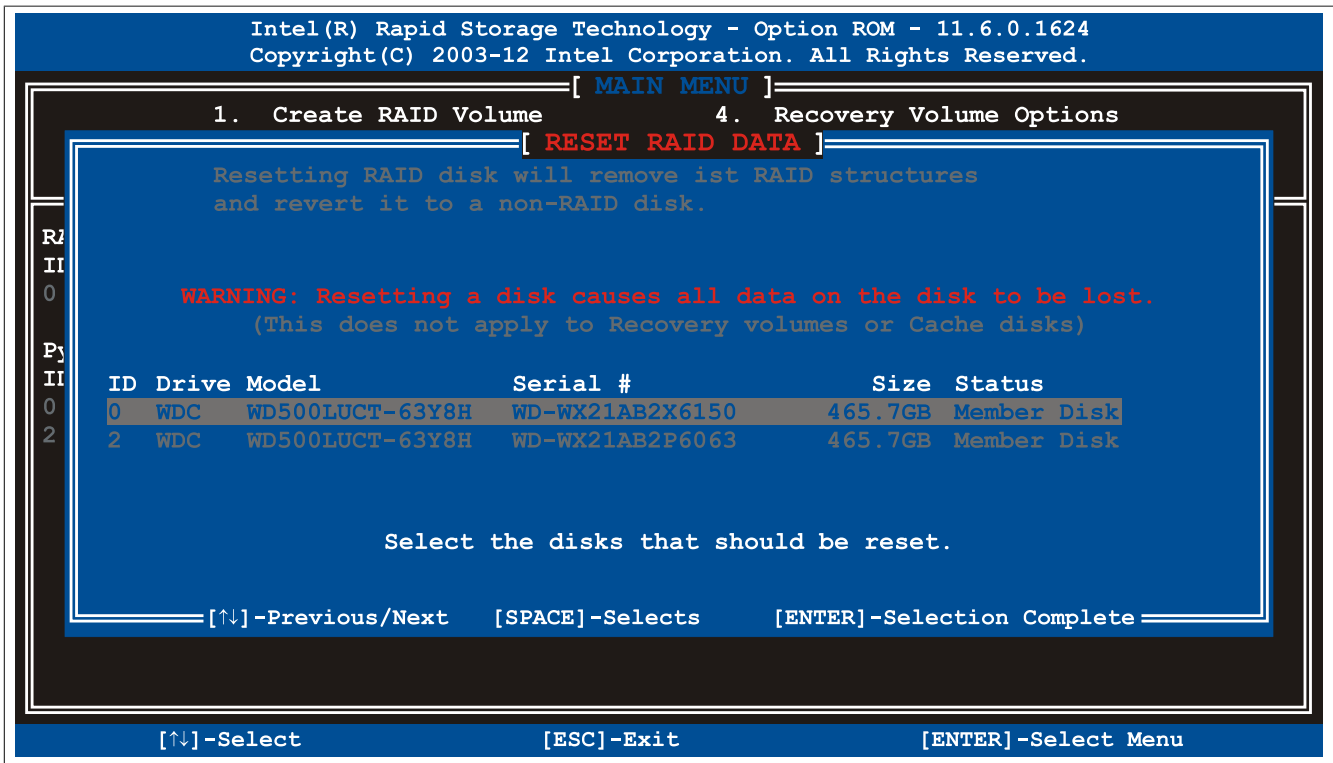


Abbildung 99: Configuration Utility - Reset Disks to Non-RAID

7.4 Recovery Volume Options

Über das Menü „Recovery Volume Options“ können Recovery Disk und Master Disk aktiviert bzw. deaktiviert werden.

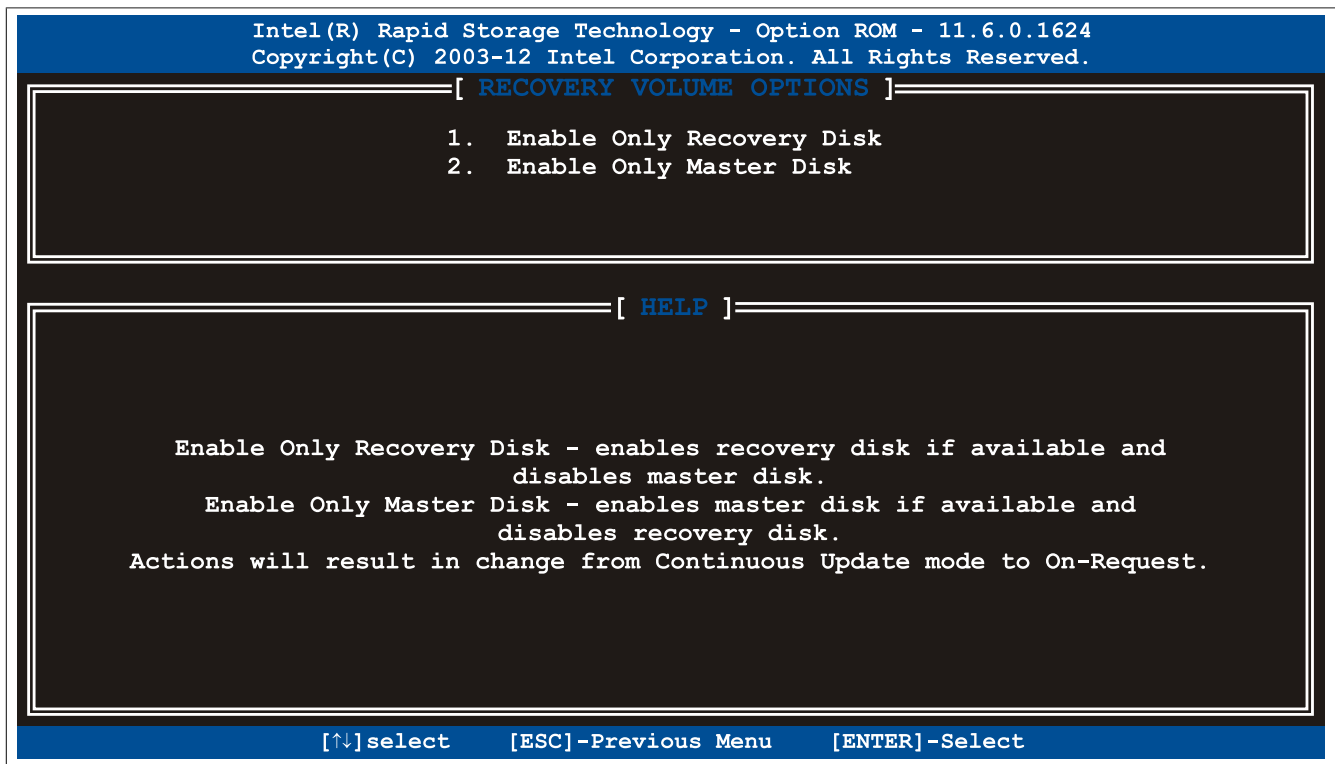


Abbildung 100: Configuration Utility - Recovery Volume Options

Kapitel 4 • Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.15. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen. Weiters sind die BIOS Menüpunkte abhängig von der Systemkonfiguration.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für „Basic Input and Output System“. Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Megatrends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Drücken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird überprüft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM „OK“ sind. Sind diese „OK“, werden sie in das CMOS übertragen. Sind diese „nicht OK“, werden die CMOS Daten auf Gültigkeit überprüft. Sind die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser „Vorbereitungen“ durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die „Entf“ Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedrückt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (während POST): „Press DEL to run Setup“



Abbildung 101: Bootscreen

1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind während dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers angenommen.

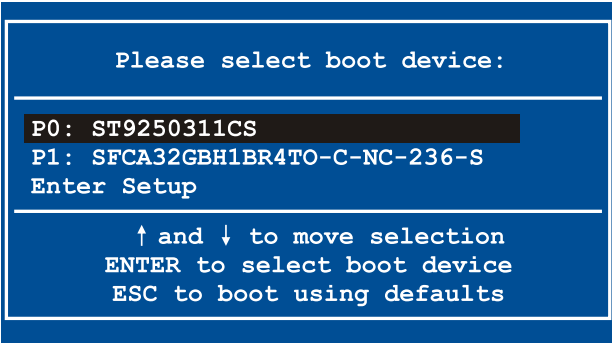
Tasten	Funktion
Entf, F2	Einstieg in das BIOS Setup Menü.
F12	Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.
F11	Aufruf des Bootmenüs. Es werden sämtliche bootfähigen Geräte die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit Cursor ↑ und Cursor ↓ und durch Bestätigen von <ENTER> wird von diesem Gerät gebootet.
	
<Pause>	Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Drücken jeder anderen beliebigen Taste läuft der POST weiter.

Tabelle 133: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
F1	Generelle Hilfe.
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Objekt.
Cursor →	Zum nächsten Objekt.
+/-	Ändert die Einstellung der ausgewählten Funktion.
Enter	In das ausgewählte Menü wechseln.
Bild ↑	Auf die vorherige Seite wechseln.
Bild ↓	Auf die nächste Seite wechseln.
Pos 1	Man springt zum ersten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
Ende	Man springt zum letzten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
F2 / F3	Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.
F7	Änderungen werden zurückgesetzt.
F9	CMOS Default Werte für alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10	Speichern und schließen.
Esc	Untermenü verlassen.

Tabelle 134: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü

1.3 Main

Unmittelbar nach Drücken der Taste „Entf“ beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

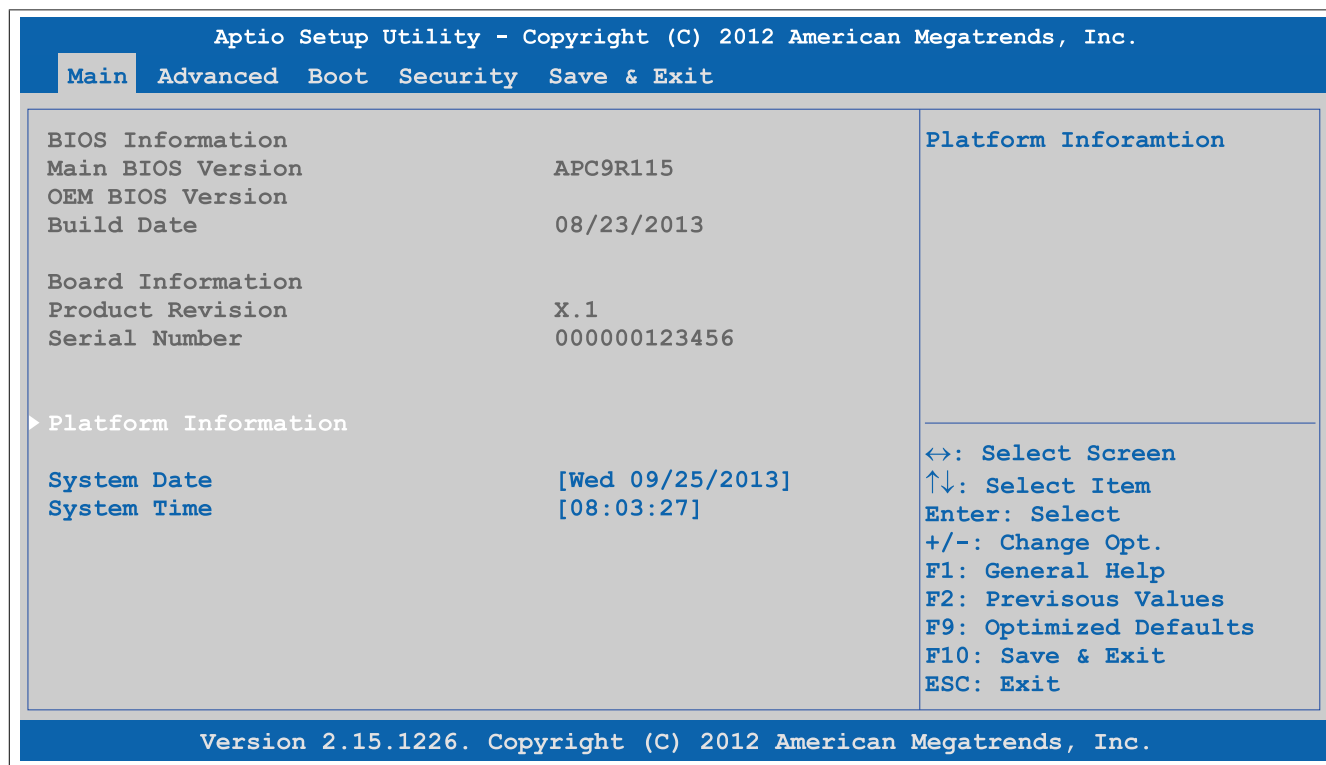


Abbildung 102: Main

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
BIOS Information			
Main BIOS Version	Anzeige der BIOS Erkennung.	keine	-
OEM BIOS Version	Anzeige der OEM BIOS Erkennung.	keine	-
Build Date	Anzeige des BIOS Erstellungsdatums.	keine	-
Board Information			
Product Revision	Anzeige der HW-Revision des CPU Boards.	keine	-
Serial Number	Anzeige der Seriennummer des CPU Boards.	keine	-
Platform Information	Anzeige von verschiedenen Informationen über Chipsatz, CPU Board und Hauptspeicher.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Platform Information" auf Seite 166
System Date	Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung vom Systemdatum	Individuelle Einstellung des Systemdatums im Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
System Time	Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung der Systemzeit	Individuelle Einstellung der Systemzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).

Tabelle 135: Main Einstellmöglichkeiten

1.3.1 Platform Information

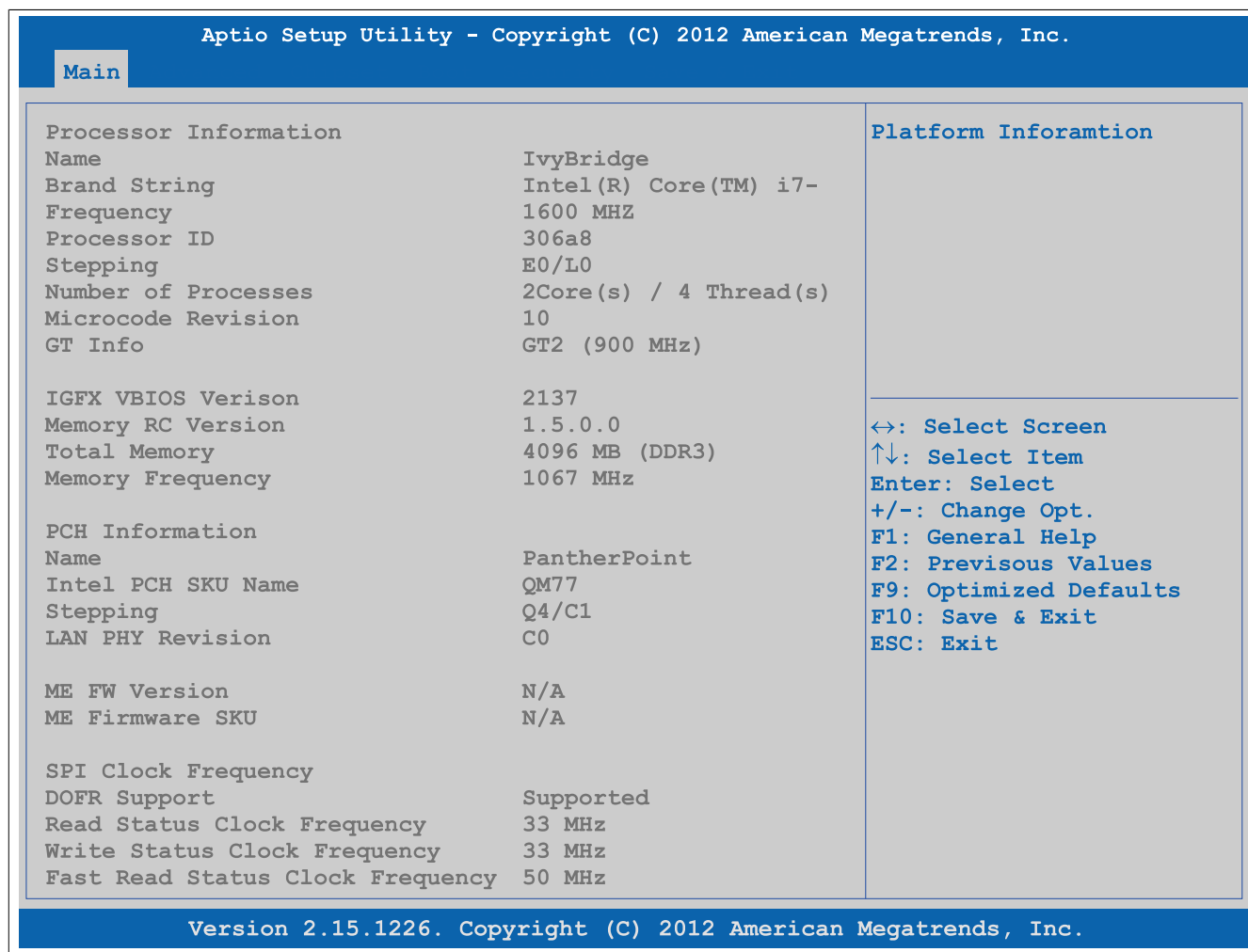


Abbildung 103: Main - Platform Information

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Processor Information			
Name	Anzeige der Prozessorarchitektur.	keine	-
Brand String	Anzeige des Prozessortyps.	keine	-
Frequency	Anzeige der Prozessor Frequenz.	keine	-
Processor ID	Anzeige der Prozessor ID.	keine	-
Stepping	Anzeige des Prozessor Steppingversion.	keine	-
Number of Processors	Anzeige der Prozessor Kerne / Threads.	keine	-
Microcode Revision	Anzeige der Prozessor Microcode Revision.	keine	-
GT Info	Anzeige der GT Information.	keine	-
IGFX VBIOS Version	Anzeige der IGFX VBIOS Version.	keine	-
Memory RC Version	Anzeige der Memory RC Version.	keine	-
Total Memory	Anzeige der Arbeitsspeichergröße.	keine	-
Memory Frequency	Anzeige der Arbeitsspeicherfrequenz.	keine	-
PCH Information			
Name	Anzeige des Platform Controller Hub.	keine	-
Intel PCH SKU Name	Anzeige des Chipsatz am CPU Board.	keine	-
Stepping	Anzeige der Chipsatz Stepping Version.	keine	-
LAN PHY Revision	Anzeige der LAN Revision.	keine	-
ME FW Version	Anzeige der Intel Management Engine Firmware Version.	keine	-
ME Firmware SKU	Anzeige der Intel Management Engine Firmware Stock Keeping Unit Version.	keine	-
SPI Clock Frequency			
DOFR Support	Anzeige des DOFR Support.	keine	-
Read Status Clock Frequency	Anzeige der Read Status Clock Frequenz.	keine	-
Write Status Clock Frequency	Anzeige der Write Status Clock Frequenz.	keine	-
Fast Read Status Clock Frequency	Anzeige der Fast Read Status Clock Frequenz.	keine	-

Tabelle 136: Main - Platform Information Übersicht

1.4 Advanced

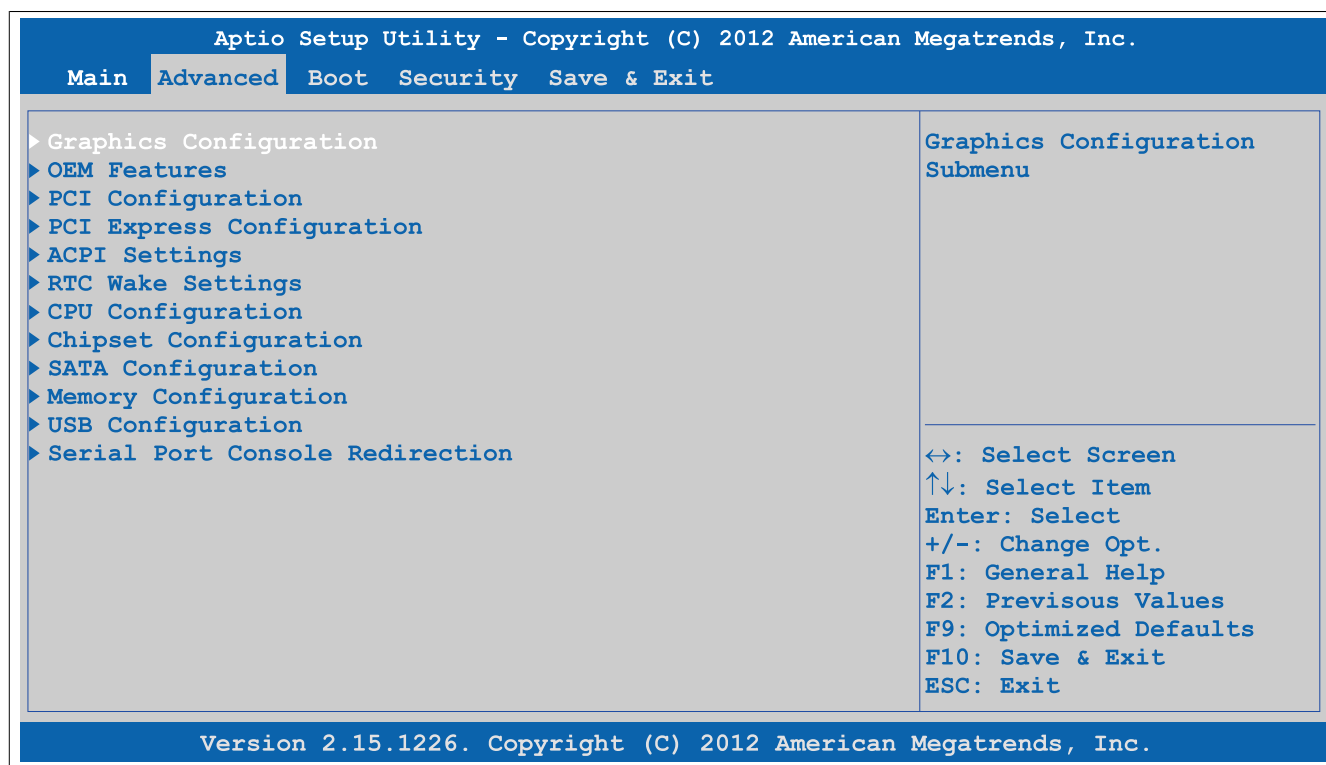


Abbildung 104: Advanced Übersicht

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Graphics Configuration	Konfiguration der Grafikeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Graphics Configuration" auf Seite 168
OEM Features	Konfiguration der OEM Features.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "OEM Features" auf Seite 170
PCI Configuration	Konfiguration der PCI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Configuration" auf Seite 190
PCI Express Configuration	Konfiguration der PCI Express Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Configuration" auf Seite 192
ACPI Settings	Konfiguration der ACPI Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "ACPI Settings" auf Seite 199
RTC Wake Settings	Konfiguration der Startzeit aus dem ausgeschalteten Zustand.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "RTC Wake Settings" auf Seite 200
CPU Configuration	Konfiguration der CPU Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Configuration" auf Seite 201
Chipset Configuration	Konfiguration der Chipsatz Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Chipset Configuration" auf Seite 204
SATA Configuration	Konfiguration der SATA Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "SATA Configuration" auf Seite 205
Memory Configuration	Konfiguration der Hauptspeicher Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Memory Configuration" auf Seite 208
USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB Configuration" auf Seite 212
Serial Port Console Redirection	Konfiguration der Remote Console.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Serial Port Console Redirection" auf Seite 216

Tabelle 137: Advanced Übersicht

1.4.1 Graphics Configuration

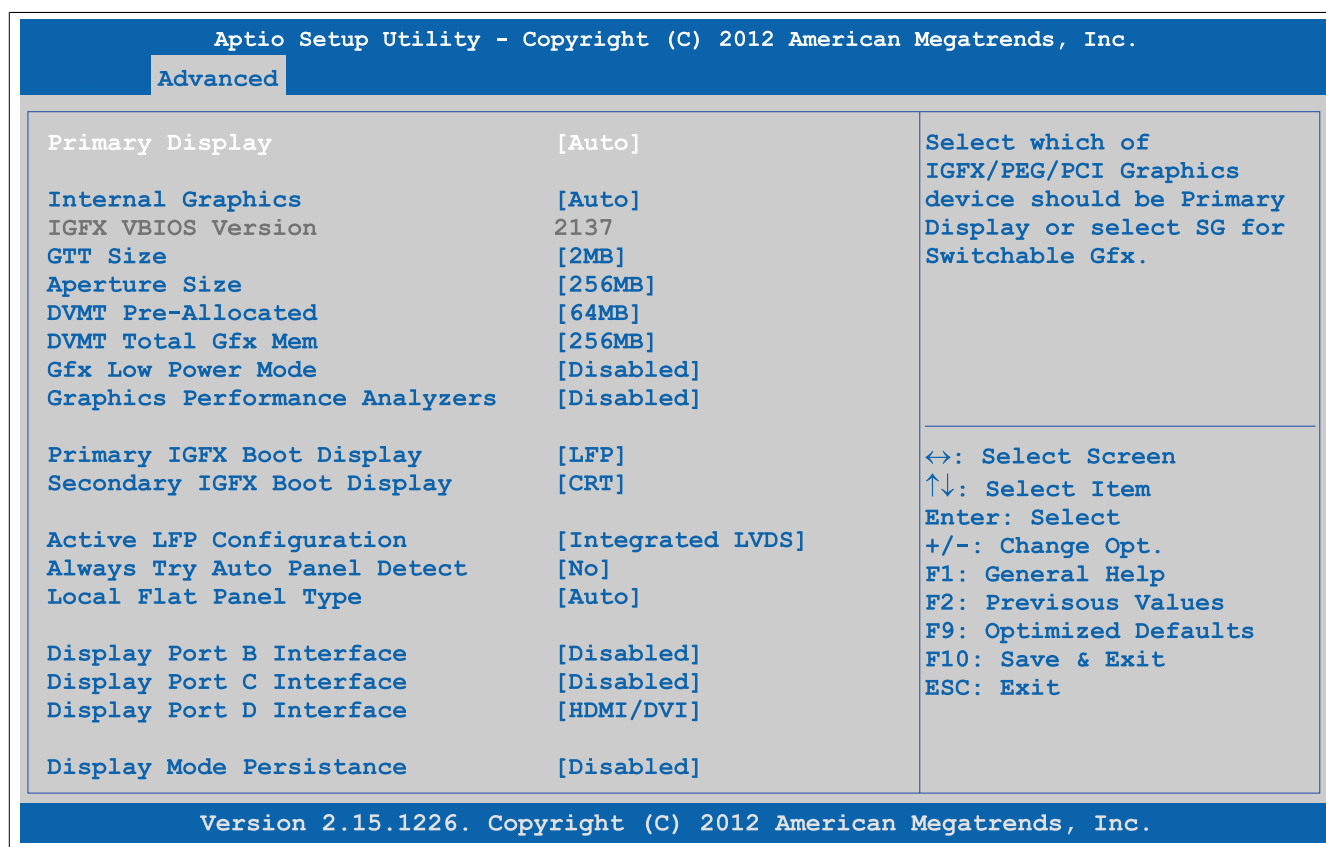


Abbildung 105: Advanced - Graphics Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Display	Option zur Auswahl des primären Anzeigegerätes.	Auto	Automatische Einstellung des Anzeigegeräts.
		IGD	Als Anzeigegerät wird der interne Grafikchip am CPU Board verwendet.
		PEG	Als Anzeigegerät wird eine externe PCI Express Grafikkarte, welche am x16 PEG Port angeschlossen ist, verwendet.
		PCI	Als Anzeigegerät wird der Grafikchip einer gesteckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics	Option zum Einstellen des internen Grafikchip.	Auto	Der interne Grafikchip ist aktiviert.
		Disabled	Der interne Grafikchip ist deaktiviert.
		Enabled	Der interne Grafikchip ist aktiviert.
IGFX VBIOS Version	Anzeige der IGFX Bios Version.	keine	-
GTT Size	Option zum Einstellen der GTT Größe.	1MB	1 MByte GTT.
		2MB	2 MByte GTT.
Aperture Size	Option zum Einstellen der Menge an RAM die vom Hauptspeicher maximal zur Verfügung gestellt wird, wenn der Grafikspeicher voll ist.	128M	128 MByte werden reserviert.
		256M	256 MByte werden reserviert.
		512M	512 MByte werden reserviert.
DVMT Pre-Allocated	Option zur Einstellung der fixen Speichergröße, welche für den internen Grafikcontroller verwendet wird.	32M, 64M, 96M bis 1024M	Der fixe Grafikspeicher wird von 32 MByte bis 1024 MByte festgelegt.
DVMT Total Gfx Mem	Option zum Einstellen der Speichergröße, welche vom internen Grafikcontroller verwendet werden kann. Der Speicherplatz über dem fix vergebenen Grafikspeicherplatz wird dynamisch nach dem DVMT 5.0 Standard vergeben.	128M	128 MByte vom Hauptspeicher werden zur Verfügung gestellt.
		256M	256 MByte vom Hauptspeicher werden zur Verfügung gestellt.
		MAX	Der gesamte Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
Gfx Low Power Mode	Option zum Einstellen der Energiesparfunktion des Grafikcontroller. Information: Diese Option ist nur für SFF verwendbar.	Enabled	Die Energiesparfunktion ist eingeschaltet. Der Grafikcontroller arbeitet nicht mit der vollen Geschwindigkeit.
		Disabled	Die Energiesparfunktion ist ausgeschaltet.
Graphics Performance Analyzers	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Intel Graphics Performance Analyzers.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Primary IGFX Boot Display	Option zum Festlegen des primären aktivierten Anzeigegeräts während des Bootvorgangs.	VBIOS Default	Die Default-Einstellung des IGFX Bios wird verwendet.

Tabelle 138: Advanced - Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Information: Die Nummerierung der EFP erfolgt dynamisch, je nach vorhandenem Display Port Interface (B/C/D) wird die Nummer automatisch vergeben.	CRT	Der CRT (Cathode Ray Tube) Kanal wird benutzt.
		LFP	Der LFP (Local Flat Panel) Kanal wird benutzt.
		EFP	Der EFP (External Flat Panel) Kanal wird benutzt.
		EFP2	Der EFP2 (External Flat Panel 2) Kanal wird benutzt.
		EFP3	Der EFP3 (External Flat Panel 3) Kanal wird benutzt.
Secondary IGFX Boot Display	Option zum Festlegen des sekundären aktivierten Anzeigegegeräts während des Bootvorgangs. Information: Die Nummerierung der EFP erfolgt dynamisch, je nach vorhandenem Display Port Interface (B/C/D) wird die Nummer automatisch vergeben. Information: Nach dem BIOS-Bootscreen wird an diesem Display und dem BIOS nichts mehr angezeigt, bis der Grafiktreiber vom Betriebssystem wieder geladen wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Der POST wird nur an einem Display angezeigt.
		CRT	Der CRT (Cathode Ray Tube) Kanal wird benutzt.
		LFP	Der LFP (Local Flat Panel) Kanal wird benutzt.
		EFP	Der EFP (External Flat Panel) Kanal wird benutzt.
		EFP2	Der EFP2 (External Flat Panel 2) Kanal wird benutzt.
Active LFP Configuration	Option zur Auswahl des aktiven LFP (Local Flat Panel) Kanals. Information: Diese Option hat keine Auswirkungen auf den Automation PC 910.	No Local Flat Panel	Kein LVDS Kanal wird verwendet.
		Integrated LVDS	Der integrierte LVDS Kanal wird verwendet.
Always Try Auto Panel Detect	Die Option sucht zuerst EDID Daten in einem externen EEPROM, um den LFP zu konfigurieren. Wurden keine EDID Daten gefunden, werden die unter „Local Flat Panel Type“ ausgewählten Daten verwendet.	No	Deaktivierung der Funktion.
		Yes	Aktivierung der Funktion.
Local Flat Panel Type	Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil für den LVDS Kanal eingestellt werden.	Auto	Automatische Erkennung und Einstellung anhand der EDID Daten.
		VGA 1x18 (002h)	640 x 480
		VGA 1x18 (013h)	640 x 480
		SVGA 1x18 (01Ah)	800 x 600
		XGA 1x18 (006h)	1024 x 768
		XGA 2x18 (007h)	1024 x 768
		XGA 1x24 (008h)	1024 x 768
		XGA 2x24 (012h)	1024 x 768
		SXGA 2x24 (00Ah)	1280 x 1024
		SXGA 2x24 (018h)	1280 x 1024
		UXGA 2x24 (00Ch)	1600 x 1200
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 2	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 3	Benutzerdefiniertes Profil
Display Port B Interface	Option zur Auswahl des Anzeigegegeräts welches an der DisplayPort Schnittstelle angeschlossen ist.	Disabled	DisplayPort Schnittstelle ist deaktiviert.
		Display Port	DisplayPort Schnittstelle wird als DisplayPort konfiguriert.
		HDMI/DVI	DisplayPort Schnittstelle wird als HDMI/DVI Schnittstelle konfiguriert.
Display Port C Interface	Option zur Auswahl des Anzeigegegeräts welches an der Monitor / Panel Option angeschlossen ist.	Disabled	Monitor / Panel Option ist deaktiviert.
		Display Port	Monitor / Panel Option wird als DisplayPort konfiguriert.
		HDMI/DVI	Monitor / Panel Option wird als HDMI/DVI Schnittstelle konfiguriert.
Display Port D Interface	Option zur Auswahl des Anzeigegegeräts welches an der Monitor / Panel Schnittstelle angeschlossen ist.	Disabled	Monitor / Panel Schnittstelle ist deaktiviert.
		Display Port	Monitor / Panel Schnittstelle wird als DisplayPort konfiguriert.
		HDMI/DVI	Monitor / Panel Schnittstelle wird als HDMI/DVI Schnittstelle konfiguriert.

Tabelle 138: Advanced - Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Display Mode Persistence	Display Mode Persistence bedeutet, dass sich das Betriebssystem an vergangene Display-Anschlusskonfigurationen erinnern und wiederherstellen kann. z.B. wird eine duale DVI Anzeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wenn beide DVI Monitore wieder angeschlossen werden, auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlossen und aktiviert wurde.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 138: Advanced - Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.2 OEM Features

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
Versions Main BIOS Version APC9R115 OEM BIOS Version MTCX 1.08 ETH1 MAC Address 00:60:65:15:9C:5D ETH2 MAC Address 00:60:65:15:9C:6D OEM String Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Q1.15 Realtime Environment [Disabled]		Change some settings important for RT.
▶ Super I/O Configuration ▶ CPU Board Features ▶ System Board Features ▶ Memory Module Features ▶ Display Board Features ▶ Bus Unit Features ▶ I/O Board 1 Features ▶ I/O Board 2 Features ▶ Fan Unit Features ▶ Slide-In 1 Features ▶ Panel Control Features		↔: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previsous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.		

Abbildung 106: Advanced - OEM Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Main BIOS Version	Anzeige der installierten B&R BIOS Version.	keine	-
OEM BIOS Version		keine	-
MTCX	Anzeige der installierten MTCX Version.	keine	-
ETH1 MAC Address	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH1 Schnittstelle.	keine	-
ETH2 MAC Address	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH2 Schnittstelle.	keine	-
Realtime Environment	Diese Option setzt Einstellungen für Echtzeitbetriebssysteme wie z.B. ARWin.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Das Hyper-threading, der Turbo Mode und das EIST werden deaktiviert. Weiters wird das ASPM und der IRQ des Root Port 2 und 3 deaktiviert.
TI XIO2001 PCI Bridge ¹⁾	Option zum Einstellen des DMA Zugriffs.	Enabled	Der DMA Zugriff wird optimiert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Super I/O Configuration	Konfiguration spezieller Einstellungen für die Schnittstellen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Super I/O Configuration" auf Seite 171
CPU Board Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen des CPU Boards.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Board Features" auf Seite 172
System Board Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen der Systemeinheit.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "System Board Features" auf Seite 173
Memory Module Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen des Hauptspeichers.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Memory Module Features" auf Seite 176
Display Board Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen des Panel PC Displays.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Display Board Features" auf Seite 177

Tabelle 139: Advanced - OEM Features - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Bus Unit Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen der Buseinheit.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Bus Unit Features" auf Seite 180
I/O Board 1 Features²⁾	Anzeige gerätespezifischer Informationen der Interface Option 1.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "I/O Board 1 Features" auf Seite 181
I/O Board 2 Features²⁾	Anzeige gerätespezifischer Informationen der Interface Option 2.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "I/O Board 2 Features" auf Seite 183
Fan Unit Features³⁾	Anzeige gerätespezifischer Informationen des Lüfter Kit.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Fan Unit Features" auf Seite 184
Slide-In 1 Features⁴⁾	Anzeige gerätespezifischer Informationen des Slide-in Laufwerk 1.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Slide-in 1 Features" auf Seite 187
Panel Control Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen des angeschlossenen Panels.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel Control Features" auf Seite 188

Tabelle 139: Advanced - OEM Features - Menü

- 1) Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Buseinheit mit PCI Steckplatz verbaut ist.
2) Diese Option wird nur angezeigt, wenn die entsprechende Option in der Systemeinheit verbaut ist.
3) Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Lüfter Kit in der Systemeinheit verbaut ist.
4) Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Slide-in Laufwerk in der Buseinheit verbaut ist.

1.4.2.1 Super I/O Configuration

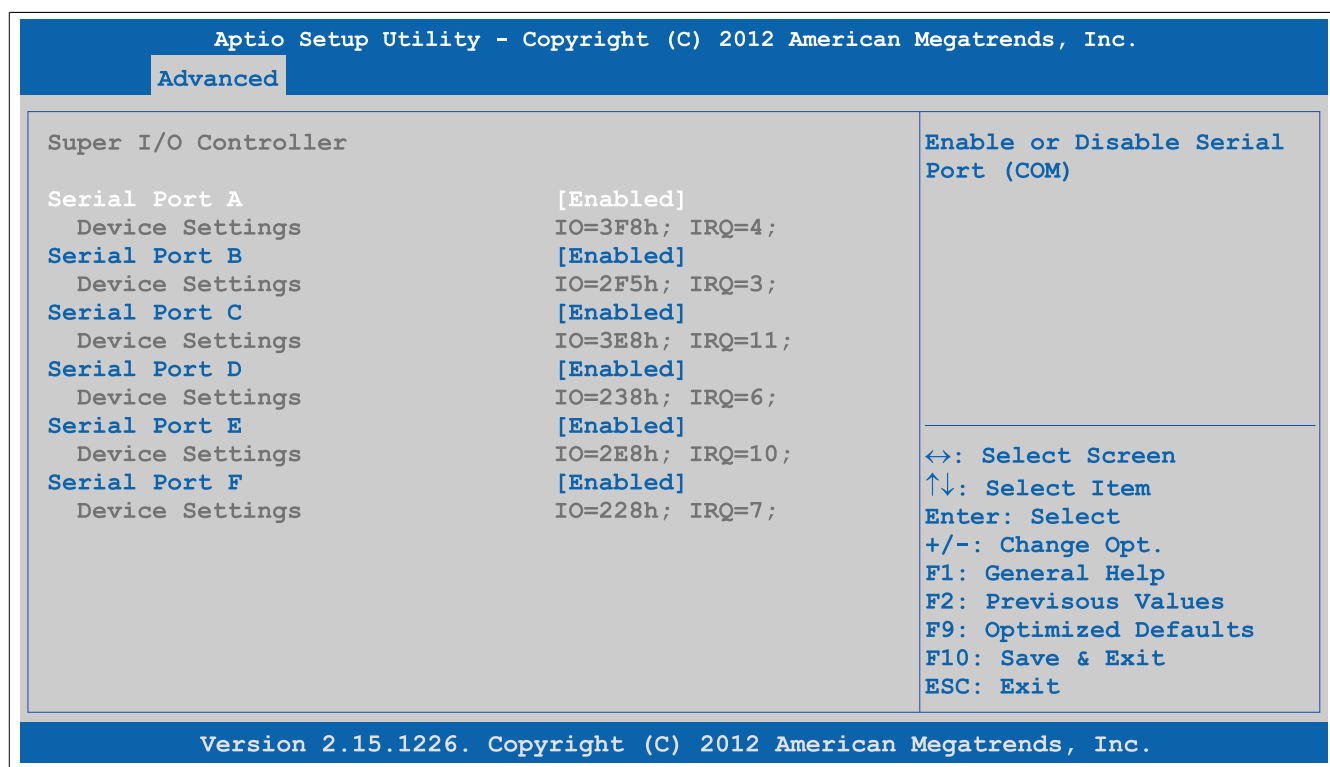


Abbildung 107: Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Serial Port A	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM1 im System.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings	Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts für den COM1 Port.	keine	-
Serial Port B	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM2 im System.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings	Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts für die serielle Schnittstelle COM2 im System.	keine	-
Serial Port C	Einstellung für den onboard Touch Screen.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings	Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts für den onboard Touch Screen.	keine	-
Serial Port D	Einstellung für den Touch Screen eines angeschlossenen Panels.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings	Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts für den Touch Screen eines angeschlossenen Panels.	keine	-
Serial Port E ¹⁾	Einstellung für die RS232 IF Option im IF Option Slot 1.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.

Tabelle 140: Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device Settings	Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts für die RS232 IF Option im IF Option Slot 1.	keine	-
Serial Port F ¹⁾	Einstellung für die RS232 IF Option im IF Option Slot 2.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings	Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts für die RS232 IF Option im IF Option Slot 2.	keine	-
CAN Controller ¹⁾	Einstellung für die CAN IF Option.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings	Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts für die CAN IF Option.	keine	-

Tabelle 140: Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration Einstellmöglichkeiten

1) Diese Option wird nur angezeigt, wenn die entsprechende IF Option in der Systemeinheit verbaut ist.

1.4.2.2 CPU Board Features



Abbildung 108: Advanced - OEM Features - CPU Board Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Geräteerkennung des CPU Boards.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der CPU Board Hardware Revision.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Temperatur Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values" auf Seite 173

Tabelle 141: Advanced - OEM Features - CPU Board Features

1.4.2.2.1 Temperature Values

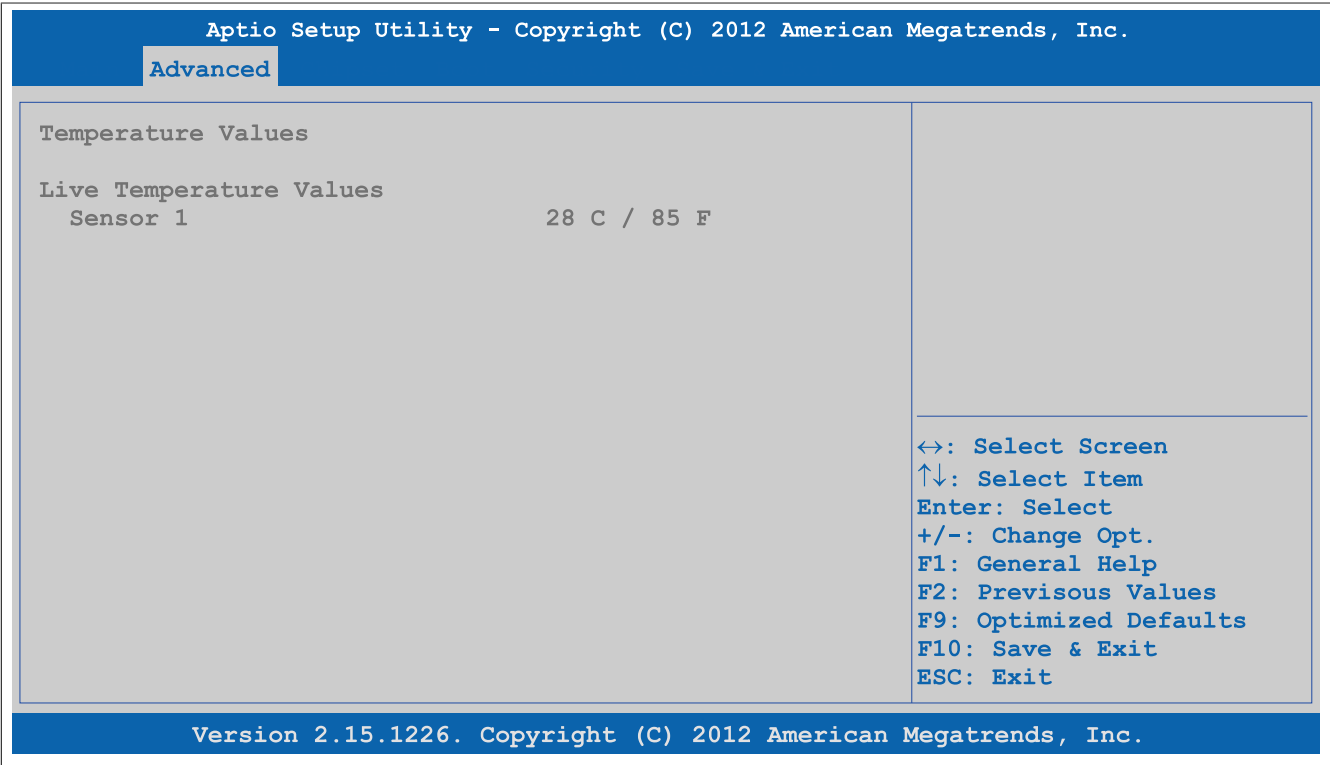


Abbildung 109: Advanced - OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 1 (CPU) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 142: Advanced - OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values

1.4.2.3 System Board Features

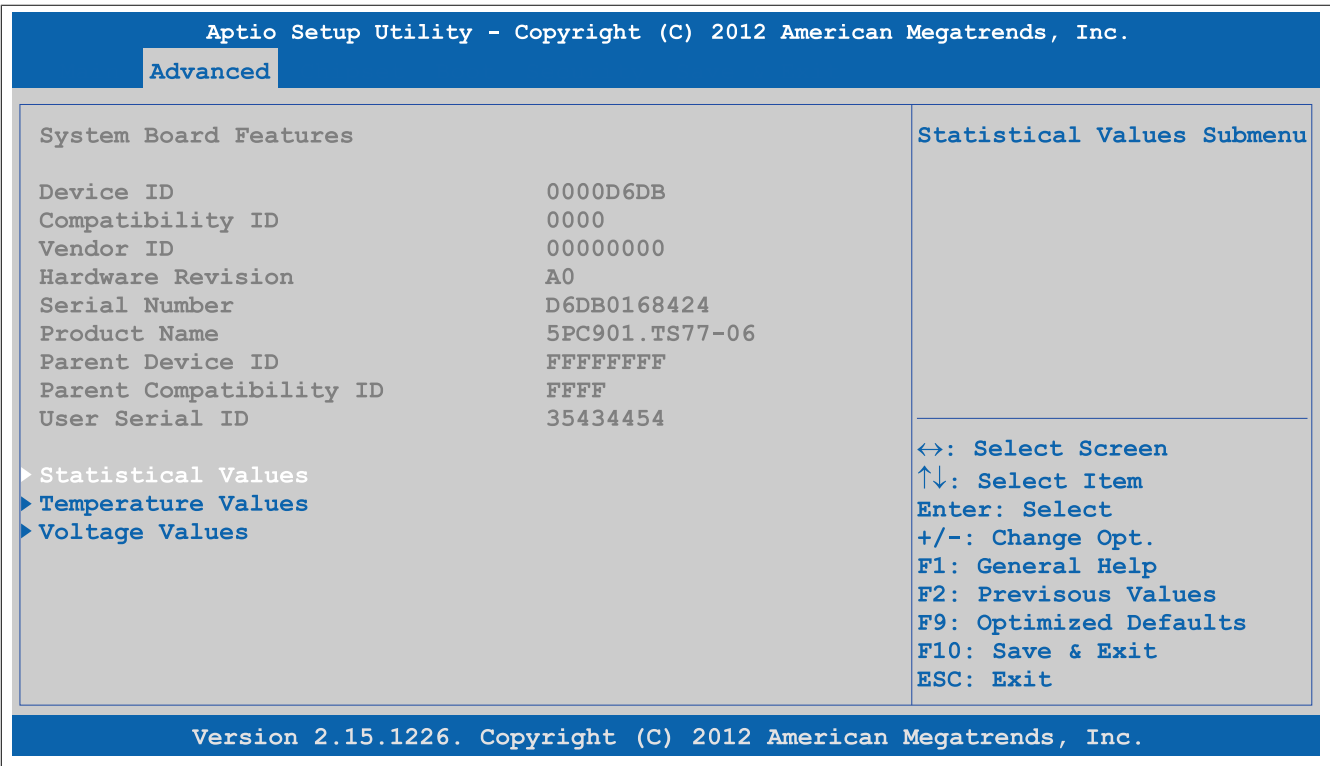


Abbildung 110: Advanced - OEM Features - System Board Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Geräteerkennung des CPU Boards.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der CPU Board Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatibility ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 174
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values" auf Seite 175
Voltage Control	Anzeige der aktuellen Batterieeigenschaften.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Voltage Values" auf Seite 176

Tabelle 143: Advanced - OEM Features - System Board Features

1.4.2.3.1 Statistical Values

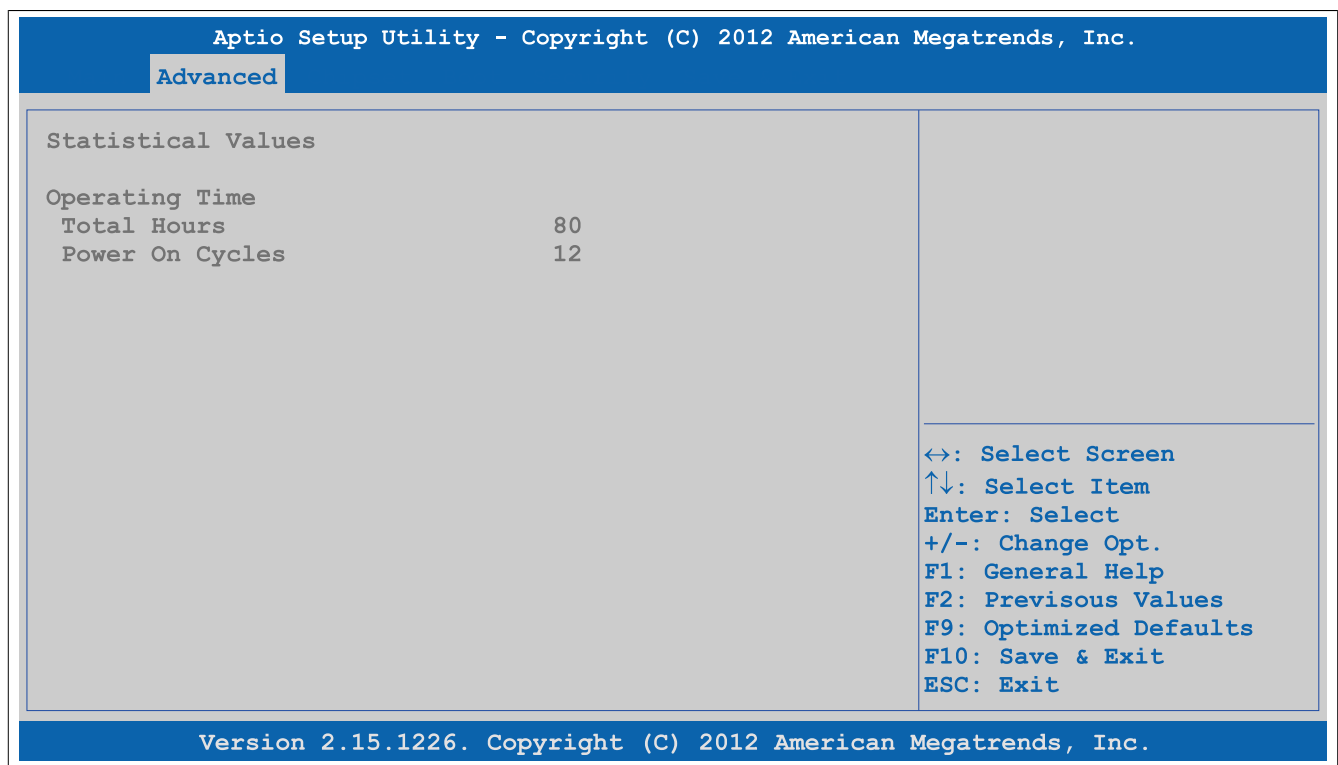


Abbildung 111: Advanced - OEM Features - System Board Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 144: Advanced - OEM Features - System Board Features - Statistical Values

1.4.2.3.2 Temperature Values

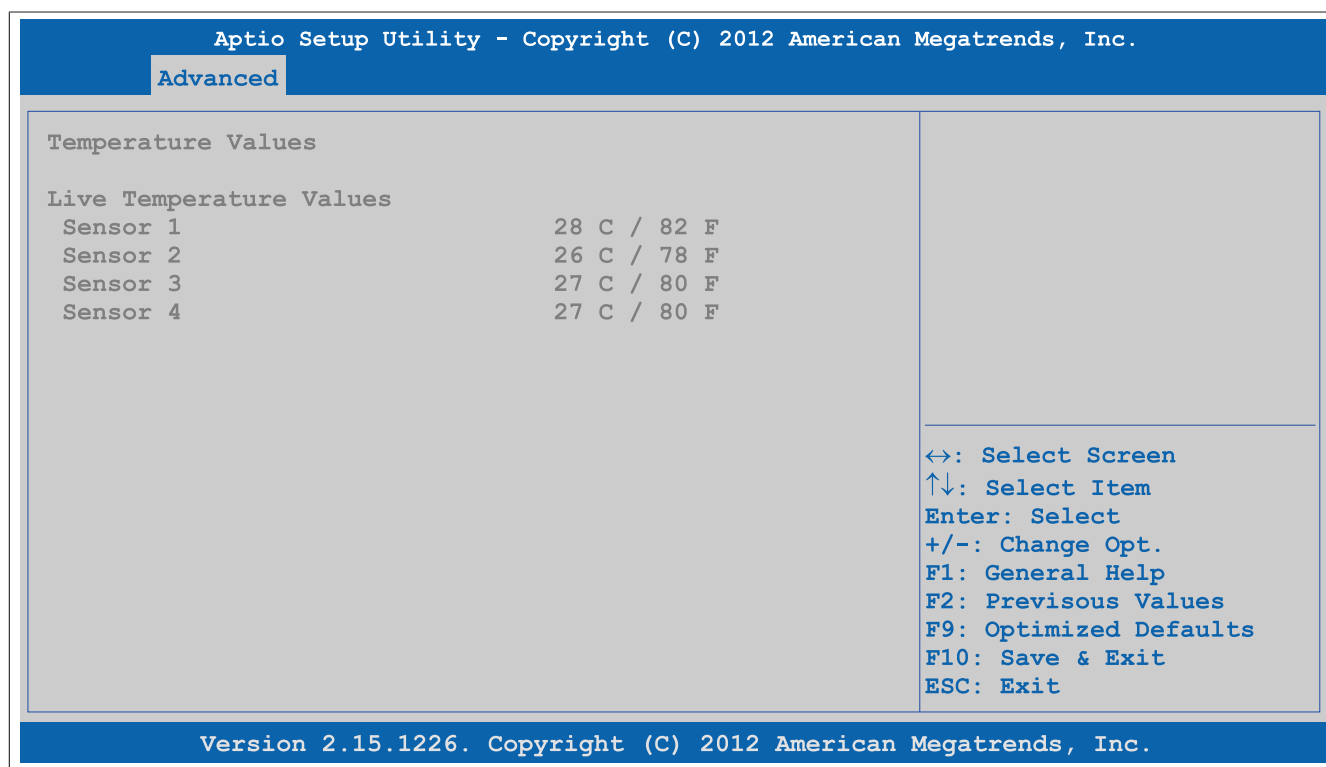


Abbildung 112: Advanced - OEM Features - System Board Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 1 (Board) in °C und °F.	keine	-
Sensor 2	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 2 (Chipsatz) in °C und °F.	keine	-
Sensor 3	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 3 (Board Netzteil) in °C und °F.	keine	-
Sensor 4	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 4 (CFast) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 145: Advanced - OEM Features - System Board Features - Temperature Values

1.4.2.3.3 Voltage Values

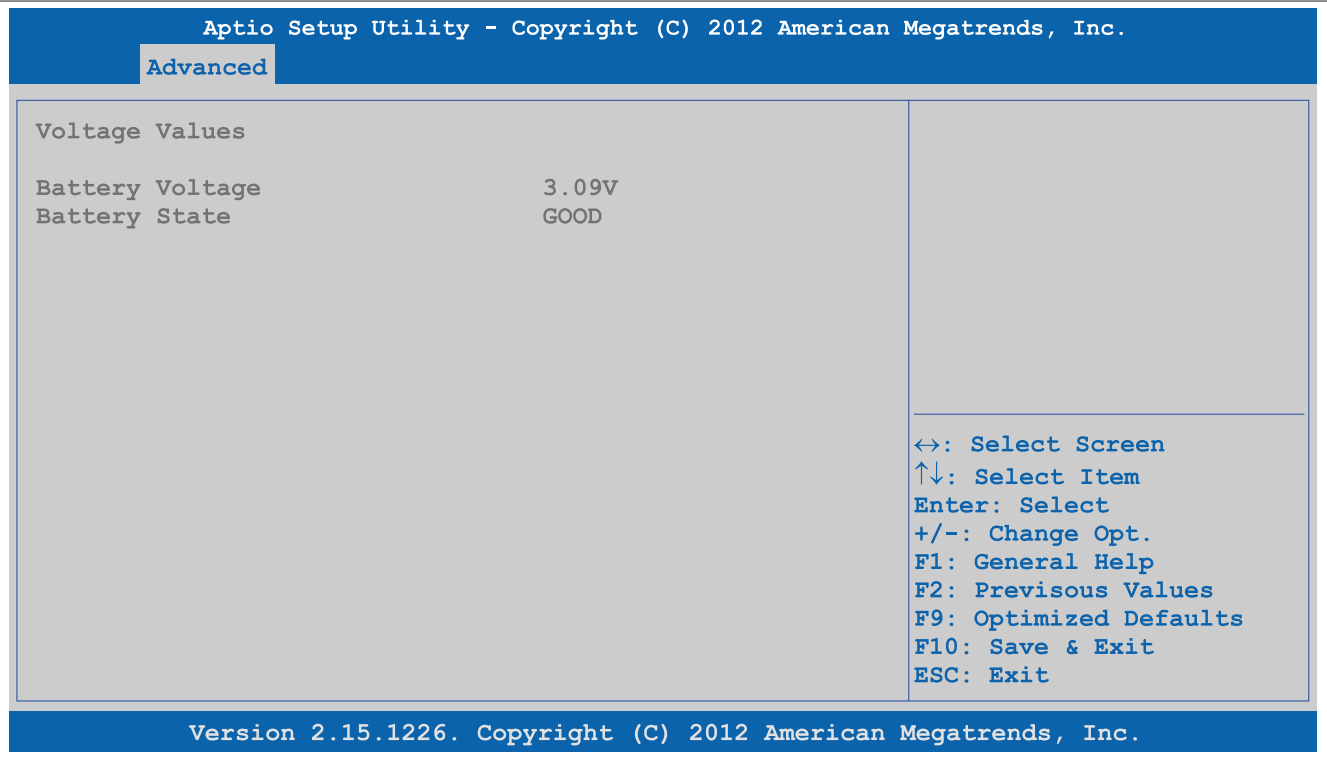


Abbildung 113: Advanced - OEM Features - System Board Features - Voltage Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Battery Voltage	Anzeige der Batteriespannung in Volt.	keine	-
Battery State	Anzeige des Batteriestatus.	keine	-

Tabelle 146: Advanced - OEM Features - System Board Features - Voltage Values

1.4.2.4 Memory Module Features

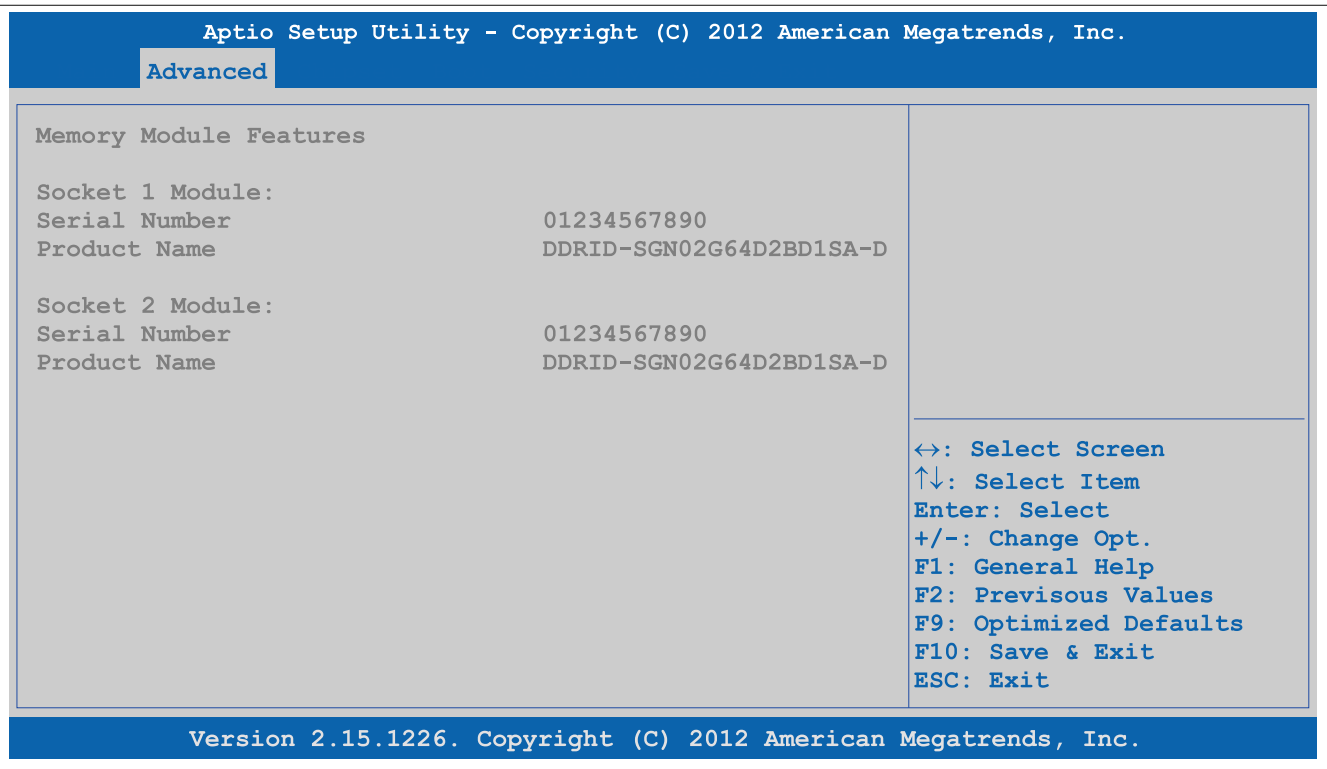


Abbildung 114: Advanced - OEM Features - Memory Module Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Socket 1 Module			
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der Produktnummer.	keine	-
Socket 2 Module			
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der Produktnummer.	keine	-

Tabelle 147: Advanced - OEM Features - Memory Module Features

1.4.2.5 Display Board Features



Abbildung 115: Advanced - OEM Features - Display Board Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Geräteerkennung der Displayeinheit.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der Displayeinheit Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatibility ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 178
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values" auf Seite 178
Panel #15	Anzeige der Panel Eigenschaften der Displayeinheit.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel #15" auf Seite 179

Tabelle 148: Advanced - OEM Features - Display Board Features

1.4.2.5.1 Statistical Values

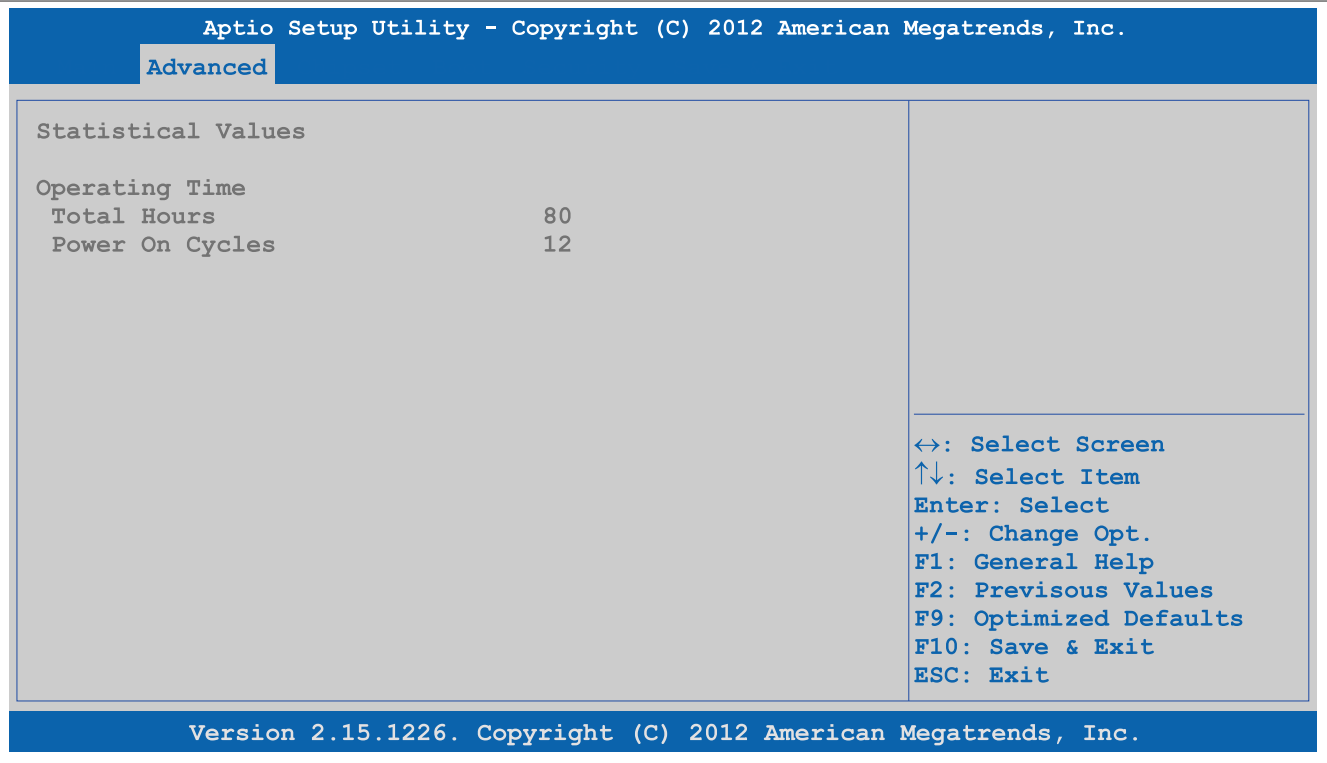


Abbildung 116: Advanced - OEM Features - Display Board Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 149: Advanced - OEM Features - Display Board Features - Statistical Values

1.4.2.5.2 Temperature Values

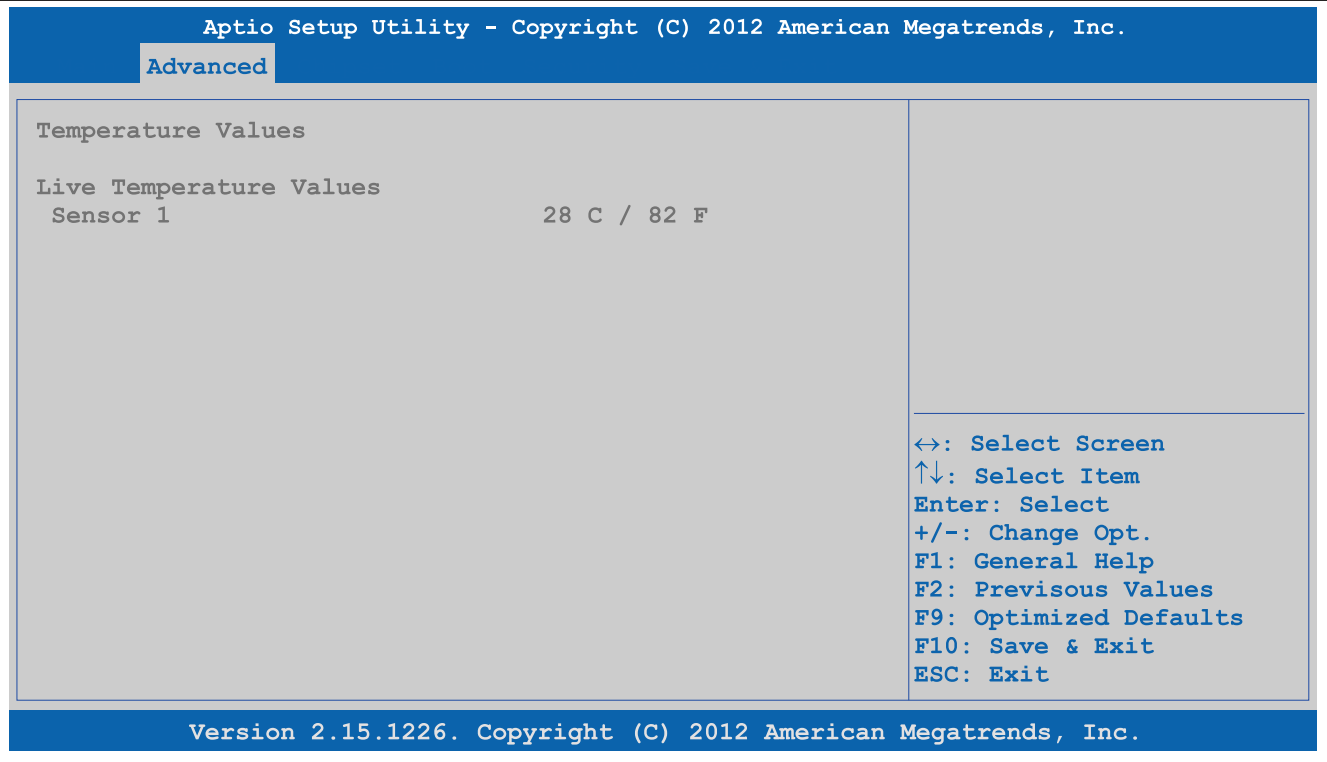


Abbildung 117: Advanced - OEM Features - Display Board Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors (Displayeinheit) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 150: Advanced - OEM Features - Display Board Features - Temperature Values

1.4.2.5.3 Panel #15



Abbildung 118: Advanced - OEM Features - Display Board Features - Panel #15

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Version	Anzeige der Firmwareversion.	keine	-
Brightness	Einstellung der Helligkeit der Displayeinheit.	0 bis 100	Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewählten Panel. Einstellungen werden sofort wirksam.
Fan Speed	Anzeige der Lüfterumdrehungen der Displayeinheit.	keine	-
Keys/Leds	Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs der Displayeinheit.	keine	-
Temperature	Temperaturanzeige der Displayeinheit in °C und °F.	keine	-

Tabelle 151: Advanced - OEM Features - Display Board Features - Panel #15

1.4.2.6 Bus Unit Features

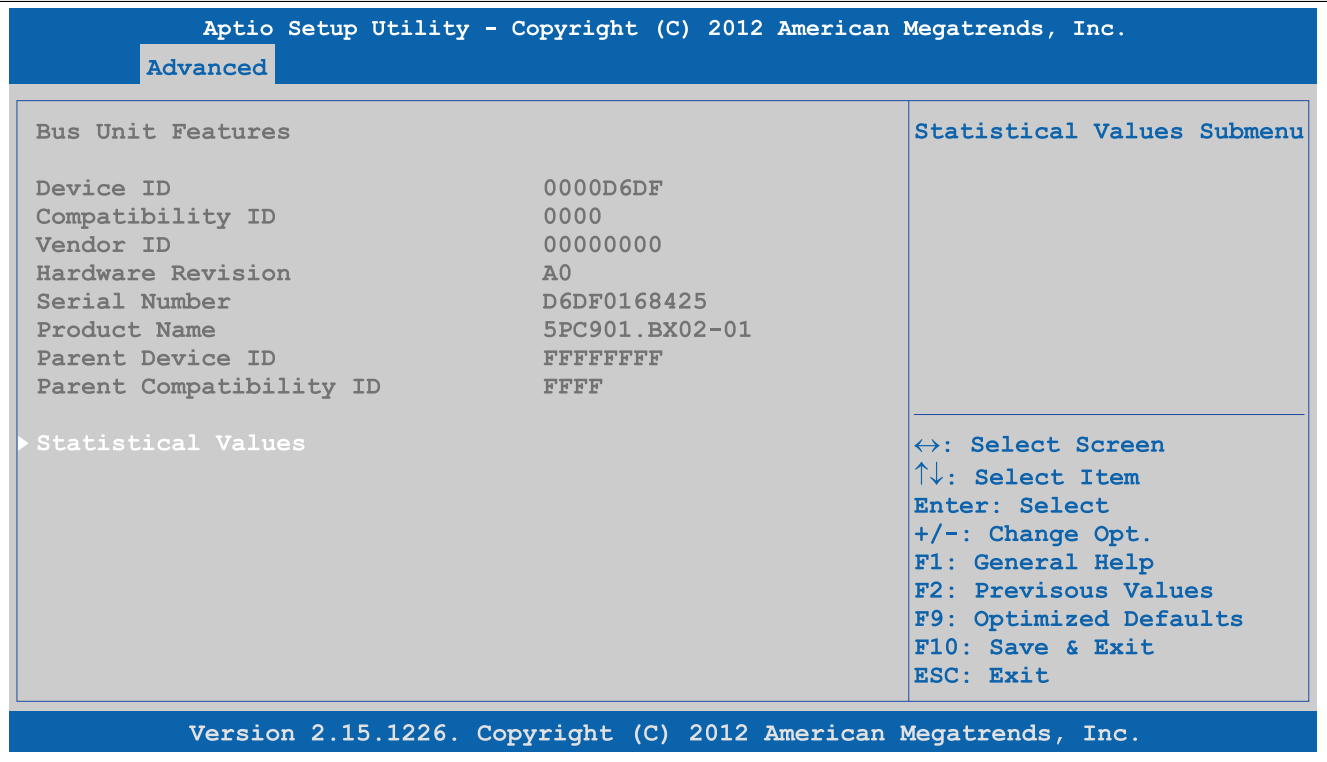


Abbildung 119: Advanced - OEM Features - Bus Unit Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekenung der Buseinheit.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekenung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revison	Anzeige der Buseinheit Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatibility ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 181

Tabelle 152: Advanced - OEM Features - Bus Unit Features

1.4.2.6.1 Statistical Values

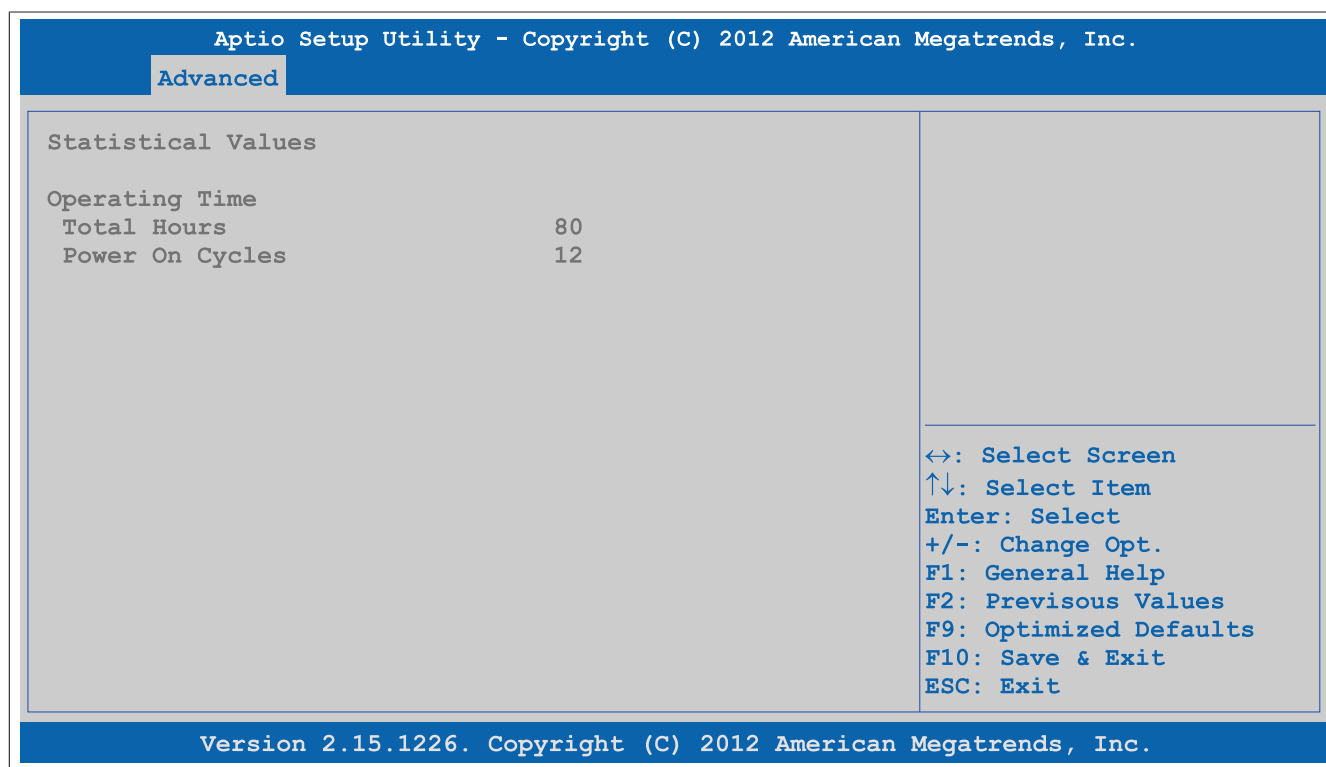


Abbildung 120: Advanced - OEM Features - Bus Unit Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 153: Advanced - OEM Features - Bus Unit Features - Statistical Values

1.4.2.7 I/O Board 1 Features



Abbildung 121: Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Geräteerkennung der IF Option 1.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der IF Option 1 Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatibility ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 182

Tabelle 154: Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features

1.4.2.7.1 Statistical Values

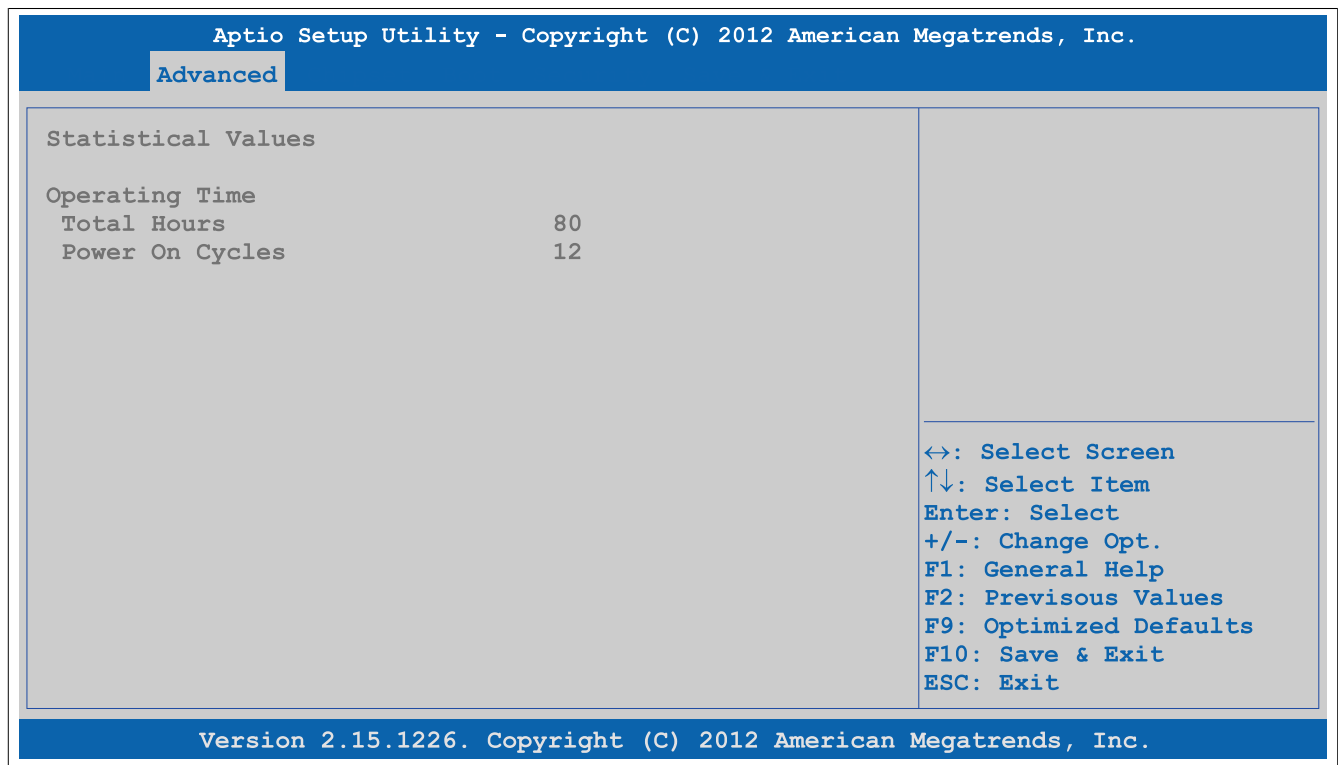


Abbildung 122: Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 155: Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features - Statistical Values

1.4.2.8 I/O Board 2 Features

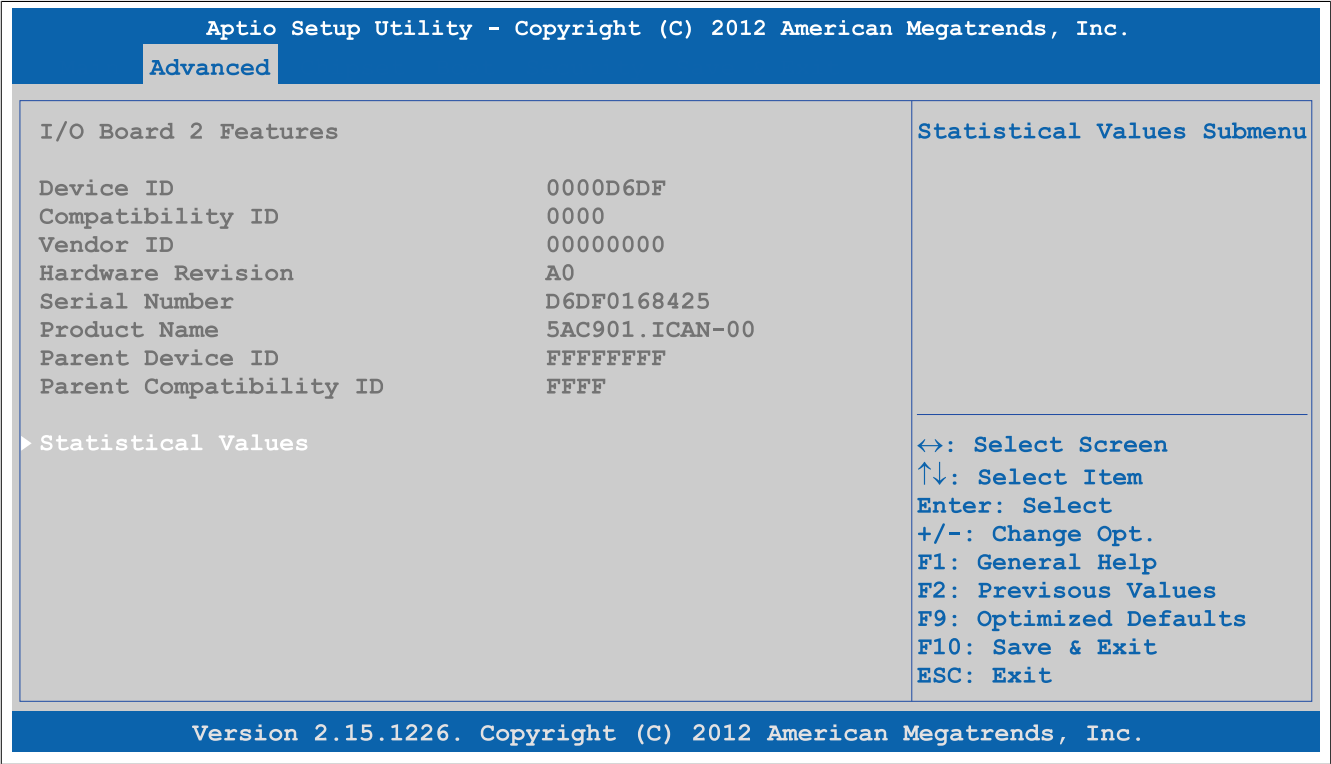


Abbildung 123: Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung der IF Option 2.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der IF Option 2 Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatibility ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 184

Tabelle 156: Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features

1.4.2.8.1 Statistical Values

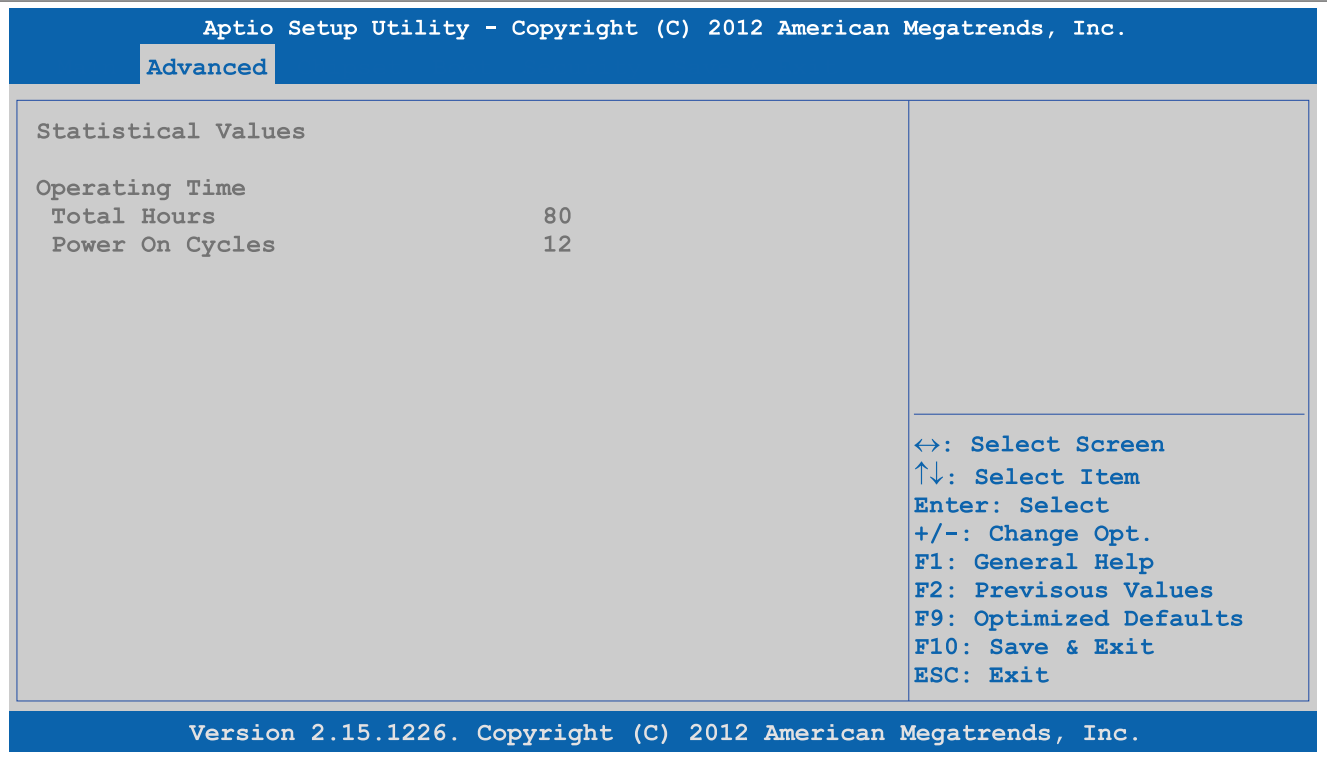


Abbildung 124: Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 157: Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features - Statistical Values

1.4.2.9 Fan Unit Features

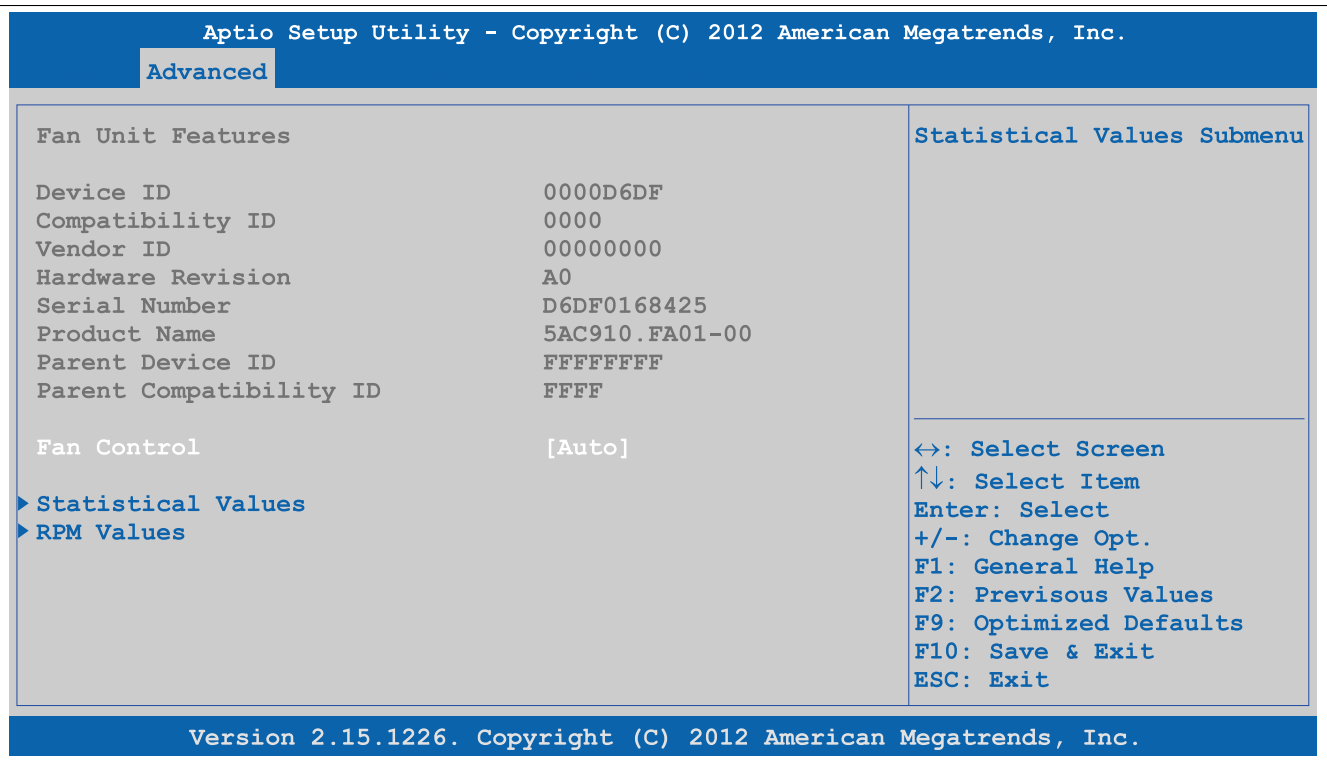


Abbildung 125: Advanced - OEM Features - Fan Unit Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Geräteerkennung des Lüfter Kit.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der Lüfter Kit Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatibility ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
Fan Control	Information: Beim Aufwecken des Geräts aus dem S3 (Suspend to RAM) Mode ist das Lüfter forcen aus dem BIOS nicht möglich. Die Einstellung "Auto" ist aktiv.	Auto	Automatische Lüfterregelung.
		Minimum	Minimale Umdrehungsgeschwindigkeit wird eingestellt. Erhöht sich jedoch eine Temperatur, so regelt der Lüfter trotzdem automatisch um kritische Temperaturen nicht zu überschreiten.
		25%	25% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit wird eingestellt.
		50%	50% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit wird eingestellt.
		75%	75% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit wird eingestellt.
		Maximum	Maximale Umdrehungsgeschwindigkeit wird eingestellt.
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 185
RPM Values	Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit der einzelnen Lüfter am Lüfter Kit.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "RPM Values" auf Seite 186

Tabelle 158: Advanced - OEM Features - Fan Unit Features

1.4.2.9.1 Statistical Values

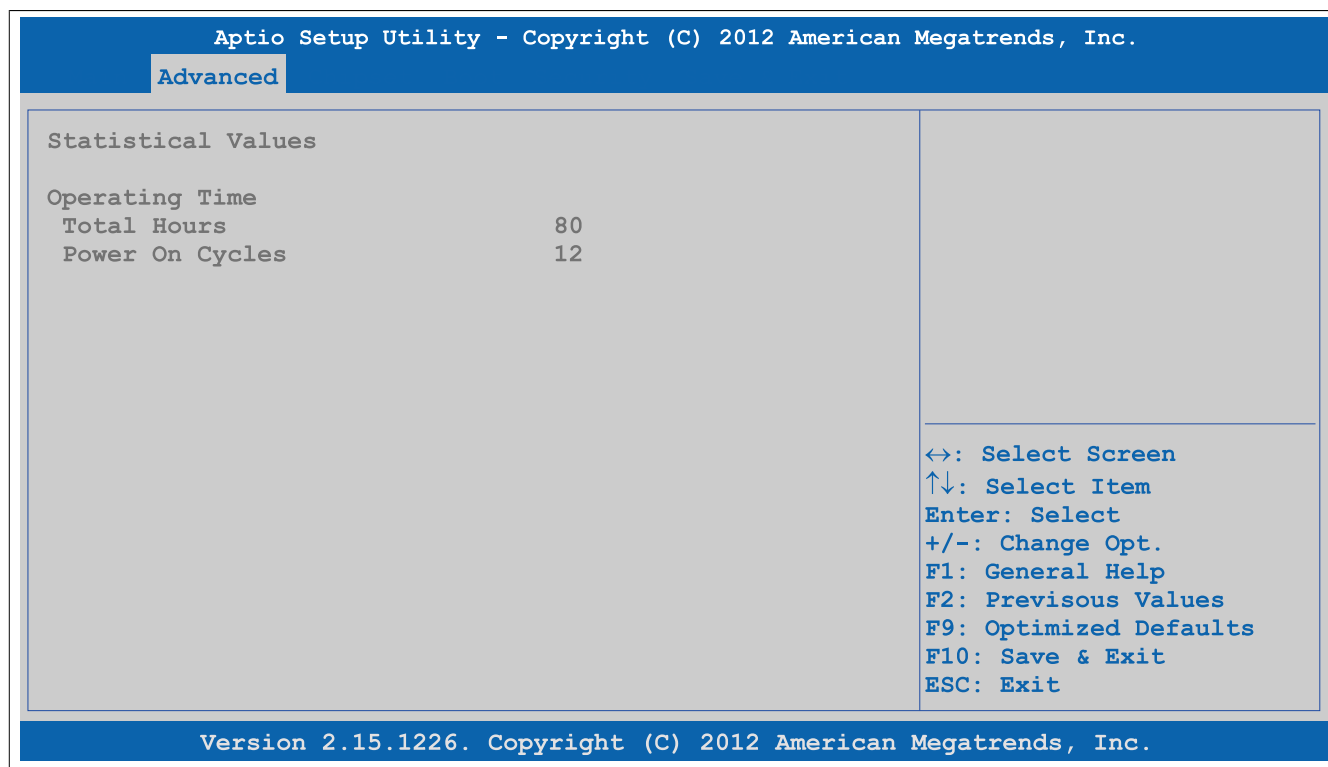


Abbildung 126: Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 159: Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - Statistical Values

1.4.2.9.2 RPM Values

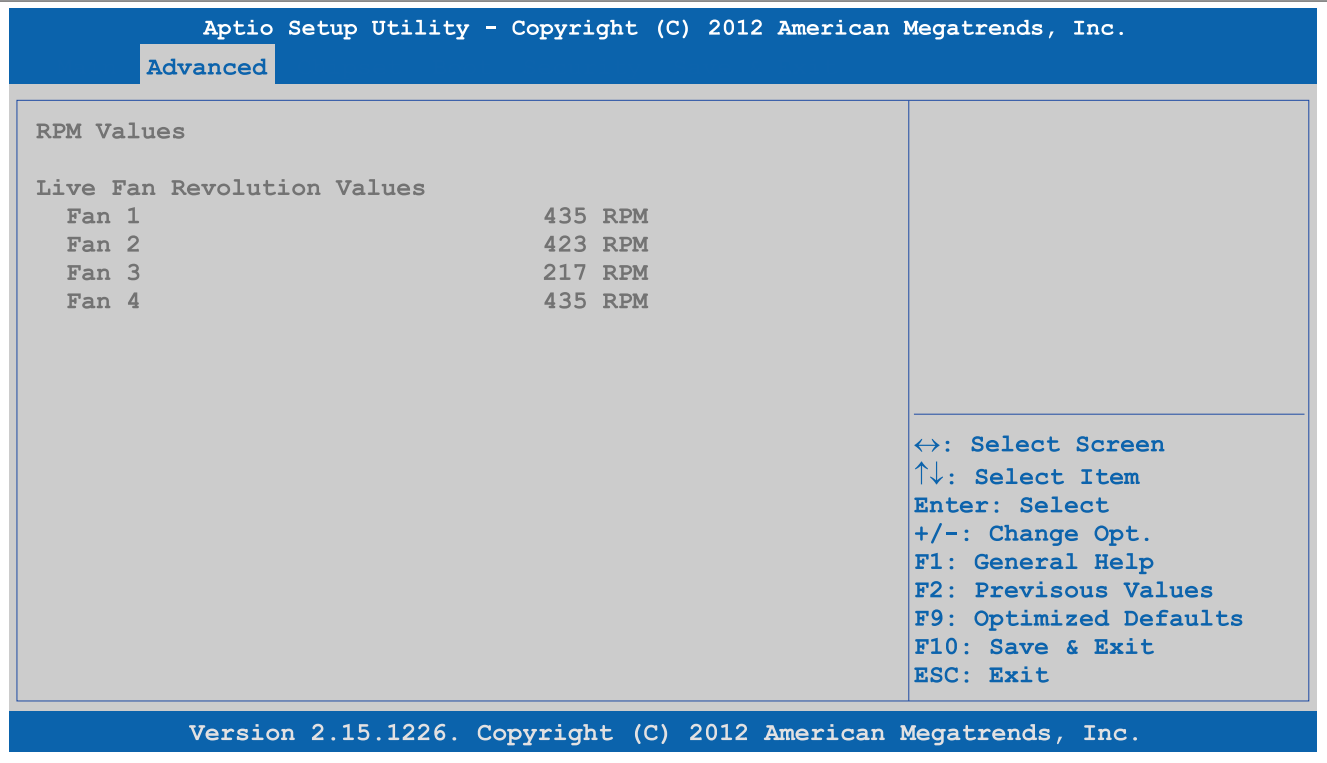


Abbildung 127: Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - RPM Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Fan 1	Anzeige der aktuellen Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfter 1 in RPM.	keine	-
Fan 2	Anzeige der aktuellen Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfter 2 in RPM.	keine	-
Fan 3	Anzeige der aktuellen Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfter 3 in RPM.	keine	-
Fan 4	Anzeige der aktuellen Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfter 4 in RPM.	keine	-

Tabelle 160: Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - RPM Values

1.4.2.10 Slide-in 1 Features

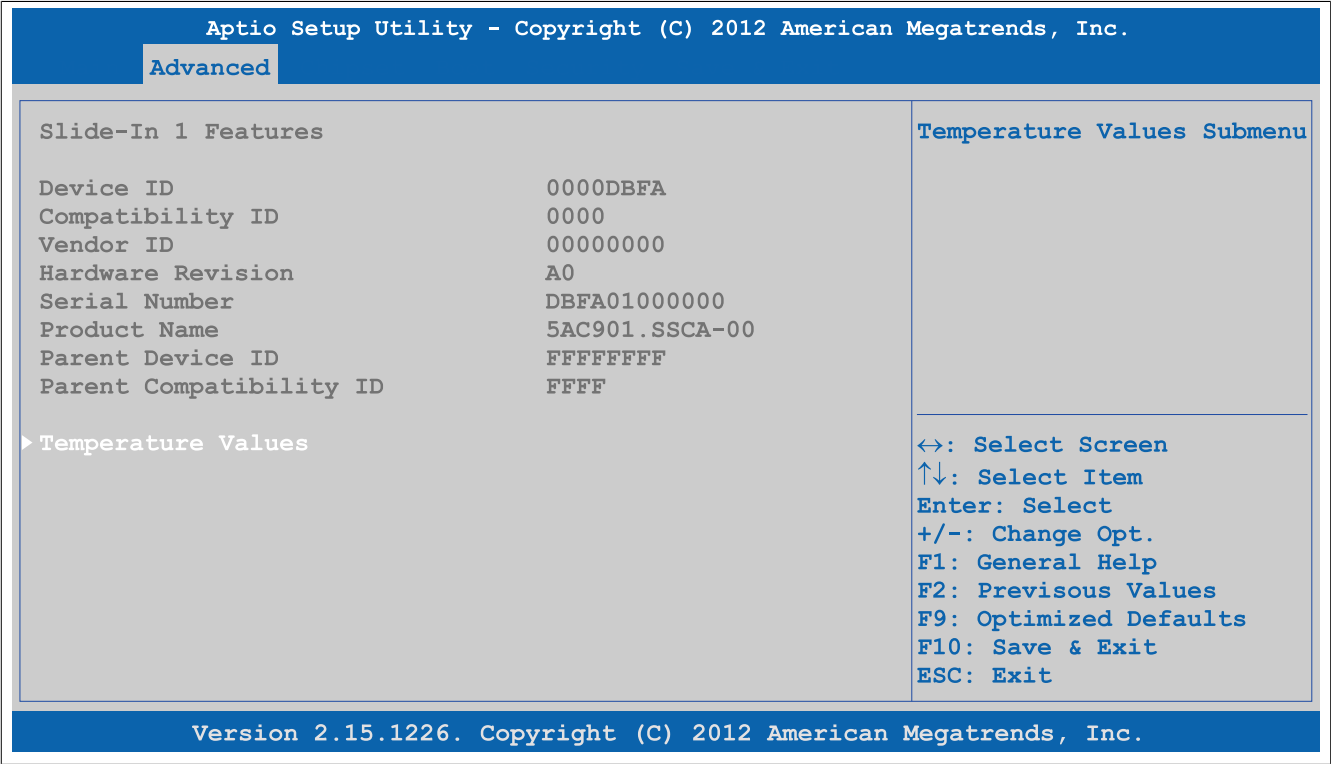


Abbildung 128: Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekenung des Slide-in 1 Laufwerks.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekenung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revison	Anzeige der Slide-in Laufwerk Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatibility ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values" auf Seite 188

Tabelle 161: Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features

1.4.2.10.1 Temperature Values

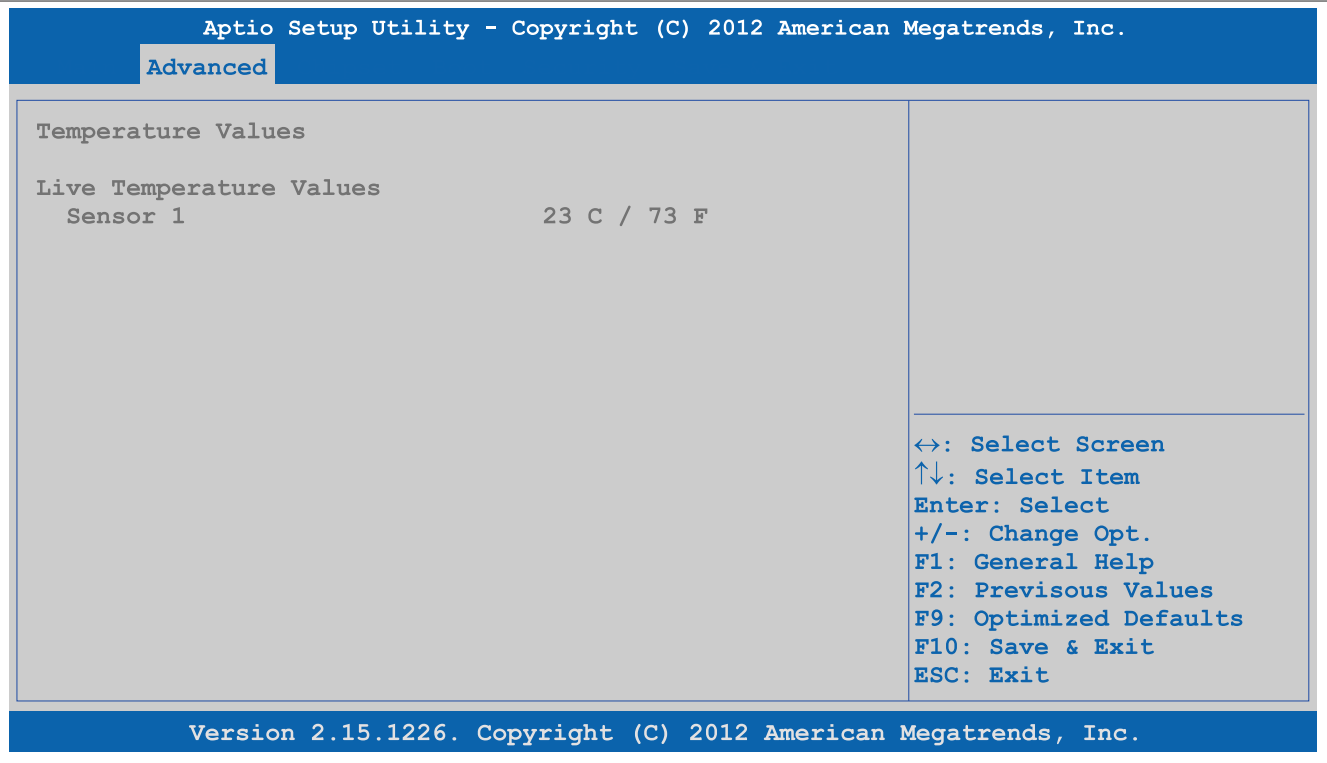


Abbildung 129: Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 1 (Slide-in 1 Laufwerk) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 162: Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features - Temperature Values

1.4.2.11 Panel Control Features

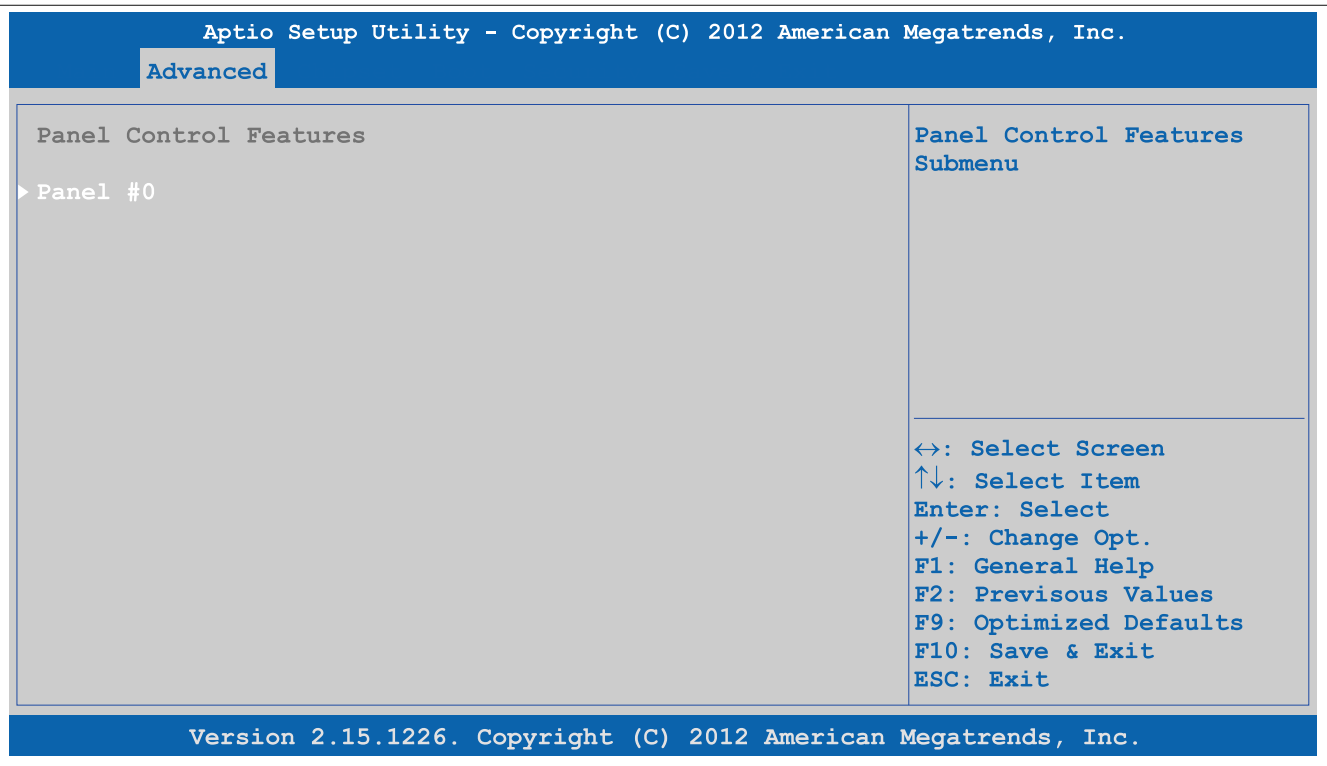


Abbildung 130: Advanced - OEM Features - Panel Control Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Panel #x	Anzeige der Panel Eigenschaften des angeschlossenen Panels.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel #x" auf Seite 189

Tabelle 163: Advanced - OEM Features - Panel Control Features

1.4.2.11.1 Panel #x



Abbildung 131: Advanced - OEM Features - Panel Control Features - Panel #x

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Version	Anzeige der Firmwareversion des SCLR Controllers.	keine	-
Brightness	Einstellung der Helligkeit des Panels.	0 bis 100	Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewählten Panel. Einstellungen werden sofort wirksam.
Fan Speed	Anzeige der Lüfterumdrehungen des Panels.	keine	-
Keys/Leds	Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des Panels.	keine	-
Temperature	Temperaturanzeige des Panels in °C und °F.	keine	-

Tabelle 164: Advanced - OEM Features - Panel Control Features - Panel #x

1.4.3 PCI Configuration

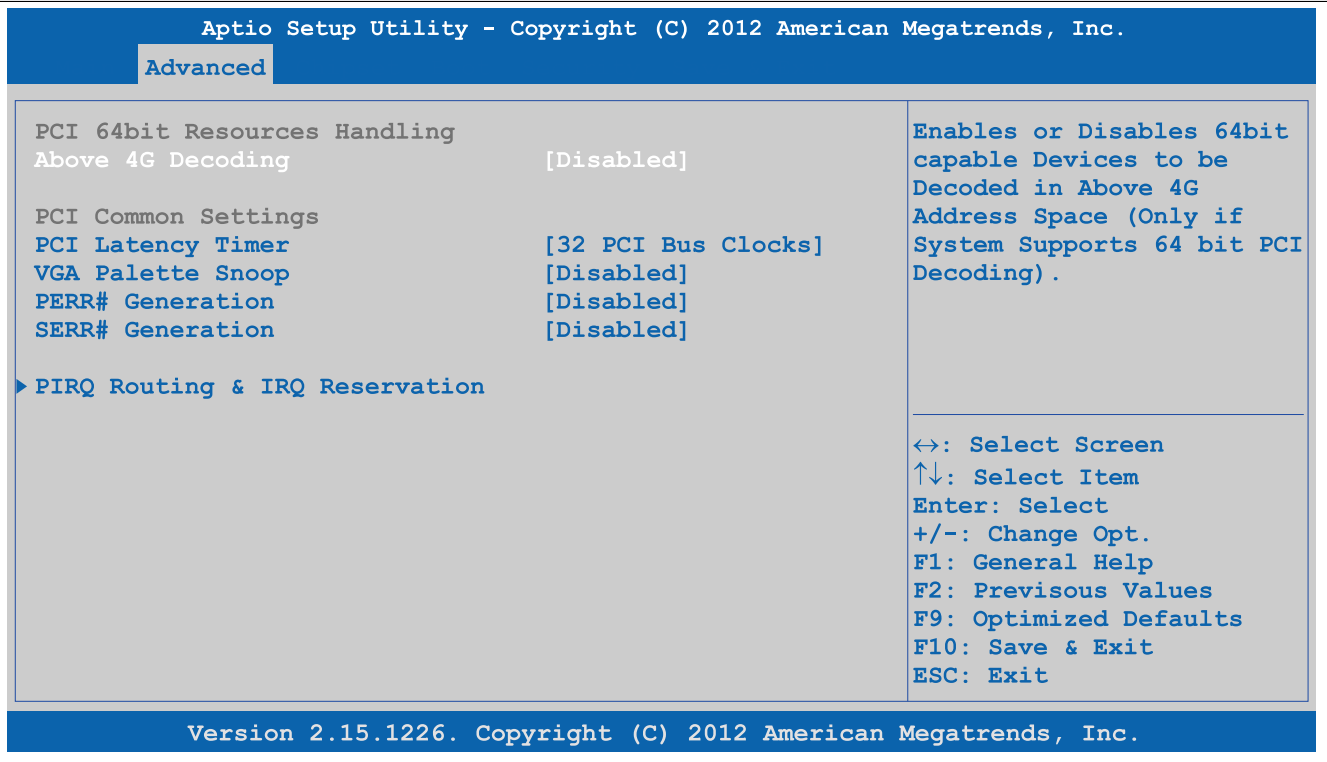


Abbildung 132: Advanced - PCI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Above 4G Decoding	Option zum Aktivieren / Deaktivieren 64-Bit fähiger Geräte um diese im Adressraum über 4 GByte zu decodieren (nur wenn das System die 64-Bit Dekodierung unterstützt).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
PCI Latency Timer	Diese Option kontrolliert, wie lange (in PCI-Ticks) eine Karte des PCI-Bus den Master noch für sich beanspruchen darf, wenn eine andere PCI-Karte bereits einen Zugriff angemeldet hat.	32 PCI Bus Clocks bis 248 PCI Bus Clocks	Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.
VGA Palette Snoop	Option um Grafikkarten mit 256 Farben zu unterstützen. Diese Option sollte nur auf "Enabled" gestellt sein, wenn die Farben nicht richtig dargestellt werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
PERR# Generation	Option zum Generieren eines PERR Signals (Parity Error). Dieses Signal zeigt einen Takt nach PAR einen Daten-Parity-Fehler an.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
SERR# Generation	Option zum Generieren eines SERR Signals (System Error). Dieses Signal zeigt bei einem Special-Cycle-Befehl einen Daten- oder sonstigen Systemfehler an.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
PIRQ Routing & IRQ Reservation	Konfiguration des PIRQ Routings.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PIRQ Routing & IRQ Reservation" auf Seite 191

Tabelle 165: Advanced - PCI Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.3.1 PIRQ Routing & IRQ Reservation

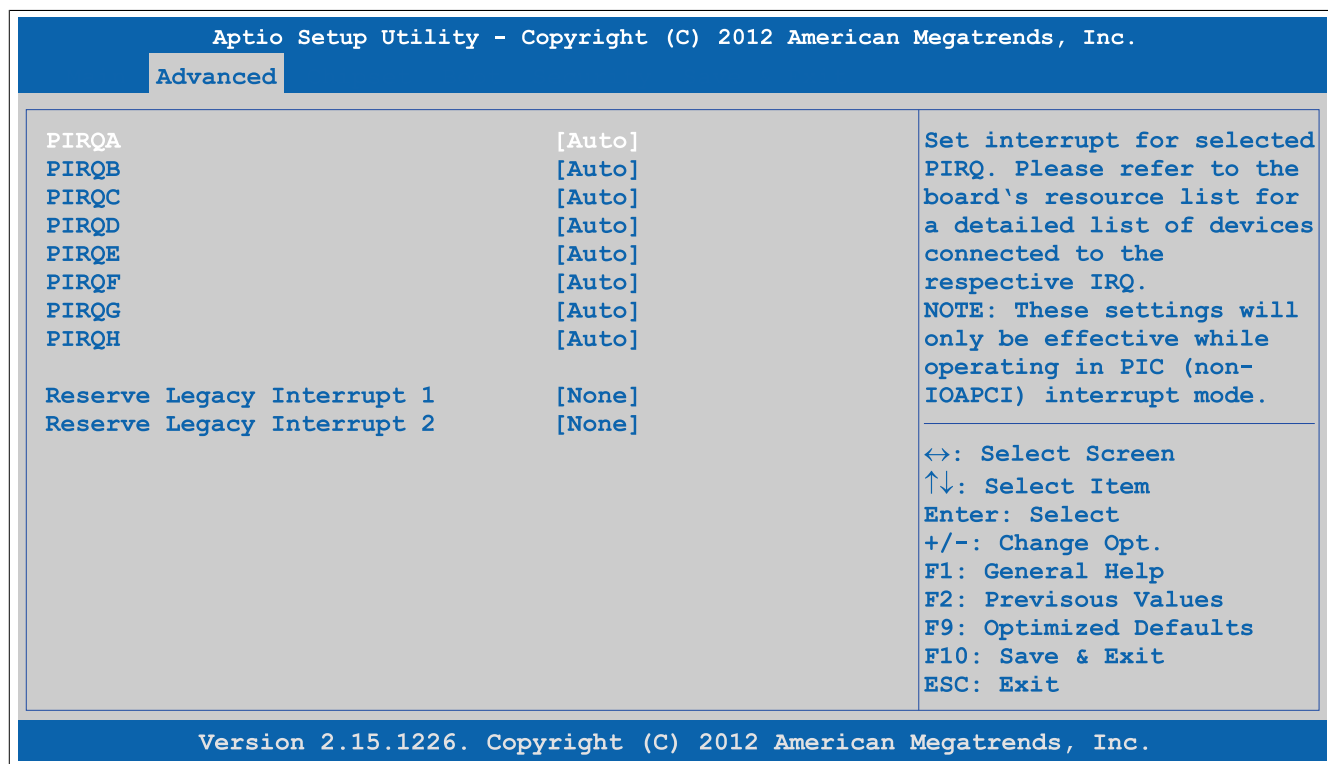


Abbildung 133: Advanced - PCI Configuration - PIRQ Routing & IRQ Reservation

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PIRQA	Option zum Einstellen des PIRQ A.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
PIRQB	Option zum Einstellen des PIRQ B.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
PIRQC	Option zum Einstellen des PIRQ C.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
PIRQD	Option zum Einstellen des PIRQ D.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
PIRQE	Option zum Einstellen des PIRQ E.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
PIRQF	Option zum Einstellen des PIRQ F.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
PIRQG	Option zum Einstellen des PIRQ G.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
PIRQH	Option zum Einstellen des PIRQ H.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Manuelle Zuordnung.
Reserve Legacy Interrupt 1	Der hier reservierte Interrupt wird keinem PCI oder PCI Express Gerät zur Verfügung gestellt.	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Der IRQx wird reserviert.
Reserve Legacy Interrupt 2	Der hier reservierte Interrupt wird keinem PCI oder PCI Express Gerät zur Verfügung gestellt.	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
		IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ14, IRQ15	Der IRQx wird reserviert.

Tabelle 166: Advanced - PCI Configuration - PIRQ Routing & IRQ Reservation Einstellmöglichkeiten

1.4.4 PCI Express Configuration

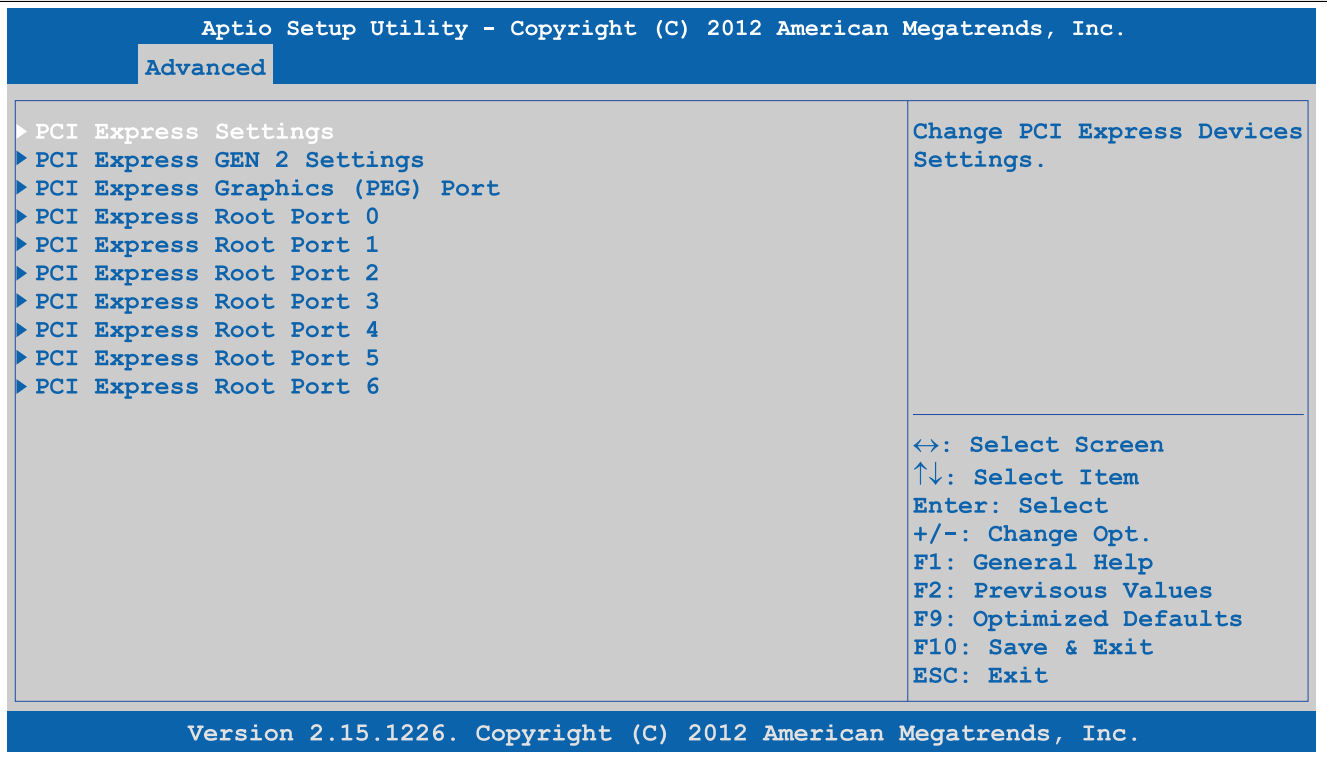


Abbildung 134: Advanced - PCI Express Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Settings	Konfiguration der PCI Express Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Settings" auf Seite 193
PCI Express GEN 2 Settings	Konfiguration der PCI Express GEN2 Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express GEN 2 Settings" auf Seite 194
PCI Express Graphics (PEG) Port	Konfiguration der PCI Express Graphics Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Graphics (PEG) Port" auf Seite 195
PCI Express Root Port 0	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 0.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port" auf Seite 197
PCI Express Root Port 1	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 1.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port" auf Seite 197
PCI Express Root Port 2	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 2.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port" auf Seite 197
PCI Express Root Port 3	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 3.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port" auf Seite 197
PCI Express Root Port 4	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 4.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port" auf Seite 197
PCI Express Root Port 5	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 5.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port" auf Seite 197
PCI Express Root Port 6	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 6.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port" auf Seite 197

Tabelle 167: Advanced - PCI Express Configuration Menü

1.4.4.1 PCI Express Settings

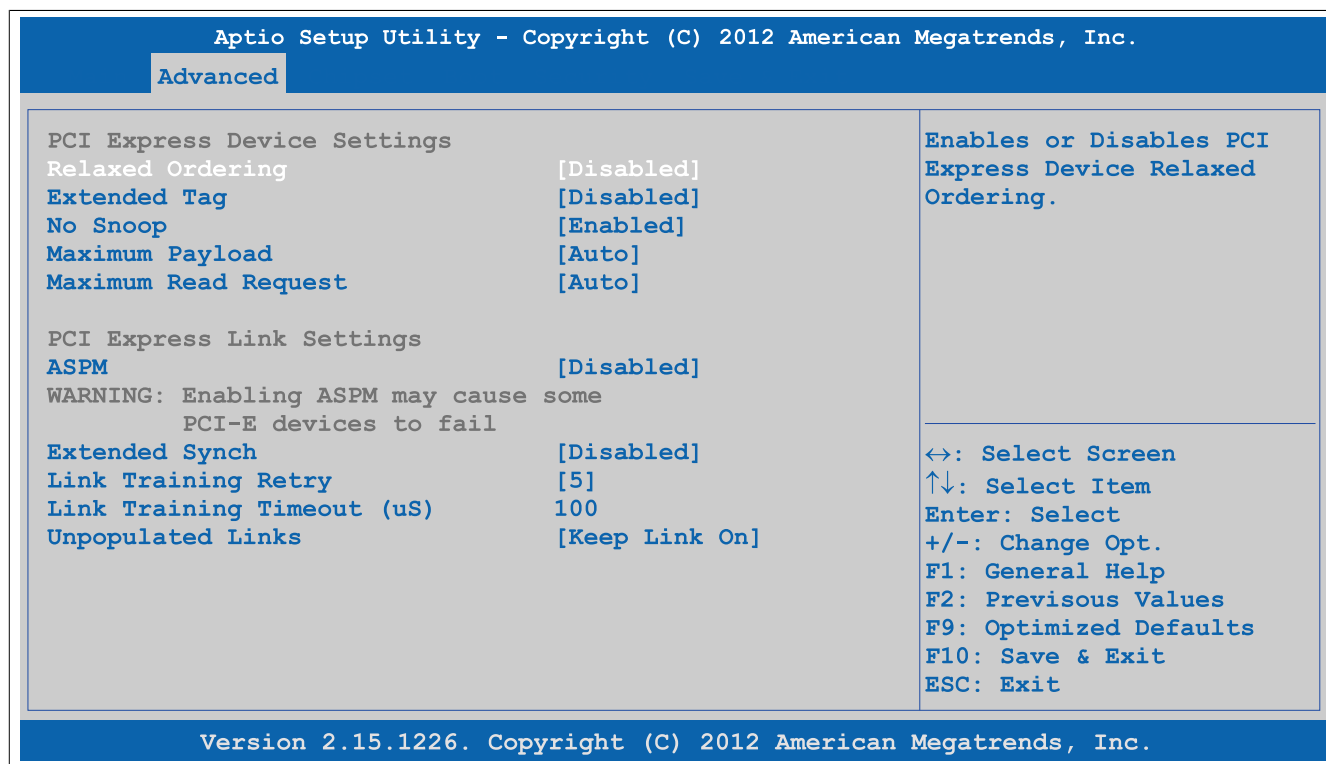


Abbildung 135: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Settings

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Relaxed Ordering	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Relaxed Ordering.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Extended Tag	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Extended Tag.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es können nur 5 Bits verwendet werden.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Es können Geräte mit 8-Bit im Requester Transaction-ID-Feld verwendet werden.
No Snoop	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der No Snoop Option.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Maximum Payload	Option zum Einstellen der maximalen Paketgröße bei der Datenübertragung.	Auto	Automatische Zuordnung der Paketgröße.
		128 Bytes bis 4096 Bytes	Manuelle Zuordnung der Paketgröße.
Maximum Read Request	Option zum Einstellen der maximalen Leseanforderung.	Auto	Automatische Zuordnung.
		128 Bytes bis 4096 Bytes	Manuelle Zuordnung.
ASPM ¹⁾	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (L0s/L1) für PCIe Slots wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Disabled	Die Energiesparfunktion ist deaktiviert.
		Auto	Maximale Energieeinsparung. Die Energiesparfunktion wird auf L0 oder L1 gesetzt.
		Force L0s	Der L0 Modus wird aktiviert.
Extended Synch	Option zum Einstellen eines erweiterten Synchronisierungsmusters um die Systemleistung zu verbessern.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Link Training Retry	Option zum Festlegen der Anzahl wie oft die Software versuchen soll den Link umzuleiten, wenn das vorherige Training nicht erfolgreich war.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		2	2 Link Training Versuche
		3	3 Link Training Versuche
		5	5 Link Training Versuche
Link Training Timeout (µS)	Option zum Festlegen der Mikrosekunden, die die Software wartet bevor der Link Training Bit im Link Status Register abgefragt wird.	10 bis 1000	Einstellen der Zeit in µs.
Unpopulated Links	Option zum Aktivieren / Deaktivieren von PCIe Slots, in denen keine Geräte gesteckt sind.	Keep Link On	PCIe Slot, in denen keine Geräte gesteckt sind, bleiben aktiviert.
		Disable Link	PCIe Slot, in denen keine Geräte gesteckt sind, werden deaktiviert um Strom zu sparen.

Tabelle 168: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Settings Einstellmöglichkeiten

1) ASPM = Active State Power Management

1.4.4.2 PCI Express GEN 2 Settings

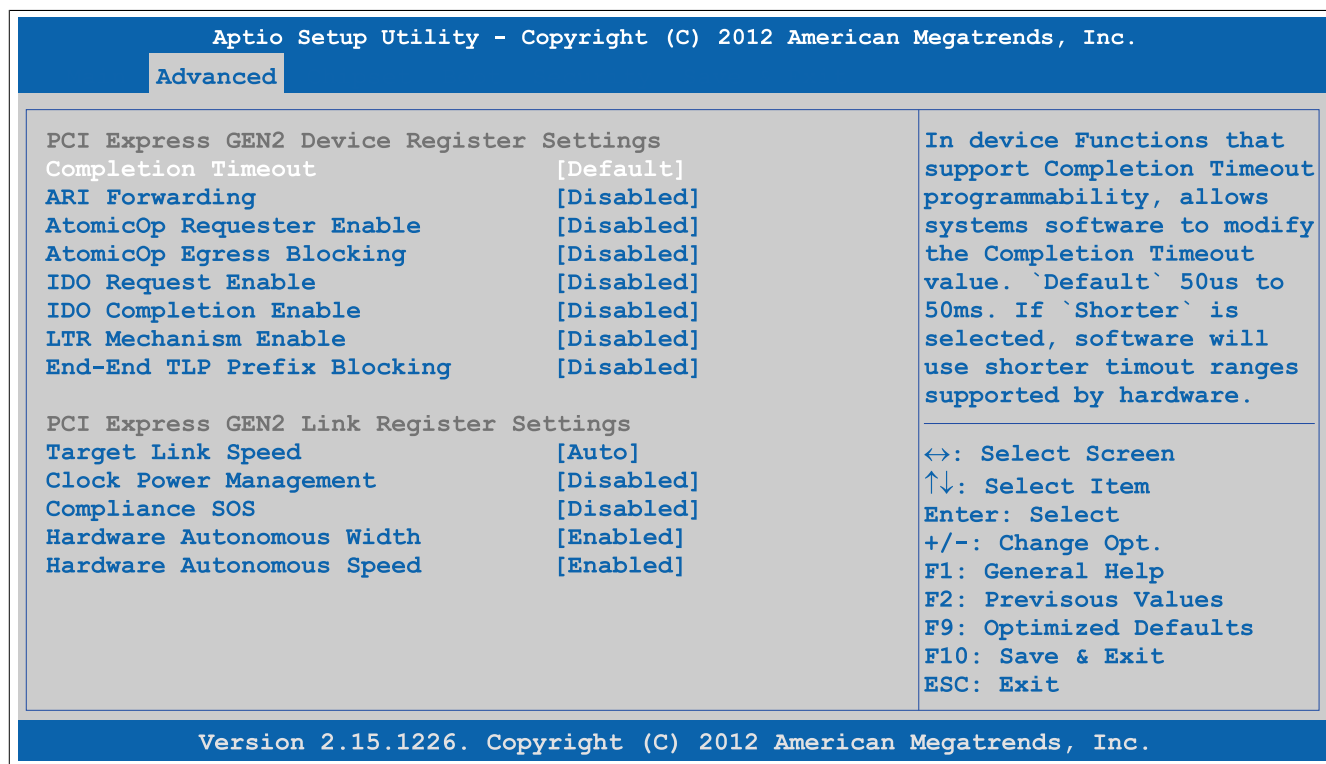


Abbildung 136: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Completion Timeout	In Gerätefunktionen, die die Programmierbarkeit des Completion Timeout unterstützen, wird der Software das ändern des Completion Timeout Werts erlaubt.	Default	Der Timeout Bereich liegt zwischen 50 µs und 50 ms.
		Shorter	Die Software verwendet kürzere Timeout Bereiche die von der Hardware unterstützt werden.
		Longer	Die Software verwendet längere Timeout Bereiche die von der Hardware unterstützt werden.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
ARI Forwarding	If supported by hardware and set to Enabled, the Downstream Port disables its traditional Device Number field being 0 enforcement when turning a Type1 Configuration Request into a Type0 configuration request, permitting access to Extended functions in an ARI device immediately below the port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
AtomicOp Requester Enable	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des AtomicOp Requester.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. AtomicOp Abfragen werden nur initiiert, wenn das Bus Master Enable-Bit im Kommandoregister gesetzt ist.
AtomicOp Egress Blocking	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des AtomicOp Egress Blocking. If supported by hardware and set to Enabled, outbound AtomicOp requests via egress ports will be locked.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Ausgehende AtomicOp Abfragen werden über den Ausgangs Port blockiert.
IDO Request Enable	If supported by hardware and set to Enabled, this permits setting the number of ID-based ordering (IDO) bit (Attribute[2]) requests to be initiated.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
IDO Completion Enable	If supported by hardware and set to Enabled, this permits setting the number of ID-based ordering (IDO) bit (Attribute[2]) requests to be initiated.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
LTR Mechanism Enable	If supported by hardware and set to Enabled, this enables the Latency Tolerance Reporting (LTR) Mechanism.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
End-End TLP Prefix Blocking	If supported by hardware and set to Enabled, this function will block forwarding of TLPs containing End-End TLP prefixes.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 169: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Target Link Speed	If supported by hardware and set to "Force to 2.5 GT/s" for Downstream Ports, this sets an upper limit on Link operational speed by re-districting the values advertised by the Upstream component in its training sequences. When "Auto" is selected HW initialized data will be used.	Auto	TBD
		Force to 2.5 GT/s	TBD
		Force to 5.0 GT/s	TBD
Clock Power Management	If supported by hardware and set to Enabled, the device is permitted to use CLKREQ# signal for power management of Link clock in accordance to protocol defined in appropriate form factor specification.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Compliance SOS	If supported by hardware and set to Enabled, this will force LTSSM to send SKP Ordered Sets between sequences when sending Compliance Pattern or Modified Compliance Pattern.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Hardware Autonomous Width	If supported by hardware and set to Disabled, this will disable the hardware's ability to change link width except width size reduction for the purpose of correcting unstable link operation.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Hardware Autonomous Speed	If supported by hardware and set to Disabled, this will disable the hardware's ability to change link speed except speed size reduction for the purpose of correcting unstable link operation.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Das PCIe Gerät kann den Link Speed, mit Ausnahme zur Korrektur eines instabilen Betriebs, nicht mehr ändern.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 169: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings Einstellmöglichkeiten

1.4.4.3 PCI Express Graphics (PEG) Port

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
PCI Express Graphics (PEG) Port	[Auto]	Disabled=Disabled internal PEG interface devices and do not detect the devices connected to the PEG port. Enabled=Enable internal PEG interface devices also if no device is detected on PEG port. Auto=Disable internal PEG interface devices
PEG Root Port Configuration	[1 x8 + 2 x4]	
PEG0	Not Present	
PEG0 Speed	[Auto]	
PEG0 ASPM	[Disabled]	
PEG1	Not Present	
PEG1 Speed	[Gen1]	
PEG1 ASPM	[Disabled]	
PEG2	Not Present	
PEG2 Speed	[Auto]	
PEG2 ASPM	[Disabled]	
Detected Non-compliant Device	[Disabled]	↔: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
De-emphasis Control	[-3.5 dB]	
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.		

Abbildung 137: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Graphics (PEG) Port

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Graphics (PEG) Port	Option zum Einstellen des PCI Express Graphics Port.	Disabled	Interne PEG Interface Geräte werden deaktiviert und Geräte die an den PEG Port angeschlossen sind werden nicht erkannt.
		Enabled	Interne PEG Interface Geräte werden aktiviert, auch wenn kein Gerät am PEG Port erkannt wird.
		Auto	Interne PEG Interface Geräte werden deaktiviert wenn kein Gerät am PEG Port erkannt wird.
PEG Root Port Configuration	Option zum Auswählen der Root Port Konfiguration an den 16 PCIe Kanälen des PEG Port.	1 x16	Konfiguration mit 1 x16.
		2 x8	Konfiguration mit 2 x8.
		1 x8 + 2 x4	Konfiguration mit 1 x8 und 2 x4.
PEG0	Anzeige des Betriebsmodus, mit dem das angeschlossene Gerät am PEG0 Port betrieben wird.	keine	-

Tabelle 170: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Graphics (PEG) Port Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PEG0 Speed	Option zum Einstellen der maximalen Transfer-rate am PEG0 Port.	Auto	Die maximal schnellste Übertragungsrate wird ausgewählt.
		Gen1	Die Transferrate beträgt maximal 2,5 GT/s.
		Gen2	Die Transferrate beträgt maximal 5 GT/s.
		Gen3	Die Transferrate beträgt maximal 8 GT/s.
PEG0 ASPM ¹⁾	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion für den PEG0 Port wenn dieser nicht sämtliche Leistung benötigt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		ASPM L0s	Aktivierung der L0 Energiesparfunktion.
		ASPM L1	Aktivierung der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.
		ASPM L0sL1	Automatische Zuordnung der L0s oder L1 Energiesparfunktion durch das PCIe Gerät.
ASPM L0s ²⁾	Option zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Root Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert.
		Endpoint Only	Die Energiesparfunktion wird für den Endpoint Port aktiviert.
		Both Root and Endpoint Ports	Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert.
PEG1	Anzeige des Betriebsmodus, mit dem das angeschlossene Gerät am PEG1 Port betrieben wird.	keine	-
PEG1 Speed	Option zum Einstellen der maximalen Transfer-rate am PEG1 Port.	Auto	Die maximal schnellste Übertragungsrate wird ausgewählt.
		Gen1	Die Transferrate beträgt maximal 2,5 GT/s.
		Gen2	Die Transferrate beträgt maximal 5 GT/s.
		Gen3	Die Transferrate beträgt maximal 8 GT/s.
PEG1 ASPM ¹⁾	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion für den PEG1 Port wenn dieser nicht sämtliche Leistung benötigt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		ASPM L0s	Aktivierung der L0 Energiesparfunktion.
		ASPM L1	Aktivierung der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.
		ASPM L0sL1	Automatische Zuordnung der L0s oder L1 Energiesparfunktion durch das PCIe Gerät.
ASPM L0s ³⁾	Option zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Root Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert.
		Endpoint Only	Die Energiesparfunktion wird für den Endpoint Port aktiviert.
		Both Root and Endpoint Ports	Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert.
PEG2	Anzeige des Betriebsmodus, mit dem das angeschlossene Gerät am PEG2 Port betrieben wird.	keine	-
PEG2 Speed	Option zum Einstellen der maximalen Transfer-rate am PEG2 Port.	Auto	Die maximal schnellste Übertragungsrate wird ausgewählt.
		Gen1	Die Transferrate beträgt maximal 2,5 GT/s.
		Gen2	Die Transferrate beträgt maximal 5 GT/s.
		Gen3	Die Transferrate beträgt maximal 8 GT/s.
PEG2 ASPM ¹⁾	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion für den PEG2 Port wenn dieser nicht sämtliche Leistung benötigt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		ASPM L0s	Aktivierung der L0 Energiesparfunktion.
		ASPM L1	Aktivierung der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.
		ASPM L0sL1	Automatische Zuordnung der L0s oder L1 Energiesparfunktion durch das PCIe Gerät.
ASPM L0s ⁴⁾	Option zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Root Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert.
		Endpoint Only	Die Energiesparfunktion wird für den Endpoint Port aktiviert.
		Both Root and Endpoint Ports	Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert.
Detect Non-compliant Device	Option zum Erkennen von nicht-kompatiblen PCI Express Geräten am PEG Port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Es können auch nicht-kompatible PCI Express Geräte am PEG Port erkannt werden.
De-emphasis Control	Option zur Einstellung der Entzerrung am PEG Port.	-6 dB	-6 dB Entzerrung werden verwendet.
		-3.5 dB	-3,5 dB Entzerrung werden verwendet.

Tabelle 170: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Graphics (PEG) Port Einstellmöglichkeiten

1) ASPM = Active State Power Management

2) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn PEG0 ASPM auf ASPM L0s oder ASPM L0sL1 eingestellt ist.

3) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn PEG1 ASPM auf ASPM L0s oder ASPM L0sL1 eingestellt ist.

4) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn PEG2 ASPM auf ASPM L0s oder ASPM L0sL1 eingestellt ist.

1.4.4.4 PCI Express Root Port

Warnung!

Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.

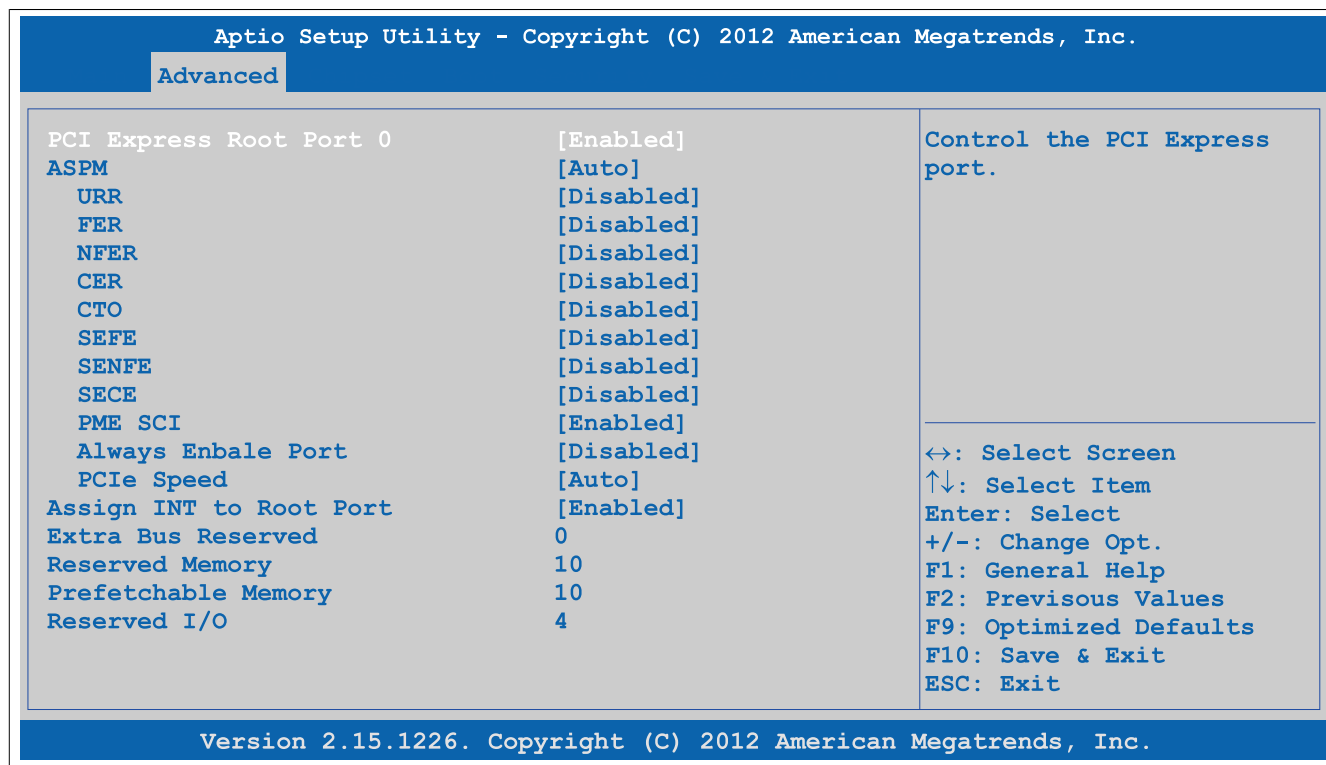


Abbildung 138: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Root Port x	Mit dieser Option wird der PCI Express Root Port x aktiviert / deaktiviert.	Enabled	PCI Express Root Port 1 wird aktiviert.
		Disabled	PCI Express Root Port 1 und 2 wird deaktiviert.
ASPM	<i>Active State Power Management</i> Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (L0s/L1) für PCIe Geräte wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		L0s	Aktivierung der L0 Energiesparfunktion.
		L1	Aktivierung der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.
		L0sL1	Automatische Zuordnung der L0s oder L1 Energiesparfunktion durch das PCIe Gerät.
		Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
URR	<i>Unsupported Request (UR) Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
FER	<i>Fatal Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
NFER	<i>Non-Fatal Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CER	<i>Correctable Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CT0	<i>PCI Express Completion Timer T0</i>	Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 171: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	<p>Mit dieser Option wird der PCI Express Completion Timer aktiviert / deaktiviert.</p> <p>Information:</p> <p>Wenn das System ein ROB (Processor Reorder Buffer) Timeout entdeckt hat, sollte diese Einstellung auf Enabled gestellt werden.</p>	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SEFE	<i>System Error on Fatal Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SENF	<i>System Error on Non-Fatal Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein nicht-schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SECE	<i>System Error on Correctable Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein korrigierbarer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Power Management erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Power Management erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Always Enable Port	Option zur ständigen Aktivierung des Ports.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIe Speed	Option zum Einstellen der PCI Express Transfer-rate.	Auto	Automatische Einstellung der Transferrate.
		Gen1	Die Transferrate beträgt maximal 2,5 GT/s.
		Gen2	Die Transferrate beträgt maximal 5 GT/s.
Assign INT to Root Port	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des IRQ für den Root Port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Extra Bus Reserved	Option zum Einstellen von extra Bus reserviert für Bridges hinter dieser Root Bridge.	0 bis 7	
Reserved Memory	Option zum Einstellen von reserviertem Speicher Bereich für diese Root Bridge.	0 bis 20	
Prefetchable Memory	Option zum Einstellen von prefetchable Speicher Bereich für diese Root Bridge.	1 bis 20	
Reserved I/O	Option zum Einstellen von reserviertem I/O Bereich (4K/8K/12K/16K/20K) für diese Root Bridge.	4 bis 20	

Tabelle 171: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port Einstellmöglichkeiten

1.4.5 ACPI Settings

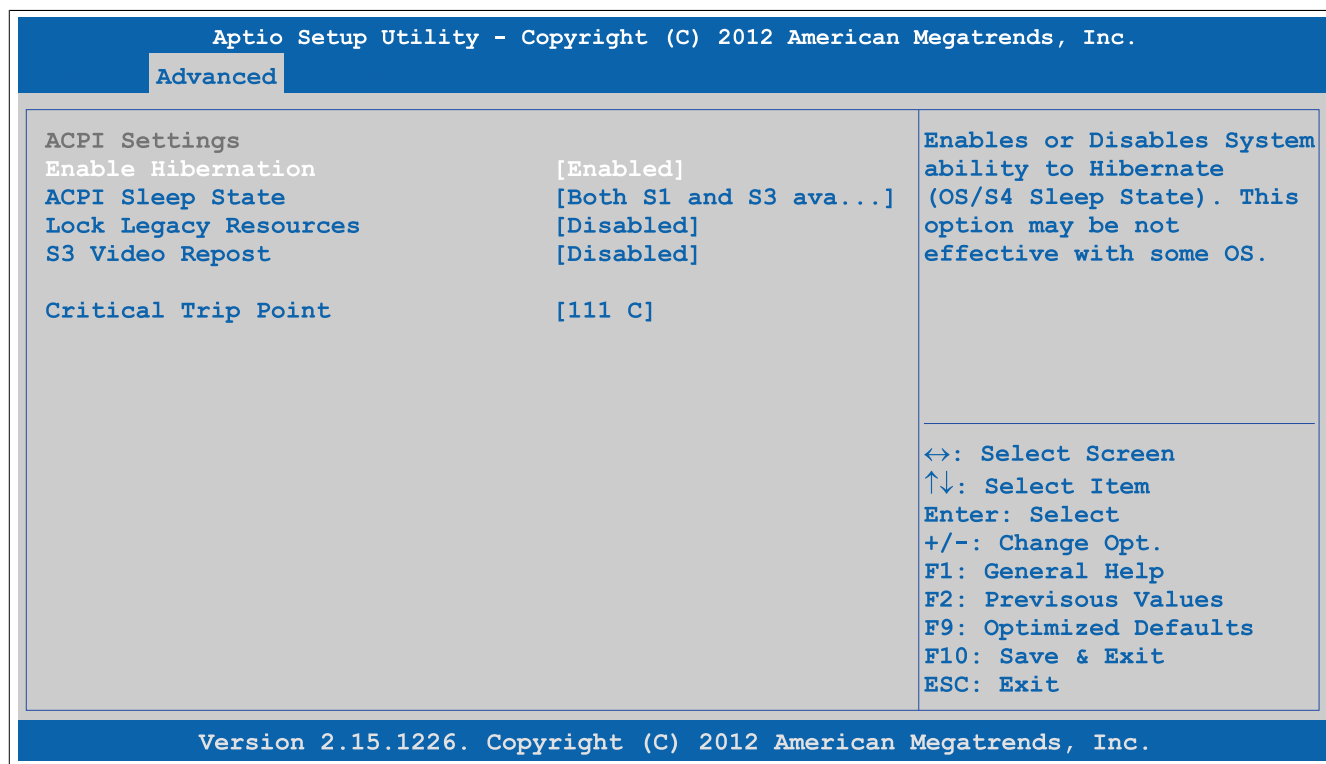


Abbildung 139: Advanced - ACPI Settings

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Enable Hibernation	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Hibernation Funktion. Das Betriebssystem kann in den S4 Zustand versetzt werden. Diese Option kann bei manchen Betriebssystemen wirkungslos bleiben.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
ACPI Sleep State	Auswahl des ACPI Status welcher bei Aktivierung des Suspend Modus verwendet werden soll.	Suspend Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		S1 only (CPU Stop Clock)	Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese stehen auf Tastendruck wieder zur Verfügung.
		S3 only (Suspend to RAM)	Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der aktuelle Zustand des Betriebssystems in das RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit Strom versorgt.
		Both S1 and S3 available for OS to choose from	Es werden S1 und S3 aktiviert. Die Zustände können dann vom Betriebssystem gewählt werden.
Lock Legacy Resources	Option zum Einstellen, ob das Betriebssystem Einstellungen an den Legacy-Ressourcen vornehmen kann.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
S3 Video Repost	Option zum Einstellen eines neuerlichen Ausführen des Grafik-ROM nach dem Start aus dem S3-Status.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Critical Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem das System herunterfährt.	POR	Der Critical Trip Point wird auf 105°C eingestellt.
		87 C, 95 C, 103 C, 111 C, 119 C, 127 C	Temperatureinstellung für den Critical Trip Point. In 5°C Schritten einstellbar.

Tabelle 172: Advanced - ACPI Settings Einstellmöglichkeiten

1.4.6 RTC Wake Settings

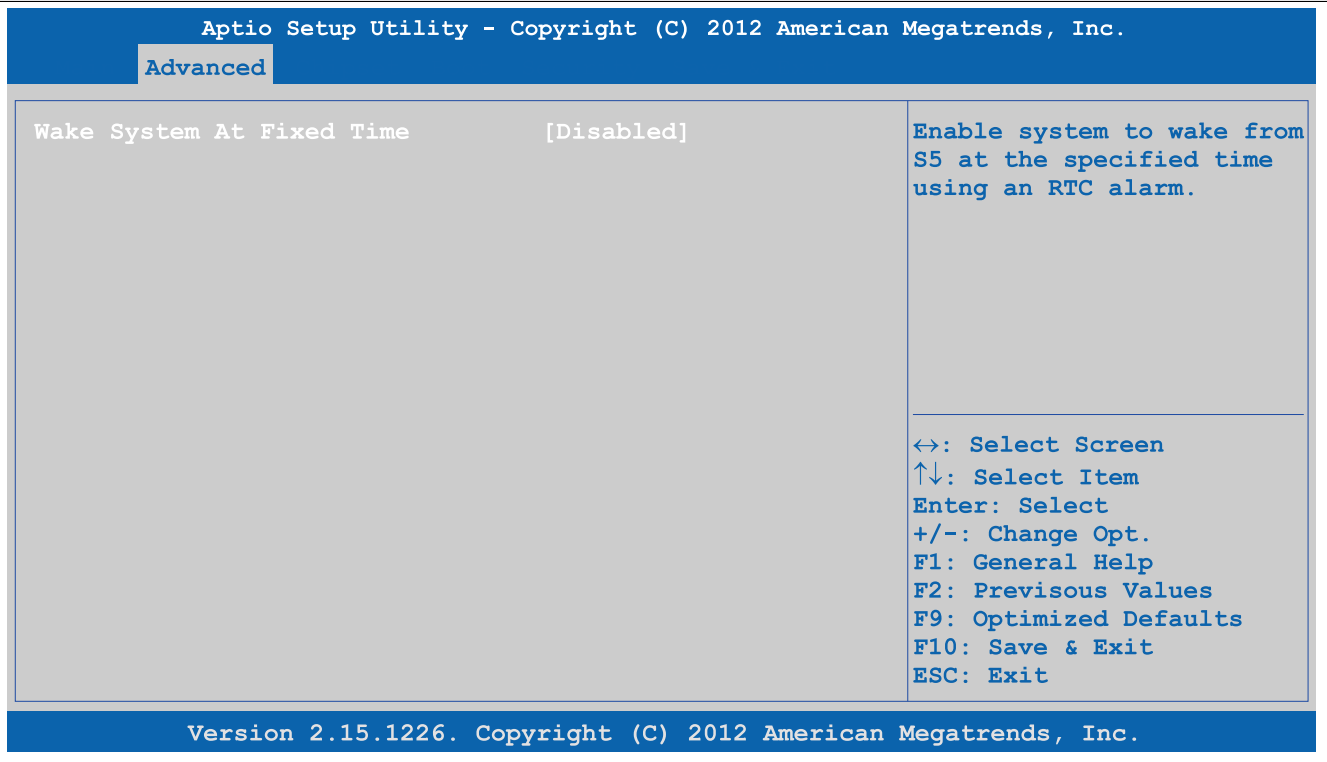


Abbildung 140: Advanced - RTC Wake Settings

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Wake System At Fixed Time	Option zum Einstellen der sekundengenauen Uhrzeit, zu der das System aus ausgeschaltetem Zustand (ACPI S5) hochfährt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Wake up hour	Option zum Einstellen der Stunde.	0 bis 23	Beispiel: Eingabe 3, das System fährt um 3 Uhr (3 am) hoch. Eingabe 15, das System fährt um 15 Uhr (3 pm) hoch.
Wake up minute	Option zum Einstellen der Minute.	0 bis 59	Beispiel: Eingabe 15, das System fährt in Minute 15 hoch.
Wake up second	Option zum Einstellen der Sekunde.	0 bis 59	Beispiel: Eingabe 32, das System fährt in Sekunde 32 hoch.

Tabelle 173: Advanced - RTC Wake Settings Einstellmöglichkeiten

1.4.7 CPU Configuration

Information:

Die Anzeigen und Einstellungen können sich je nach verwendetem CPU Board unterscheiden.

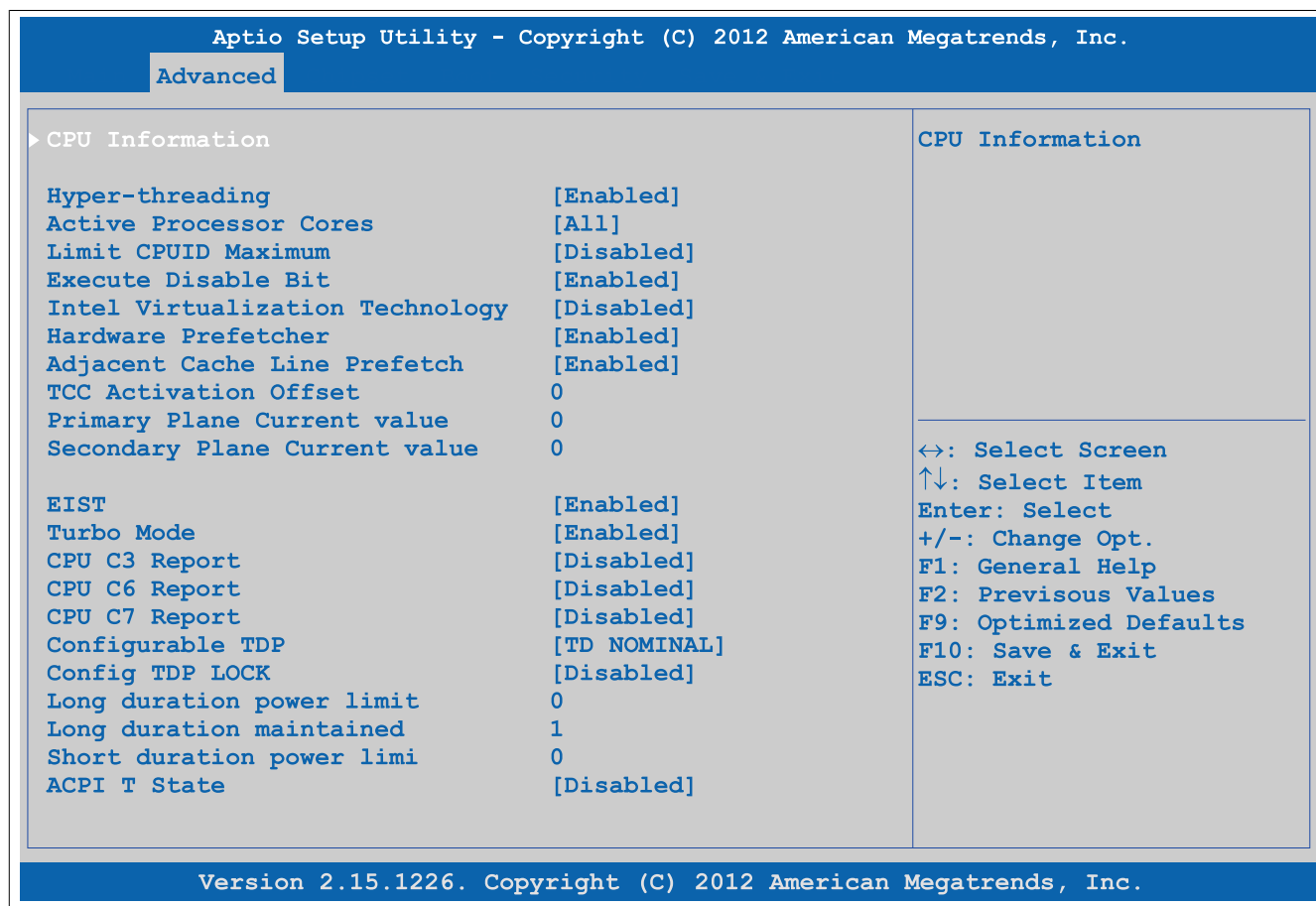


Abbildung 141: Advanced - CPU Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CPU Information	Anzeige der CPU Eigenschaften.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Information" auf Seite 203
Hyper-threading	Option zum Einstellen der Intel Hyper-Threading Technologie.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Jeder Prozessorkern kann mehrere Aufgaben (Threads) gleichzeitig ausführen kann. Die Intel HT-Technologie erhöht auch den Prozessordurchsatz und verbessert die Gesamtleistung von Multithread-Software.
Active Processor Cores	Option zum Einstellen der verwendeten Kerne des Prozessors.	All	Es werden alle Prozessorkerne verwendet.
		1	Es wird nur ein Prozessorkern verwendet.
Limit CPUID Maximum	Option zur Limitierung des CPUID Wertes. Dies kann z.B. bei älteren Betriebssystemen notwendig sein. Information: Bei Verwendung von Windows XP muss diese Option auf <i>Disabled</i> gestellt sein.	Disabled	Bei Anfrage des CPUID Wertes liefert der Prozessor den aktuell maximalen Wert zurück.
		Enabled	Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maximalen CPUID Wert auf 03h wenn der Prozessor einen höheren Wert unterstützt.
Execute Disable Bit	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Hardwareunterstützung zur Unterbindung der Datenausführung.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Intel Virtualization Technology	Option zum Aktivieren / Deaktivieren einer Virtuellen Maschine. Information: Um eine Änderung der Einstellung wirksam zu machen, ist ein Neustart erforderlich.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Ist die Funktion aktiviert, kann eine Virtuelle Maschine die zusätzlichen Hardwarekapazitäten verwenden.

Tabelle 174: Advanced - CPU Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Hardware Prefetcher	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Hardware Prefetcher.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Daten werden im Cache zwischengespeichert. Dadurch wird eine Leistungssteigerung erzielt.
Adjacent Cache Line Prefetch	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Adjacent Cache Line Prefetch.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Es wird die aktuelle und nächste Zeile in den Cache geladen und somit der Lesevorgang beschleunigt.
TCC ¹⁾ Activation Offset	Option zum Einstellen des Offset des Thermal Control Circuit (TCC) bei Temperaturen, die niedriger sind als die TCC Aktivierungstemperatur.	0 bis 50	Einstellung des Offset.
Primary Plane Current Value	Option zum Einstellen des momentanen maximalen Strom am Primary Plane.	0 bis 255	Einstellung von 0 bis 255.
Secondary Plane Current Value	Option zum Einstellen des momentanen maximalen Strom am Secondary Plane.	0 bis 255	Einstellung von 0 bis 255.
EIST	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Intel® SpeedStep™ Technologie.	Disabled	Intel® SpeedStep™ wird deaktiviert.
		Enabled	Intel® SpeedStep™ wird aktiviert.
Turbo Mode	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Intel® Turbo Boost Technologie.	Disabled	Intel® Turbo Boost Technologie wird deaktiviert.
		Enabled	Intel® Turbo Boost Technologie wird aktiviert.
CPU C3 Report	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des CPU C3 (ACPI C2) Report an das Betriebssystem.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Report an das Betriebssystem versandt.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
CPU C6 Report	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des CPU C6 (ACPI C3) Report an das Betriebssystem.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Report an das Betriebssystem versandt.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
CPU C7 Report	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des CPU C7 (ACPI C3) Report an das Betriebssystem.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Report an das Betriebssystem versandt.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Configurable TDP ²⁾	Option zum Einstellen der TDP Levels.	TDP NOMINAL	Der TDP wird nicht unter- bzw- überschritten.
		TDP DOWN	Der TDP wird unterschritten und der Prozessor arbeitet mit einer niedrigeren Leistung.
		TDP UP	Der TDP wird überschritten und der Prozessor arbeitet mit einer höheren Leistung.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Config TDP LOCK	Option zum Sperren und Konfigurieren des TDP Control Registers.		Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Long duration power limit	Long duration power limit in Watt.	0 bis 255	Einstellung von 0 bis 255.
Long duration maintained	Zeitraum in der die Option "Long duration power" aktiviert ist.	0 bis 120	Einstellung von 0 bis 120.
Short duration power limit	Short duration power limit in Watt.	0 bis 255	Einstellung von 0 bis 255.
ACPI T State	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des ACPI T State Support.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 174: Advanced - CPU Configuration Einstellmöglichkeiten

1) TCC = Thermal Control Circuit

2) TDP = Thermal design power

1.4.7.1 CPU Information

Information:

Die Anzeigen und Einstellungen können sich je nach verwendetem CPU Board unterscheiden.

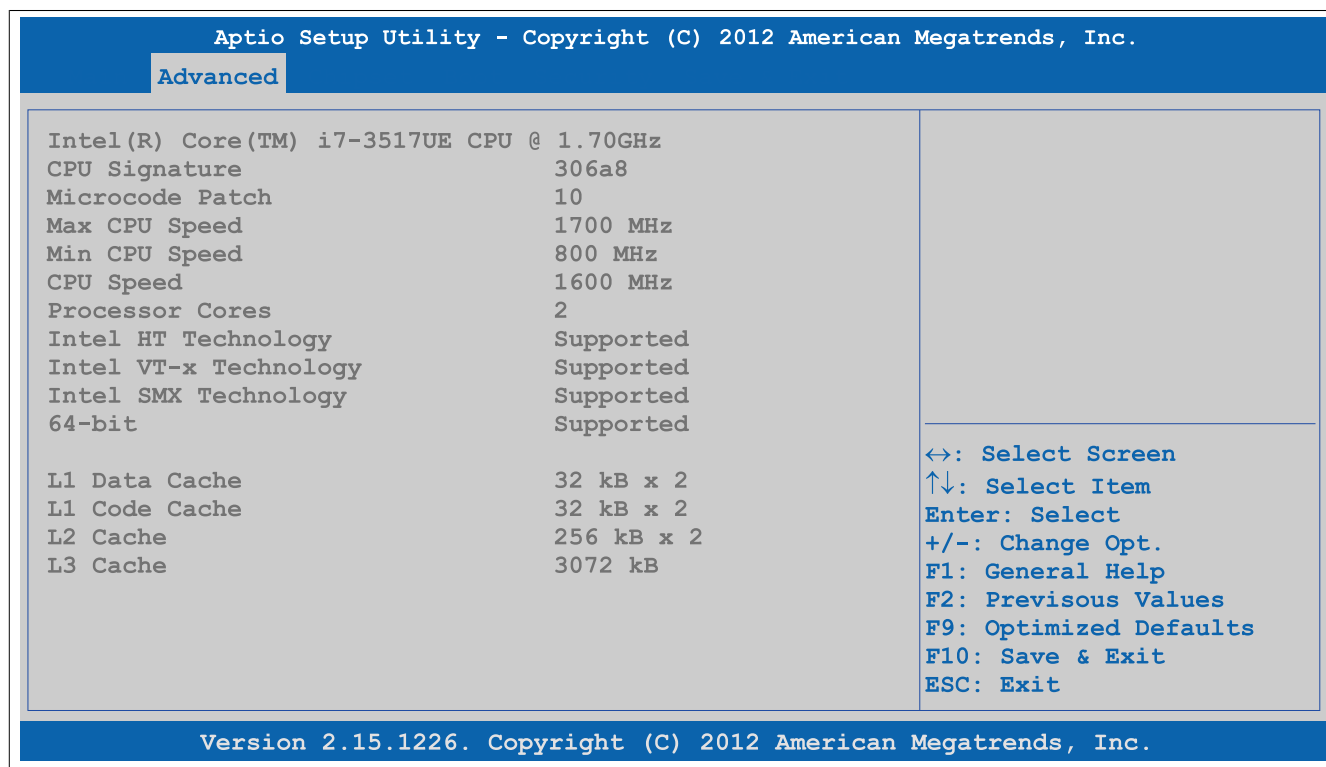


Abbildung 142: Advanced - CPU Configuration - CPU Information

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CPU Signature	Anzeige der CPU ID.	keine	-
Microcode Patch	Anzeige des Microcode Patch ID.	keine	-
Max CPU Speed	Anzeige der maximalen Prozessorfrequenz.	keine	-
Min CPU Speed	Anzeige der minimalen Prozessorfrequenz.	keine	-
CPU Speed	Anzeige der Prozessorfrequenz.	keine	-
Processor Cores	Anzeige der Prozessorkerne.	keine	-
Intel HT Technology	Anzeige, ob der Prozessor die Intel HT Technology unterstützt.	keine	-
Intel VT-x Technology	Anzeige, ob der Prozessor die Intel VT-x Technology unterstützt.	keine	-
Intel SMX Technology	Anzeige, ob der Prozessor die Intel SMX Technology unterstützt.	keine	-
64-bit	Anzeige, ob der Prozessor die Intel 64-Bit Architektur unterstützt.	keine	-
L1 Data Cache	Anzeige der L1 Data Cache Größe.	keine	-
L1 Code Cache	Anzeige der L1 Code Cache Größe.	keine	-
L2 Cache	Anzeige der L2 Cache Größe.	keine	-
L3 Cache	Anzeige der L3 Cache Größe.	keine	-

Tabelle 175: Advanced - CPU Configuration - CPU Information Einstellmöglichkeiten

1.4.8 Chipset Configuration

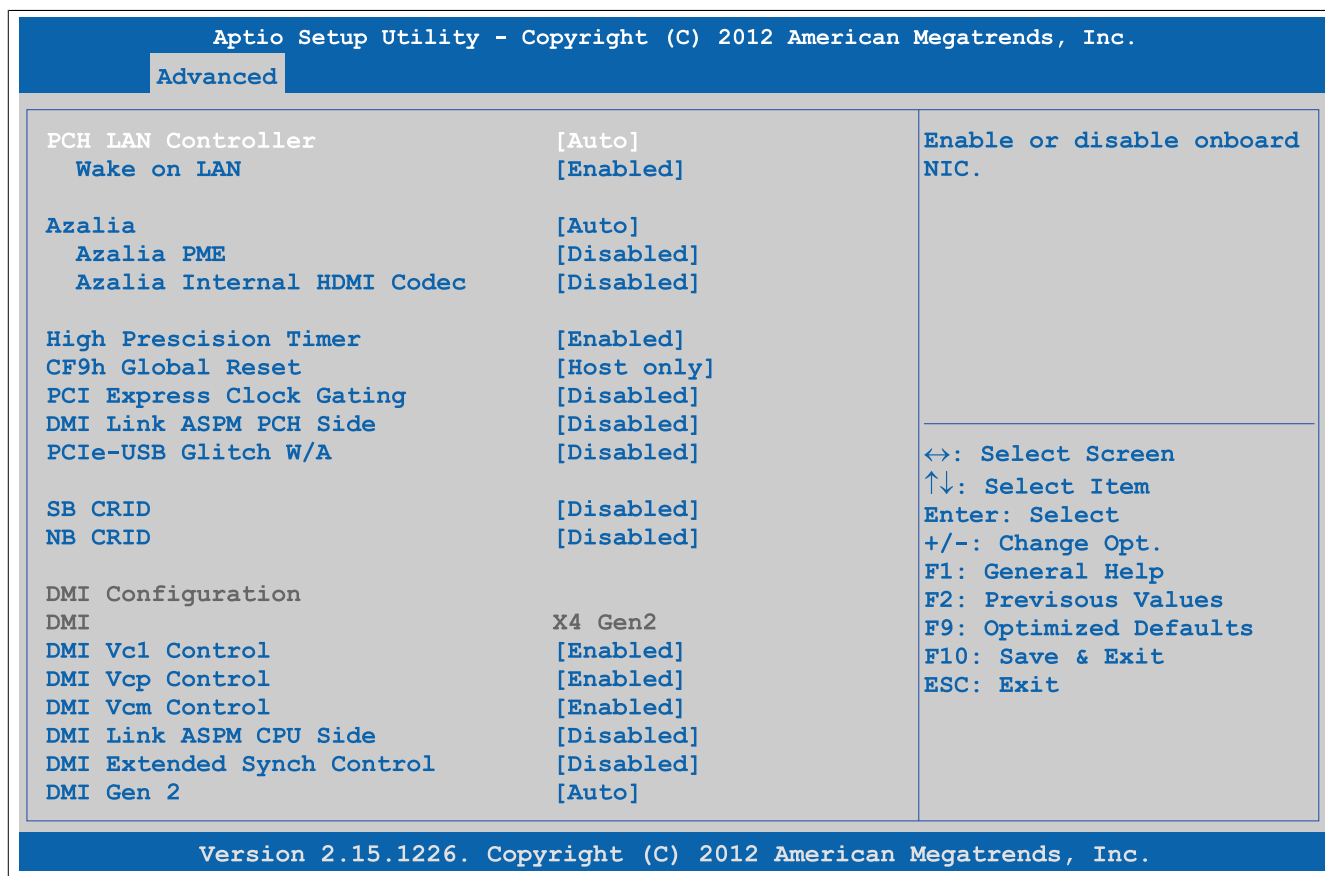


Abbildung 143: Advanced - Chipset Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCH LAN Controller	Hier kann der Onboard LAN Controller (ETH1) ein- bzw. ausgeschaltet werden.	Disabled	Deaktivierung des Controllers.
		Enabled	Aktivierung des Controllers.
Wake on LAN	Option zum Einschalten des Systems über den Onboard LAN Controller (ETH1).	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der LAN Controller kann das System einschalten.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion. Der LAN Controller kann das System nicht einschalten.
Azalia	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Audio Controllers.	Disabled	Deaktivierung des Audio Controllers.
		Enabled	Aktivierung des Audio Controllers.
		Auto	Der Audio Controller wird nur aktiviert, wenn ein Gerät angeschlossen ist.
Azalia PME	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Power Management des Audio Controllers.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Azalia Internal HDMI Co- dec	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des inter- nen HDMI Codec für Azalia.	Disabled	Audio Ausgabe ist deaktiviert.
		Enabled	Audio Ausgabe ist aktiviert.
High Precision Timer	Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und andere Programme können diverse Anwendungen besser synchronisieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Bei Multimedia Anwendungen wird empfohlen, die Funktion auf Enabled zu stellen.
CF9h Global Reset	Option zum Einstellen der Resetart am CF9h Resetregister.	Host only	Nur Chipset.
		Host+ME	Chipset und Management Engine.
PCI Express Clock Gating	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des PCI Express Clock Gating für jeden einzelnen Root Port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
DMI Link ASPM PCH Side	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Active State Power Management (ASPM) am DMI Link auf der PCH Seite.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
PCIe-USB Glitch W/A	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des PCIe-USB Glitch, wenn ein nicht richtig funktionierendes USB Gerät nach dem PCIe/PEG Port angeschlossen ist.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
SB CRID	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der South Bridge Compatible Revision ID.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
NB CRID	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der North Bridge Compatible Revision ID.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
DMI Configuration			
DMI	Anzeige der DMI Version / Generation.	keine	-

Tabelle 176: Advanced - Chipset Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
DMI Vc1 Control	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des DMI Vc1.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
DMI Vcp Control	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des DMI Vcp.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
DMI Vcm Control	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des DMI Vcm.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
DMI Link ASPM CPU Side	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Active State Power Management (ASPM) am DMI Link auf der CPU Seite.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		L0s	Aktivierung der L0 Energiesparfunktion.
		L1	Aktivierung der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.
		L0sL1	Automatische Zuordnung der L0s oder L1 Energiesparfunktion durch das PCIe Gerät.
DMI Extended Synch Control	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der DMI Extended Synchronization.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
DMI Gen 2	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der DMI Gen 2.	Auto	Deaktiviert für IVB A0 MB/DT und IVB B0 MB, aktiviert für andere CPUs.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 176: Advanced - Chipset Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.9 SATA Configuration

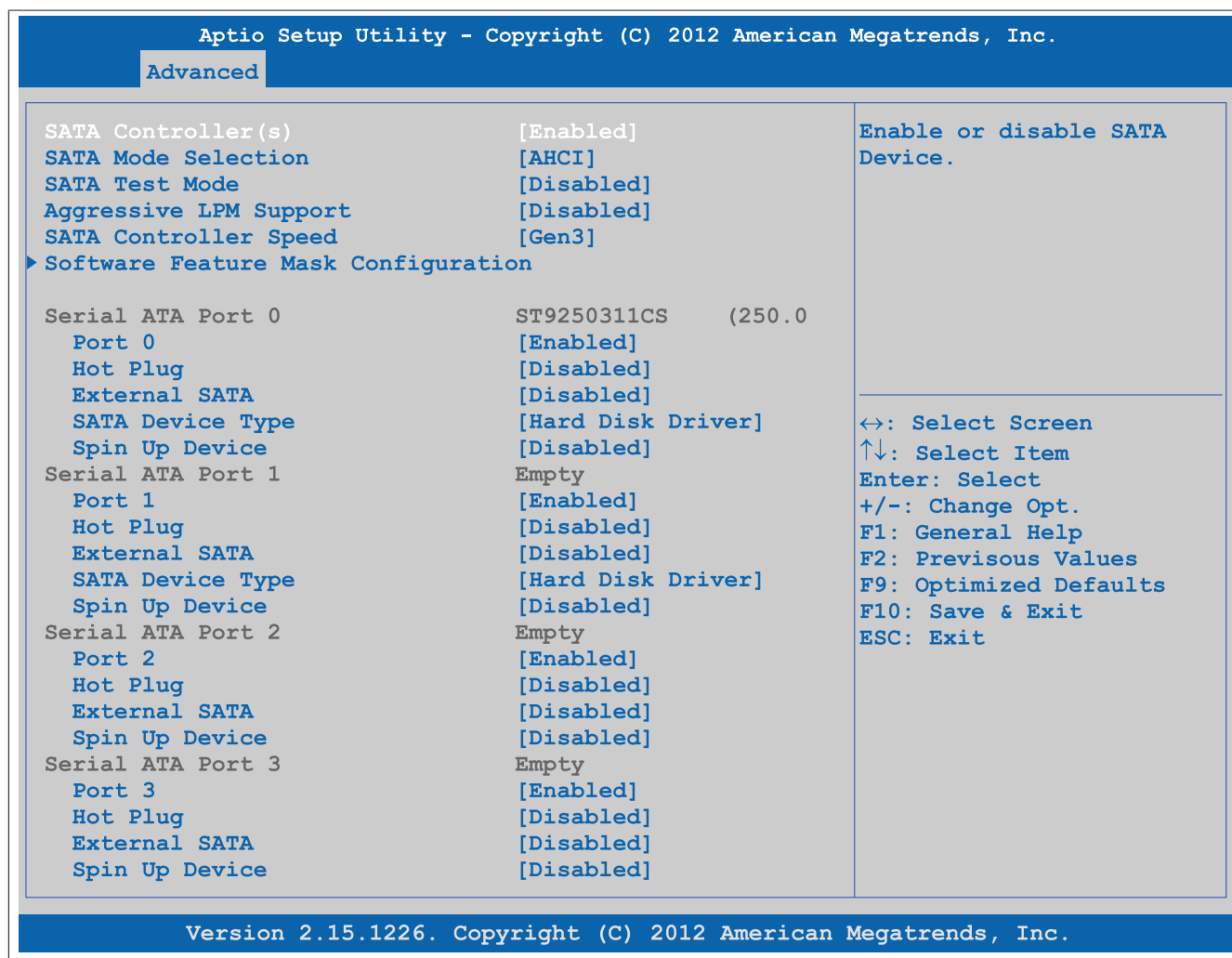


Abbildung 144: Advanced - SATA Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
SATA Controller(s)	Option zum Einstellen der SATA Unterstützung.	Enabled	SATA-Geräte werden unterstützt.
		Disabled	SATA-Geräte werden nicht unterstützt.
SATA Mode Selection	Option zum Einstellen der unterstützten Serial ATA Anschlüsse.	IDE	Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA physikalisches Speicherlaufwerk benutzt. Das Konfigurieren der SATA Ports ist nicht möglich.

Tabelle 177: Advanced - SATA Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
		AHCI	Mit der Einstellung AHCI kann man den internen Speichertreiber der SATA-Funktionen aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufälligem Schreib-Lese-Zugriff erhöhen, indem das Laufwerk die Reihenfolge der Befehle selbst festlegt.
		RAID	Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix Storage Technologie mit der Serial ATA Festplatte konfiguriert werden.
SATA Test Mode	Option zum Einstellen der Testfunktion. Diese wird nur für Kontrollmessungen verwendet.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Aggressive LPM Support	Aggressive Link Power Management (ALPM) ist eine Methode zum Stromsparen des SATA Datenträgers.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SATA Controller Speed	Option zum Einstellen der maximalen SATA Transferrate. Die Transferrate ist auch von der maximal möglichen Transferrate des Datenträgers abhängig.	Gen1	Die maximale SATA Transferrate 1.5 Gbit/s.
		Gen2	Die maximale SATA Transferrate 3.0 Gbit/s.
		Gen3	Die maximale SATA Transferrate 6.0 Gbit/s.
Software Feature Mask Configuration	Konfiguration verschiedener Laufwerkeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Software Feature Mask Configuration" auf Seite 207
Alternate ID ¹⁾	Option zum Aktivieren / Deaktivieren eines Reports der Alternate Device ID.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Serial ATA Port 0	Anzeige des am SATA Port 0 angeschlossenen Datenträgers.	keine	-
Port 0	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des SATA Port 0.	Disabled	Der SATA Port 0 ist deaktiviert.
		Enabled	Der SATA Port 0 ist aktiviert.
Hot Plug	Option zum Einstellen der Hot-Plug-Fähigkeit des SATA Port 0.	Disabled	Der SATA Port 0 ist nicht Hot-Plug-fähig.
		Enabled	Der SATA Port 0 ist Hot-Plug-fähig. Geräte können im laufenden Betrieb an-/abgeschlossen werden.
External SATA	Option zum Einstellen des externen SATA Ports.	Disabled	Der Port wird extern als eSATA verwendet.
		Enabled	Der Port wird intern als SATA verwendet.
Mechanical Presence Switch ²⁾	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Reports wenn dieser Port einen Mechanical Presence Switch hat.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
SATA Device Type	Identifizierung ob am SATA Port ein Solid State oder Hard Disk Datenträger angeschlossen ist.	Hard Disk Driver	Am SATA Port ist eine Hard Disk angeschlossen.
		Solid State Drive	Am SATA Port ist eine SSD angeschlossen.
Spin Up Device	Option zum Einstellen einer Initialisierungssequenz für das angeschlossene Gerät während des Starts für den SATA Port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Serial ATA Port 1	Anzeige des am SATA Port 1 angeschlossenen Datenträgers.	keine	-
Port 1	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des SATA Port 1.	Disabled	Der SATA Port 1 ist deaktiviert.
		Enabled	Der SATA Port 1 ist aktiviert.
Hot Plug	Option zum Einstellen der Hot-Plug-Fähigkeit des SATA Port 1.	Disabled	Der SATA Port 1 ist nicht Hot-Plug-fähig.
		Enabled	Der SATA Port 1 ist Hot-Plug-fähig. Geräte können im laufenden Betrieb an-/abgeschlossen werden.
External SATA	Option zum Einstellen des externen SATA Ports.	Disabled	Der Port wird extern als eSATA verwendet.
		Enabled	Der Port wird intern als SATA verwendet.
Mechanical Presence Switch ²⁾	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Reports wenn dieser Port einen Mechanical Presence Switch hat.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
SATA Device Type	Identifizierung ob am SATA Port ein Solid State oder Hard Disk Datenträger angeschlossen ist.	Hard Disk Driver	Am SATA Port ist eine Hard Disk angeschlossen.
		Solid State Drive	Am SATA Port ist eine SSD angeschlossen.
Spin Up Device	Option zum Einstellen einer Initialisierungssequenz für das angeschlossene Gerät während des Starts für den SATA Port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Serial ATA Port 2	Anzeige des am SATA Port 2 angeschlossenen Datenträgers.	keine	-
Port 2	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des SATA Port 2.	Disabled	Der SATA Port 2 ist deaktiviert.
		Enabled	Der SATA Port 2 ist aktiviert.
Hot Plug	Option zum Einstellen der Hot-Plug-Fähigkeit des SATA Port 2.	Disabled	Der SATA Port 2 ist nicht Hot-Plug-fähig.
		Enabled	Der SATA Port 2 ist Hot-Plug-fähig. Geräte können im laufenden Betrieb an-/abgeschlossen werden.
External SATA	Option zum Einstellen des externen SATA Ports.	Disabled	Der Port wird extern als eSATA verwendet.
		Enabled	Der Port wird intern als SATA verwendet.
Mechanical Presence Switch ²⁾	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Reports wenn dieser Port einen Mechanical Presence Switch hat.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
SATA Device Type	Identifizierung ob am SATA Port ein Solid State oder Hard Disk Datenträger angeschlossen ist.	Hard Disk Drive	Am SATA Port ist eine Hard Disk angeschlossen.
		Solid State Drive	Am SATA Port ist eine SSD angeschlossen.

Tabelle 177: Advanced - SATA Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Spin Up Device	Option zum Einstellen einer Initialisierungssequenz für das angeschlossene Gerät während des Starts für den SATA Port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Serial ATA Port 3	Anzeige des am SATA Port 3 angeschlossenen Datenträgers.	keine	-
Port 3	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des SATA Port 3.	Disabled	Der SATA Port 3 ist deaktiviert.
		Enabled	Der SATA Port 3 ist aktiviert.
Hot Plug	Option zum Einstellen der Hot-Plug-Fähigkeit des SATA Port 3.	Disabled	Der SATA Port 3 ist nicht Hot-Plug-fähig.
		Enabled	Der SATA Port 3 ist Hot-Plug-fähig. Geräte können im laufenden Betrieb an-/abgeschlossen werden.
External SATA	Option zum Einstellen des externen SATA Ports.	Disabled	Der Port wird extern als eSATA verwendet.
		Enabled	Der Port wird intern als SATA verwendet.
Mechanical Presence Switch ²⁾	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Reports wenn dieser Port einen Mechanical Presence Switch hat.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
SATA Device Type	Identifizierung ob am SATA Port ein Solid State oder Hard Disk Datenträger angeschlossen ist.	Hard Disk Drive	Am SATA Port ist eine Hard Disk angeschlossen.
		Solid State Drive	Am SATA Port ist eine SSD angeschlossen.
Spin Up Device	Option zum Einstellen einer Initialisierungssequenz für das angeschlossene Gerät während des Starts für den SATA Port.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 177: Advanced - SATA Configuration Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *SATA Mode Selection* auf *RAID* eingestellt ist.
2) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *Hot Plug* auf *Enabled* eingestellt ist.

1.4.9.1 Software Feature Mask Configuration

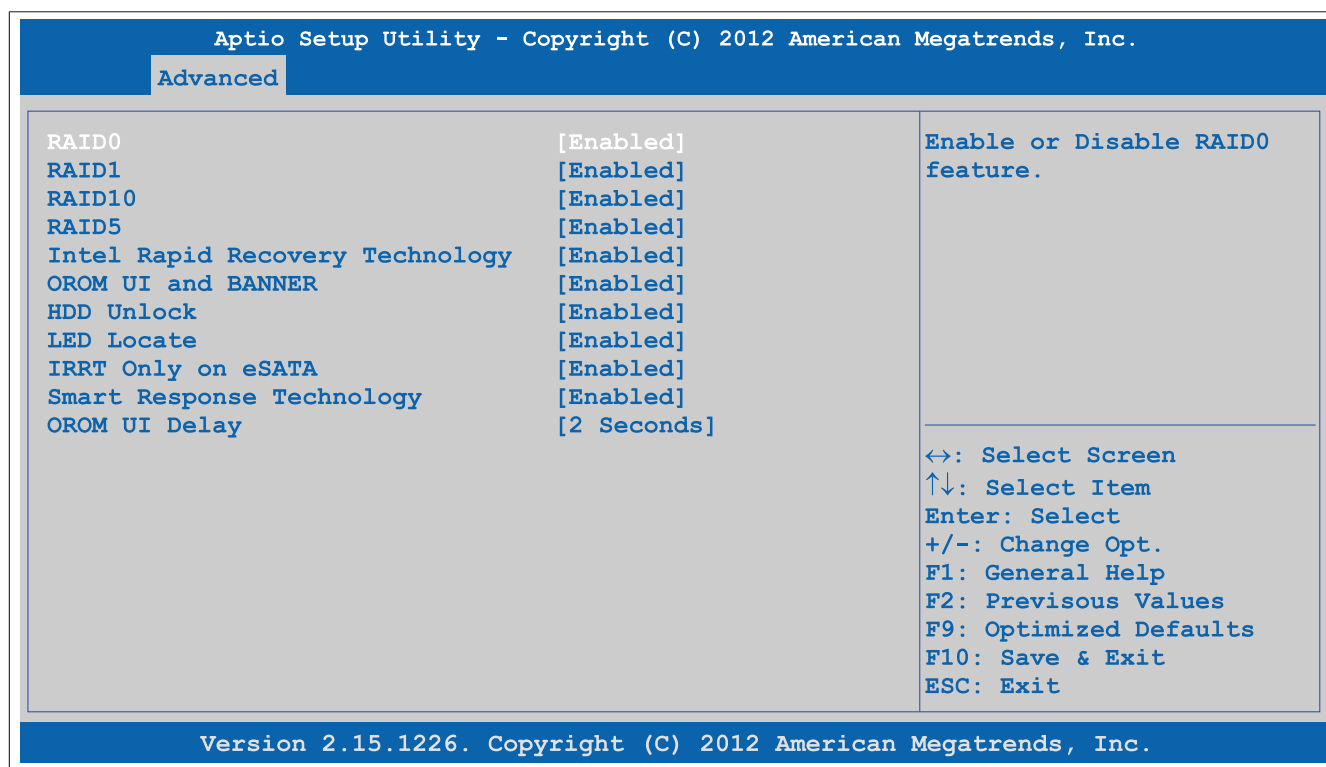


Abbildung 145: Advanced - SATA Configuration - Software Feature Mask Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
RAID0	Option zum Aktivieren / Deaktivieren eines RAID0 Systems.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
RAID1	Option zum Aktivieren / Deaktivieren eines RAID1 Systems.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
RAID10	Option zum Aktivieren / Deaktivieren eines RAID10 Systems.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
RAID5	Option zum Aktivieren / Deaktivieren eines RAID5 Systems.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Intel Rapid Recovery Technology	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Intel® Rapid-Recovery-Technologie.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
OROM UI and BANNER	Option zum Anzeigen des OROM UI.	Disabled	Es wird kein OROM UI oder eine Information angezeigt.

Tabelle 178: Advanced - SATA Configuration - Software Feature Mask Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
HDD Unlock	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des HDD Passwort Unlock im Betriebssystem.	Enabled	Das OROM UI wird angezeigt.
		Disabled	Das HDD Passwort Unlock ist deaktiviert.
LED Locate	Option zum Anzeigen des LED/SGPIO wenn ein Laufwerk angeschlossen ist.	Enabled	Das HDD Passwort Unlock ist aktiviert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IRRT Only on eSATA ¹⁾	Option zum Einstellen der Intel® Rapid-Recovery-Technologie.	Disabled	Es wird angezeigt, dass ein Laufwerk angeschlossen ist.
		Enabled	Jedes RAID System kann interne und eSATA Laufwerke verwenden.
Smart Response Technology	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Intel® Smart Response Technologie.	Disabled	Nur IRRT Systeme können interne und eSATA Laufwerke verwenden.
		Enabled	Deaktivierung der Funktion.
OROM UI Delay	Option zum Anzeigen der Verzögerungszeit des OROM UI Splash Screens.	2 Seconds, 4 Seconds, 6 Seconds, 8 Seconds	Aktivierung der Funktion.
			Einstellung in Sekunden.

Tabelle 178: Advanced - SATA Configuration - Software Feature Mask Configuration Einstellmöglichkeiten

1) IRRT = Intel Rapid Recovery Technology

1.4.10 Memory Configuration

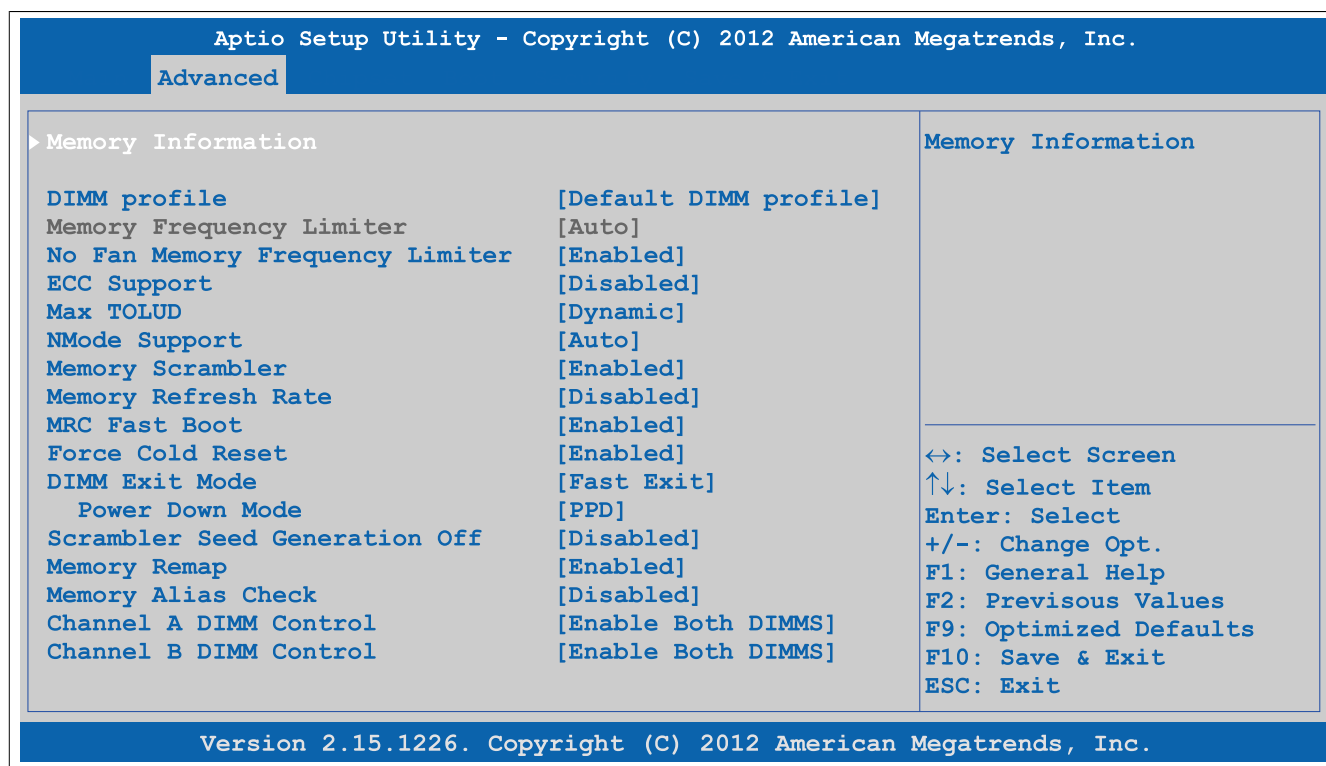


Abbildung 146: Advanced - Memory Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Memory Information	Anzeige der Hauptspeicher Eigenschaften.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Memory Information" auf Seite 210
DIMM profile	Option zum Einstellen des Hauptspeicher Timing Profils.	Default DIMM profile	Das Default Profil wird verwendet.
		Custom Profile	Ein benutzerdefiniertes Profil wird verwendet.
		XMP Profile 1	Das XMP Profil 1 wird verwendet.
		XMP Profile 2	Das XMP Profil 2 wird verwendet.
Custom Profile Control¹⁾	Konfiguration des Hauptspeicher Timing Profils.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Custom Profile Control" auf Seite 211
Memory Frequency Limiter ²⁾	Option zum Einstellen der maximal möglichen Hauptspeicherfrequenz.	Auto	Automatische Konfiguration.
		1067, 1333, 1600, 1867, 2133, 2400, 2667	Manuelle Konfiguration.
No Fan Memory Frequency Limiter	Option zum automatischen Drosseln der Hauptspeicherfrequenz wenn kein Lüfter in der Systemeinheit vorhanden ist.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 179: Advanced - Memory Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ECC Support	Option zur Aktivierung / Deaktivierung des Hauptspeicher ECC Support.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Max TOLUD ³⁾	Option zum Einstellen des maximalen "Top Of Low Usable DRAM".	Dynamic	Die dynamische Zuordnung passt den TOLUD automatisch, basierend auf die MMIO Länge des Grafikcontrollers, an.
		1 GB, 1.25 GB, 1.5 GB, 1.75 GB, 2 GB, 2.25 GB, 2.5 GB, 2.75 GB, 3 GB, 3.25 GB	Manuelle Einstellung des TOLUD.
NMode Support	Option zum Einstellen des NMode Support.	Auto	Automatische Einstellung.
		1N Mode	Einstellung auf 1N Mode.
		2N Mode	Einstellung auf 2N Mode.
Memory Scrambler	Option zur Aktivierung / Deaktivierung des Memory Scrambler Support.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Memory Refresh Rate	Option zum Einstellen der RAM Refresh Rate.	Disabled	Automatische Einstellung.
		x1	Manuelle Einstellung.
		x2	Manuelle Einstellung.
MRC Fast Boot	Option zur Aktivierung / Deaktivierung des MRC Fast Boot.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Force Cold Reset	Option zur Aktivierung / Deaktivierung des Force Cold Reset.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
DIMM Exit Mode	Option zum Einstellen des DIMM Exit Mode.	Auto	Automatische Einstellung.
		Slow Exit	Slow Exit Mode ist aktiviert.
		Fast Exit	Fast Exit Mode ist aktiviert.
Power Down Mode	Option zum Einstellen des Energiesparmodus des Hauptspeichers.	No Power Down	TBD
		APD	TBD
		PPD	TBD
		APD-PPD	TBD
Scrambler Seed Generation Off	Option zur Aktivierung / Deaktivierung des Scrambler Seed Generation Off.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Memory Remap	Option zur Aktivierung / Deaktivierung des Memory Remap überhalb von 4 GByte.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Memory Alias Check	Option zur Aktivierung / Deaktivierung des Memory Alias Check.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Channel A DIMM Control	Option zum Einstellen des Hauptspeicher A Kanals.	Enable Both DIMMS	Beide Hauptspeicher des Kanal A werden aktiviert.
		Disable DIMM0	Der DIMM0 Hauptspeicher des Kanal A wird deaktiviert.
		Disable DIMM1	Der DIMM1 Hauptspeicher des Kanal A wird deaktiviert.
		Disable Both DIMMS	Beide Hauptspeicher des Kanal A werden deaktiviert.
Channel B DIMM Control	Option zum Einstellen des Hauptspeicher B Kanals.	Enable Both DIMMS	Beide Hauptspeicher des Kanal B werden aktiviert.
		Disable DIMM0	Der DIMM0 Hauptspeicher des Kanal B wird deaktiviert.
		Disable DIMM1	Der DIMM1 Hauptspeicher des Kanal B wird deaktiviert.
		Disable Both DIMMS	Beide Hauptspeicher des Kanal B werden deaktiviert.

Tabelle 179: Advanced - Memory Configuration Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn *DIMM profile* auf *Custom Profile* gestellt ist.
 2) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *No Fan Memory Frequency Limiter* auf *Disabled* gestellt ist.
 3) TOLUD = Top Of Low Usable DRAM

1.4.10.1 Memory Information

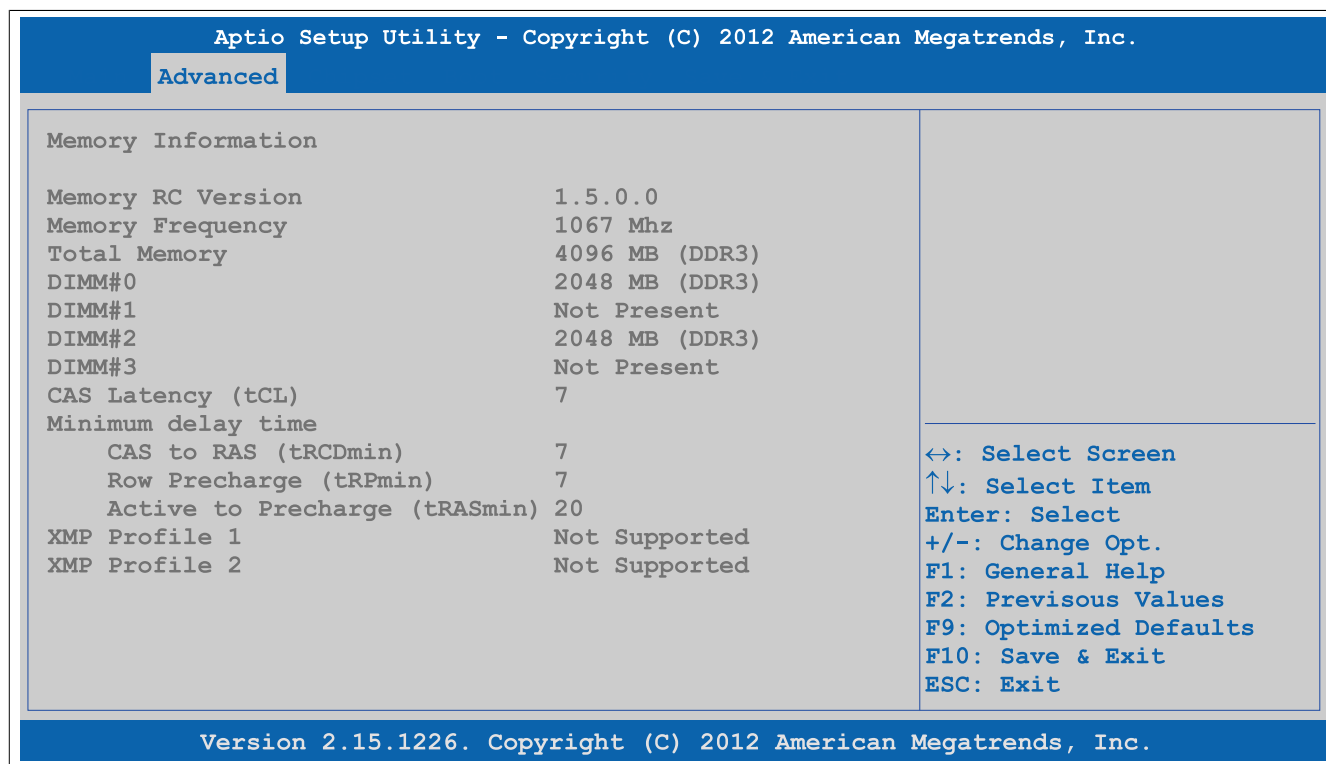


Abbildung 147: Advanced - Memory Configuration - Memory Information

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Memory RC Version	Anzeige der Hauptspeicher RC Version.	keine	-
Memory Frequency	Anzeige der Hauptspeicher Frequenz.	keine	-
Total Memory	Anzeige der Gesamtspeichergröße des Hauptspeichers.	keine	-
DIMM#0	Anzeige der Speichergröße des Hauptspeichers im DIMM Slot 0.	keine	-
DIMM#1	Anzeige der Speichergröße des Hauptspeichers im DIMM Slot 1.	keine	-
DIMM#2	Anzeige der Speichergröße des Hauptspeichers im DIMM Slot 2.	keine	-
DIMM#3	Anzeige der Speichergröße des Hauptspeichers im DIMM Slot 3.	keine	-
CAS Latency (tCL)	Anzeige der CAS Latenz.	keine	-
Minimum delay time			
CAS to RAS (tRCDmin)	Anzeige der Verzögerungszeit zwischen CAS# und RAS#.	keine	-
Row Precharge (tRPmin)	Anzeige der Row Precharge Zeit.	keine	-
Active to Precharge (tRASmin)	Anzeige der minimalen aktiven RAS# Zeit.	keine	-
XMP Profile 1	Anzeige des XMP Profils 1.	keine	-
XMP Profile 2	Anzeige des XMP Profils 2.	keine	-

Tabelle 180: Advanced - Memory Configuration - Memory Information

1.4.10.2 Custom Profile Control

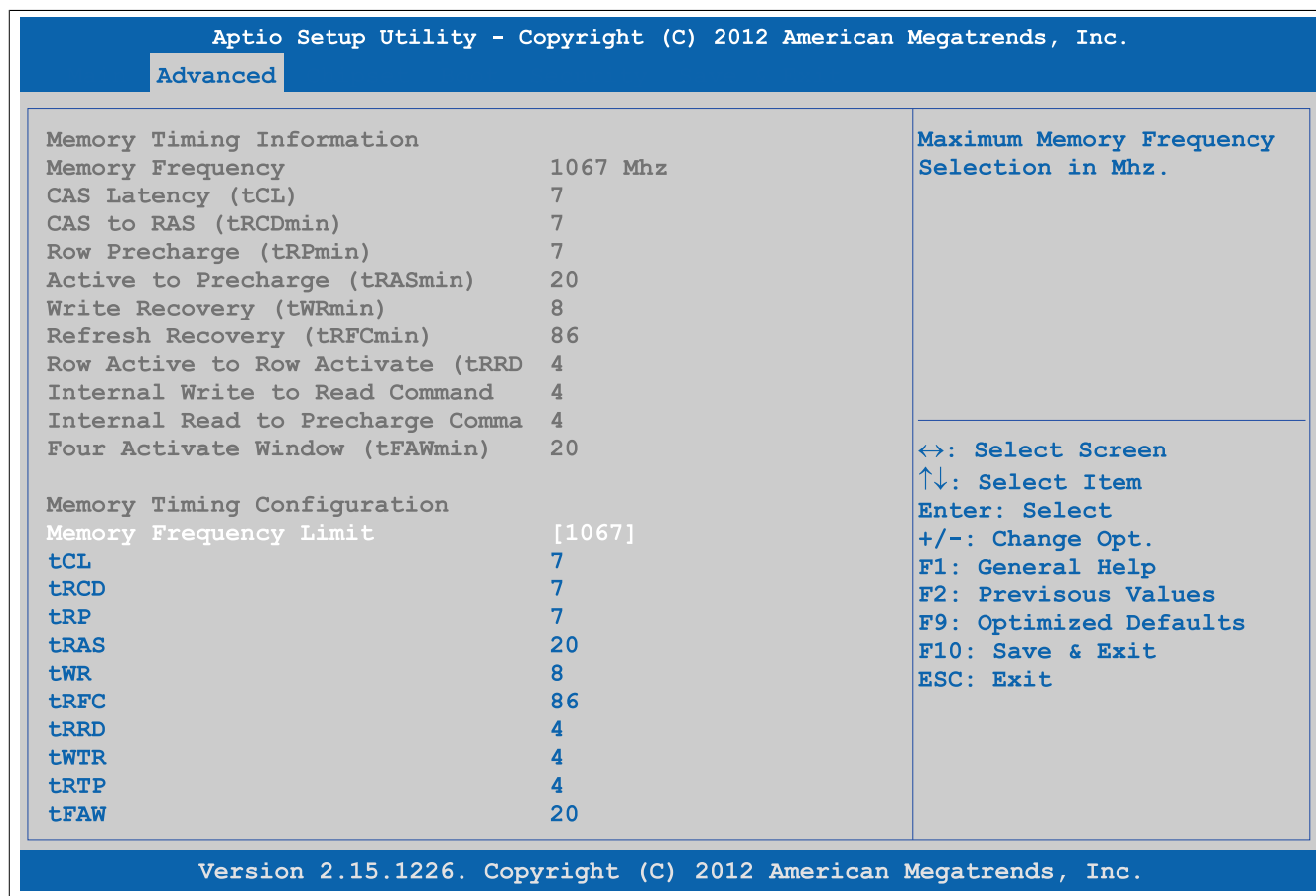


Abbildung 148: Advanced - Memory Configuration - Custom Profile Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Memory Frequency Limiter	Einstellung der maximalen Hauptspeicher Frequenz in MHz.	1067, 1333, 1600, 1867, 2133, 2400, 2667	
tCL	Einstellung der CAS Latenz.	4 bis 18	
tRCD	Einstellung der minimalen "CAS to RAS" Zeit.	1 bis 38	
tRP	Einstellung der minimalen "Row Precharge" Zeit.	1 bis 38	
tRAS	Einstellung der minimalen "Active to Precharge" Zeit.	1 bis 586	
tWR	Einstellung der minimalen "Write Recovery" Zeit.	1 bis 38	
tRFC	Einstellung der minimalen "Refresh Recovery" Zeit.	1 bis 9363	
tRRD	Einstellung der minimalen "Row Active to Row Active" Zeit.	1 bis 38	
tWTR	Einstellung der minimalen "Internal Write to Read Command" Zeit.	1 bis 38	
tRTP	Einstellung der minimalen "Internal Read to Precharge Command" Zeit.	1 bis 38	
tFAW	Einstellung der minimalen "Four Active Window" Zeit.	1 bis 586	

Tabelle 181: Advanced - Memory Configuration - Custom Profile Control Einstellmöglichkeiten

1.4.11 USB Configuration

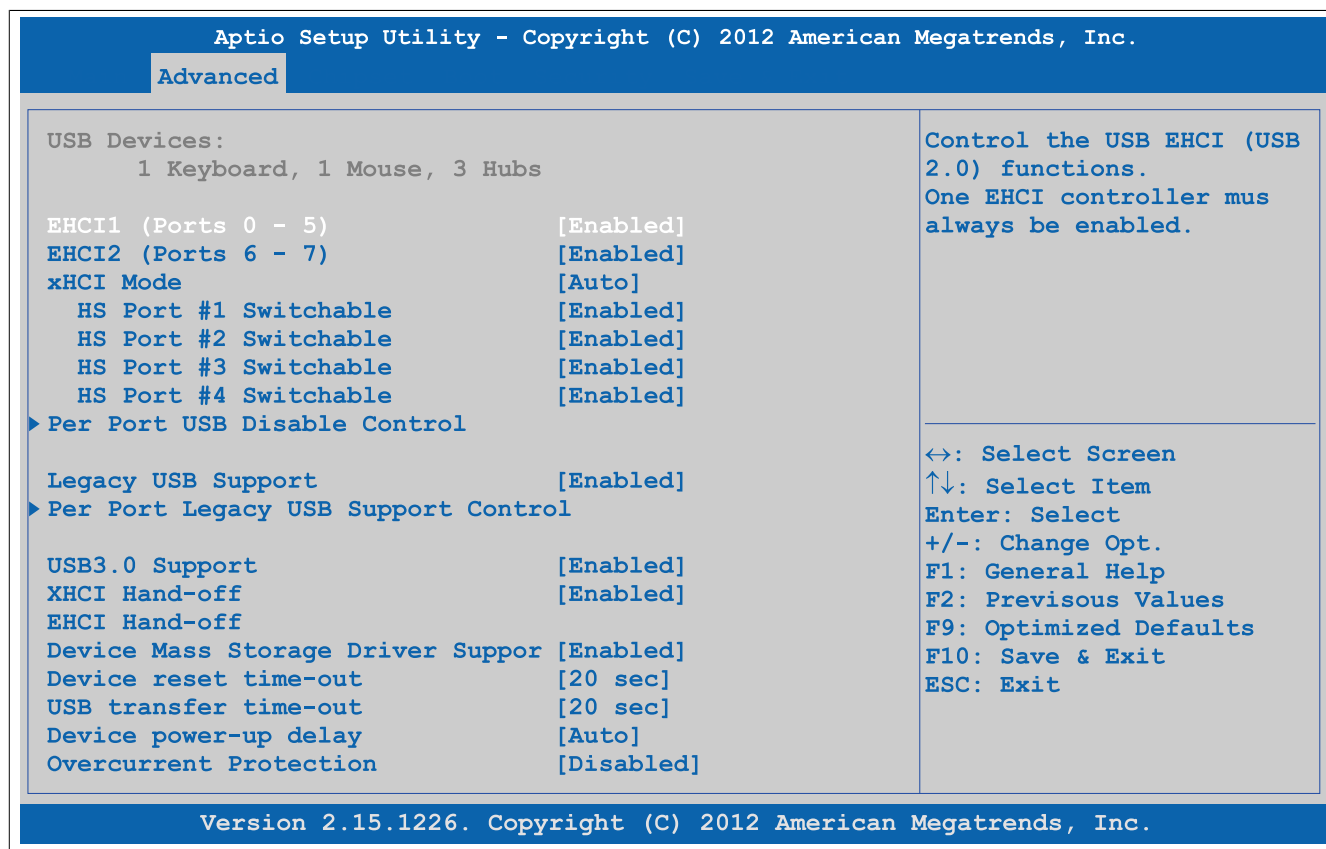


Abbildung 149: Advanced - USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
EHCI1 (Ports 0-5)	Einstellung des USB EHCI Controllers 1 für die USB Ports #0 bis #5 (an der Systemeinheit USB1 bis USB4, USB an der Monitor / Panel Schnittstelle und der Buseinheit).	Enabled	Aktivierung des EHCI Controllers 1.
		Disabled	Deaktivierung des EHCI Controllers 1.
EHCI2 (Ports 6-7)	Einstellung des USB EHCI Controllers 1 für die USB Ports #6 bis #7 (an der Systemeinheit USB5 und USB an der Monitor / Panel Option).	Enabled	Aktivierung des EHCI Controllers 2.
		Disabled	Deaktivierung des EHCI Controllers 2.
xHCI Mode	Option zum Einstellen des xHCI Controllers.	Smart Auto	Die USB 3.0 Schnittstellen werden erst beim Start des Betriebssystems als USB 3.0 behandelt, davor als USB 2.0 Schnittstellen. Wird der APC910 rebootet werden die USB 3.0 Ports während des Bootvorganges aber trotzdem als USB 3.0 behandelt.
		Auto	Während des BIOS Bootvorganges werden die USB 3.0 Ports als USB 2.0 Ports behandelt. Erst wenn das Betriebssystem hochgefahren und die USB 3.0 Treiber geladen hat, werden die USB 3.0 Ports auch als solche behandelt.
		Enabled	Der xHCI Controller ist aktiviert und die USB 3.0 Schnittstellen werden immer als solche erkannt.
		Disabled	Der xHCI Controller ist deaktiviert. Alle USB 3.0 Schnittstellen werden zu USB 2.0 Schnittstellen.
HS Port #1 Switchable	Option zum Einstellen des HS Port 1 zwischen xHCI und EHCI zu wechseln.	Disabled	Der Port 1 wird auf EHCI geroutet und wird mit maximal USB 2.0 betrieben.
		Enabled	Der Port 1 wird auf xHCI geroutet. Der entsprechende SS Port ist aktiviert.
HS Port #2 Switchable	Option zum Einstellen des HS Port 2 zwischen xHCI und EHCI zu wechseln.	Disabled	Der Port 2 wird auf EHCI geroutet und wird mit maximal USB 2.0 betrieben.
		Enabled	Der Port 2 wird auf xHCI geroutet. Der entsprechende SS Port ist aktiviert.
HS Port #3 Switchable	Option zum Einstellen des HS Port 3 zwischen xHCI und EHCI zu wechseln.	Disabled	Der Port 3 wird auf EHCI geroutet und wird mit maximal USB 2.0 betrieben.
		Enabled	Der Port 3 wird auf xHCI geroutet. Der entsprechende SS Port ist aktiviert.
HS Port #4 Switchable	Option zum Einstellen des HS Port 4 zwischen xHCI und EHCI zu wechseln.	Disabled	Der Port 4 wird auf EHCI geroutet und wird mit maximal USB 2.0 betrieben.
		Enabled	Der Port 4 wird auf xHCI geroutet. Der entsprechende SS Port ist aktiviert.

Tabelle 182: Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Per Port USB Disable Control	Konfiguration zum Aktivieren / Deaktivieren der einzelnen USB Ports.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Per Port USB Disable Control" auf Seite 214
Legacy USB Support	Option zum Einstellen des Legacy USB Support. Es funktioniert keine USB Schnittstelle während des Starts. Nach dem Betriebssystemstart steht der USB Support wieder zur Verfügung. Eine USB Tastatur wird während des POST noch erkannt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung.
Per Port Legacy USB Support Control	Konfiguration zum Aktivieren / Deaktivieren des Legacy Support der einzelnen USB Ports.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Per Port Legacy USB Support Control" auf Seite 215
USB3.0 Support	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des USB 3.0 Modus.	Enabled	Alle USB 3.0 Schnittstellen laufen im USB 3.0 Modus.
		Disabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 oder 1.1 Modus.
XHCI Hand-off	Option zum Einstellen der Unterstützung für Betriebssysteme ohne vollautomatische XHCI Funktion.	Enabled	Aktiviert die USB 3.0 Unterstützung.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion. USB Geräte werden mit Betriebssystemen ohne vollautomatische XHCI Funktion somit nur mit USB 2.0 betrieben.
EHCI Hand-off	Option zum Einstellen der Unterstützung für Betriebssysteme ohne vollautomatische EHCI Funktion.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. USB Geräte werden mit Betriebssystemen ohne vollautomatische EHCI Funktion somit nur mit USB 1.1 betrieben.
		Enabled	Aktiviert die USB 2.0 Unterstützung.
Device Mass Storage Driver Support	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der USB-Massenspeichergeräte Unterstützung.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Device reset time-out	Hier kann die Zeit, die der POST für USB-Speichergeräte nach dem Gerätestartbefehl warten soll, eingestellt werden.	10 sec, 20 sec, 30 sec, 40 sec	Einstellung des Werts in Sekunden.
USB transfer time-out	Option zum Einstellen des Timeout-Werts für Control-, Bulk- und Interrupt-Transfer.	1 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec	Einstellung des Werts in Sekunden.
Device power-up delay	Option zum Einstellen der maximalen Zeit, bis sich ein USB-Gerät beim Host-Controller meldet.	Auto	Die maximale Zeit wird automatisch vergeben. Für einen Root-Port wird 100 ms vergeben, für einen Hub-Port wird die Information aus dem Hub Descriptor genommen.
		Manual	Die maximale Zeit kann manuell bei der Option "Device power-up delay in seconds" eingegeben werden.
Device power-up delay in seconds ¹⁾	Option zum manuellen Einstellen des Device power-up delay.	1 bis 40	Einstellung des Werts in Sekunden.
Overcurrent Protection	Option zum Einstellen des Überstromschutzes bei allen USB Schnittstellen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 182: Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *Device power-up delay* auf *Manual* eingestellt ist.

1.4.11.1 Per Port USB Disable Control

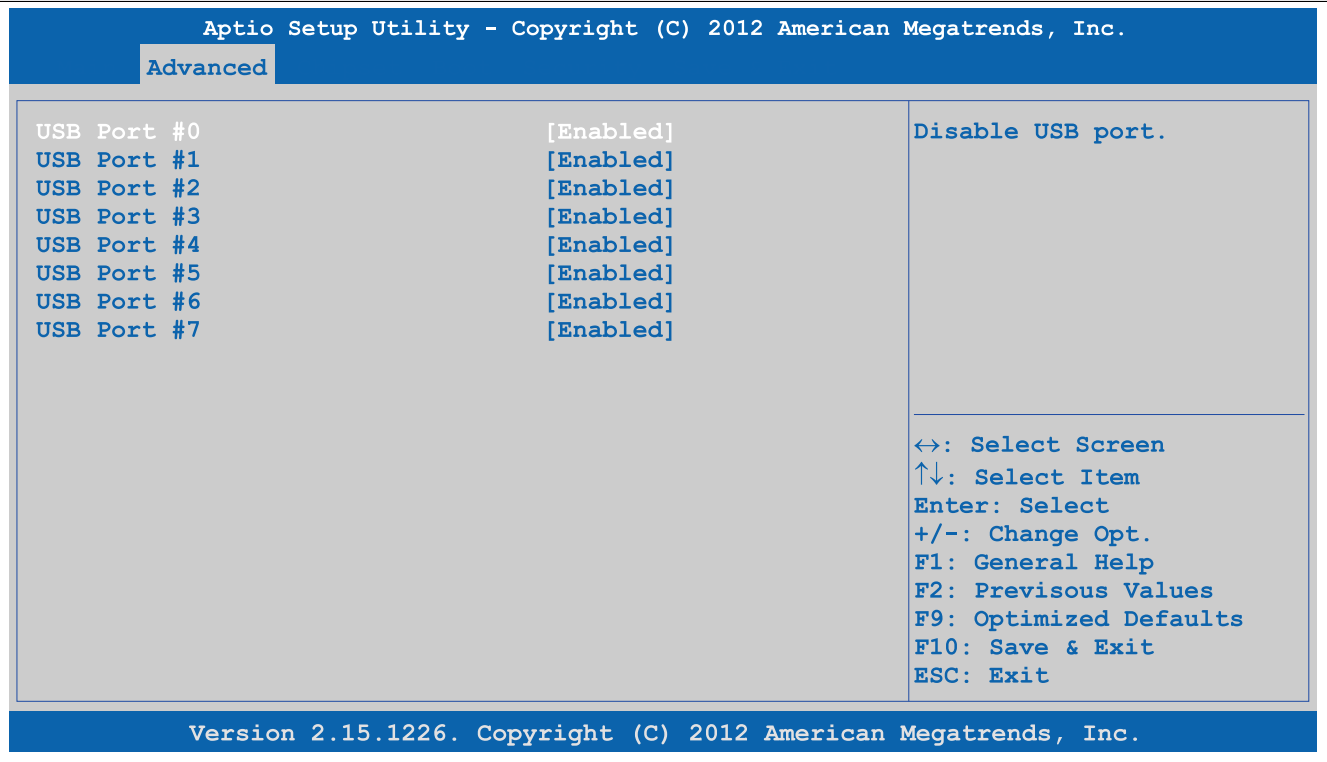


Abbildung 150: Advanced - USB Configuration - Per Port USB Disable Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB Port #0	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB4 Port.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB Port #1	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB2 Port.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB Port #2	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB3 Port.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB Port #3	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB1 Port.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB Port #4	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB Port an der Buseinheit.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB Port #5	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB Port an der Monitor / Panel Schnittstelle.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB Port #6	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB5 Port.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB Port #7	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB Port an der Monitor / Panel Option.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.

Tabelle 183: Advanced - USB Configuration - Per Port USB Disable Control Einstellmöglichkeiten

1.4.11.2 Per Port Legacy USB Support Control

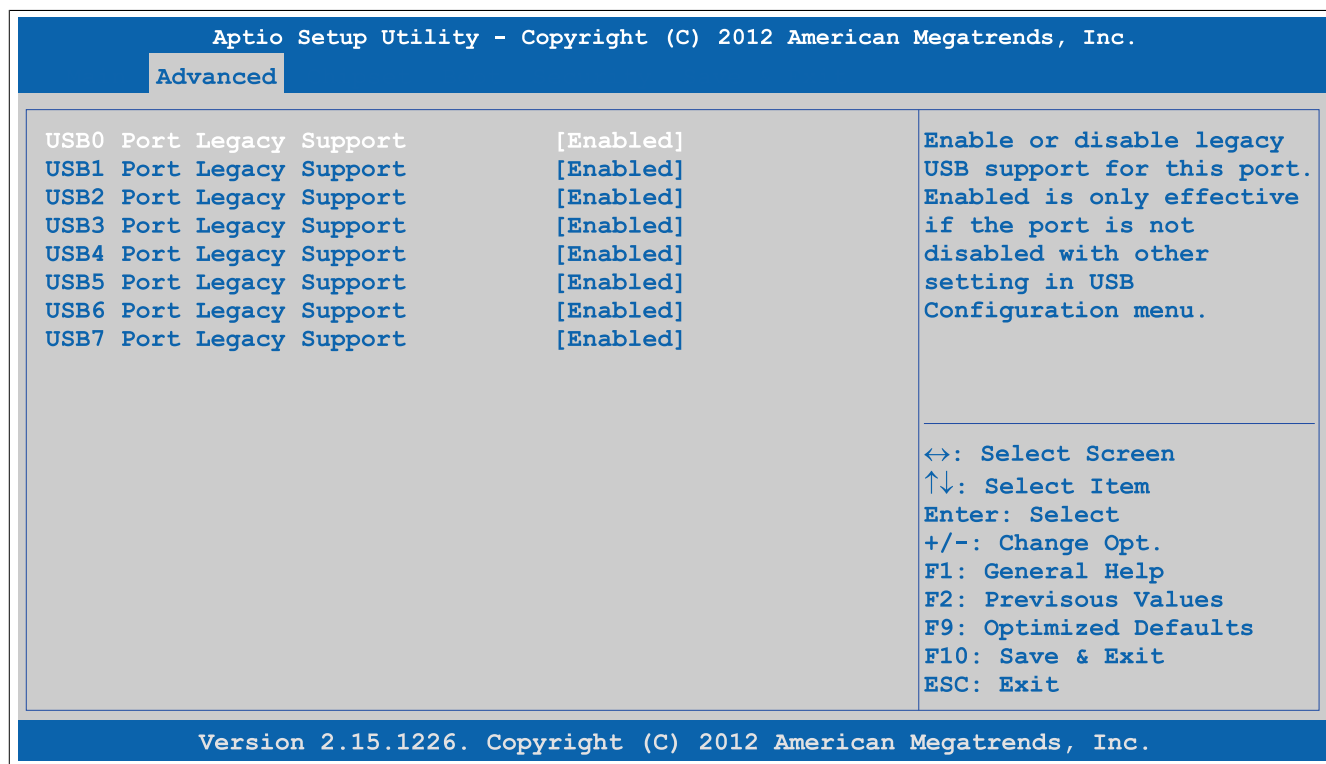


Abbildung 151: Advanced - USB Configuration - Per Port Legacy USB Support Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB0 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB4 Port Legacy Support.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB1 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB2 Port Legacy Support.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB2 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB3 Port Legacy Support.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB3 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB1 Port Legacy Support.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB4 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB Port Legacy Support an der Buseinheit.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB5 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB Port Legacy Support an der Monitor / Panel Schnittstelle.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB6 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB5 Port Legacy Support.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.
USB7 Port Legacy Support	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des USB Port Legacy Support an der Monitor / Panel Option.	Disabled	Deaktivierung des USB Ports.
		Enabled	Aktivierung des USB Ports.

Tabelle 184: Advanced - USB Configuration - Per Port Legacy USB Support Control Einstellmöglichkeiten

1.4.12 Serial Port Console Redirection

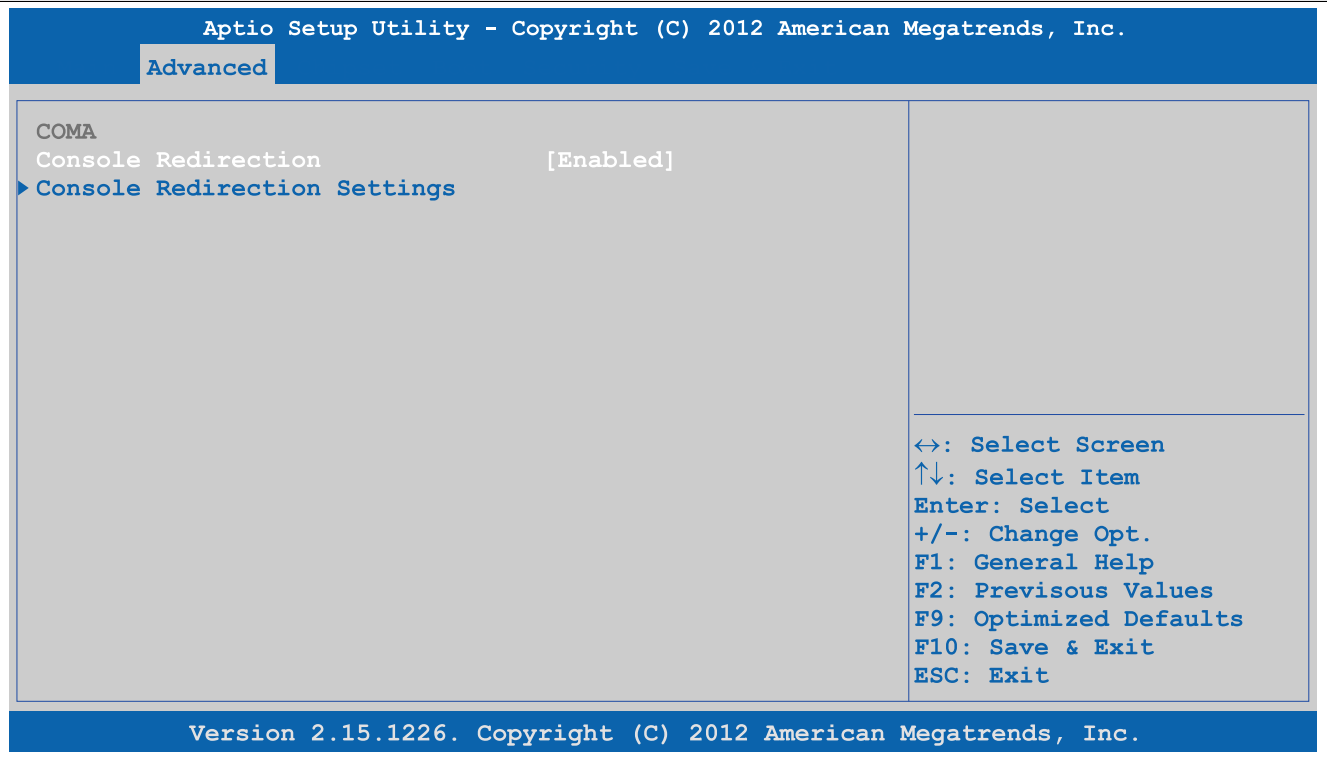


Abbildung 152: Advanced - Serial Port Console Redirection

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Console Redirection	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Console Redirection.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Console Redirection Settings	Konfiguration der Remote Console.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Console Redirection Settings" auf Seite 217

Tabelle 185: Advanced - Serial Port Console Redirection Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellung ist nur möglich, wenn *Device power-up delay* auf *Manual* eingestellt ist.

1.4.12.1 Console Redirection Settings

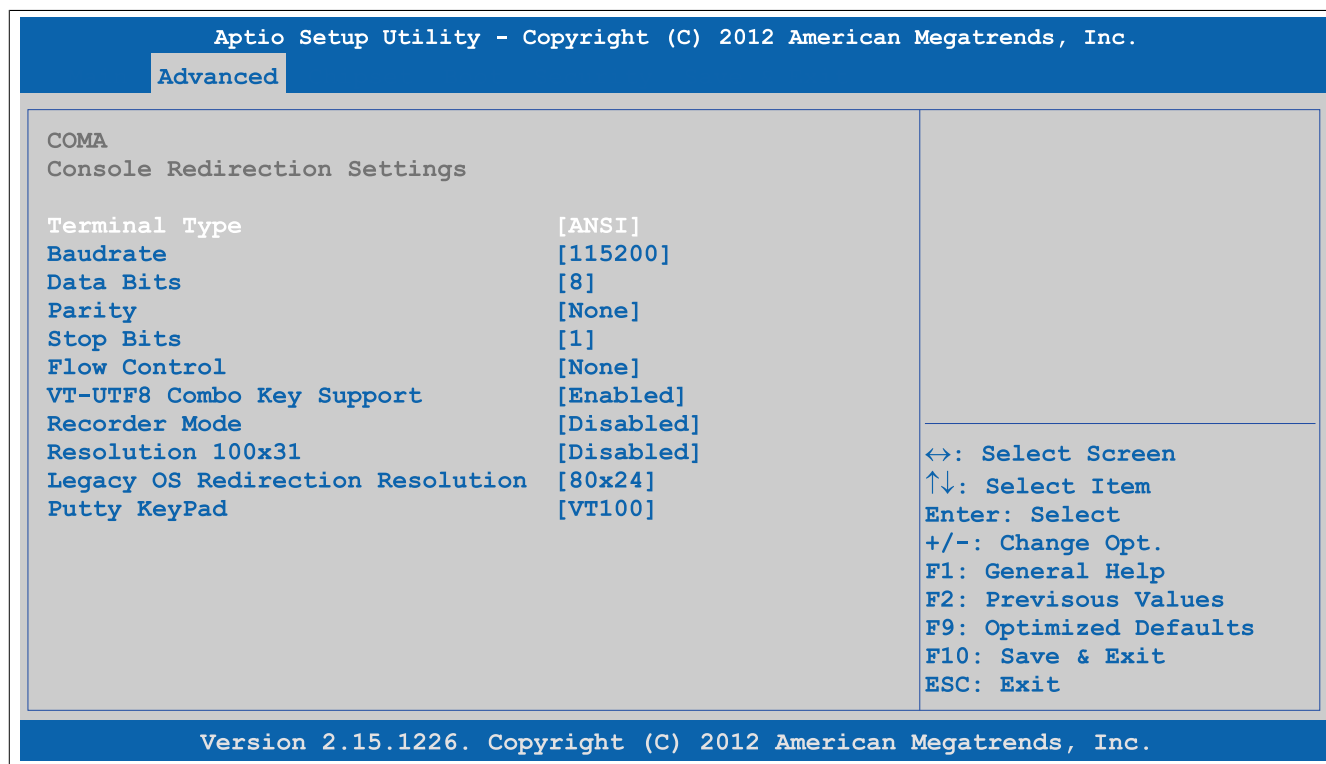


Abbildung 153: Advanced - Console Redirection - Console Redirection Settings

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Terminal Type	Option zum Einstellen der Tastatureingabe.	VT100	Die VT100 Konvention (ASCII-Zeichensatz) wird aktiviert.
		VT100+	Die VT100+ Konvention (ASCII-Zeichensatz und Unterstützung von Farbe, Funktionstasten usw.) wird aktiviert.
		VT-UTF8	Die VT-UTF8 Konvention (verwendet UTF8-Kodierung, um Unicode-Zeichen einem oder mehreren Bytes zuzuordnen) wird aktiviert.
		ANSI	Die ANSI Konvention (erweiterter ASCII-Zeichensatz) wird aktiviert.
Baudrate	Option zum Einstellen der Übertragungsrate der Seriellen Schnittstelle (Bit pro Sekunde).	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Es ist die Übertragungsrate von x Bit aktiviert.
Data Bits	Option zum Einstellen der verwendeten Zeichenlänge (Datenbits) bei der seriellen Kommunikation.	7	Zeichenlänge mit 7 Bit
		8	Zeichenlänge mit 8 Bit
Parity	Option zum Einstellen der verwendeten Paritätsbits bei der seriellen Kommunikation.	None	Es wird kein Paritätsbit verwendet.
		Even	Es wird eine gerade Anzahl von Paritätsbits verwendet.
		Odd	Es wird eine ungerade Anzahl von Paritätsbits verwendet.
		Mark	Paritätsbit ist immer 1.
		Space	Paritätsbit ist immer 0.
Stop Bits	Option zum Einstellen der verwendeten Stopbits bei der seriellen Kommunikation.	1	Es wird 1 Bit als Stopbit verwendet.
Flow Control	Option zum Einstellen der Datenflusssteuerung.	2	Es werden 2 Bit als Stopbits verwendet.
		None	Keine Datenflusssteuerung ist aktiviert.
VT-UTF8 Combo Key Support	Mit dieser Option kann die VT-UTF8 Combo Key Support für die Anschlüsse ANSI und VT100 aktiviert werden.	Hardware RTS/CTS	Hardware Handshake wird aktiviert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Recorder Mode	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Recorder Mode.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resolution 100x31	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der erweiterten Terminal Auflösung.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Legacy OS Redirection Resolution	Option zum Einstellen der Anzahl von Zeilen und Spalten für die Legacy OS Redirection.	80x24	Auflösung mit 80x24
		80x25	Auflösung mit 80x25
Putty KeyPad	TBD	VT100	TBD
		LINUX	TBD

Tabelle 186: Advanced - Console Redirection - Console Redirection Settings Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
		XTERMR6	TBD
		SCO	TBD
		ESCN	TBD
		VT400	TBD

Tabelle 186: Advanced - Console Redirection - Console Redirection Settings Einstellmöglichkeiten

1.5 Boot

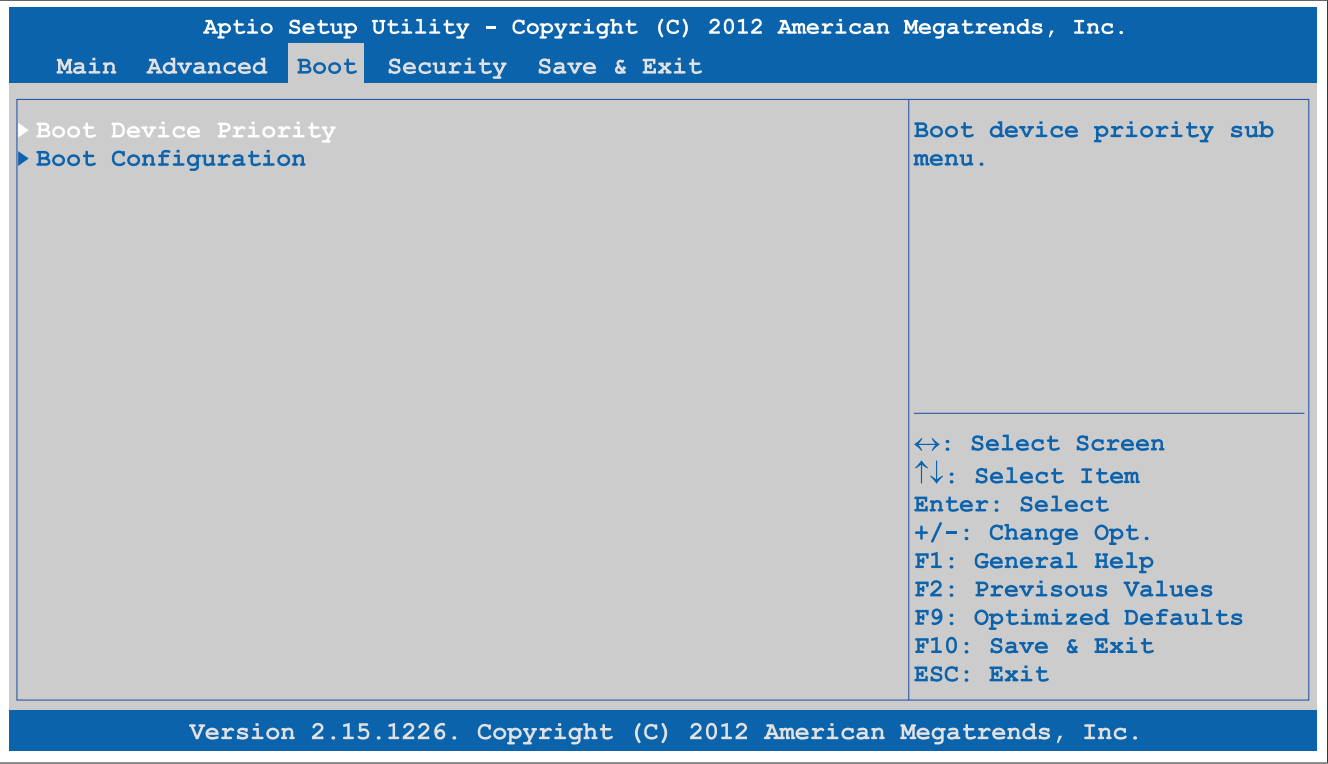


Abbildung 154: Boot

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Device Priority	Konfiguration der Bootreihenfolge.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Boot Device Priority" auf Seite 219
Boot Configuration	Konfiguration der Booteigenschaften.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Boot Configuration" auf Seite 220

Tabelle 187: Boot Übersicht

1.5.1 Boot Device Priority

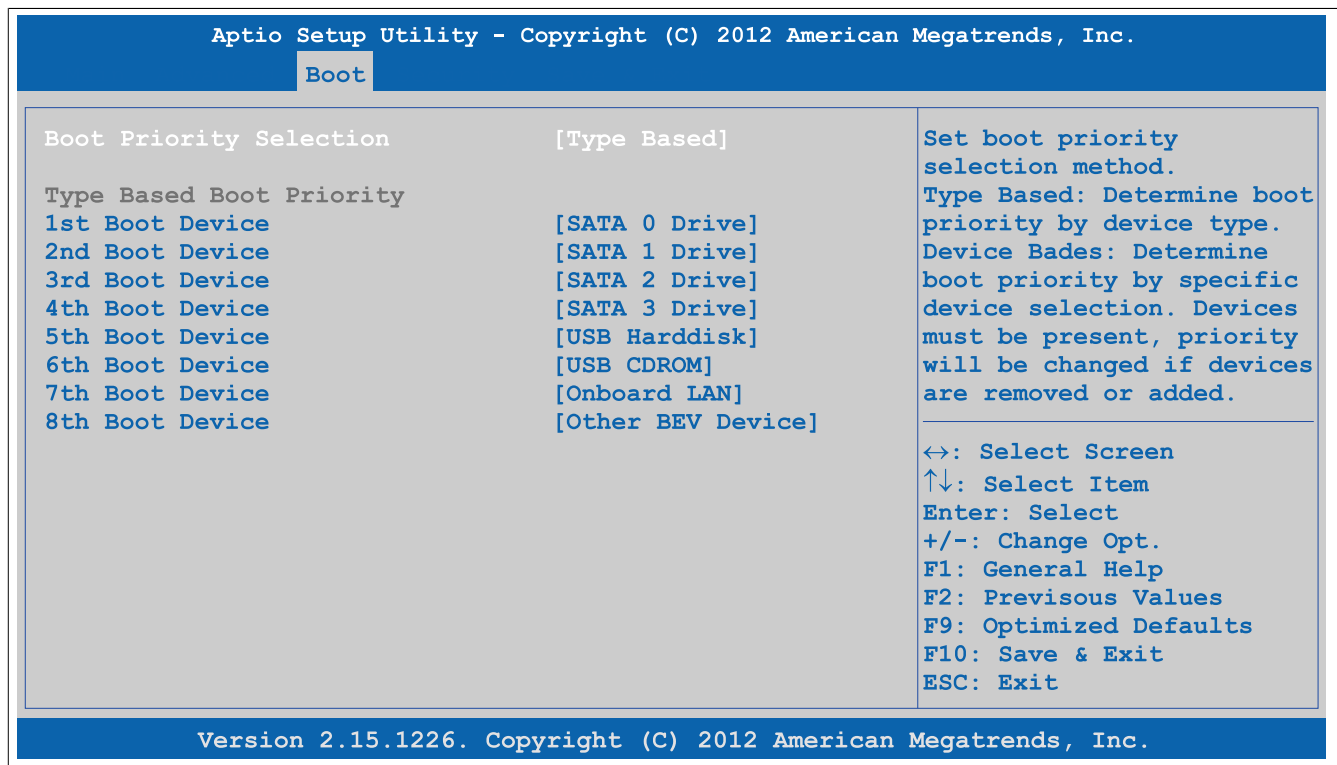


Abbildung 155: Boot - Boot Device Priority

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Priority Selection	Hier kann eingestellt werden, nach welcher Methode die Laufwerke gebootet werden sollen.	Device Based	Es werden nur die vom System erkannten Geräte aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach die Reihenfolge geändert werden. Information: Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.
		Type Based	Mann kann die Bootreihenfolge einer Gerätetypenliste ändern. Es ist auch möglich nicht angeschlossene Gerätetypen in dieser Liste anzugeben. Information: Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.
1st Boot Device	Unter dieser Option können die Boot- Laufwerke eingestellt werden.	Disabled, SATA 0 Drive, SATA 1 Drive, SATA 2 Drive, SATA 3 Drive, USB Floppy, USB Harddisk, USB CDROM, Onboard LAN, External LAN, Other BEV Device	Auswahl der gewünschten Reihenfolge.
2nd Boot Device			
3rd Boot Device			
4th Boot Device			
5th Boot Device			
6th Boot Device			
7th Boot Device			
8th Boot Device			

Tabelle 188: Boot - Boot Device Priority Einstellmöglichkeiten

1.5.2 Boot Configuration

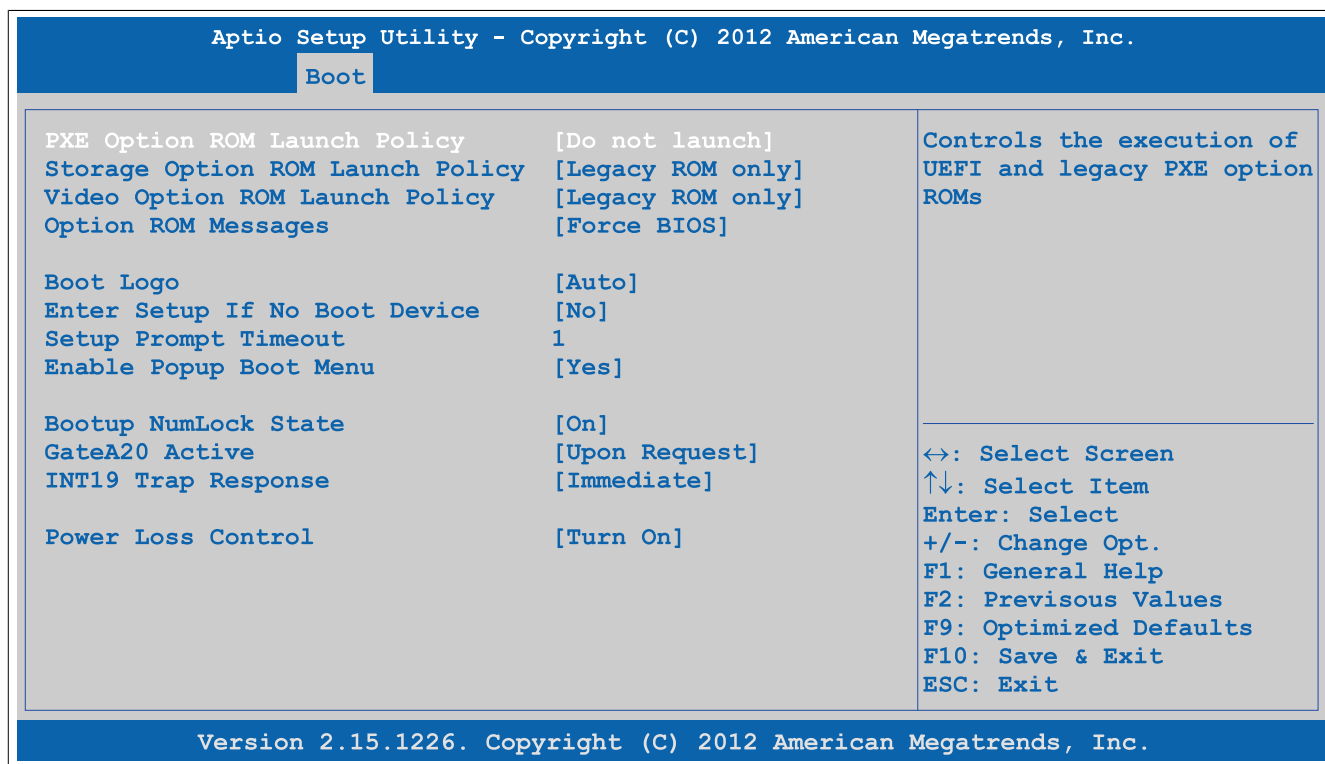


Abbildung 156: Boot - Boot Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PXE Option ROM Launch Policy	Option zum Booten vom PXE Option ROM.	Do not launch	Es wird nicht vom PXE Option ROM gebootet.
		UEFI ROM only	Es wird vom UEFI ROM gebootet.
		Legacy ROM only	Es wird vom Legacy ROM gebootet.
Storage Option ROM Launch Policy	Option zum Booten vom Storage Option ROM.	Do not launch	Es wird nicht vom Storage Option ROM gebootet.
		UEFI ROM only	Es wird vom UEFI ROM gebootet.
		Legacy ROM only	Es wird vom Legacy ROM gebootet.
Video Option ROM Launch Policy	Option zum Booten vom Video Option ROM.	Do not launch	Es wird nicht vom Video Option ROM gebootet.
		UEFI ROM only	Es wird vom UEFI ROM gebootet.
		Legacy ROM only	Es wird vom Legacy ROM gebootet.
Option ROM Messages	Option zum Anzeigen von Option ROM Meldungen während des Post-Vorgangs.	Force BIOS	Option ROM Meldungen werden während des Post-Vorgangs angezeigt
		Keep Current	Option ROM Meldungen werden während des Post-Vorgangs nicht angezeigt
Boot Logo	Option zum Einstellen des Boot Logo.	Disabled	Boot Logo wird nicht angezeigt.
		Enabled	Boot Logo wird angezeigt.
		Auto	Boot Logo wird angezeigt.
Enter Setup If No Boot Device	Option zum Einstellen, ob das Setup Menü angezeigt wird wenn kein bootfähiges Laufwerk angeschlossen ist.	No	Das Setup Menü wird nicht angezeigt.
		Yes	Das Setup Menü wird angezeigt.
Setup Prompt Timeout	Option zum Einstellen, wie lange der Setup Activation Key (Taste zum Einstieg in das BIOS) angezeigt wird.	1 bis 65534	Der Setup Activation Key wird x Sekunden angezeigt.
		65535	Der Setup Activation Key wird für unbegrenzte Zeit angezeigt.
Enable Popup Boot Menu	Option zum Aktivieren / Deaktivieren des Popup Boot Menü.	Yes	Aktivierung der Funktion. Bei drücken von "F11" während des POST kann ein Bootmedium ausgewählt werden.
		No	Deaktivierung der Funktion. Während des POST kann kein Bootmedium ausgewählt werden. Es wird nach der eingestellten Bootreihenfolge gebootet.
Bootup NumLock State	Option zum Einstellen der Zehnertastatur (NumLock) beim Booten des Systems.	On	Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
		Off	Vom numerischen Tastenblock sind lediglich die Cursorfunktionen aktiviert.
GateA20 Active	Legt die Art fest, mit der auf den Speicher oberhalb 1 MByte zugegriffen wird.	Upon Request	GA20 kann deaktiviert werden.
		Always	GA20 wird nicht deaktiviert.

Tabelle 189: Boot - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
INT19 Trap Response	Option zum Einstellen der Interrupt Trap-Reaktion bei Option ROM.	Immediate	Führt die Interrupt Trap-Reaktion sofort aus.
		Postponed	Führt die Interrupt Trap-Reaktion während des Legacy- Boot aus.
Power Loss Control	Stellt fest ob das System nach einem Leistungsabfall an/aus ist.	Remain Off	Der APC910 bleibt ausgeschaltet.
		Turn On	Schaltet den APC910 ein.
		Last State	Aktiviert den vorherigen Zustand.

Tabelle 189: Boot - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten

1.6 Security

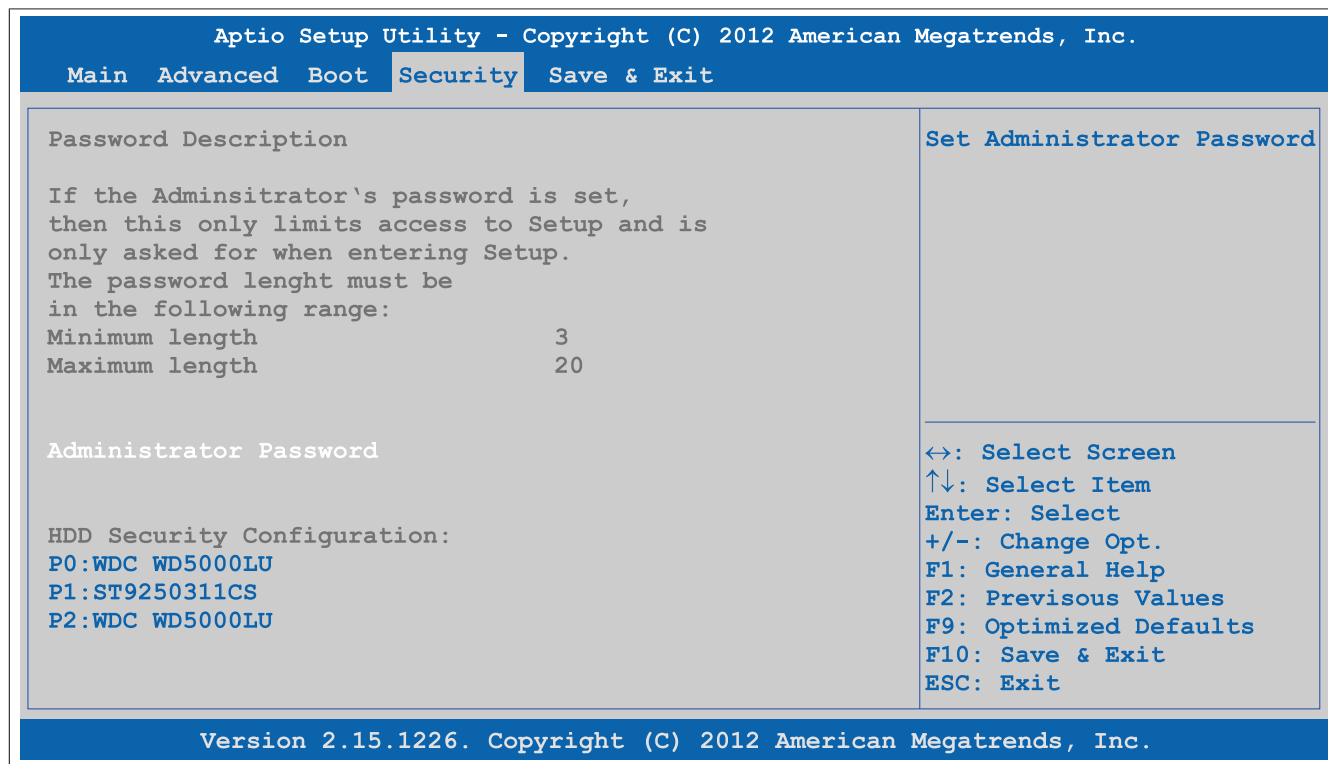


Abbildung 157: Security

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Administrator Password	Funktion zum Eingeben/Ändern eines Administrator Passwortes.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 190: Security Menü Einstellmöglichkeiten

1.6.1 HDD User Password

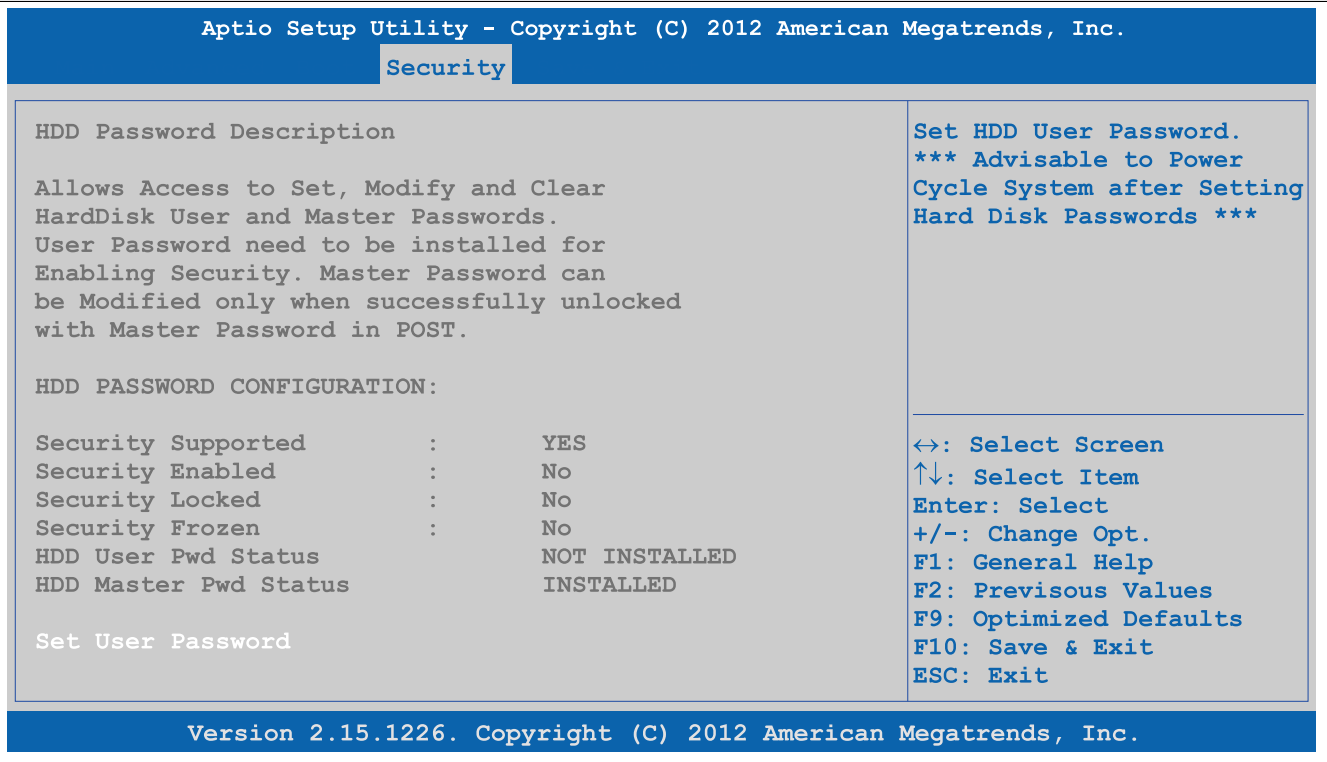


Abbildung 158: Security - HDD User Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
User Password	Funktion zum Eingeben/Ändern eines User Passwortes.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 191: Security - HDD User Password Einstellmöglichkeiten

1.7 Save & Exit

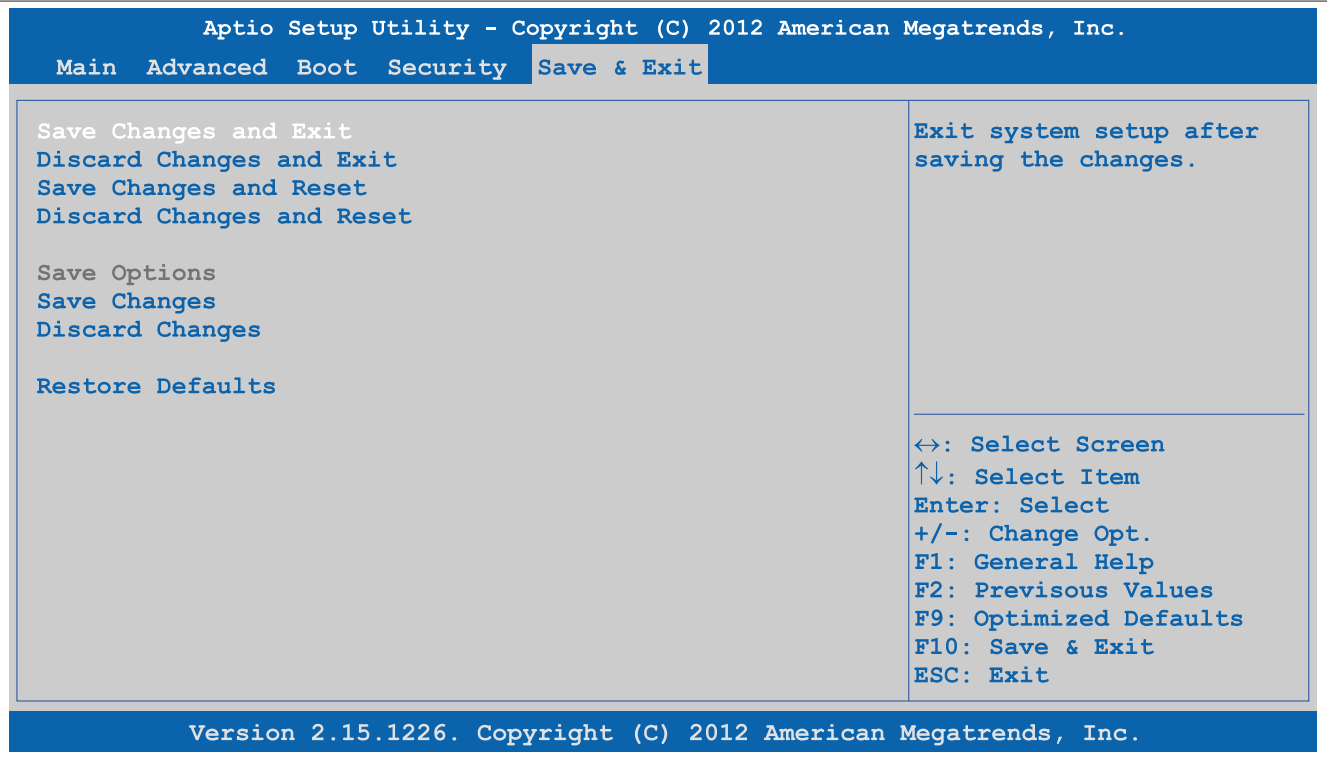


Abbildung 159: Save & Exit

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Save Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Bestätigung im CMOS gespeichert.	Yes / No	
Discard Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern.	Yes / No	
Save Changes and Reset	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Bestätigung im CMOS gespeichert und das System wird rebootet.	Yes / No	
Discard Changes and Reset	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Das System wird zusätzlich rebootet.	Yes / No	
Save Changes	Vorgenommene Änderungen werden nach Bestätigung im CMOS gespeichert.	Yes / No	
Discard Changes	Wurden Einstellungen vorgenommen und man weiß nicht mehr welche, so können diese (sofern sie nicht schon gespeichert wurden) wieder zurückgesetzt werden.	Yes / No	
Restore Defaults	Bei diesem Punkt werden die BIOS Defaultwerte wieder hergestellt.	Yes / No	

Tabelle 192: Save & Exit Menü Einstellmöglichkeiten

1.8 BIOS Defaulteinstellungen

Je nach Konfiguration des Gesamtgeräts können sich die BIOS Defaulteinstellungen unterscheiden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausführen der Funktion „Restore Defaults“ im BIOS Setup Hauptmenü „Save & Exit“ oder beim Drücken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten für diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

1.8.1 Advanced

1.8.1.1 Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Primary Display	Auto	
Internal Graphics	Auto	
IGFX VBIOS Version	-	
GTT Size	2MB	
Aperture Size	256M	
DVMT Pre-Allocated	64M	
DVMT Total Gfx Mem	256M	
Gfx Low Power Mode	Disabled	
Graphics Performance Analyzers	Disabled	
Primary IGFX Boot Display	LFP	
Secondary IGFX Boot Display	CRT	
Active LFP Configuration	Integrated LVDS	
Always Try Auto Panel Detect	No	
Local Flat Panel Type	Auto	
Display Port B Interface	Disabled	
Display Port C Interface	Disabled	
Display Port D Interface	HDMI/DVI	
Display Mode Persistence	Disabled	

Tabelle 193: Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.2 OEM Features

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Main BIOS Version	-	
OEM BIOS Version	-	
MTCX	-	
ETH2 MAC Address	-	
Realtime Environment	Disabled	

Tabelle 194: Advanced - OEM Features Profileinstellungsübersicht

1.8.1.2.1 Super I/O Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Serial Port A	Enabled	
Device Settings	-	
Serial Port B	Enabled	
Device Settings	-	
Serial Port C	Enabled	
Device Settings	-	
Serial Port D	Disabled	
Device Settings	-	
Serial Port E	Enabled	
Device Settings	-	
Serial Port F	Enabled	
Device Settings	-	

Tabelle 195: Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.3 PCI Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Above 4G Decoding	Disabled	
PCI Latency Timer	32 PCI Bus Cycles	
VGA Palette Snoop	Disabled	
PERR# Generation	Disabled	
SERR# Generation	Disabled	

Tabelle 196: Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
PIRQ Routing & IRQ Reservation		
PIRQA	Auto	
PIRQB	Auto	
PIRQC	Auto	
PIRQD	Auto	
PIRQE	Auto	
PIRQF	Auto	
PIRQG	Auto	
PIRQH	Auto	
Reserve Legacy Interrupt 1	None	
Reserve Legacy Interrupt 2	None	

Tabelle 196: Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.4 PCI Express Configuration

1.8.1.4.1 PCI Express Settings

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Relaxed Ordering	Disabled	
Extended Tag	Disabled	
No Snoop	Enabled	
Maximum Payload	Auto	
Maximum Read Request	Auto	
ASPM	Disabled	
Extended Synch	Disabled	
Link Training Retry	5	
Link Training Timeout (µS)	100	
Unpopulated Links	Keep Link On	

Tabelle 197: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Settings Profileinstellungsübersicht

1.8.1.4.2 PCI Express GEN 2 Settings

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Completion Timeout	Default	
ARI Forwarding	Disabled	
AtomicOp Requester Enable	Disabled	
AtomicOp Egress Blocking	Disabled	
IDO Request Enable	Disabled	
IDO Completion Enable	Disabled	
LTR Mechanism Enable	Disabled	
End-End TLP Prefix Blocking	Disabled	
Target Link Speed	Auto	
Clock Power Management	Disabled	
Compliance SOS	Disabled	
Hardware Autonomous Width	Enabled	
Hardware Autonomous Speed	Enabled	

Tabelle 198: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings Profileinstellungsübersicht

1.8.1.4.3 PCI Express Graphics (PEG) Port

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
PCI Express Graphics (PEG) Port	Disabled	

Tabelle 199: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Graphics (PEG) Port Profileinstellungsübersicht

1.8.1.4.4 PCI Express Root Port

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
PCI Express Root Port x	Enabled	
ASPM	Auto	
URR	Disabled	
FER	Disabled	
NFER	Disabled	
CER	Disabled	
CT0	Disabled	
SEFE	Disabled	
SENFE	Disabled	
SECE	Disabled	
PME SCI	Enabled	

Tabelle 200: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Always Enable Port	Disabled	
PCIe Speed	Auto	
Assign INT to Root Port	Enabled	
Extra Bus Reserved	0	
Reserved Memory	10	
Prefetchable Memory	10	
Reserved I/O	4	

Tabelle 200: Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port Profileinstellungsübersicht

1.8.1.5 ACPI Settings

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Enable Hibernation	Enabled	
ACPI Sleep State	Both S1 and S3 available for OS to choose from	
Lock Legacy Resources	Disabled	
S3 Video Repost	Disabled	
Critical Trip Point	111 C	

Tabelle 201: Advanced - ACPI Settings Profileinstellungsübersicht

1.8.1.6 RTC Wake Settings

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Wake System At Fixed Time	Disabled	

Tabelle 202: Advanced - RTC Wake Settings Profileinstellungsübersicht

1.8.1.7 CPU Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Hyper-threading	Enabled	
Active Processor Cores	All	
Limit CPUID Maximum	Disabled	
Execute Disable Bit	Enabled	
Intel Virtualization Technology	Disabled	
Hardware Prefetcher	Enabled	
Adjacent Cache Line Prefetch	Enabled	
TCC Activation Offset	0	
Primary Plane Current Value	0	
Secondary Plane Current Value	0	
EIST	Enabled	
Turbo Mode	Enabled	
CPU C3 Report	Disabled	
CPU C6 Report	Disabled	
CPU C7 Report	Disabled	
Configurable TDP	TDP NOMINAL	
Config TDP LOCK	Disabled	
Long duration power limit	0	
Long duration maintained	1	
Short duration power limit	0	
ACPI T State	Disabled	

Tabelle 203: Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.8 Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
PCH LAN Controller	Enabled	
Wake on LAN	Enabled	
Azalia	Auto	
Azalia PME	Disabled	
Azalia Internal HDMI Codec	Disabled	
High Precision Timer	Enabled	
CF9h Global Reset	Host only	
PCI Express Clock Gating	Disabled	
DMI Link ASPM PCH Side	Disabled	
PCIe-USB Glitch W/A	Disabled	
SB CRID	Disabled	
NB CRID	Disabled	

Tabelle 204: Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
DMI	-	
DMI Vc1 Control	Enabled	
DMI Vcp Control	Enabled	
DMI Vcm Control	Enabled	
DMI Link ASPM CPU Side	Disabled	
DMI Extended Synch Control	Disabled	
DMI Gen 2	Auto	

Tabelle 204: Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.9 SATA Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
SATA Controller(s)	Enabled	
SATA Mode Selection	AHCI	
SATA Test Mode	Disabled	
Aggressive LPM Support	Disabled	
SATA Controller Speed	Gen3	
Alternate ID	Disabled	
Serial ATA Port 0	-	
Port 0	Enabled	
Hot Plug	Disabled	
External SATA	Disabled	
SATA Device Type	Hard Disk Driver	
Spin Up Device	Disabled	
Serial ATA Port 1	-	
Port 1	Enabled	
Hot Plug	Disabled	
External SATA	Disabled	
SATA Device Type	Hard Disk Driver	
Spin Up Device	Disabled	
Serial ATA Port 2	-	
Port 2	Enabled	
Hot Plug	Disabled	
External SATA	Disabled	
Spin Up Device	Disabled	
Serial ATA Port 3	-	
Port 3	Enabled	
Hot Plug	Disabled	
External SATA	Disabled	
Spin Up Device	Disabled	

Tabelle 205: Advanced - SATA Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.10 Memory Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
DIMM profile	Default DIMM profile	
No Fan Memory Frequency Limiter	Enabled	
ECC Support	Disabled	
Max TOLUD	Dynamic	
NMode Support	Auto	
Memory Scrambler	Enabled	
Memory RefreshRate	Disabled	
MRC Fast Boot	Enabled	
Force Cold Reset	Enabled	
DIMM Exit Mode	Fast Exit	
Power Down Mode	PPD	
Scrambler Seed Generation Off	Disabled	
Memory Remap	Enabled	
Memory Alias Check	Disabled	
Channel A DIMM Control	Enable Both DIMMS	
Channel B DIMM Control	Enable Both DIMMS	

Tabelle 206: Advanced - Memory Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.11 USB Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
EHCI1 (Ports 0-5)	Enabled	
EHC2 (Ports 6-7)	Enabled	
xHCI Mode	Auto	
HS Port #1 Switchable	Enabled	
HS Port #2 Switchable	Enabled	
HS Port #3 Switchable	Enabled	
HS Port #4 Switchable	Enabled	
Legacy USB Support	Enabled	
USB3.0 Support	Enabled	
XHCI Hand-off	Enabled	
EHCI Hand-off	Disabled	
USB Mass Storage Driver Support	Enabled	
Device reset time-out	20 sec	
USB transfer time-out	20 sec	
Device power-up delay	Auto	
Overcurrent Protection	Disabled	
Per Port USB Disable Control		
USB Port #0	Enabled	
USB Port #1	Enabled	
USB Port #2	Enabled	
USB Port #3	Enabled	
USB Port #4	Enabled	
USB Port #5	Enabled	
USB Port #6	Enabled	
USB Port #7	Enabled	
Per Port Legacy USB Support Control		
USB0 Port Legacy Support	Enabled	
USB1 Port Legacy Support	Enabled	
USB2 Port Legacy Support	Enabled	
USB3 Port Legacy Support	Enabled	
USB4 Port Legacy Support	Enabled	
USB5 Port Legacy Support	Enabled	
USB6 Port Legacy Support	Enabled	
USB7 Port Legacy Support	Enabled	

Tabelle 207: Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht

1.8.1.12 Serial Port Console Redirection

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Console Redirection	Disabled	

Tabelle 208: Advanced - Serial Port Console Redirection Profileinstellungsübersicht

1.8.2 Boot

1.8.2.1 Boot Device Priority

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Boot Priority Selection	Type Based	
1st Boot Device	SATA 0 Drive	
2nd Boot Device	SATA 1 Drive	
3rd Boot Device	SATA 2 Drive	
4th Boot Device	SATA 3 Drive	
5th Boot Device	USB Harddisk	
6th Boot Device	USB CDROM	
7th Boot Device	Onboard LAN	
8th Boot Device	Other BEV Device	

Tabelle 209: Boot - Boot Device Priority Profileinstellungsübersicht

1.8.2.2 Boot Configuration

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
PXE Option ROM Launch Policy	Do not launch	
Storage Option ROM Launch Policy	Legacy ROM only	
Video Option ROM Launch Policy	Legacy ROM only	
Option ROM Messages	Force BIOS	

Tabelle 210: Boot - Boot Configuration Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Defaultprofil	Meine Einstellung
Boot Logo	Auto	
Enter Setup If No Boot Device	No	
Setup Prompt Timeout	1	
Enable Popup Boot Menu	Yes	
Bootup NumLock State	On	
GateA20 Active	Upon Request	
INT19 Trap Response	Immediate	
Power Loss Control	Turn On	

Tabelle 210: Boot - Boot Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9 Ressourcenaufteilung

1.9.1 RAM-Adressbelegung

RAM Adresse	Adresse in Hex	Ressource
(TOM - xxxx) – (TOM ¹⁾)	N.A.	ACPI reclaim, PCI memory range, Video
1024kB – (TOM - xxxx)	100000 - N.A.	Extended memory
869kB – 1024kB	0E0000h - 0FFFFFFh	Runtime BIOS
768kB – 896kB	0C0000h - 0DFFFFh	Expansion Area
640kB – 768kB	0A0000h - 0BFFFFh	Video memory and BIOS
639 kB – 640 kB	09FC00h - 09FFFFh	Extended BIOS data
0 – 639 kB	000000h - 09FC00h	Conventional memory

Tabelle 211: RAM-Adressbelegung

1) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM

1.9.2 I/O-Adressbelegung

I/O Adresse	Ressource
0000h - 00FFh	Motherboard Ressourcen
0170h - 0177h	Secondary IDE Kanal
01F0h - 01F7h	Primary IDE Kanal
0228h - 022Fh	COMF (I/O Board 2)
02E8h - 02EFh	COME (I/O Board 1)
02F8h - 02FFh	COMB (COM2)
0376h - 0376h	Secondary IDE Kanal Kommando Port
0377h - 0377h	Secondary IDE Kanal Status Port
0384h - 0385h	CAN Controller
03B0h - 03DFh	Video System
03E8h - 03EFh	COMC (SDL onboard)
03F6h - 03F6h	Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h	Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh	COMA (COM1)
0400h - 047Fh	Motherboard Ressourcen
0500h - 057Fh	Motherboard Ressourcen
0CF8h - 0CFBh	PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh	PCI Config Data Register
0D00h - FFFFh	PCI / PCI Express Bus
4100h - 417Fh	MTCX
FF00h - FF07h	IDE Bus Master Register

Tabelle 212: I/O-Adressbelegung

1.9.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NONE
Systemtimer	•																
Tastatur		•															
IRQ Kaskade			•														
COMA (COM1)				○	•	○	○	○			○	○	○				
COMB (COM2)				•	○	○	○	○									
ACPI ¹⁾										•							
Echtzeituhr									•								
Coprozessor (FPU)														•			
Primär IDE Kanal															•		
Secondary IDE Kanal																•	
B&R	COMC (SDL onboard)			○	○	○	○	○			○	•	○				
	COME (IF Option 1 / I/O Board 1)			○	○	○	○	○			•	○	○				
	COMF (IF Option 2 / I/O Board 2)			○	○	○	○	•			○	○	○				
	CAN			○	○	○	○	○			•	○	○				

Tabelle 213: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.

- ... Standardeinstellung
- ... mögliche Einstellung

1.9.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (**A**dvanced **P**rogrammable Interrupt **C**ontroller) Mode stehen insgesamt 23 IRQs zur Verfügung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Windows Betriebssystems aktiviert wird.

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	NONE
Systemtimer	•																								
Tastatur		•																							
IRQ Kaskade			•																						
COMA (COM1)				○	•	○	○	○			○	○	○												
COMB (COM2)				•	○	○	○	○																	
ACPI ¹⁾									•																
Echtzeituhr									•																
Coprozessor (FPU)														•											
Primary IDE Kanal															•										
Secondary IDE Kanal																•									
B&R	COMC (SDL onboard)			○	○	○	○	○			○	•	○												
	COME (IF Option 1 / I/O Board 1)			○	○	○	○	○			•	○	○												
	COMF (IF Option 2 / I/O Board 2)			○	○	○	○	•			○	○	○												
	CAN			○	○	○	○	○			•	○	○												
PIRQ A ²⁾																•									
PIRQ B ³⁾																	•								
PIRQ C ⁴⁾																		•							
PIRQ D ⁵⁾																			•						
PIRQ E ⁶⁾																				•					
PIRQ F ⁷⁾																					•				
PIRQ G ⁸⁾																						•			
PIRQ H ⁹⁾																							•		

Tabelle 214: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

- 1) **A**dvanced **C**onfiguration and **P**ower Interface.
- 2) PIRQ A: für PCIe; PEG 0/1/2, PCI Express Root Port 0, VGA Controller, PCI Express Root Port 4 (ETH2)
- 3) PIRQ B: für PCIe; PCI Express Root Port 1, PCI Express Root Port 5
- 4) PIRQ C: für PCIe; PCI Express Root Port 2, SRAM
- 5) PIRQ D: für PCIe; PCI Express Root Port 3, PCIe to PCI Bridge
- 6) PIRQ E: für PCIe; onboard Gigabit LAN Controller (ETH1)
- 7) PIRQ F: für PCIe; EHCI Host Controller 2, Serial ATA Controller 1, Serial ATA Controller 2
- 8) PIRQ G: für PCIe; Intel High Definition Audio Controller, SMBus Controller
- 9) PIRQ H: für PCIe; EHCI Host Controller 1, XHCI Host Controller

- ... Standardeinstellung
- ... mögliche Einstellung

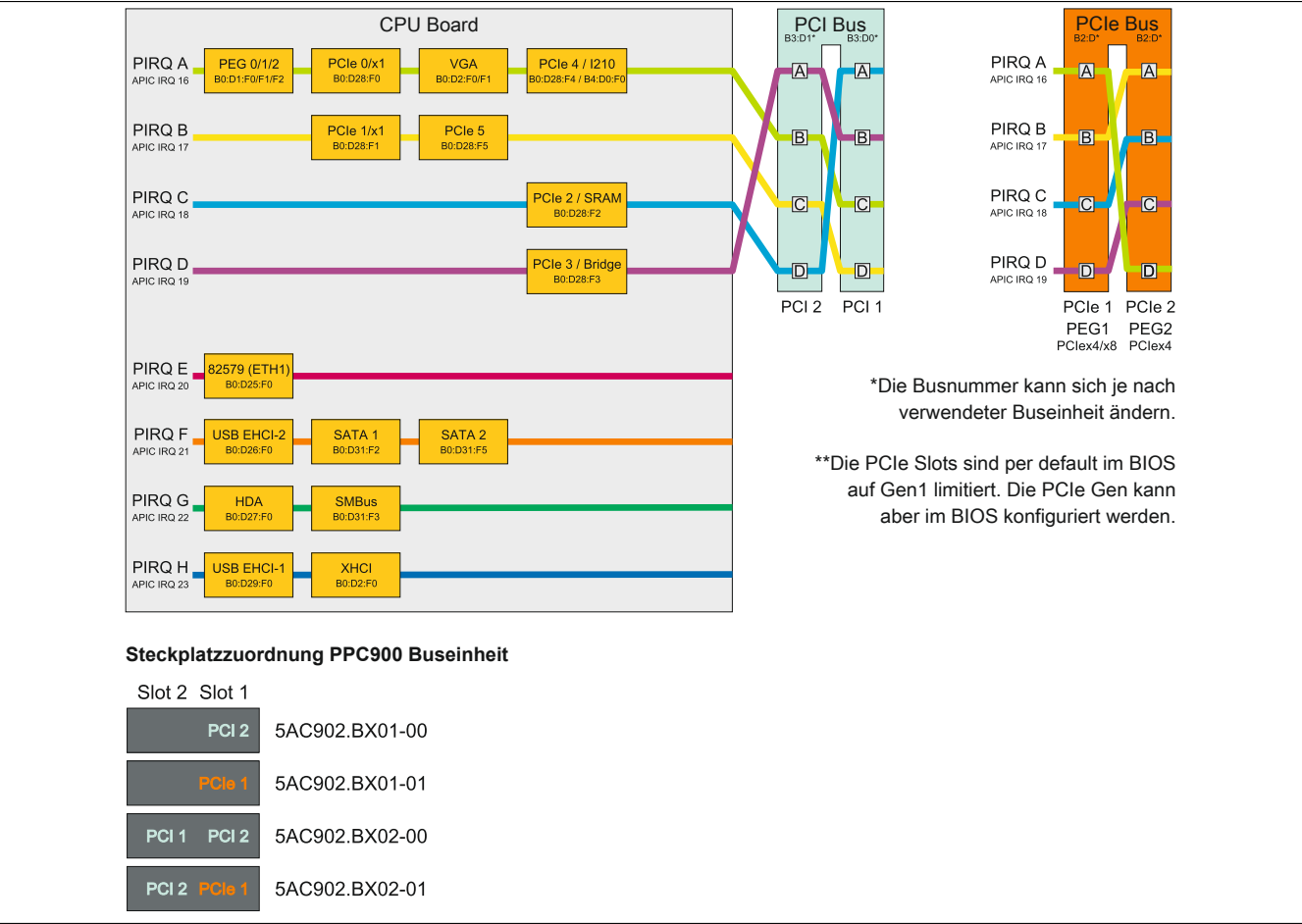


Abbildung 160: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board QM77/HM76

2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geräten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue Versionen können von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

- Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder Komponenten hinzuzufügen (Informationen über Änderungen können der Liesmich bzw. der Readme Datei des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen gelöscht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.

2.1.1.1 Welche BIOS Version und Firmware ist bereits installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des PPC900 gelangt man mit „Entf“ ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü „Advanced“ den Unterpunkt „OEM Features“ auswählen.

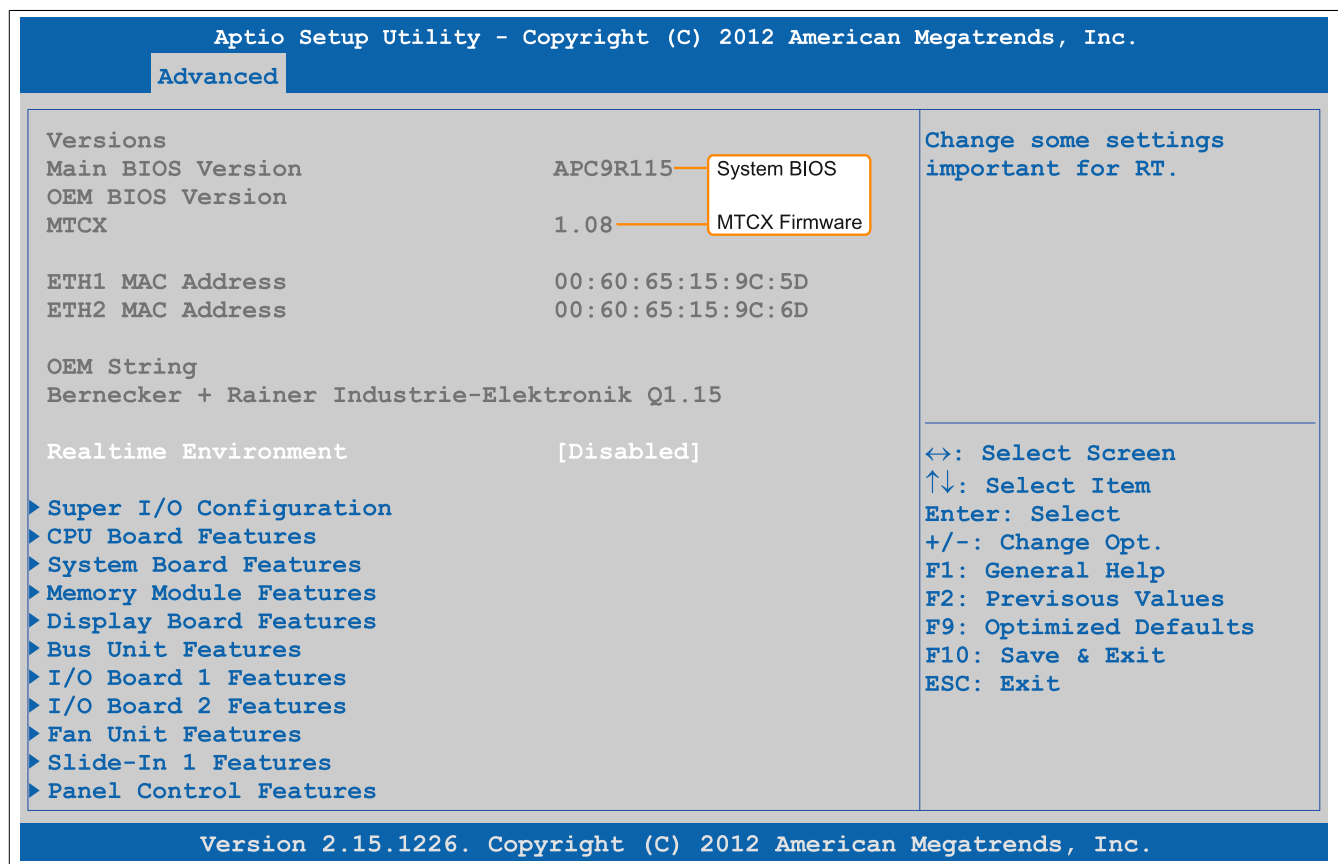


Abbildung 161: Softwareversion

2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile „sys a:“ oder „format a: /s“ bootfähig gemacht werden.

Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 236.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 238.

Informationen zum Erstellen eines Massenspeichers für ein B&R Upgrade siehe Seite 239.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

```
1. Upgrade AMI BIOS for APC910/PPC900 (QM77 bzw. HM76)
2. Exit
```

zu Punkt 1:

Es wird das BIOS automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2:

Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wird automatisch der Punkt 1 ausgeführt und der Industrie PC selbstständig aktualisiert.

6. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
7. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" auswählen.

2.2 Firmwareupgrade

Mit dem „Firmware Upgrade (MTCX, AP830)“ ist es möglich, je nach Ausführung des PPC900 Systems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, AP830) zu aktualisieren.

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt über den Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. In der Systemsteuerung das **Control Center** öffnen.
3. Die Registerkarte **Versionen** öffnen.
4. Unter Systemeinheit bei **MTCX** auf **Update** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.
5. Unter **Dateiname** den Namen der Firmwaredatei eingeben oder eine Datei auswählen.
6. Auf **Öffnen** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. **Abbrechen** ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

Warnung!

Während der Übertragung der Firmware dürfen keine Paneltasten gedrückt werden! Dies kann den Vorgang stören.

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann abhängig vom verwendeten Speicherbaustein mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Die Stromversorgung des PC muss aus- und wieder einschaltet werden, damit die neue Firmware wirksam und die aktualisierte Version angezeigt wird. Beim Beenden des Control Centers wird eine Aufforderung dazu angezeigt.

Information:

Genauere Informationen zum Sichern und Updaten der Firmware ist der Control Center Hilfe zu entnehmen.

2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

1. Eine leere 1,44MB HD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
2. Windows Explorer öffnen
3. Mit der rechten Maustaste auf das 3½-Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt „Formatieren...“ auswählen.

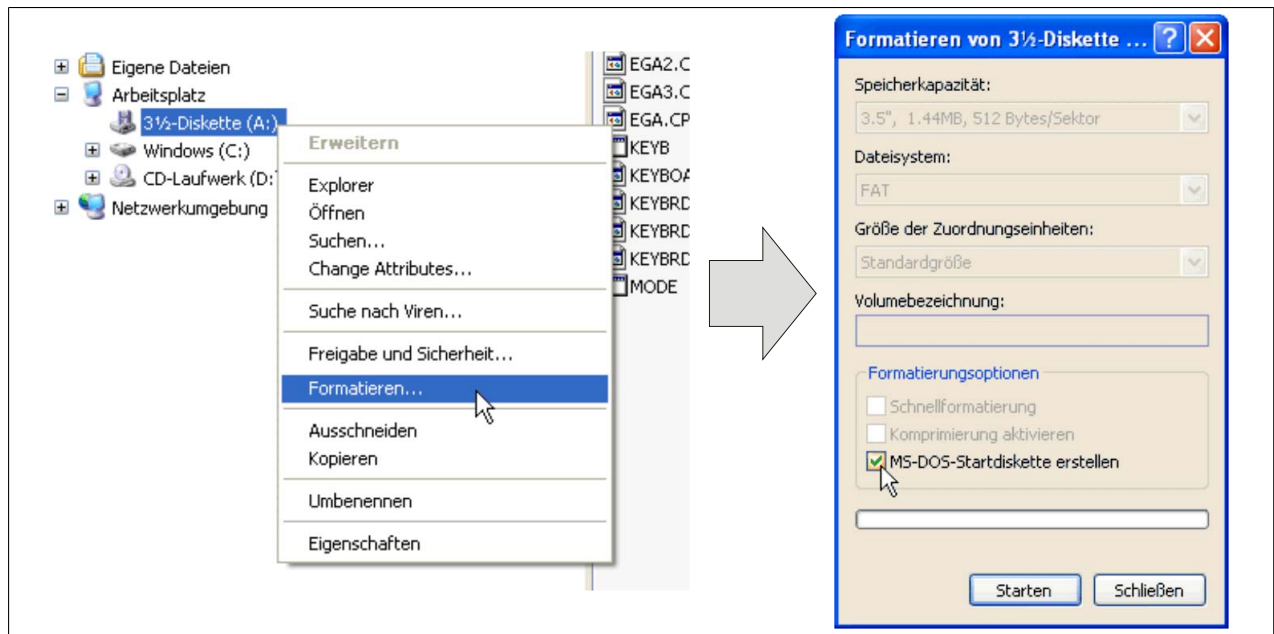


Abbildung 162: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

4. Danach die Checkbox „**MS-DOS-Startdiskette erstellen**“ anhaken, „**Starten**“ drücken und die nachfolgende Warnmeldung mit „OK“ bestätigen.



Abbildung 163: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2



Abbildung 164: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette müssen nun nachträglich einige Dateien dieser Diskette gelöscht werden, da dies wegen der Größe der Updates erforderlich ist.

Dazu müssen alle Dateien (versteckte Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

Im Explorer- Menüpunkt „Extras“ die Option „Ordneroptionen...“, Registerkarte „Ansicht“, Punkt „Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)“ (ist standardmäßig aktiviert) nun deaktivieren und den Punkt „Alle Dateien und Ordner anzeigen“ aktivieren.

Vorher				Nachher			
Name	Größe	Typ	Geändert am	Name	Größe	Typ	Geändert am
DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	AUTOEXEC	1 KB	Stapelverarbeitungsdatei f...	04.10.2004 15:14
EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00	COMMAND	91 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00	CONFIG	1 KB	Systemdatei	04.10.2004 15:14
EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00	DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00	EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	IO	114 KB	Systemdatei	15.05.2001 18:57
KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00	KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
				MSDOS	1 KB	Systemdatei	07.04.2001 13:40

Abbildung 165: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4

Name	Größe	Typ	Geändert am
AUTOEXEC	1 KB	Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS	04.10.2004 15:14
COMMAND	91 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
CONFIG	1 KB	Systemdatei	04.10.2004 15:14
DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
IO	114 KB	Systemdatei	15.05.2001 18:57
KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
MSDOS	1 KB	Systemdatei	07.04.2001 13:40

Abbildung 166: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5

Es können nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, IO.sys und MSDOS.sys gelöscht werden.

2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen USB Memory Sticks ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss der USB Memory Stick speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benötigt

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen eines bootfähigen USB Memory Sticks benötigt:

- B&R USB Memory Stick
- B&R Industrie PC
- USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

1. Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.
2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl **Laufwerke > Aktualisieren** aktualisiert werden.
3. Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.
4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf einen USB-Memorystick installieren** auswählen.
5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche **Aus einer ZIP-Datei...** klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche **Aus einem Verzeichnis...** klicken.
6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktion starten** klicken.

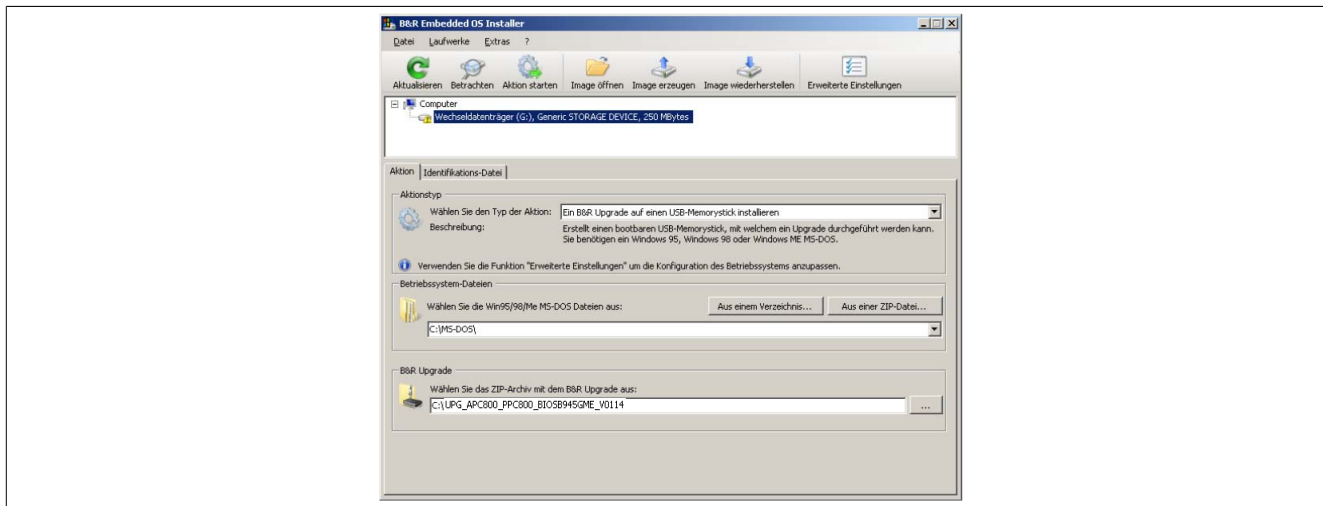


Abbildung 167: Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files

2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 236 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.5 So erstellen Sie einen bootfähigen Massenspeicher für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen Massenspeichern (z.B. CFast) ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss der Massenspeicher speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benötigt

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen eines bootfähigen Massenspeichers benötigt:

- B&R Massenspeicher (z.B. CFast)
- PC mit CFast Slot
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.5.2 Vorgangsweise

1. Verbinden des Massenspeichers mit dem PC.
2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl **Laufwerke > Aktualisieren** aktualisiert werden.
3. Markieren des Massenspeichers in der Laufwerksliste.
4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf einen Massenspeicher installieren** auswählen.
5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche **Aus einer ZIP-Datei...** klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche **Aus einem Verzeichnis...** klicken.
6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktion starten** klicken.

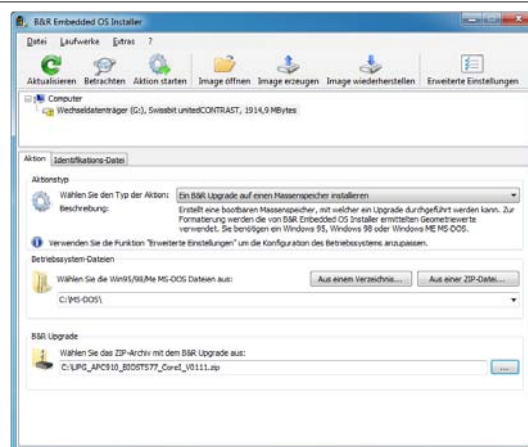


Abbildung 168: Erstellung eines Massenspeichers für B&R Upgrade Files

2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 236 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

3 Windows 7

3.1 Allgemeines

Windows® 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Die 64 Bit Varianten nutzen die aktuelle PC Infrastruktur voll aus. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederherstellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geräten sind nur einige der Vorteile, die Windows® 7 bietet. In der Professional Ausführung steht Windows® 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Englisch zur Verfügung, während Windows® 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen (ab Service Pack 1 bis zu 36 Sprachen) unterstützt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein großer Vorteil für einfache logistische Abläufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows® Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies bedeutet eine gegenüber dem Consumermarkt erheblich längere Verfügbarkeit.

3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows 7 Professional/Ultimate	
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 215: 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten

3.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1200-GER	Professional	APC810 APC910 PPC800 PPC900	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Deutsch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.1200-ENG	Professional	APC810 APC910 PPC800 PPC900	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte

Tabelle 216: Windows 7 - Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 PPC800 PPC900	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	20 GByte ¹⁾	2 GByte

Tabelle 216: Windows 7 - Übersicht

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

3.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows 7 Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

3.5 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.6 Eigenheiten, Einschränkungen

- In Windows 7 ist kein Beep.sys mehr enthalten, somit ist auch z.B. bei einem Tastendruck kein akustisches Signal mehr hörbar.
- Die Ermittlung der Windows 7 Systembewertung (Systemklassifikation) wird aktuell nicht unterstützt (dies gilt nicht für PP500, APC510, APC511, APC910 und PPC800 mit NM10 Chipsatz).

4 Windows Embedded Standard 7

4.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows® XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows® Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von B&R Industrie PCs. Windows® Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows® 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows® Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows® Embedded Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, während Windows® Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows® Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows® Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten.⁴⁾ Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.

4.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1541-ENG	Windows Embedded Standard 7 SP1 - 32-Bit - Englisch - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	
5SWWI7.1641-ENG	Windows Embedded Standard 7 SP1 - 64-Bit - Englisch - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	
5SWWI7.1741-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 32-Bit - Multilanguage - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	
5SWWI7.1841-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Multilanguage - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset - Lizenz	
	Erforderliches Zubehör	
	CFast Karten	
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte	
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte	
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	
5SWWI7.2000-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	

Tabelle 217: 5SWWI7.1541-ENG, 5SWWI7.1641-ENG, 5SWWI7.1741-MUL, 5SWWI7.1841-MUL - Bestelldaten

4.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1541-ENG	Embedded	PPC900	QM77 HM76	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1641-ENG	Embedded	PPC900	QM77 HM76	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	2 GByte
5SWWI7.1741-MUL	Premium	PPC900	QM77 HM76	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1841-MUL	Premium	PPC900	QM77 HM76	SP1	64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	2 GByte

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

4.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 7.

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	✓	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓	✓
Administrator Account	✓	✓
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar

Tabelle 218: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

⁴⁾ 64-Bit Versionen werden nicht von allen Systemen unterstützt

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Windows Explorer Shell	✓	✓
Registry Filter	✓	✓
Internet Explorer 8.0	✓	✓
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	✓
AntiMalware (Windows Defender)	-	✓
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	✓
Windows Firewall	✓	✓
.NET Framework 3.5	✓	✓
32-Bit und 64-Bit Support	✓	✓
Remote Desktop Protocol 7.0	✓	✓
File Compression Utility	✓	✓
Windows Installer Service	✓	✓
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	✓	✓
DirectX	✓	✓
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	✓
International Components and Language Services	✓	✓
Language Pack Setup	✓	✓
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	✓	✓
Bitlocker	-	✓
Applocker	-	✓
Tablet PC Support	-	✓
Windows Touch	-	✓
Boot from USB Stick	✓	✓
Accessories	✓	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 218: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

4.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 7 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (32-Bit: mind. 8 GByte; 64-Bit: mind. 16 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

Information:

Wenn der EWF verwendet werden soll, sind während des Setup oder SYSPREP alle Massenspeicher (außer dem Bootlaufwerk) aus dem System zu entfernen. Alternativ können die zusätzlichen Massenspeicher auch im BIOS deaktiviert werden.

4.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversionen installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

4.6.1 Touch Screen Treiber

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert. Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel 800/900 nachträglich angeschlossen, muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert oder in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusätzliche Touch Screen Schnittstelle ausgewählt werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein „Enhanced Write Filter (EWF)“ oder „File Based Write Filter (FBWF)“ aktiviert ist.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

5 Windows XP Professional

5.1 Allgemeines

Information:

Aufgrund der Abkündigung des Supportes für Windows XP durch Microsoft werden ab dem **08. April 2014** weder für Windows XP noch für Office 2013 Sicherheitsupdates, Hotfixes, kostenloser oder bezahlter Support sowie technische Ressourcen bereitgestellt.

5.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Professional	
5SWWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 219: 5SWWWXP.0600-ENG, 5SWWWXP.0600-GER, 5SWWWXP.0600-MUL - Bestelldaten

5.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWWXP.0600-ENG	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWWXP.0600-GER	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWWXP.0600-MUL	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Multilanguage	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte

5.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

5.5 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

6 Windows Embedded Standard 2009

6.1 Allgemeines

Windows® Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows® XP Professional. Es kommt zum Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter Betriebssystemgröße ablaufen sollen. In Kombination mit Compact-Flash Speichern ermöglicht Windows® Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebssystems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich zu bekannten Features von Windows® XP Professional ist Windows® Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter für einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows® Embedded Standard 2009 so einfach wie möglich zu gestalten bietet B&R komplette Images für Industrie PCs, Power Panel und Mobile Panel an. Neben Windows® Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem Windows® XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfügung.

Windows® Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows® XP Professional mit Service Pack 3 und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows® XP Professional mit SP3 liefert Windows® Embedded Standard 2009 in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

6.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0741-ENG	Windows Embedded Standard 2009 - Englisch - Für PPC900 mit QM77/HM76 Chipset	
	Erforderliches Zubehör	
	CFast Karten	
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte	
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte	
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte	
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte	
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte	

Tabelle 220: 5SWWXP.0741-ENG - Bestelldaten

6.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0741-ENG	PPC900	QM77 HM76	Englisch	Ja	2 GByte	256 MByte

6.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 8.0	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
OpenGL Support	✓
Local Network Bridge	✓

Tabelle 221: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

Funktion	vorhanden
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓
Media Player 6.4	✓
DirectX 9.0c	✓
Accessories	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 221: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

6.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 2009 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

6.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1 Richtlinien und Erklärungen

1.1 CE- Kennzeichnung



Alle für die gültigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden für B&R Produkte erfüllt.

1.2 EMV-Richtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 61000-6-2:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereich
EN 61000-6-4:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrundnorm Störaussendung für Industriebereich

1.3 Niederspannungsrichtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 60204-1:2006 + A1:2009	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

2 Zulassungen

Gefahr!

Ein Gesamtgerät kann nur eine Zulassung erhalten, wenn **ALLE** darin verbauten und angeschlossenen Einzelkomponenten die entsprechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwendet, welche **KEINE** entsprechende Zulassung besitzt, so enthält auch das Gesamtgerät **KEINE** Zulassung.

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

Sofern nicht anders angegeben liegen folgende Zulassungen vor:

2.1 UL Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equipment" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL508 - 17th Edition
Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 142-M1987

2.2 UL Haz. Loc. Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equipment for Use in Hazardous Locations" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard ANSI/ISA 12.12.01:2013
Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 213-M1987

Ind. Cont. Eq.
for Haz.Locs.
Cl. I, Div. 2,
Groups ABCD
2P61 (T3C)

2.3 GOST-R



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle zertifiziert und dürfen in die Russische Föderation eingeführt werden.

Kapitel 6 • Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

1 Spannungsversorgungsstecker

1.1 0TB103.9x

1.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

1.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 222: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

1.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöriteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0TB103.9		0TB103.91	
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE			Ja	
cULus			Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2			Ja ¹⁾	
GL			Ja ¹⁾	
Feldklemme				
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL			
Anzahl der Pole	3 (female)			
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme		Ausführung als Federzugklemme ³⁾	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)			
Kontaktabstand	5,08 mm			
Anschlussquerschnitt				
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14		AWG 26 bis 12	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen			0,20 bis 1,50 mm²	
eindrätig			0,20 bis 2,50 mm²	
feindrätig	0,20 bis 1,50 mm²		0,20 bis 2,50 mm²	
mit Aderendhülse			0,20 bis 1,50 mm²	
Anzugsmoment	0.4 Nm		-	

Tabelle 223: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

Produktbezeichnung	0TB103.9	0TB103.91
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung		300 V
Nennstrom ²⁾		10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand		≤5 mΩ

Tabelle 223: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
 2) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!
 3) Die Feldklemme in Federzugausführung ist nicht anreihbar.

1.2 0TB3103.8000

1.2.1 Allgemeines

Diese einreihige 3-polige Feldklemme wird als Spannungsversorgungsklemme verwendet.

1.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB3103.8000	Steckverbinder, 230 VAC, 3-polig female, Schraubklemme 4 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 224: 0TB3103.8000 - Bestelldaten

1.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	0TB3103.8000
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
Feldklemme	
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Anzahl der Pole	3 (male)
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kontaktabstand	7,62 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 24 bis 10
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 4 mm ²
flexibel	0,2 bis 4 mm ²
starr	0,2 bis 4 mm ²
Anzugsmoment	min. 0,5 Nm / max. 0,6 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	400 V
Nennstrom	20 A

Tabelle 225: 0TB3103.8000 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2 Ersatz CMOS Batterien

2.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000

2.1.1 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) benötigt.

Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazität, Status „Bad“, ausgetauscht werden.

2.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
0AC201.91	Batterien Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 226: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Allgemeines		
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30°C	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Kapazität	950 mAh	
Selbstentladung	<1% pro Jahr (bei 23°C)	
Spannungsbereich	3V	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Lagerung	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	0 bis 95%	
Lagerung	0 bis 95%	
Transport	0 bis 95%	

Tabelle 227: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

3 CFast Karten

3.1 5CFAST.xxxx-00

3.1.1 Allgemeines

Die CFast-Karten basieren auf der Single Level Cell (SLC) Technologie und sind SATA 2.6 kompatibel, die Abmessungen sind identisch mit CompactFlash Karten.

3.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CFast Karten	
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte	
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte	
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte	
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte	
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte	

Tabelle 228: 5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00, 5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Bestelldaten

3.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöriteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFAST.2048-00	5CFAST.4096-00	5CFAST.8192-00	5CFAST.016G-00	5CFAST.032G-00
Allgemeines					
Kapazität	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre				
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen				
Lifetime Monitoring	Ja				
MTBF	> 2.500.000 Stunden (bei 25°C)				
Wartung	keine				
unterstützte Betriebsmodi	SATA 2.6, max. PIO Mode 4, Multiword DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 6				
kontinuierliches Lesen					
typisch					
bei 128 kByte Blockgröße	56 MByte/s	107 MByte/s	116 MByte/s	116 MByte/s	116 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße	23 MByte/s	26 MByte/s	29 MByte/s	29 MByte/s	29 MByte/s
maximal					
bei 128 kByte Blockgröße	60 MByte/s	110 MByte/s	120 MByte/s	120 MByte/s	120 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße	25 MByte/s	30 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s
kontinuierliches Schreiben					
typisch					
bei 128 kByte Blockgröße	24 MByte/s	49 MByte/s	93 MByte/s	93 MByte/s	93 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße	17 MByte/s	19 MByte/s	21 MByte/s	21 MByte/s	21 MByte/s
maximal					
bei 128 kByte Blockgröße	30 MByte/s	55 MByte/s	100 MByte/s	100 MByte/s	100 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße	20 MByte/s	25 MByte/s	25 MByte/s	25 MByte/s	25 MByte/s
Zertifizierungen					
CE	Ja				
cULus	Ja				
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾				
GOST-R	Ja				
GL	Ja ¹⁾				
Endurance					
SLC-Flash	Ja				
Wear Leveling	statisch				
S.M.A.R.T. Support	Ja				
Unterstützung					
Hardware	APC910, PPC900				

Tabelle 229: 5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00, 5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFAST.2048-00	5CFAST.4096-00	5CFAST.8192-00	5CFAST.016G-00	5CFAST.032G-00
Betriebssysteme					
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Professional	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 2009			Ja		
Software					
PVI Transfer Tool		≥ V4.0.0.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.2.3014)			
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20	≥ V3.21
Umgebungsbedingungen					
Temperatur					
Betrieb			0 bis 70°C		
Lagerung			-50 bis 100°C		
Transport			-50 bis 100°C		
Luftfeuchtigkeit					
Betrieb			max. 85% bei 70°C		
Lagerung			max. 85% bei 70°C		
Transport			max. 85% bei 70°C		
Vibration					
Betrieb			20 g peak, 10 bis 2000 Hz		
Lagerung			20 g peak, 10 bis 2000 Hz		
Transport			20 g peak, 10 bis 2000 Hz		
Schock					
Betrieb			1,5 kg peak, 0,5 ms		
Lagerung			1,5 kg peak, 0,5 ms		
Transport			1,5 kg peak, 0,5 ms		
Meereshöhe					
Betrieb			TBD		
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen					
Breite			42,8 ±0,10 mm		
Länge			36,4 ±0,10 mm		
Tiefe			3,6 ±0,10 mm		
Gewicht			10 g		

Tabelle 229: 5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00,
5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.1.4 Abmessungen

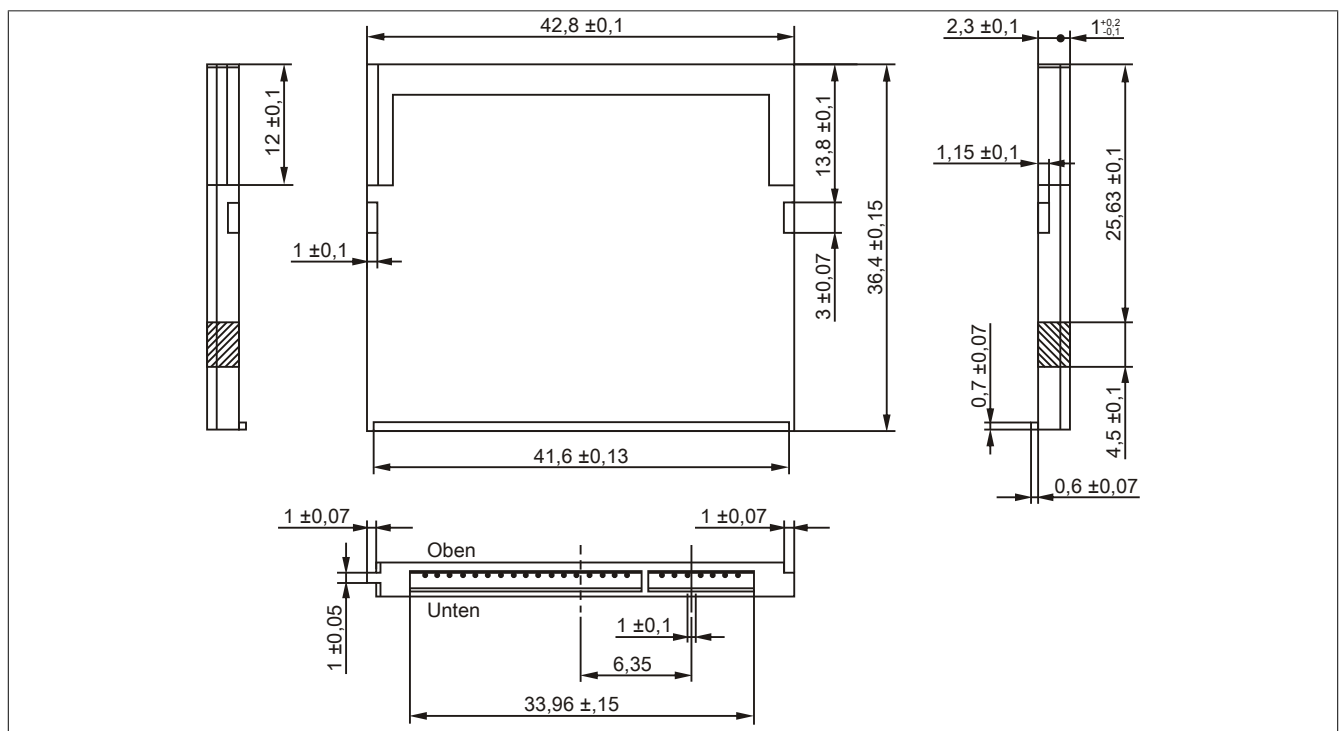


Abbildung 169: Abmessungen CFast Karte

3.1.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm

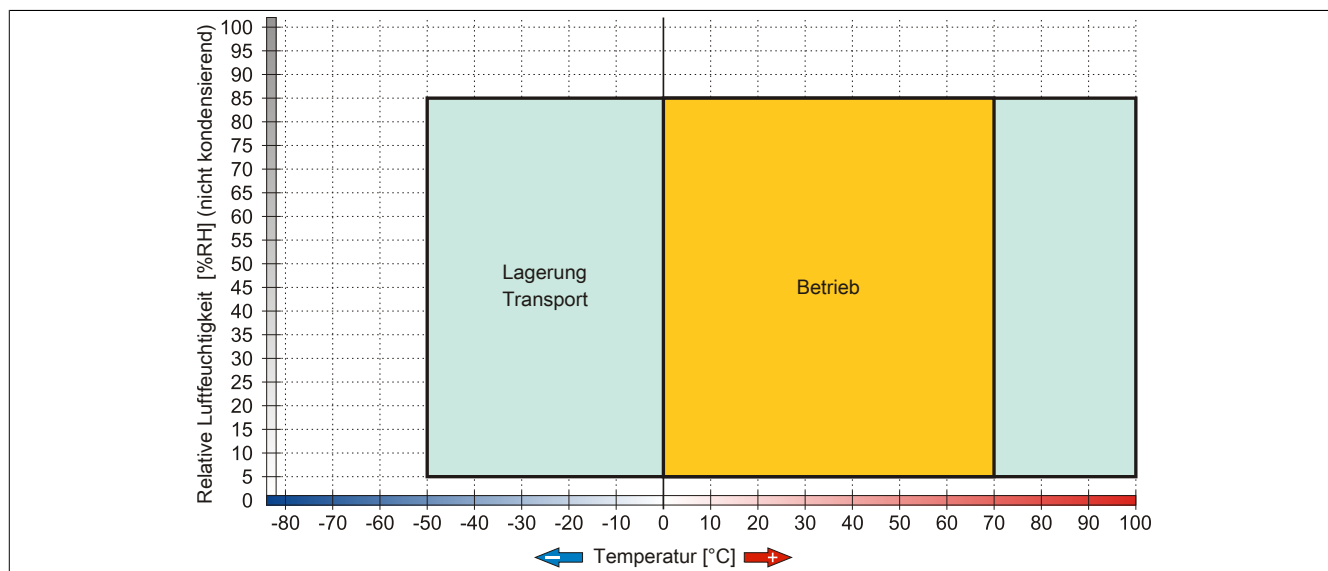


Abbildung 170: 5CFAST.xxxx-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

4 USB Memory Sticks

4.1 5MMUSB.xxxx-01

4.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Controller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein „fdisk / mbr“ auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

4.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	

Tabelle 230: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten

4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01
Allgemeines		
Kapazität	2 GByte	4 GByte
Datenerhaltung	> 10 Jahre	
LEDs	1 LED (grün) ¹⁾	
MTBF	> 3.000.000 Stunden	
Typ	USB 1.1, USB 2.0	
Wartung	keine	
Formatierung ab Werk	FAT16	FAT32
Zertifizierungen		
CE	Ja	
GOST-R	Ja	
Schnittstellen		
USB		
Typ	USB 1.1, USB 2.0	
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle	
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
sequentielles Lesen	Full Speed max. 1 MByte/s, High Speed max. 32 MByte/s	
sequentielles Schreiben	Full Speed max. 0,9 MByte/s, High Speed max. 23 MByte/s	
Unterstützung		
Betriebssysteme		
Windows 7	Ja	
Windows XP Professional	Ja	
Windows XP Embedded	Ja	
Windows ME	Ja	
Windows 2000	Ja	
Windows CE 5.0	Ja	
Windows CE 4.2	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Stromaufnahme	max. 500 µA Schlafmodus, max. 120 mA Lesen/Schreiben	

Tabelle 231: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-50 bis 100°C	
Transport	-50 bis 100°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	85%, nicht kondensierend	
Lagerung	85%, nicht kondensierend	
Transport	85%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Schock		
Betrieb	max. 1500 g (peak)	
Lagerung	max. 1500 g (peak)	
Transport	max. 1500 g (peak)	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3048 m	
Lagerung	max. 12192 m	
Transport	max. 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	17,97 mm	
Länge	67,85 mm	
Höhe	8,35 mm	

Tabelle 231: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

4.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

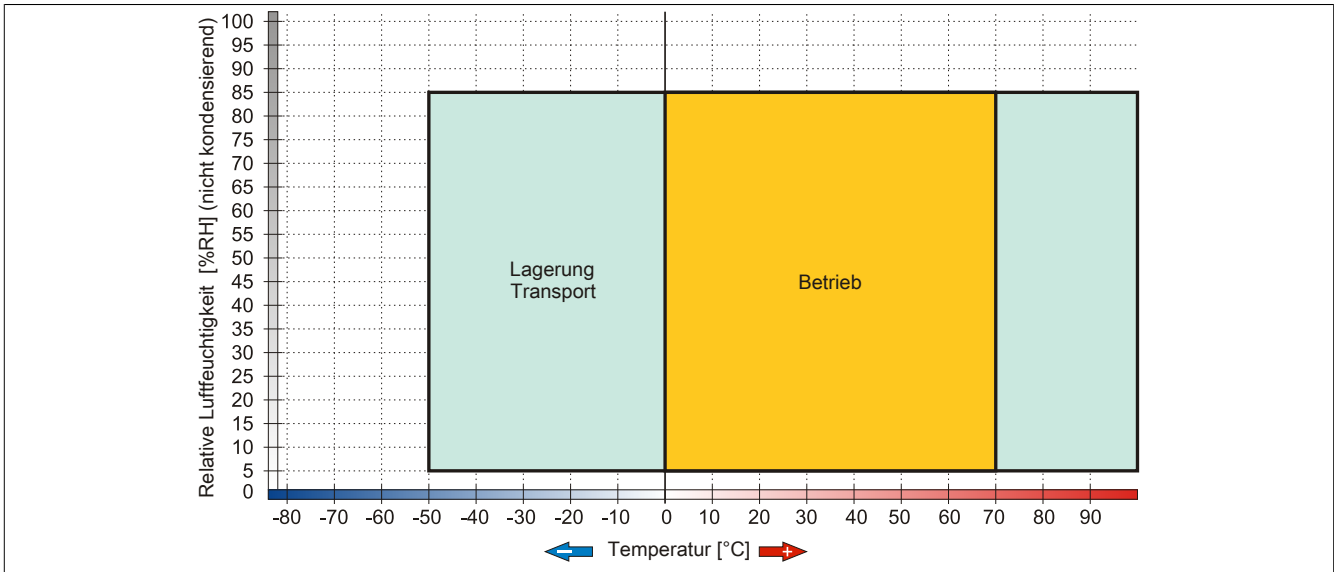


Abbildung 171: 5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

5 Kabel

5.1 DVI Kabel

5.1.1 5CADVI.0xxx-00

5.1.1.1 Allgemeines

Die DVI Kabel 5CADVI.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

5.1.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	DVI Kabel	
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	

Tabelle 232: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten

5.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CADVI.0018-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0100-00
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja ¹⁾		
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 28		
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt		
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 86%		
Außenmantel			
Material	PVC		
Farbe	beige		
Bedruckung	AWM STYLE 20276 80°C 30V VW1 DVI DIGITAL SINGLE LINK DER AN		
Steckverbindung			
Typ	2x DVI-D (18+1), male		
Steckzyklen	100		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Elektrische Eigenschaften			
Leiterwiderstand	max. 237 Ω/km		
Isolationswiderstand	min. 100 MΩ/km		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser	max. 8,5 mm		
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)		
Gewicht	ca. 260 g	ca. 460 g	ca. 790 g

Tabelle 233: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

5.1.1.4 Biegeradiusspezifikation

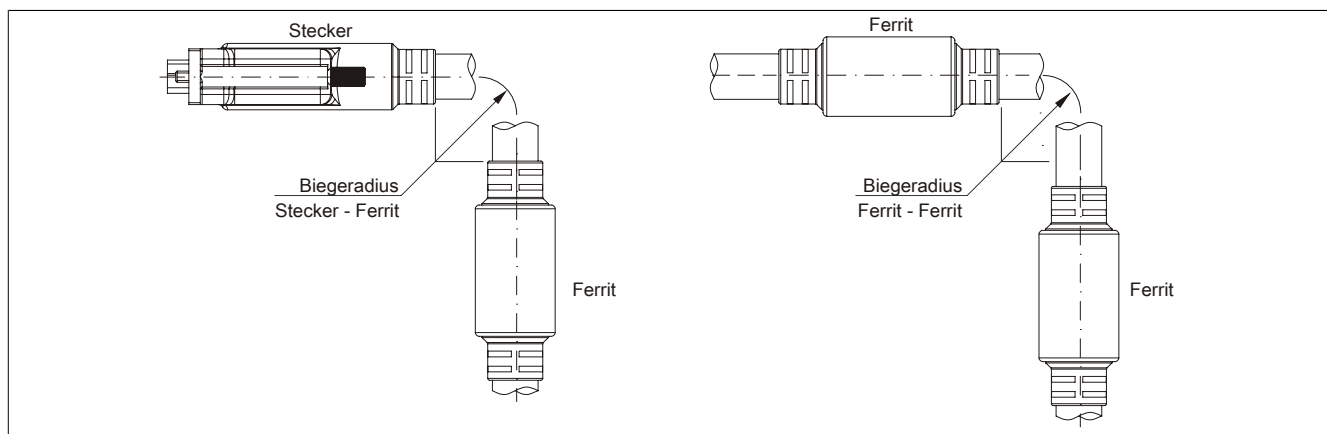


Abbildung 172: Biegeradiusspezifikation

5.1.1.5 Abmessungen

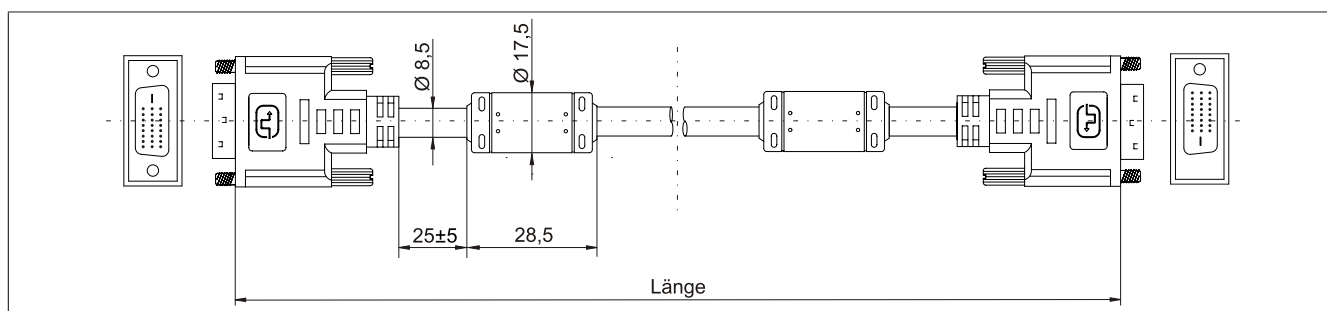


Abbildung 173: 5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen

5.1.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

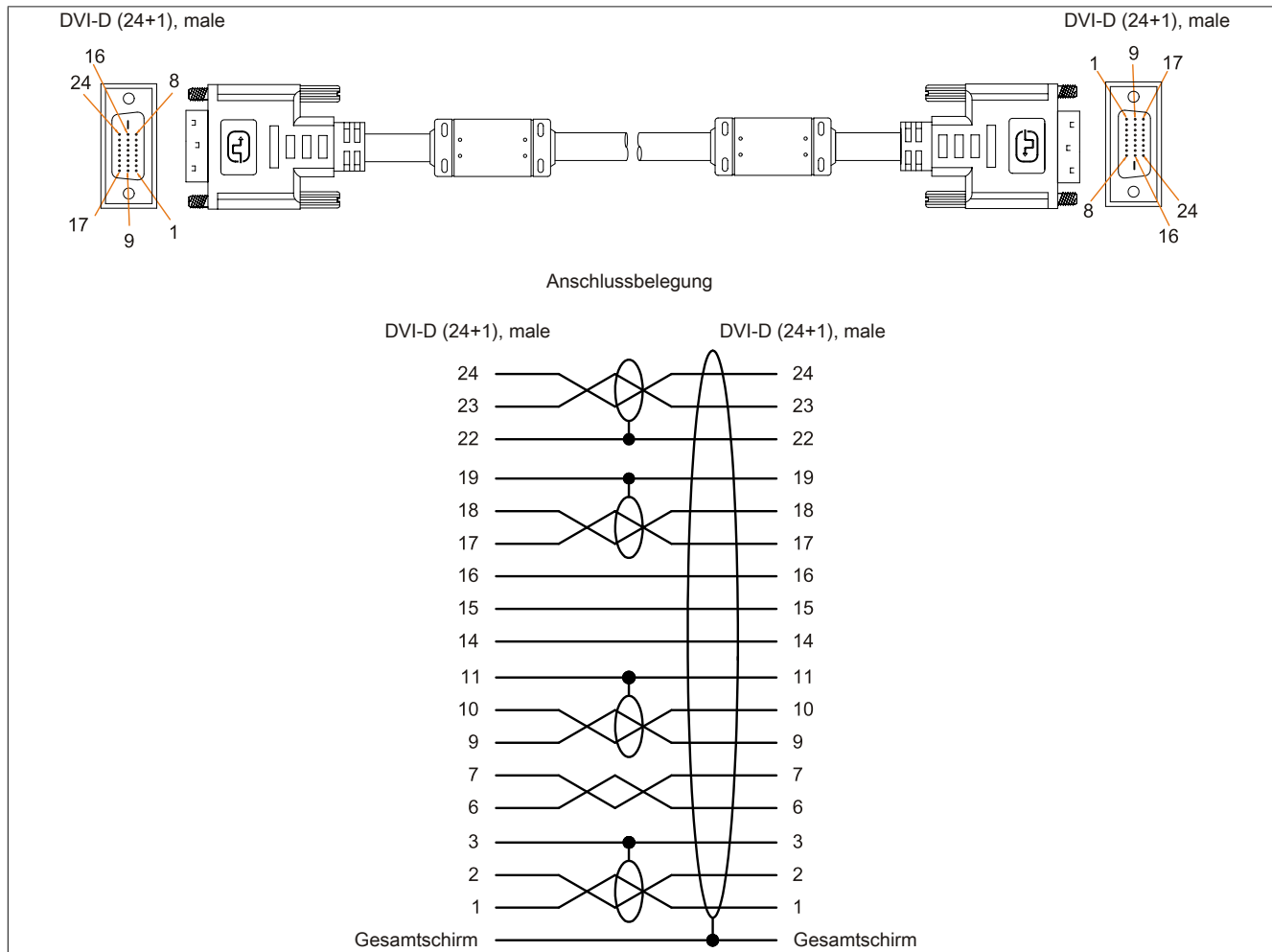


Abbildung 174: 5CADVI.0xxx-00 - Belegung

5.2 SDL Kabel

5.2.1 5CASDL.0xxx-00

5.2.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel 5CASDL.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert. Für eine flexible Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) ist der Einsatz der SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 erforderlich.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

5.2.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	

Tabelle 234: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten

5.2.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-00	5CASDL. 0050-00	5CASDL. 0100-00	5CASDL. 0150-00	5CASDL. 0200-00	5CASDL. 0250-00	5CASDL. 0300-00
Allgemeines							
Zertifizierungen	Ja Ja Ja Ja ¹⁾						
CE							
cULus							
GOST-R							
GL							
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG 28		AWG 24				
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt						
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85%						
Außenmantel	PVC schwarz E74020-C (UL) AWM STYLE 20176 80°C 30V VW-1 DVI DIGITAL LINK						
Material							
Farbe							
Bedruckung							
Steckverbindung							
Typ	2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen	100						
Kontakte	vergoldet						
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung						
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm						
Elektrische Eigenschaften							
Leiterwiderstand	- ≤ 93 Ω/km						
AWG 24							
AWG 28	≤ 237 Ω/km						
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen	1,8 m ±30 mm 5 m ±30 mm 10 m ±50 mm 15 m ±100 mm 20 m ±100 mm 25 m ±100 mm 30 m ±100 mm typ. 8,6 ±0,2 mm max. 9 mm typ. 11 ±0,2 mm max. 11,5 mm						
Länge							
Durchmesser							
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)						
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)						
Gewicht	ca. 300 g	ca. 580 g	ca. 1500 g	ca. 2250 g	ca. 2880 g	ca. 4800 g	ca. 5520 g

Tabelle 235: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

5.2.1.4 Biegeradiusspezifikation

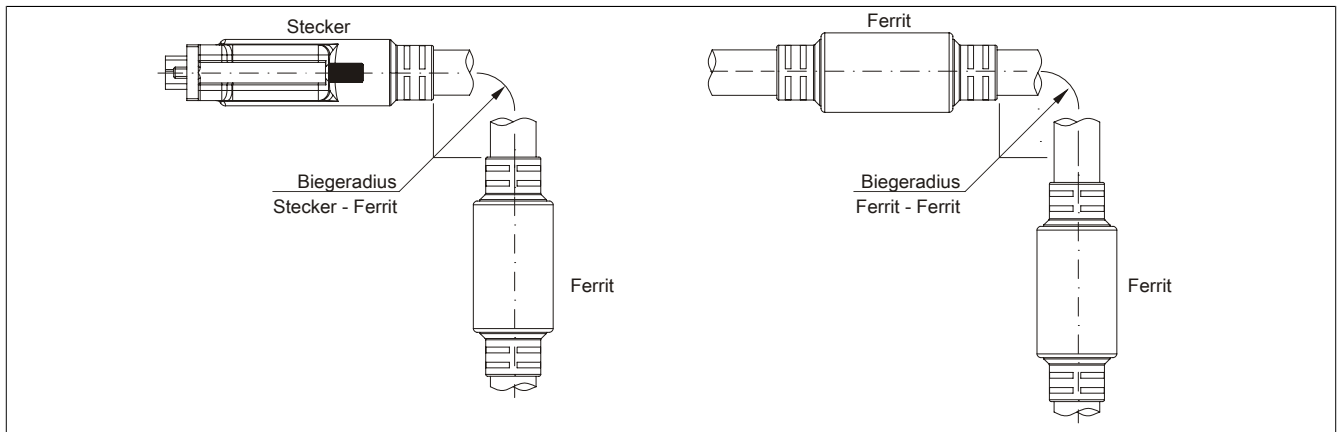


Abbildung 175: Biegeradiusspezifikation

5.2.1.5 Abmessungen

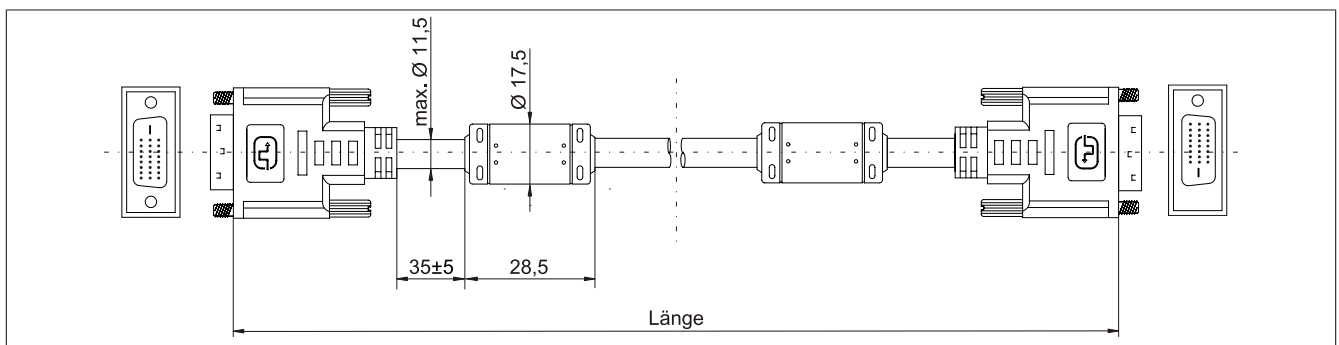


Abbildung 176: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen

5.2.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

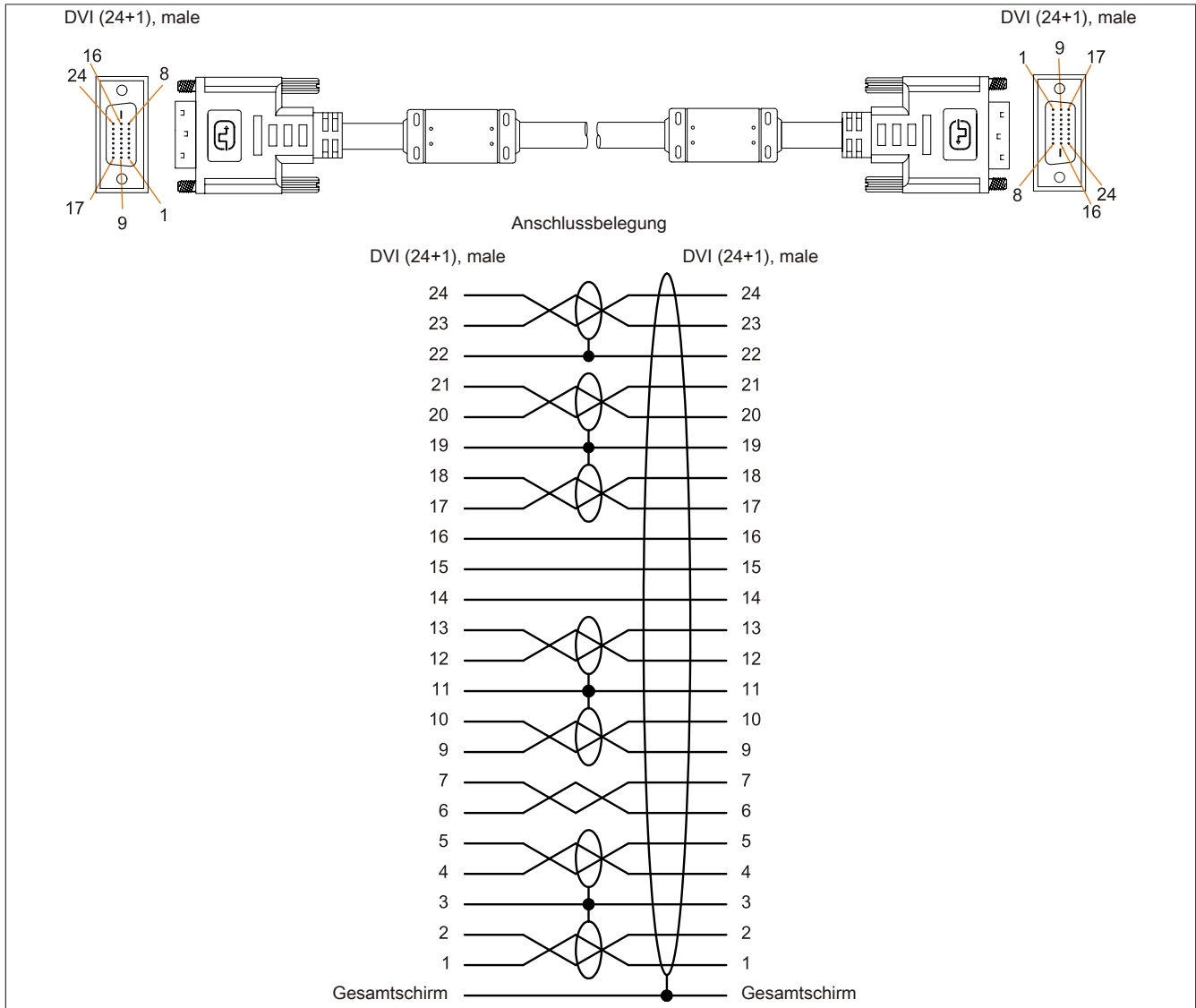


Abbildung 177: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung

5.3 SDL Kabel mit 45° Stecker

5.3.1 5CASDL.0xxx-01

5.3.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel mit 45° Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

5.3.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	

Tabelle 236: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten

5.3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0018-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0150-01
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	Ja			
cULus	Ja			
GOST-R	Ja			
GL	Ja ¹⁾			
Kabelaufbau				
Drahtquerschnitt	AWG 28		AWG 24	
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt			
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85%			
Außenmantel				
Material	PVC			
Farbe	schwarz			
Steckverbindung				
Typ	2x DVI-D (24+1), male			
Steckzyklen	100			
Kontakte	vergoldet			
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung			
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm			
Elektrische Eigenschaften				
Leiterwiderstand				
AWG 24	-		≤ 93 Ω/km	
AWG 28	≤ 237 Ω/km		-	
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm	10 m ±100 mm	15 m ±100 mm
Durchmesser	max. 9 mm		max. 11,5 mm	
Biegeradius				
feste Verlegung	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)			
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)			
Gewicht	ca. 300 g	ca. 590 g	ca. 2800 g	ca. 2860 g

Tabelle 237: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

5.3.1.4 Biegeradiusspezifikation

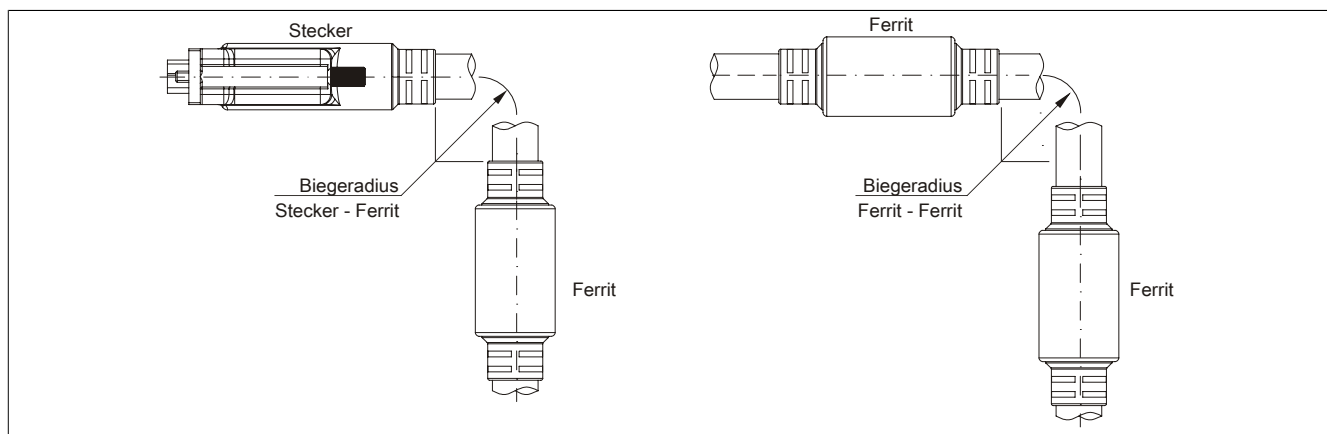


Abbildung 178: Biegeradiusspezifikation

5.3.1.5 Abmessungen

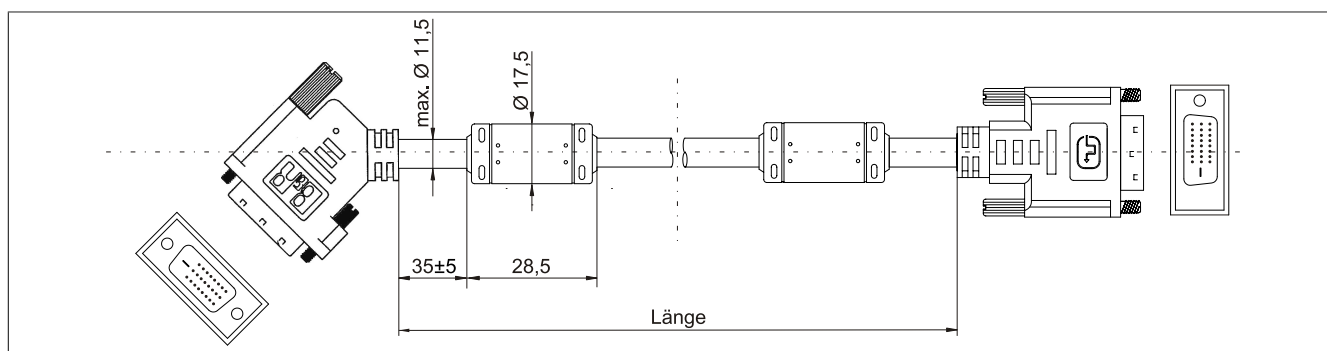


Abbildung 179: 5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen

5.3.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

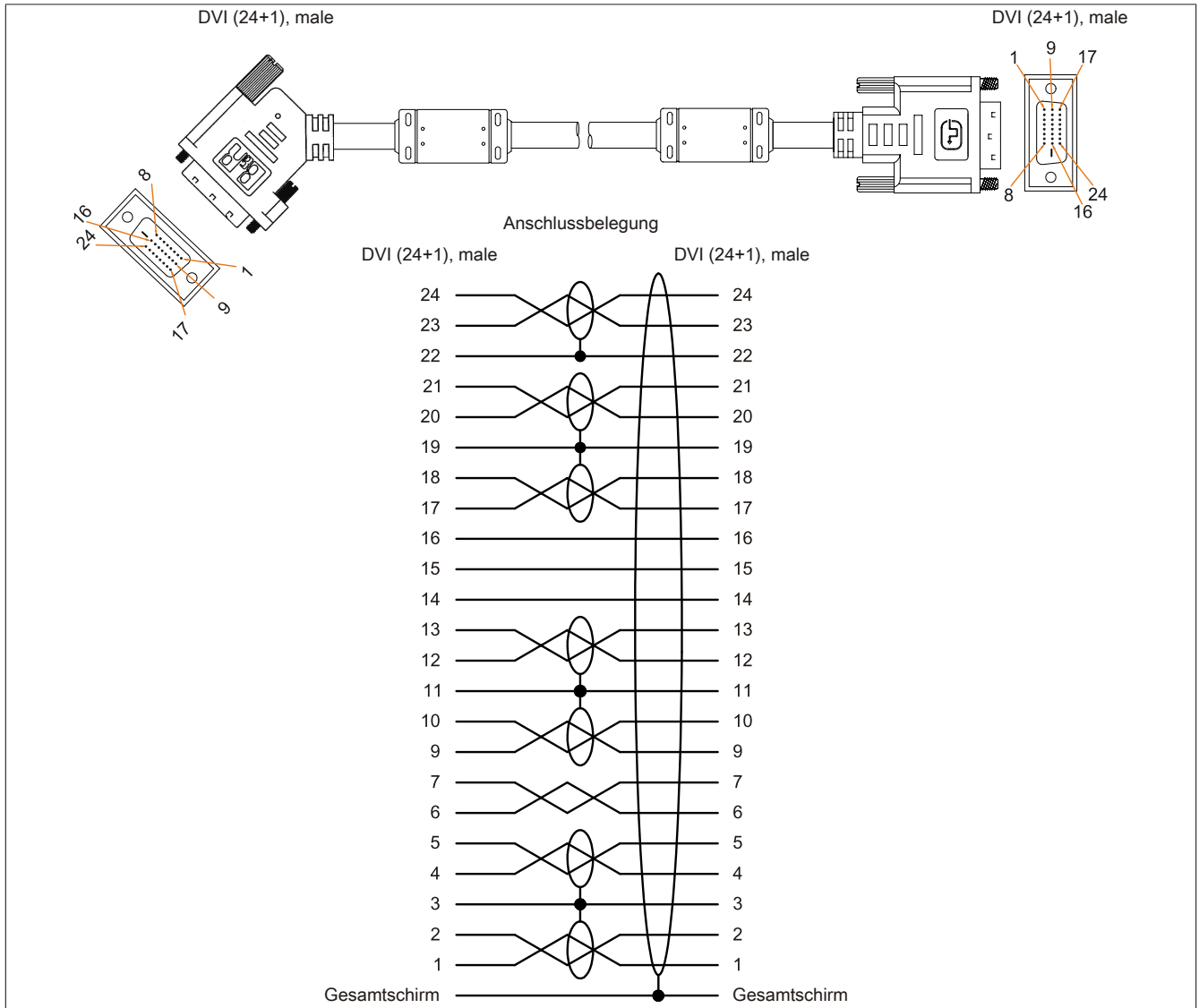


Abbildung 180: 5CASDL.0xxx-01 - Belegung

5.4 SDL Kabel flex

5.4.1 5CASDL.0xxx-03

5.4.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

5.4.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	

Tabelle 238: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten

5.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Allgemeines							
Zertifizierungen	Ja Ja Ja Ja ¹⁾						
CE							
cULus							
GOST-R							
GL							
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)						
Eigenschaften	halogen- und silikonfrei						
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt						
Gesamtschirmung	alukaschierte Folie + verzinntes Kupfergeflecht						
Außenmantel	Spezial-TMPU - seidenmatt schwarz (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E 63216						
Material							
Farbe							
Bedruckung							
Steckverbindung							
Typ	2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen	min. 200						
Kontakte	vergoldet						
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung						
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm						
Elektrische Eigenschaften							
Betriebsspannung	≤ 30 V						
Prüfspannung	1 kV 0,5 kV						
Ader/Ader							
Ader/Schirm							
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω						
Leiterwiderstand	≤ 95 Ω/km ≤ 145 Ω/km > 200 MΩ/km						
AWG 24							
AWG 26							
Isolationswiderstand							
Einsatzbedingungen							
Approbation	UL AWM 20236 80°C 30V						
Flammwidrigkeit	gemäß UL758 (cable vertical flame test)						
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10						

Tabelle 239: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Umgebungsbedingungen							
Temperatur	-20 bis 80°C						
Lagerung							
feste Verlegung							
flexible Verlegung	-5 bis 60°C						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen	1,8 m ±20 mm 5 m ±45 mm 10 m ±90 mm 15 m ±135 mm 20 m ±180 mm 25 m ±225 mm 30 m ±270 mm max. 12 mm						
Länge							
Durchmesser							
Biegeradius	≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit) ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit) ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)						
feste Verlegung							
flexible Verlegung							
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)						
Schleppkettendaten	300.000 4800 Zyklen/Stunde 180 mm; 15x Kabeldurchmesser 460 mm						
Biegewechsel							
Geschwindigkeit							
Biegeradius							
Hub							
Gewicht	ca. 460 g	ca. 1020 g	ca. 1940 g	ca. 2840 g	ca. 3740 g	ca. 4560 g	ca. 5590 g
Zugbelastbarkeit	≤ 50 N ≤ 400 N						
in Betrieb							
bei Verlegung							

Tabelle 239: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

5.4.1.4 Biegeradiusspezifikation

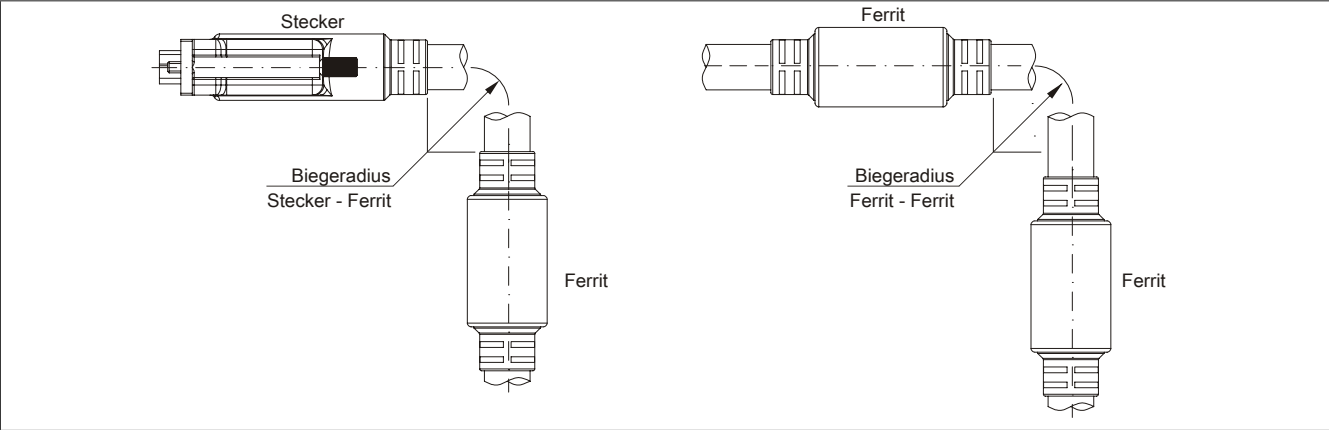


Abbildung 181: Biegeradiusspezifikation

5.4.1.5 Abmessungen

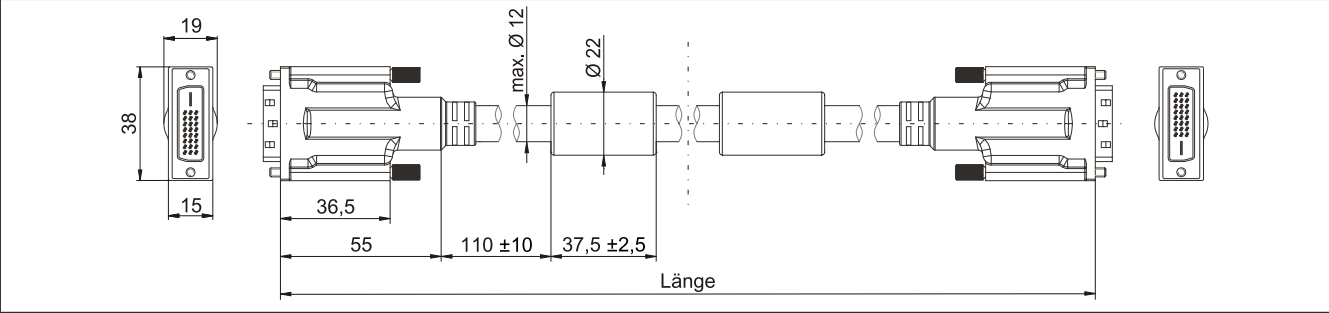


Abbildung 182: 5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen

5.4.1.6 Aufbau

Element	Belegung	Querschnitt	
DVI	TMDS Daten 0	26 AWG	
	TMDS Daten 1	26 AWG	
	TMDS Daten 2	26 AWG	
	TMDS Takt	26 AWG	
USB	XUSB0	26 AWG	Steueradern - DDC Takt - DDC Daten - +5V - Masse - Hot Plug Detect
	XUSB1	26 AWG	
Daten	SDL	26 AWG	
	DDC Takt	24 AWG	
Steueradern	DDC Daten	24 AWG	
	+5 V	24 AWG	
	Masse	24 AWG	
	Hot Plug Detect	24 AWG	

Tabelle 240: Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03

5.4.1.7 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

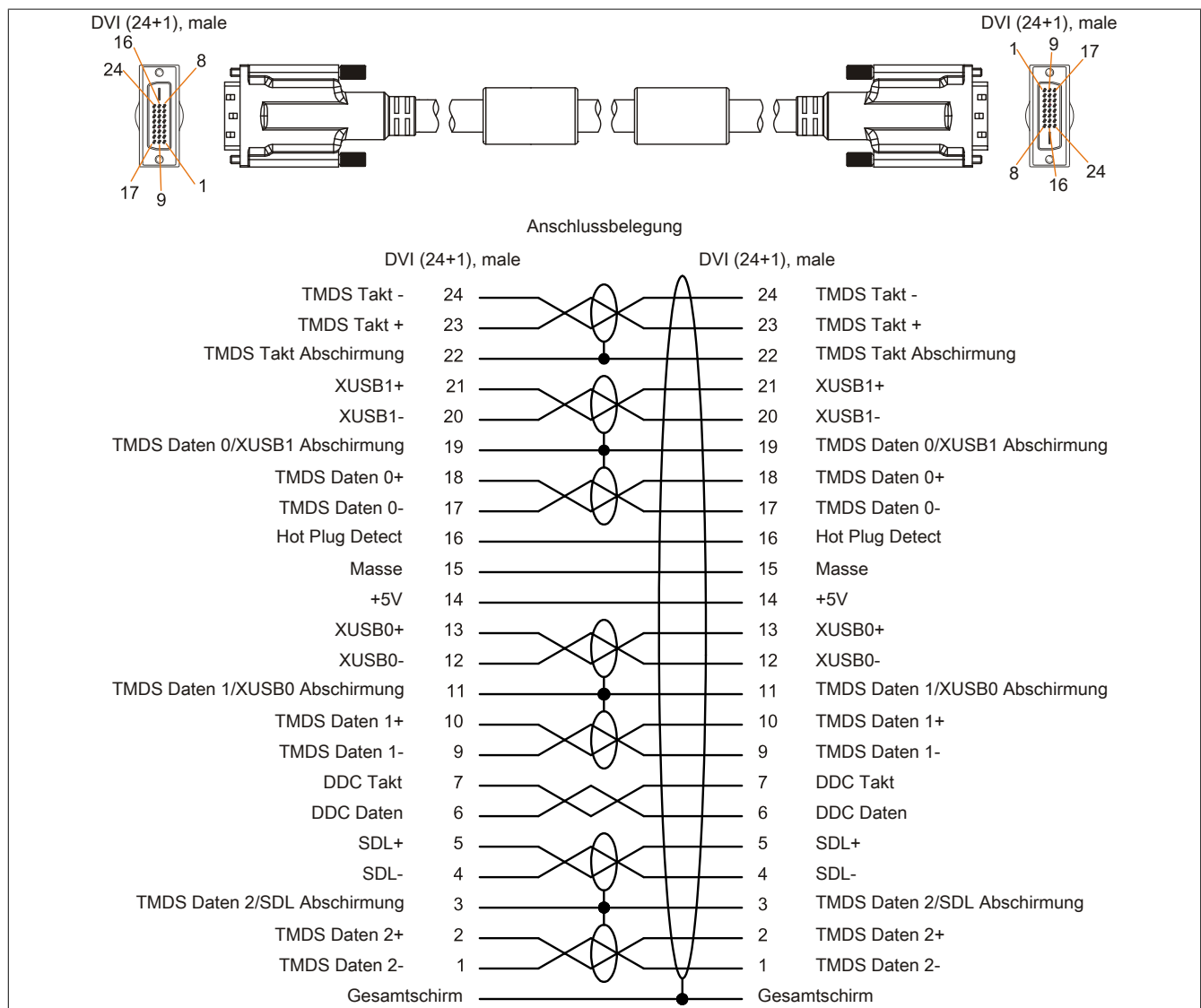


Abbildung 183: 5CASDL.0xxx-03 - Belegung

5.5 SDL Kabel flex mit Extender

5.5.1 5CASDL.0xx0-13

5.5.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel flex mit Extender 5CASDL.0xx0-13 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

5.5.1.2 Bestelldaten

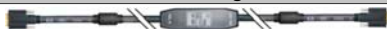
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	

Tabelle 241: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten

5.5.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung		5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE			Ja	
cULus			Ja	
GOST-R			Ja	
GL			Ja ¹⁾	
Kabelaufbau				
Drahtquerschnitt			AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)	
Eigenschaften			halogen- und silikonfrei	
Schirm			Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt	
Gesamtschirmung			alukaschierte Folie + verzinntes Kupfergeflecht	
Außenmantel				
Material			Spezial-TMPU - seidenmatt	
Farbe			schwarz	
Bedruckung			(B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E63216	
Steckverbindung				
Typ			2x DVI-D (24+1), male	
Steckzyklen			min. 200	
Kontakte			vergoldet	
mechanischer Schutz			Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung	
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben			max. 0,5 Nm	
Elektrische Eigenschaften				
Betriebsspannung			≤ 30 V	
Prüfspannung				
Ader/Ader			1 kV	
Ader/Schirm			0,5 kV	
Wellenwiderstand			100 ±10 Ω	
Leiterwiderstand				
AWG 24			≤ 95 Ω/km	
AWG 26			≤ 145 Ω/km	
Isolationswiderstand			> 200 MΩ/km	
Einsatzbedingungen				
Approbation			UL AWM 20236 80°C 30V	
Flammwidrigkeit			gemäß UL758 (cable vertical flame test)	
Öl- und Hydrolysebeständigkeit			gemäß VDE 0282-10	
Umgebungsbedingungen				
Temperatur				
Lagerung			-20 bis 60°C	
feste Verlegung			-20 bis 60°C	
flexible Verlegung			-5 bis 60°C	

Tabelle 242: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	30 m ±280 mm	40 m ±380 mm	43 m ±410 mm
Durchmesser		max. 12 mm	
Extender Box			
Breite		35 mm	
Länge		125 mm	
Höhe		18,5 mm	
Biegeradius			
feste Verlegung		≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit)	
		≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)	
flexible Verlegung		≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)	
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)		
Schleppkettendaten			
Biegewechsel		300.000	
Geschwindigkeit		4800 Zyklen/Stunde	
Biegeradius		180 mm; 15x Kabeldurchmesser	
Hub		460 mm	
Gewicht	ca. 5430 g	ca. 7200 g	ca. 7790 g
Zugbelastbarkeit			
in Betrieb		≤ 50 N	
bei Verlegung		≤ 400 N	

Tabelle 242: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

5.5.1.4 Biegeradiusspezifikation

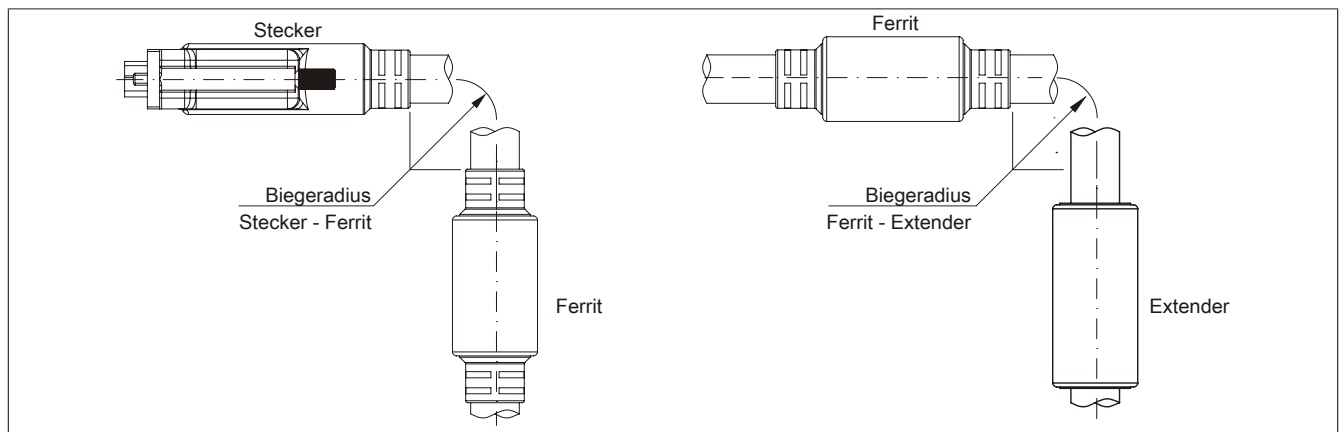


Abbildung 184: Biegeradiusspezifikation mit Extender

5.5.1.5 Abmessungen

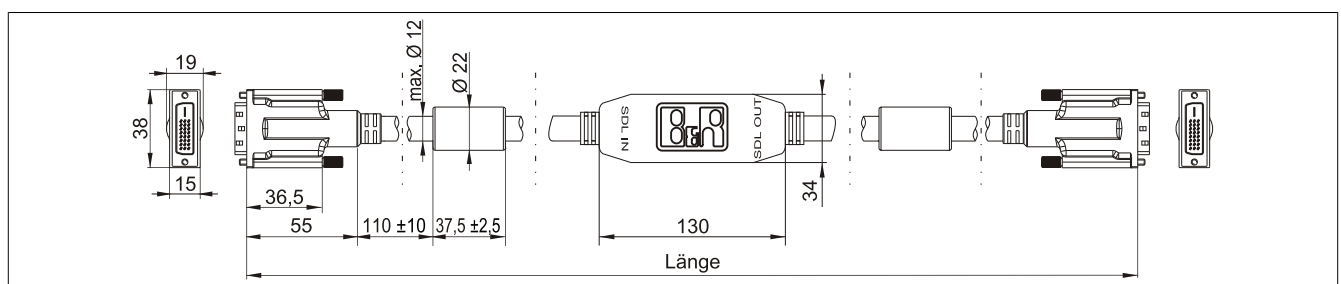


Abbildung 185: 5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen

5.5.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

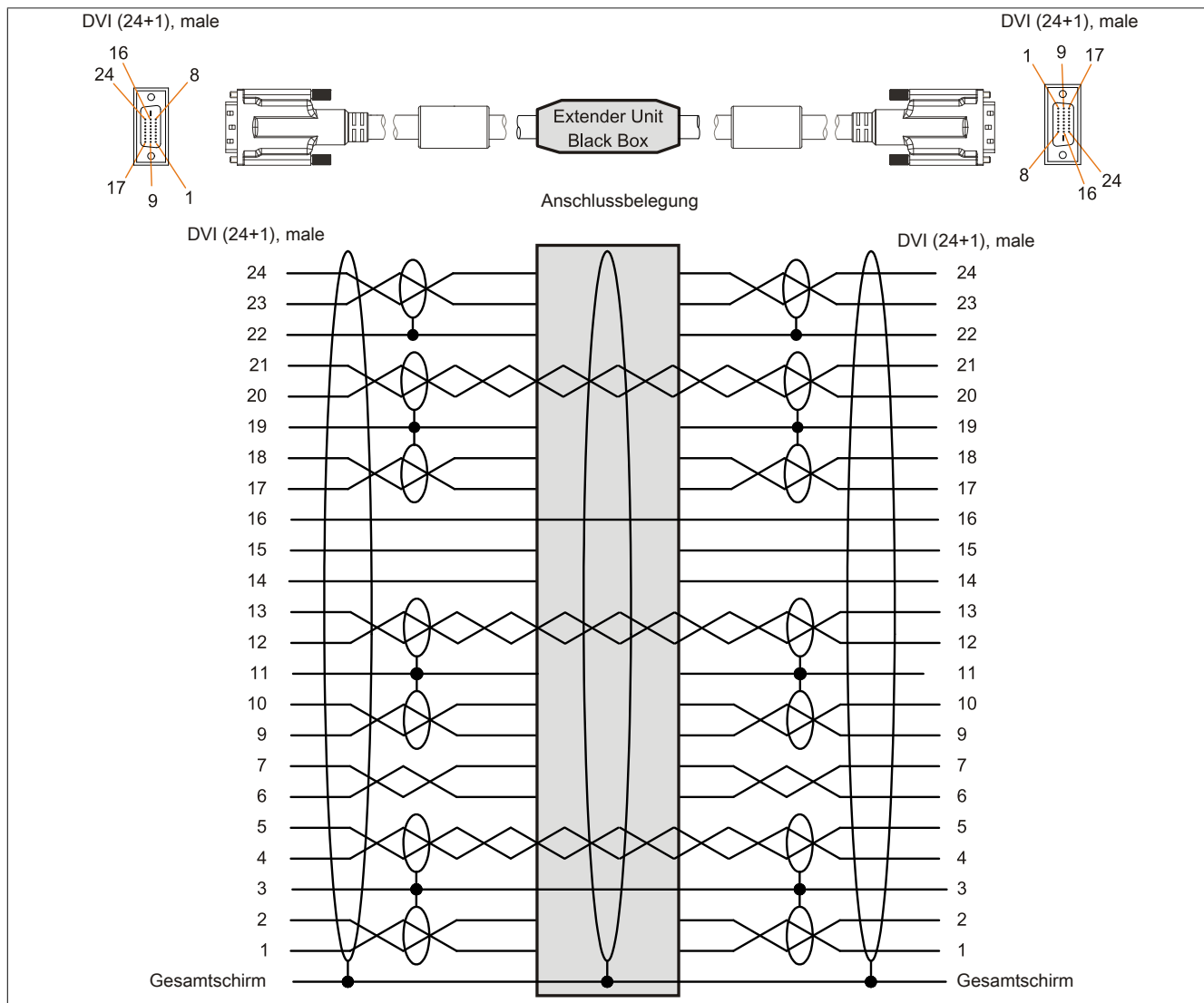


Abbildung 186: 5CASDL.0xx0-13 - Belegung

5.5.1.7 Kabelanschluss

Das SDL Kabel flex mit Extender muss in richtiger Richtung zwischen B&R Industrie PC und Automation Panel Displayeinheit angeschlossen werden. Zu diesem Zweck ist die Signalrichtung auf der Extender Unit abgebildet.

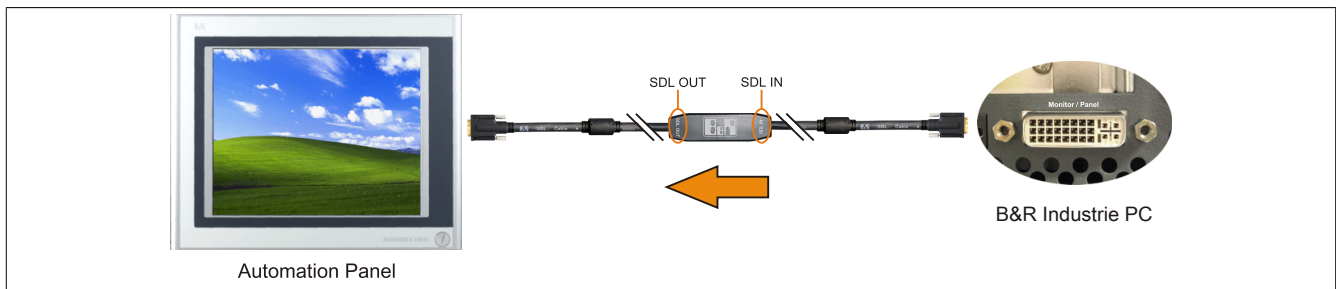


Abbildung 187: Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender

5.6 USB Kabel

5.6.1 5CAUSB.00xx-00

5.6.1.1 Allgemeines

Die USB Kabel sind für eine Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 konzipiert.

5.6.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 243: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten

5.6.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAUSB.0018-00		5CAUSB.0050-00
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
cULus		Ja	
GOST-R		Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 24, 28		
Schirm	Kabel gesamt		
Außenmantel			
Farbe	beige		
Steckverbindung			
Typ	USB Typ A male und USB Typ B male		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±30 mm		5 m ±50 mm
Durchmesser		max. 5 mm	
Biegeradius	min. 100 mm		

Tabelle 244: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten

5.6.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

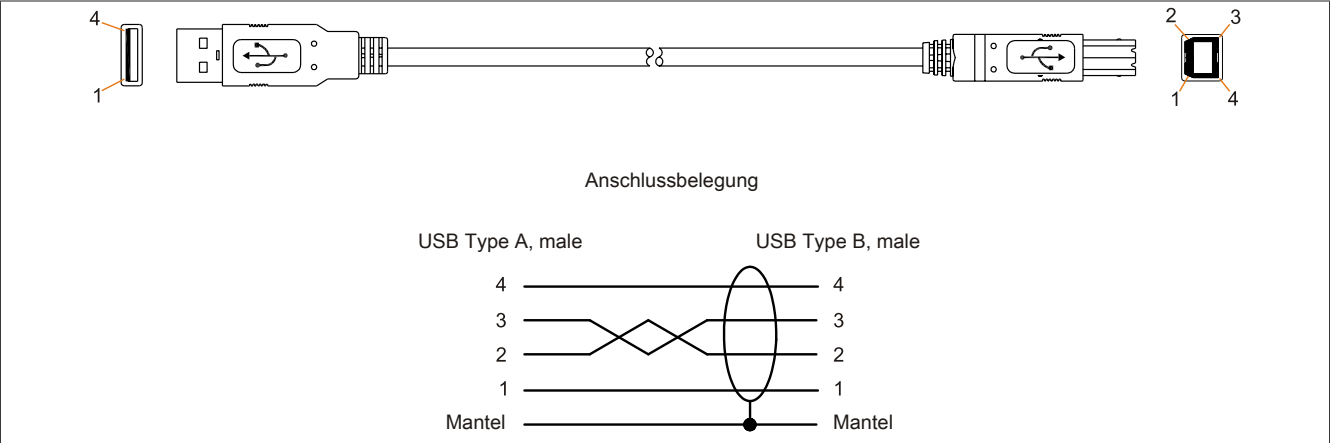


Abbildung 188: 5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel

5.7 RS232 Kabel

5.7.1 9A0014.xx

5.7.1.1 Allgemeines

Die RS232 Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232 Schnittstellen.

5.7.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	RS232 Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	

Tabelle 245: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten

5.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	9A0014.02	9A0014.05	9A0014.10
Allgemeines			
Zertifizierungen CE GOST-R	-	Ja	Ja
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt		AWG 26	
Schirm		Kabel gesamt	
Außenmantel Farbe		beige	
Steckverbindung			
Typ	9-polige DSUB Buchse, male / female		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen Länge Durchmesser	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm max. 5 mm	10 m ±100 mm
Biegeradius		min. 70 mm	

Tabelle 246: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten

5.7.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

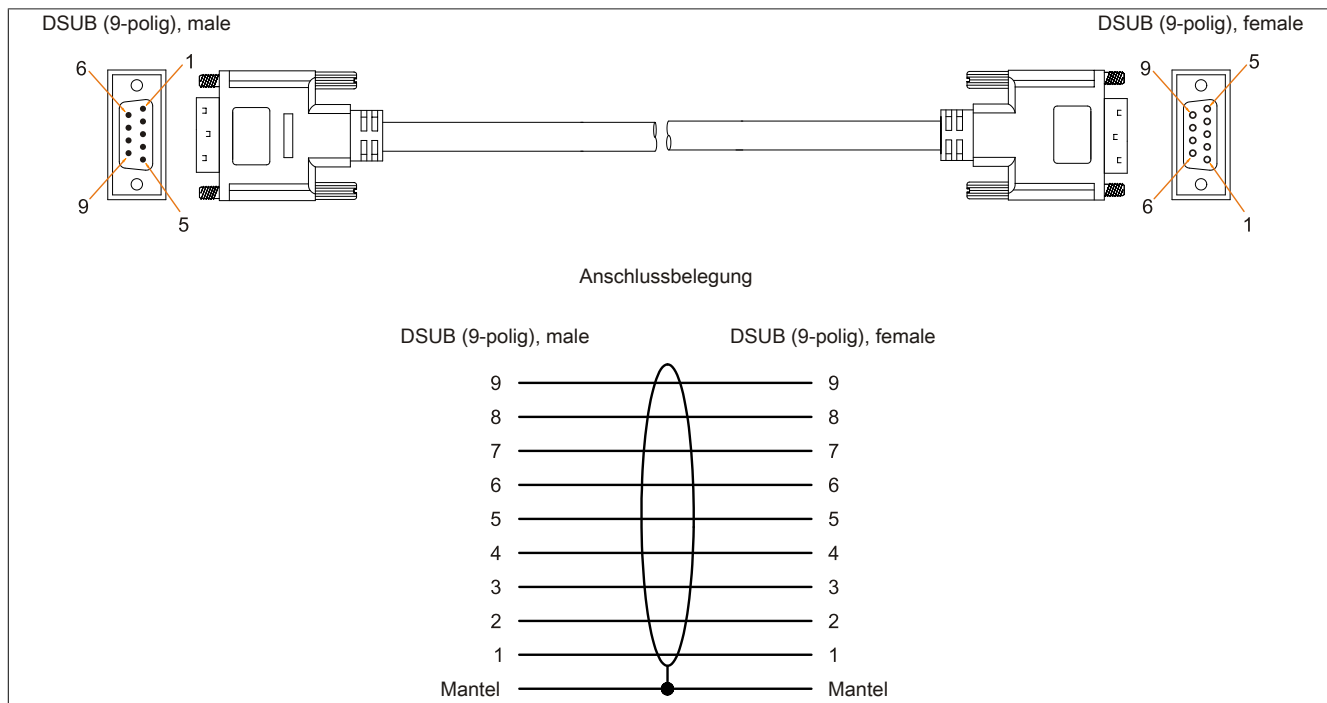


Abbildung 189: 9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel

Kapitel 7 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Batteriewechsel

Die Lithiumbatterie stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und der CMOS Daten sicher.

Information:

- Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl in spannungslosem Zustand als auch bei eingeschaltetem B&R Gerät. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.
- Beim Wechseln der Batterie in spannungslosem Zustand bleiben vorgenommene BIOS Einstellungen erhalten (werden in einem spannungssicheren EEPROM gespeichert). Datum und Uhrzeit sind nachträglich wieder einzustellen, da diese Daten beim Wechseln verloren gehen.
- Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Es sind folgende Lithium Ersatzbatterien verfügbar: 4A0006.00-000 (1 Stk.) und 0AC201.91 (4 Stk.).

1.1 Vorgehensweise

- Die Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen (Netzkabel abstecken!). Allseitig und allpolig abschalten!
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Die Batteriehalterung aus dem Panel PC ziehen ① und die Batterie entnehmen ②.

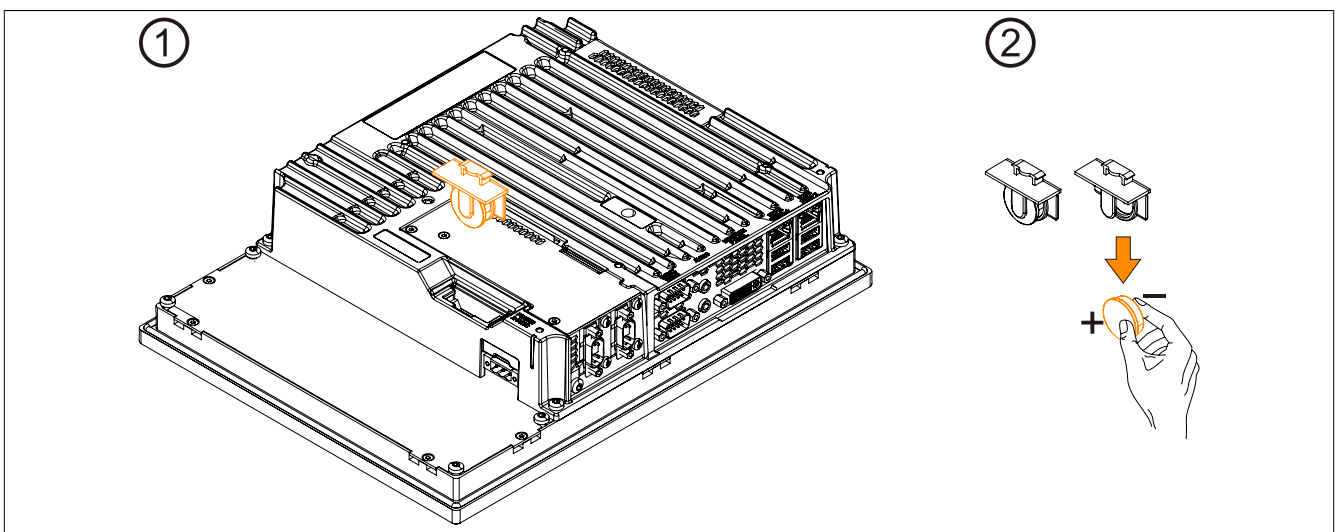


Abbildung 190: Batteriehalterung und Batterie entnehmen

- Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.

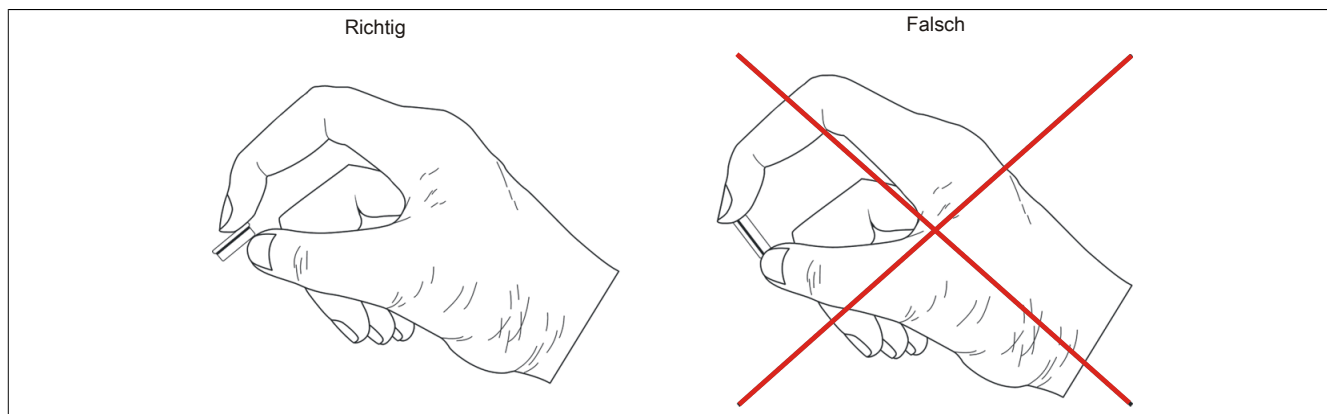


Abbildung 191: Batteriehandhabung

- Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.
- Die Batteriehalterung in den Panel PC stecken.
- Den B&R Industrie PC wieder unter Spannung setzen - Netzstecker anstecken.
- Datum und Uhrzeit im BIOS kontrollieren und gegebenenfalls neu einstellen.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

2 CFast Tausch

Vorsicht!

Ein Tauschen der CFast Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

Das Tauschen der CFast Karte ist durch Betätigung des Auswerfers (siehe Abbildung) schnell und sicher möglich.

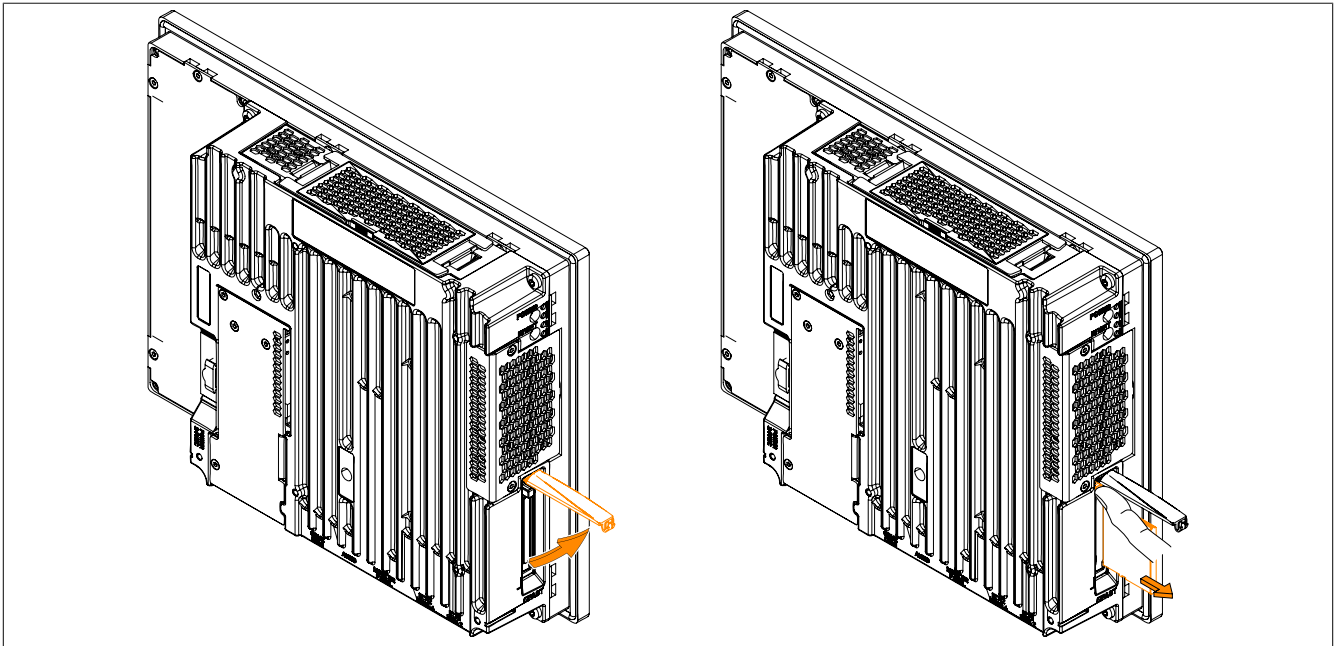


Abbildung 192: CFast Tausch

3 Reinigung

Gefahr!

Die Reinigung des Gerätes darf nur in ausgeschaltetem Zustand durchgeführt werden, um so, durch Berühren des Touch Screens oder Drücken von Tasten, das Auslösen unbeabsichtigter Funktionen zu vermeiden.

Zum Reinigen des Gerätes ist ein feuchtes Tuch zu verwenden. Zum Befeuchten des Reinigungstuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel, Druckluft oder Dampfstrahler verwenden.

Information:

Displays mit Touch Screen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

4 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer

4.1 Backlight

Die Lebensdauer des Backlight wird in „Half Brightness Time“ angegeben. Eine Betriebszeit von 50.000 Stunden würde bedeuten, dass nach dieser Zeit die Displayhelligkeit immer noch 50% beträgt.

4.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlängert werden?

- Die Displayhelligkeit auf den geringsten, für die Augen angenehmen Wert einstellen
- Verwendung von dunklen Bildern
- Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann ca. eine 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

4.2 Image Sticking

Als Image Sticking wird das „Einbrennen“ eines Bildes nach längerer Anzeige eines statischen Bildes auf einem Display bezeichnet. Es tritt jedoch nicht nur bei statischen Bildern auf. Image Sticking wird in technischer Literatur auch als burn-in effect, image retention, memory effect, memory sticking oder ghost image bezeichnet.

Es werden 2 verschiedene Arten unterschieden:

- Fläche (Area type): man kann diese Art bei einem dunkelgrauen Bild erkennen. Der Effekt verschwindet, wenn das Display eine längere Zeit ausgeschaltet wird.
- Linie (Line type): kann zu einem bleibenden Schaden führen.

4.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?

- Statische Bilder
- Kein Bildschirmschoner
- Scharfe Kontrastübergänge (z.B. schwarz/weiß)
- Hohe Umgebungstemperaturen
- Betrieb außerhalb der Spezifikation

4.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?

- Laufendes wechseln zwischen statischen und dynamischen Bildern
- Verhindern von zu großen Helligkeitsunterschieden zwischen Vorder- und Hintergrunddarstellung
- Verwendung von Farben mit ähnlicher Helligkeit
- Verwendung von Komplementärfarben bei den Folgebildern
- Verwendung von Bildschirmschonern

5 Pixelfehler

Information:

Displays können auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bildpunkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewährleistung dar.

Anhang A

1 Abkürzungen

Abkürzung	Steht für	Beschreibung
NC	Normally closed	Steht bei einem Relaiskontakt für Öffner.
	Not connected	Wird bei der Beschreibung von Anschlussbelegungen verwendet, wenn eine Klemme oder ein Pin moduleseitig nicht angeschlossen ist.
ND	Not defined	Steht in den technischen Datentabellen für einen nicht definierten Wert. Z. B. weil es von einem Kabelhersteller zu bestimmten technischen Daten keine Angabe gibt.
NO	Normally open	Steht bei einem Relaiskontakt für Schließer.
TBD	To be defined	Wird in den technischen Datentabellen verwendet, wenn es derzeit zu diesem technischen Datum noch keine Angabe gibt. Der Wert wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.

Tabelle 247: Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen

2 Blickwinkel

Die Blickwinkelangaben (R, L, U, D) der Displaytypen können den technischen Daten der Einzelkomponenten entnommen werden.

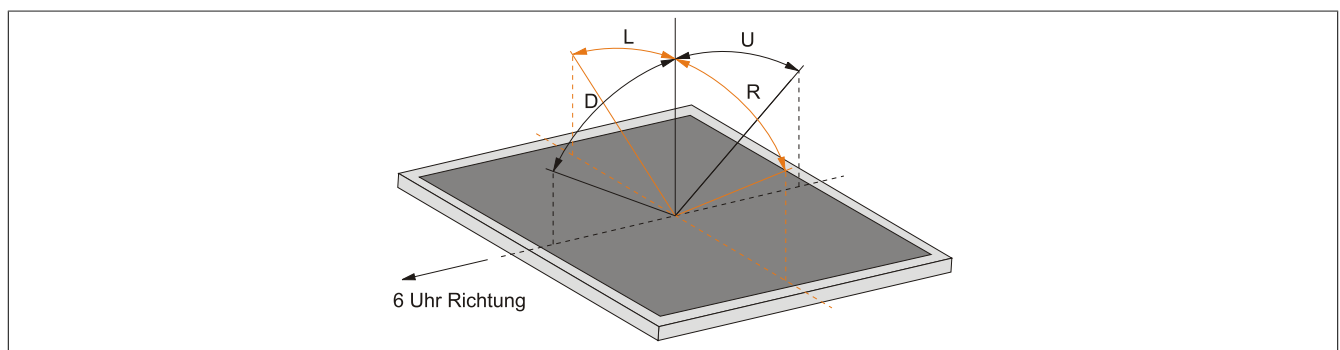


Abbildung 1:	Konfiguration Grundsystem - Panel PC 900.....	19
Abbildung 2:	Konfiguration Zubehör - Panel PC 900.....	20
Abbildung 3:	Panel PC 900 - ohne Buseinheit.....	21
Abbildung 4:	Panel PC 900 - mit 1 Slot Buseinheit.....	21
Abbildung 5:	Panel PC 900 - mit 2 Slot Buseinheit.....	21
Abbildung 6:	Abmessungen - Panel PC 900 + Netzteil + Buseinheiten.....	22
Abbildung 7:	Einbauzeichnung - Panel PC 900 + Netzteil + Buseinheiten.....	23
Abbildung 8:	Abstände für die Luftzirkulation beim Panel PC 900.....	24
Abbildung 9:	Einbaulage - Panel PC 900.....	25
Abbildung 10:	Temperatursensorpositionen - Panel PC 900.....	31
Abbildung 11:	Blockschaltbild Panel PC 900.....	37
Abbildung 12:	Geräteschnittstellen Übersicht unten.....	38
Abbildung 13:	Geräteschnittstellen Übersicht seitlich.....	39
Abbildung 14:	Erdungsanschluss.....	40
Abbildung 15:	Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte.....	54
Abbildung 16:	Abmessungen Standard half-size PCIe Karte.....	54
Abbildung 17:	5AP23.1215-00 - Abmessungen.....	56
Abbildung 18:	5AP923.1215-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	56
Abbildung 19:	5AP23.1505-00 - Abmessungen.....	58
Abbildung 20:	5AP923.1505-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	58
Abbildung 21:	5AP23.1906-00 - Abmessungen.....	60
Abbildung 22:	5AP923.1906-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	60
Abbildung 23:	5AP933.156B-00 - Abmessungen.....	62
Abbildung 24:	5AP933.156B-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	62
Abbildung 25:	5AP933.185B-00 - Abmessungen.....	64
Abbildung 26:	5AP933.185B-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	64
Abbildung 27:	5AP933.215C-00 - Abmessungen.....	66
Abbildung 28:	5AP933.215C-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	66
Abbildung 29:	5AP933.240C-00 - Abmessungen.....	68
Abbildung 30:	5AP933.240C-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	68
Abbildung 31:	1 Slot Buseinheiten.....	78
Abbildung 32:	2 Slot Buseinheiten.....	78
Abbildung 33:	5AC901.CHDD-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	83
Abbildung 34:	5AC901.CSSD-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	85
Abbildung 35:	5AC901.CSSD-04 Rev. ≤ C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	87
Abbildung 36:	5AC901.CSSD-04 Rev. ≥ D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	88
Abbildung 37:	5AC901.CSSD-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	90
Abbildung 38:	5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	92
Abbildung 39:	5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≤ C0.....	94
Abbildung 40:	5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≥ D0.....	95
Abbildung 41:	5MMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	97
Abbildung 42:	5AC901.SDVW-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	100
Abbildung 43:	RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus.....	104
Abbildung 44:	5AC901.I485-00 - Abschlusswiderstand.....	105
Abbildung 45:	5AC901.ICAN-00 - Abschlusswiderstand.....	107
Abbildung 46:	5AC901.BUPS-00 - Abmessungen.....	117
Abbildung 47:	5AC901.BUPS-00 - Bohrschablone.....	118
Abbildung 48:	5AC901.BUPS-01 - Abmessungen.....	120
Abbildung 49:	5AC901.BUPS-01 - Bohrschablone.....	121
Abbildung 50:	Halteklammern vorbereiten.....	126
Abbildung 51:	Halteklammern einsetzen (Symbolfoto).....	127
Abbildung 52:	Halteklammern festschrauben.....	127
Abbildung 53:	Torxschrauben der Systemeinheit lösen.....	128
Abbildung 54:	Systemeinheit & CPU Board entfernen.....	128
Abbildung 55:	Torxschrauben der Montageplatte lösen.....	129
Abbildung 56:	Montageplatte entfernen.....	129
Abbildung 57:	Schrauben entfernen.....	130

Abbildung 58:	AC Netzteil tauschen.....	130
Abbildung 59:	Montageplatte montieren.....	131
Abbildung 60:	AC Netzteil montieren.....	131
Abbildung 61:	Torxschrauben lösen.....	132
Abbildung 62:	Abdeckblech entfernen.....	132
Abbildung 63:	Hauptspeicher tauschen.....	133
Abbildung 64:	Torxschrauben des Abdeckblechs lösen.....	134
Abbildung 65:	Abdeckblech entfernen.....	135
Abbildung 66:	Torxschrauben und Blindabdeckung entfernen.....	135
Abbildung 67:	Interface Option einbauen und fixieren.....	136
Abbildung 68:	Abdeckblech montieren.....	136
Abbildung 69:	Abdeckblech mit Torxschrauben fixieren.....	137
Abbildung 70:	Torxschrauben lösen.....	138
Abbildung 71:	Abdeckblech entfernen.....	138
Abbildung 72:	Lasche am Slide-in compact Laufwerk lösen.....	138
Abbildung 73:	Slide-in compact Laufwerk entfernen.....	139
Abbildung 74:	Verriegelung nach innen drücken.....	140
Abbildung 75:	Filterdeckel entfernen.....	141
Abbildung 76:	Torxschrauben lösen und Seitenabdeckung entfernen.....	142
Abbildung 77:	Buseinheit an der Systemeinheit montieren.....	142
Abbildung 78:	Seitenabdeckung montieren.....	143
Abbildung 79:	Torxschrauben lösen und Seitenabdeckung entfernen.....	144
Abbildung 80:	Torxschrauben lösen und Blindabdeckung entfernen.....	145
Abbildung 81:	PCI / PCIe Karte in die Buseinheit einbauen.....	145
Abbildung 82:	Seitenabdeckung montieren.....	146
Abbildung 83:	Torxschrauben lösen und Seitenabdeckung entfernen.....	147
Abbildung 84:	Slide-in Blindabdeckung von der Seitenabdeckung entfernen.....	147
Abbildung 85:	Slide-in Laufwerk in die Buseinheit einbauen.....	148
Abbildung 86:	Seitenabdeckung montieren.....	148
Abbildung 87:	Anschluss des USV Kabels an die Batterie.....	149
Abbildung 88:	Montage einer Schraubklemme.....	150
Abbildung 89:	Montage einer Federzugklemme.....	150
Abbildung 90:	Montage einer Schraubklemme.....	151
Abbildung 91:	Spannungsversorgungsstecker an ein B&R Gerät anschließen (Symbolbild).....	152
Abbildung 92:	Funktionserdesymbol.....	153
Abbildung 93:	Erdungskonzept Panel PC 900.....	153
Abbildung 94:	Biegeradius Kabelanschluss.....	154
Abbildung 95:	Displayhelligkeit regeln.....	157
Abbildung 96:	Configuration Utility - Boot.....	158
Abbildung 97:	Configuration Utility - Übersicht.....	158
Abbildung 98:	Configuration Utility - Create RAID Volume.....	159
Abbildung 99:	Configuration Utility - Delete RAID Volume.....	160
Abbildung 100:	Configuration Utility - Reset Disks to Non-RAID.....	161
Abbildung 101:	Configuration Utility - Recovery Volume Options.....	162
Abbildung 102:	Bootscreen.....	163
Abbildung 103:	Main.....	165
Abbildung 104:	Main - Platform Information.....	166
Abbildung 105:	Advanced Übersicht.....	167
Abbildung 106:	Advanced - Graphics Configuration.....	168
Abbildung 107:	Advanced - OEM Features.....	170
Abbildung 108:	Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration.....	171
Abbildung 109:	Advanced - OEM Features - CPU Board Features.....	172
Abbildung 110:	Advanced - OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values.....	173
Abbildung 111:	Advanced - OEM Features - System Board Features.....	173
Abbildung 112:	Advanced - OEM Features - System Board Features - Statistical Values.....	174
Abbildung 113:	Advanced - OEM Features - System Board Features - Temperature Values.....	175
Abbildung 114:	Advanced - OEM Features - System Board Features - Voltage Values.....	176

Abbildung 115:	Advanced - OEM Features - Memory Module Features.....	176
Abbildung 116:	Advanced - OEM Features - Display Board Features.....	177
Abbildung 117:	Advanced - OEM Features - Display Board Features - Statistical Values.....	178
Abbildung 118:	Advanced - OEM Features - Display Board Features - Temperature Values.....	178
Abbildung 119:	Advanced - OEM Features - Display Board Features - Panel #15.....	179
Abbildung 120:	Advanced - OEM Features - Bus Unit Features.....	180
Abbildung 121:	Advanced - OEM Features - Bus Unit Features - Statistical Values.....	181
Abbildung 122:	Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features.....	181
Abbildung 123:	Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features - Statistical Values.....	182
Abbildung 124:	Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features.....	183
Abbildung 125:	Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features - Statistical Values.....	184
Abbildung 126:	Advanced - OEM Features - Fan Unit Features.....	184
Abbildung 127:	Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - Statistical Values.....	185
Abbildung 128:	Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - RPM Values.....	186
Abbildung 129:	Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features.....	187
Abbildung 130:	Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features - Temperature Values.....	188
Abbildung 131:	Advanced - OEM Features - Panel Control Features.....	188
Abbildung 132:	Advanced - OEM Features - Panel Control Features - Panel #x.....	189
Abbildung 133:	Advanced - PCI Configuration.....	190
Abbildung 134:	Advanced - PCI Configuration - PIRQ Routing & IRQ Reservation.....	191
Abbildung 135:	Advanced - PCI Express Configuration.....	192
Abbildung 136:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Settings.....	193
Abbildung 137:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings.....	194
Abbildung 138:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Graphics (PEG) Port.....	195
Abbildung 139:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port.....	197
Abbildung 140:	Advanced - ACPI Settings.....	199
Abbildung 141:	Advanced - RTC Wake Settings.....	200
Abbildung 142:	Advanced - CPU Configuration.....	201
Abbildung 143:	Advanced - CPU Configuration - CPU Information.....	203
Abbildung 144:	Advanced - Chipset Configuration.....	204
Abbildung 145:	Advanced - SATA Configuration.....	205
Abbildung 146:	Advanced - SATA Configuration - Software Feature Mask Configuration.....	207
Abbildung 147:	Advanced - Memory Configuration.....	208
Abbildung 148:	Advanced - Memory Configuration - Memory Information.....	210
Abbildung 149:	Advanced - Memory Configuration - Custom Profile Control.....	211
Abbildung 150:	Advanced - USB Configuration.....	212
Abbildung 151:	Advanced - USB Configuration - Per Port USB Disable Control.....	214
Abbildung 152:	Advanced - USB Configuration - Per Port Legacy USB Support Control.....	215
Abbildung 153:	Advanced - Serial Port Console Redirection.....	216
Abbildung 154:	Advanced - Console Redirection - Console Redirection Settings.....	217
Abbildung 155:	Boot.....	218
Abbildung 156:	Boot - Boot Device Priority.....	219
Abbildung 157:	Boot - Boot Configuration	220
Abbildung 158:	Security.....	221
Abbildung 159:	Security - HDD User Password.....	222
Abbildung 160:	Save & Exit.....	222
Abbildung 161:	PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board QM77/HM76.....	232
Abbildung 162:	Softwareversion.....	233
Abbildung 163:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1.....	236
Abbildung 164:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2.....	236
Abbildung 165:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3.....	236
Abbildung 166:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4.....	237
Abbildung 167:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5.....	237
Abbildung 168:	Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files.....	238
Abbildung 169:	Erstellung eines Massenspeichers für B&R Upgrade Files.....	239
Abbildung 170:	Abmessungen CFast Karte.....	254
Abbildung 171:	5CFAST.xxxx-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	255

Abbildung 172:	5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	257
Abbildung 173:	Biegeradiusspezifikation.....	259
Abbildung 174:	5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen.....	259
Abbildung 175:	5CADVI.0xxx-00 - Belegung.....	260
Abbildung 176:	Biegeradiusspezifikation.....	262
Abbildung 177:	5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen.....	262
Abbildung 178:	5CASDL.0xxx-00 - Belegung.....	263
Abbildung 179:	Biegeradiusspezifikation.....	265
Abbildung 180:	5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen.....	265
Abbildung 181:	5CASDL.0xxx-01 - Belegung.....	266
Abbildung 182:	Biegeradiusspezifikation.....	268
Abbildung 183:	5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen.....	268
Abbildung 184:	5CASDL.0xxx-03 - Belegung.....	269
Abbildung 185:	Biegeradiusspezifikation mit Extender.....	271
Abbildung 186:	5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen.....	271
Abbildung 187:	5CASDL.0xx0-13 - Belegung.....	272
Abbildung 188:	Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender.....	273
Abbildung 189:	5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel.....	274
Abbildung 190:	9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel	276
Abbildung 191:	Batteriehalterung und Batterie entnehmen.....	277
Abbildung 192:	Batteriehandhabung.....	278
Abbildung 193:	CFast Tausch.....	279

Tabelle 1:	Handbuchhistorie.....	9
Tabelle 2:	Umweltgerechte Werkstofftrennung.....	12
Tabelle 3:	Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise.....	13
Tabelle 4:	Nennmaßbereiche.....	13
Tabelle 5:	Abmessungen - Displayeinheiten.....	22
Tabelle 6:	Abmessungen - CPU Boards & Systemeinheiten, Buseinheiten und Netzteil.....	22
Tabelle 7:	Einba Zeichnungen - Displayeinheiten.....	23
Tabelle 8:	Einbaulagen im Betrieb mit und ohne Lüfter Kit.....	25
Tabelle 9:	Einbaulagen im Betrieb mit Einzelkomponenten mit Einschränkungen.....	25
Tabelle 10:	Gewicht - Displayeinheiten.....	26
Tabelle 11:	Gewicht - CPU Boards & Systemeinheiten, Buseinheiten und Netzteil.....	26
Tabelle 12:	Umgebungstemperatur mit Lüfter.....	28
Tabelle 13:	Umgebungstemperatur ohne Lüfter.....	29
Tabelle 14:	Umgebungstemperatur Lagerung / Transport.....	30
Tabelle 15:	Temperatursensorpositionen.....	31
Tabelle 16:	Temperatursensorpositionen.....	31
Tabelle 17:	Luftfeuchtigkeit - Displayeinheiten.....	32
Tabelle 18:	Luftfeuchtigkeit - CPU Boards & Systemeinheiten, Buseinheiten und Netzteil.....	32
Tabelle 19:	Vibration.....	33
Tabelle 20:	Schock.....	33
Tabelle 21:	Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC.....	34
Tabelle 22:	Spannungsversorgungsanschluss Netzteil VAC.....	34
Tabelle 23:	Leistungskalkulation CPU Board.....	35
Tabelle 24:	Leistungskalkulation - Displayeinheiten.....	36
Tabelle 25:	Leistungskalkulation Interface Optionen.....	36
Tabelle 26:	Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC.....	40
Tabelle 27:	Spannungsversorgungsanschluss Netzteil VAC.....	41
Tabelle 28:	Ein/Aus- Schalter.....	41
Tabelle 29:	Pinbelegung COM1.....	42
Tabelle 30:	Pinbelegung COM2.....	42
Tabelle 31:	Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL.....	43
Tabelle 32:	Pinbelegung DVI Anschluss.....	43
Tabelle 33:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	44
Tabelle 34:	Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung.....	44
Tabelle 35:	Ethernet Anschluss (ETH1).....	45
Tabelle 36:	Ethernet Anschluss (ETH2).....	45
Tabelle 37:	USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss.....	46
Tabelle 38:	CFast Slot.....	47
Tabelle 39:	Audio.....	47
Tabelle 40:	Daten Status LEDs.....	48
Tabelle 41:	Power Button.....	49
Tabelle 42:	Reset Button.....	49
Tabelle 43:	Batterie.....	50
Tabelle 44:	Bedeutung Batteriestatus.....	50
Tabelle 45:	Slide-in compact Slot.....	51
Tabelle 46:	Slide-in Slot.....	51
Tabelle 47:	Hauptspeicher Einschub.....	52
Tabelle 48:	IF Option 1 Steckplatz.....	53
Tabelle 49:	IF Option 2 Steckplatz.....	53
Tabelle 50:	5AP923.1215-00 - Bestelldaten.....	55
Tabelle 51:	5AP923.1215-00 - Technische Daten.....	55
Tabelle 52:	5AP923.1505-00 - Bestelldaten.....	57
Tabelle 53:	5AP923.1505-00 - Technische Daten.....	57
Tabelle 54:	5AP923.1906-00 - Bestelldaten.....	59
Tabelle 55:	5AP923.1906-00 - Technische Daten.....	59
Tabelle 56:	5AP933.156B-00 - Bestelldaten.....	61
Tabelle 57:	5AP933.156B-00 - Technische Daten.....	61

Tabelle 58:	5AP933.185B-00 - Bestelldaten.....	63
Tabelle 59:	5AP933.185B-00 - Technische Daten.....	63
Tabelle 60:	5AP933.215C-00 - Bestelldaten.....	65
Tabelle 61:	5AP933.215C-00 - Technische Daten.....	65
Tabelle 62:	5AP933.240C-00 - Bestelldaten.....	67
Tabelle 63:	5AP933.240C-00 - Technische Daten.....	67
Tabelle 64:	5PC901.TS77-00, 5PC901.TS77-01, 5PC901.TS77-02, 5PC901.TS77-03, 5PC901.TS77-04, 5PC901.TS77-05, 5PC901.TS77-06 - Bestelldaten.....	69
Tabelle 65:	5PC901.TS77-00, 5PC901.TS77-01, 5PC901.TS77-02, 5PC901.TS77-03, 5PC901.TS77-04, 5PC901.TS77-05, 5PC901.TS77-06 - Technische Daten.....	69
Tabelle 66:	5PC901.TS77-07, 5PC901.TS77-08, 5PC901.TS77-09, 5PC901.TS77-10 - Bestelldaten.....	72
Tabelle 67:	5PC901.TS77-07, 5PC901.TS77-08, 5PC901.TS77-09, 5PC901.TS77-10 - Technische Daten.....	72
Tabelle 68:	5PC911.SX00-00 - Bestelldaten.....	75
Tabelle 69:	5PC911.SX00-00 - Technische Daten.....	75
Tabelle 70:	5PC911.SX00-01 - Bestelldaten.....	76
Tabelle 71:	5PC911.SX00-01 - Technische Daten.....	76
Tabelle 72:	5MMDDR.1024-03, 5MMDDR.2048-03, 5MMDDR.4096-03, 5MMDDR.8192-03 - Bestelldaten.....	77
Tabelle 73:	5MMDDR.1024-03, 5MMDDR.2048-03, 5MMDDR.4096-03, 5MMDDR.8192-03 - Technische Daten.....	77
Tabelle 74:	5AC902.BX01-00, 5AC902.BX01-01, 5AC902.BX02-00, 5AC902.BX02-01 - Bestelldaten.....	79
Tabelle 75:	5AC902.BX01-00, 5AC902.BX01-01, 5AC902.BX02-00, 5AC902.BX02-01 - Technische Daten.....	79
Tabelle 76:	5AC902.FA00-00 - Bestelldaten.....	80
Tabelle 77:	5AC902.FA00-00 - Technische Daten.....	80
Tabelle 78:	5AC902.FA0X-00 - Bestelldaten.....	81
Tabelle 79:	5AC902.FA0X-00 - Technische Daten.....	81
Tabelle 80:	5AC901.CHDD-01 - Bestelldaten.....	82
Tabelle 81:	5AC901.CHDD-01 - Technische Daten.....	82
Tabelle 82:	5AC901.CSSD-03 - Bestelldaten.....	84
Tabelle 83:	5AC901.CSSD-03 - Technische Daten.....	84
Tabelle 84:	5AC901.CSSD-04 - Bestelldaten.....	86
Tabelle 85:	5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04 - Technische Daten.....	86
Tabelle 86:	5AC901.CSSD-05 - Bestelldaten.....	89
Tabelle 87:	5AC901.CSSD-05 - Technische Daten.....	89
Tabelle 88:	5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten.....	91
Tabelle 89:	5MMSSD.0060-01 - Technische Daten.....	91
Tabelle 90:	5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten.....	93
Tabelle 91:	5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten.....	93
Tabelle 92:	5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten.....	96
Tabelle 93:	5MMSSD.0256-00 - Technische Daten.....	96
Tabelle 94:	5AC901.CCFA-00 - Bestelldaten.....	98
Tabelle 95:	5AC901.CCFA-00 - Technische Daten.....	98
Tabelle 96:	5AC901.SDVW-00 - Bestelldaten.....	99
Tabelle 97:	5AC901.SDVW-00 - Technische Daten.....	99
Tabelle 98:	5AC901.SSCA-00 - Bestelldaten.....	101
Tabelle 99:	5AC901.SSCA-00 - Technische Daten.....	101
Tabelle 100:	5AC901.I485-00 - Bestelldaten.....	102
Tabelle 101:	5AC901.I485-00 - Technische Daten.....	102
Tabelle 102:	Pinbelegung COM.....	103
Tabelle 103:	RS232 Buslänge und Übertragungsrate.....	103
Tabelle 104:	RS232 Kabel Anforderungen.....	103
Tabelle 105:	RS422 Buslänge und Übertragungsrate.....	104
Tabelle 106:	RS422 Kabel Anforderungen.....	104
Tabelle 107:	RS485 Buslänge und Übertragungsrate.....	104
Tabelle 108:	RS485 Kabel Anforderungen.....	104
Tabelle 109:	5AC901.ICAN-00 - Bestelldaten.....	106
Tabelle 110:	5AC901.ICAN-00 - Technische Daten.....	106
Tabelle 111:	5AC901.ICAN-00 - CAN Pinbelegung.....	107
Tabelle 112:	5AC901.ISRM-00 - Bestelldaten.....	108

Tabelle 113:	5AC901.ISRM-00 - Technische Daten.....	108
Tabelle 114:	5AC901.IHDA-00 - Bestelldaten.....	109
Tabelle 115:	5AC901.IHDA-00 - Technische Daten.....	109
Tabelle 116:	MIC, Line IN, Line OUT.....	110
Tabelle 117:	5AC901.IUPS-00 - Bestelldaten.....	112
Tabelle 118:	5AC901.IUPS-00 - Technische Daten.....	112
Tabelle 119:	5AC901.IUPS-00 / -01 - Pinbelegung.....	113
Tabelle 120:	5AC901.IUPS-01 - Bestelldaten.....	114
Tabelle 121:	5AC901.IUPS-01 - Technische Daten.....	114
Tabelle 122:	5AC901.IUPS-00 / -01 - Pinbelegung.....	115
Tabelle 123:	5AC901.BUPS-00 - Bestelldaten.....	116
Tabelle 124:	5AC901.BUPS-00 - Technische Daten.....	116
Tabelle 125:	5AC901.BUPS-01 - Bestelldaten.....	119
Tabelle 126:	5AC901.BUPS-01 - Technische Daten.....	119
Tabelle 127:	5CAUPS.0005-01, 5CAUPS.0010-01, 5CAUPS.0030-01 - Bestelldaten.....	122
Tabelle 128:	5CAUPS.0005-01, 5CAUPS.0010-01, 5CAUPS.0030-01 - Technische Daten.....	122
Tabelle 129:	5AC902.PS00-00 - Bestelldaten.....	124
Tabelle 130:	5AC902.PS00-00 - Technische Daten.....	124
Tabelle 131:	BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility.....	159
Tabelle 132:	Configuration Utility - Create RAID Volume.....	159
Tabelle 133:	Biosrelevante Tasten beim POST.....	164
Tabelle 134:	Biosrelevante Tasten im BIOS Menü.....	164
Tabelle 135:	Main Einstellmöglichkeiten.....	165
Tabelle 136:	Main - Platform Information Übersicht.....	166
Tabelle 137:	Advanced Übersicht.....	167
Tabelle 138:	Advanced - Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten.....	168
Tabelle 139:	Advanced - OEM Features - Menü.....	170
Tabelle 140:	Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration Einstellmöglichkeiten.....	171
Tabelle 141:	Advanced - OEM Features - CPU Board Features.....	172
Tabelle 142:	Advanced - OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values.....	173
Tabelle 143:	Advanced - OEM Features - System Board Features.....	174
Tabelle 144:	Advanced - OEM Features - System Board Features - Statistical Values.....	174
Tabelle 145:	Advanced - OEM Features - System Board Features - Temperature Values.....	175
Tabelle 146:	Advanced - OEM Features - System Board Features - Voltage Values.....	176
Tabelle 147:	Advanced - OEM Features - Memory Module Features.....	177
Tabelle 148:	Advanced - OEM Features - Display Board Features.....	177
Tabelle 149:	Advanced - OEM Features - Display Board Features - Statistical Values.....	178
Tabelle 150:	Advanced - OEM Features - Display Board Features - Temperature Values.....	179
Tabelle 151:	Advanced - OEM Features - Display Board Features - Panel #15.....	179
Tabelle 152:	Advanced - OEM Features - Bus Unit Features.....	180
Tabelle 153:	Advanced - OEM Features - Bus Unit Features - Statistical Values.....	181
Tabelle 154:	Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features.....	182
Tabelle 155:	Advanced - OEM Features - I/O Board 1 Features - Statistical Values.....	182
Tabelle 156:	Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features.....	183
Tabelle 157:	Advanced - OEM Features - I/O Board 2 Features - Statistical Values.....	184
Tabelle 158:	Advanced - OEM Features - Fan Unit Features.....	185
Tabelle 159:	Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - Statistical Values.....	185
Tabelle 160:	Advanced - OEM Features - Fan Unit Features - RPM Values.....	186
Tabelle 161:	Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features.....	187
Tabelle 162:	Advanced - OEM Features - Slide-in 1 Features - Temperature Values.....	188
Tabelle 163:	Advanced - OEM Features - Panel Control Features.....	189
Tabelle 164:	Advanced - OEM Features - Panel Control Features - Panel #x.....	189
Tabelle 165:	Advanced - PCI Configuration Einstellmöglichkeiten.....	190
Tabelle 166:	Advanced - PCI Configuration - PIRQ Routing & IRQ Reservation Einstellmöglichkeiten.....	191
Tabelle 167:	Advanced - PCI Express Configuration Menü.....	192
Tabelle 168:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Settings Einstellmöglichkeiten.....	193
Tabelle 169:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings Einstellmöglichkeiten..	194

Tabelle 170:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Graphics (PEG) Port Einstellmöglichkeiten.....	195
Tabelle 171:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port Einstellmöglichkeiten.....	197
Tabelle 172:	Advanced - ACPI Settings Einstellmöglichkeiten.....	199
Tabelle 173:	Advanced - RTC Wake Settings Einstellmöglichkeiten.....	200
Tabelle 174:	Advanced - CPU Configuration Einstellmöglichkeiten.....	201
Tabelle 175:	Advanced - CPU Configuration - CPU Information Einstellmöglichkeiten.....	203
Tabelle 176:	Advanced - Chipset Configuration Einstellmöglichkeiten.....	204
Tabelle 177:	Advanced - SATA Configuration Einstellmöglichkeiten.....	205
Tabelle 178:	Advanced - SATA Configuration - Software Feature Mask Configuration Einstellmöglichkeiten.....	207
Tabelle 179:	Advanced - Memory Configuration Einstellmöglichkeiten.....	208
Tabelle 180:	Advanced - Memory Configuration - Memory Information.....	210
Tabelle 181:	Advanced - Memory Configuration - Custom Profile Control Einstellmöglichkeiten.....	211
Tabelle 182:	Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten.....	212
Tabelle 183:	Advanced - USB Configuration - Per Port USB Disable Control Einstellmöglichkeiten.....	214
Tabelle 184:	Advanced - USB Configuration - Per Port Legacy USB Support Control Einstellmöglichkeiten.....	215
Tabelle 185:	Advanced - Serial Port Console Redirection Einstellmöglichkeiten.....	216
Tabelle 186:	Advanced - Console Redirection - Console Redirection Settings Einstellmöglichkeiten.....	217
Tabelle 187:	Boot Übersicht.....	218
Tabelle 188:	Boot - Boot Device Priority Einstellmöglichkeiten.....	219
Tabelle 189:	Boot - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten.....	220
Tabelle 190:	Security Menü Einstellmöglichkeiten.....	221
Tabelle 191:	Security - HDD User Password Einstellmöglichkeiten.....	222
Tabelle 192:	Save & Exit Menü Einstellmöglichkeiten.....	223
Tabelle 193:	Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht.....	224
Tabelle 194:	Advanced - OEM Features Profileinstellungsübersicht.....	224
Tabelle 195:	Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration Profileinstellungsübersicht.....	224
Tabelle 196:	Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht.....	224
Tabelle 197:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Settings Profileinstellungsübersicht.....	225
Tabelle 198:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express GEN 2 Settings Profileinstellungsübersicht.....	225
Tabelle 199:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Graphics (PEG) Port Profileinstellungsübersicht.....	225
Tabelle 200:	Advanced - PCI Express Configuration - PCI Express Root Port Profileinstellungsübersicht.....	225
Tabelle 201:	Advanced - ACPI Settings Profileinstellungsübersicht.....	226
Tabelle 202:	Advanced - RTC Wake Settings Profileinstellungsübersicht.....	226
Tabelle 203:	Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht.....	226
Tabelle 204:	Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht.....	226
Tabelle 205:	Advanced - SATA Configuration Profileinstellungsübersicht.....	227
Tabelle 206:	Advanced - Memory Configuration Profileinstellungsübersicht.....	227
Tabelle 207:	Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 208:	Advanced - Serial Port Console Redirection Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 209:	Boot - Boot Device Priority Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 210:	Boot - Boot Configuration Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 211:	RAM-Adressbelegung.....	230
Tabelle 212:	I/O-Adressbelegung.....	230
Tabelle 213:	IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode.....	230
Tabelle 214:	IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode.....	231
Tabelle 215:	5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten.....	240
Tabelle 216:	5SWWI7.1541-ENG, 5SWWI7.1641-ENG, 5SWWI7.1741-MUL, 5SWWI7.1841-MUL - Bestelldaten.....	242
Tabelle 217:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7.....	242
Tabelle 218:	5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL - Bestelldaten.....	244
Tabelle 219:	5SWWXP.0741-ENG - Bestelldaten.....	246
Tabelle 220:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009.....	246
Tabelle 221:	0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten.....	250
Tabelle 222:	0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten.....	250

Tabelle 223:	0TB3103.8000 - Bestelldaten.....	251
Tabelle 224:	0TB3103.8000 - Technische Daten.....	251
Tabelle 225:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten.....	252
Tabelle 226:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten.....	252
Tabelle 227:	5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00, 5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Bestelldaten.....	253
Tabelle 228:	5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00, 5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Technische Daten.....	253
Tabelle 229:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten.....	256
Tabelle 230:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten.....	256
Tabelle 231:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten.....	258
Tabelle 232:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten.....	258
Tabelle 233:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten.....	261
Tabelle 234:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten.....	261
Tabelle 235:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten.....	264
Tabelle 236:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten.....	264
Tabelle 237:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten.....	267
Tabelle 238:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten.....	267
Tabelle 239:	Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03.....	269
Tabelle 240:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten.....	270
Tabelle 241:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten.....	270
Tabelle 242:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten.....	274
Tabelle 243:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten.....	274
Tabelle 244:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten.....	275
Tabelle 245:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten.....	275
Tabelle 246:	Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen.....	282

0AC201.91.....	252
0TB103.9.....	250
0TB103.91.....	250
0TB3103.8000.....	251
4A0006.00-000.....	252
5AC901.BUPS-00.....	116
5AC901.BUPS-01.....	119
5AC901.CCFA-00.....	98
5AC901.CHDD-01.....	82
5AC901.CSSD-03.....	84
5AC901.CSSD-04.....	86
5AC901.CSSD-05.....	89
5AC901.I485-00.....	102
5AC901.ICAN-00.....	106
5AC901.IHDA-00.....	109
5AC901.ISRM-00.....	108
5AC901.IUPS-00.....	112
5AC901.IUPS-01.....	114
5AC901.SDVW-00.....	99
5AC901.SSCA-00.....	101
5AC902.BX01-00.....	79
5AC902.BX01-01.....	79
5AC902.BX02-00.....	79
5AC902.BX02-01.....	79
5AC902.FA00-00.....	80
5AC902.FA0X-00.....	81
5AC902.PS00-00.....	124
5AP923.1215-00.....	55
5AP923.1505-00.....	57
5AP923.1906-00.....	59
5AP933.156B-00.....	61
5AP933.185B-00.....	63
5AP933.215C-00.....	65
5AP933.240C-00.....	67
5CADVI.0018-00.....	258
5CADVI.0050-00.....	258
5CADVI.0100-00.....	258
5CASDL.0018-00.....	261
5CASDL.0018-01.....	264
5CASDL.0018-03.....	267
5CASDL.0050-00.....	261
5CASDL.0050-01.....	264
5CASDL.0050-03.....	267
5CASDL.0100-00.....	261
5CASDL.0100-01.....	264
5CASDL.0100-03.....	267
5CASDL.0150-00.....	261
5CASDL.0150-01.....	264
5CASDL.0150-03.....	267
5CASDL.0200-00.....	261
5CASDL.0200-03.....	267
5CASDL.0250-00.....	261
5CASDL.0250-03.....	267
5CASDL.0300-00.....	261
5CASDL.0300-03.....	267
5CASDL.0300-13.....	270
5CASDL.0400-13.....	270
5CASDL.0430-13.....	270
5CAUPS.0005-01.....	122
5CAUPS.0010-01.....	122
5CAUPS.0030-01.....	122
5CAUSB.0018-00.....	274

5CAUSB.0050-00.....	274
5CFAST.016G-00.....	253
5CFAST.032G-00.....	253
5CFAST.2048-00.....	253
5CFAST.4096-00.....	253
5CFAST.8192-00.....	253
5MMDDR.1024-03.....	77
5MMDDR.2048-03.....	77
5MMDDR.4096-03.....	77
5MMDDR.8192-03.....	77
5MMSSD.0060-01.....	91
5MMSSD.0128-01.....	93
5MMSSD.0256-00.....	96
5MMUSB.2048-01.....	256
5MMUSB.4096-01.....	256
5PC901.TS77-00.....	69
5PC901.TS77-01.....	69
5PC901.TS77-02.....	69
5PC901.TS77-03.....	69
5PC901.TS77-04.....	69
5PC901.TS77-05.....	69
5PC901.TS77-06.....	69
5PC901.TS77-07.....	72
5PC901.TS77-08.....	72
5PC901.TS77-09.....	72
5PC901.TS77-10.....	72
5PC911.SX00-00.....	75
5PC911.SX00-01.....	76
5SWWI7.1100-ENG.....	240
5SWWI7.1100-GER.....	240
5SWWI7.1200-ENG.....	240
5SWWI7.1200-GER.....	240
5SWWI7.1300-MUL.....	240
5SWWI7.1400-MUL.....	240
5SWWI7.1541-ENG.....	242
5SWWI7.1641-ENG.....	242
5SWWI7.1741-MUL.....	242
5SWWI7.1841-MUL.....	242
5SWWXP.0600-ENG.....	244
5SWWXP.0600-GER.....	244
5SWWXP.0600-MUL.....	244
5SWWXP.0741-ENG.....	246
9A0014.02.....	275
9A0014.05.....	275
9A0014.10.....	275

A

Abmessungen	
5AC901.BUPS-00.....	117
5AC901.BUPS-01.....	120
AC Netzkabel.....	151
AC Netzteil Einbau.....	130
ACPI.....	230, 231
ADI Control Center.....	111
Allgemeintoleranz.....	13
Anschluss Batterieeinheit.....	149
Anschluss Stromnetz	
AC Netzkabel.....	151
DC Netzkabel.....	150
Anschluss von Kabeln.....	154
Audio.....	47
Aufbau.....	19
Auflösung DVI.....	44
Auflösung SDL.....	44

B

Backlight.....	281
Batterie.....	50
Batterieeinheit.....	111, 116
Batterieeinheit Montage.....	149
Batteriewechsel.....	277
Bemaßungsnorm.....	13
Betriebssystem	
Windows 7.....	240
Windows Embedded Standard 2009.....	246
Windows Embedded Standard 7.....	242
Windows XP Professional.....	244
Biegeradius.....	154
Biegeradiusspezifikation.....	154
BIOS	
Advanced.....	167
Boot.....	218
Defaulteinstellungen.....	224
Main.....	165
Save & Exit.....	222
Security.....	221
BIOS Setup Tasten.....	164
BIOS Upgrade.....	233
Blickwinkel.....	282
Blinkcode.....	48
Bohrschablone	
5AC901.BUPS-00.....	118
5AC901.BUPS-01.....	121
Buseinheit Montage.....	142

C

CAN Master Schnittstelle.....	106
CAN Schnittstelle.....	107
CE- Kennzeichnung.....	248
CFast Slot.....	47
CFast Tausch.....	279
Chipsatz.....	69, 72
COM.....	103
COM1.....	42
COM2.....	42

CPU Board.....	18, 69, 72
CPU Board & Systemeinheit Tausch.....	128
Create RAID Volume.....	159

D

DC Netzkabel.....	150
Delete RAID Volume.....	160
Displayeinheit.....	17
Displayeinheiten.....	55
Displayhelligkeit.....	157
Displaylebensdauer.....	281
Dual-Channel Memory.....	77
DVI Kabel.....	258

E

Echtzeituhr.....	50
Einbauhinweise.....	125
Einbrenneffekt.....	281
Einschalttemperatur Lüfter.....	31
Einschübe.....	38
Elektrische Eigenschaften.....	34
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	248
EMV-Richtlinie.....	248
Entsorgung.....	12, 12
Erdung.....	40, 153
Erdungsanschluss.....	40, 153
Erstes Einschalten.....	155
ESD.....	10
Einzelbauteile.....	10
Elektrische Baugruppen mit Gehäuse.....	10
Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse.....	10
gerechte Handhabung.....	10
Verpackung.....	10
ETH1.....	45
ETH2.....	45
Ethernet 1.....	45
Ethernet 2.....	45
Ethernet Controller.....	45, 45

F

fehlerhafte Bildpunkte.....	281
Firmwareupgrade.....	235
Funktionserde.....	153

G

Geräteschnittstellen und Einschübe.....	38
Gesamtgerät.....	22
GOST-R.....	249
Gosudarstwenny Standart.....	249

H

Hauptspeicher.....	52, 77
Hauptspeicher Tausch.....	132
HDA.....	109
HDD LED.....	48
HM76 Chipsatz.....	72

I

I/O-Adressbelegung.....	230
IF Option.....	102
IF Option 1 Steckplatz.....	53
IF Option 2 Steckplatz.....	53
Image Sticking.....	281
Interface Option.....	102
Interner RAID Controller.....	158
Interrupt- Zuweisungen.....	230, 231

K

Kabel.....	258
DVI Kabel.....	258
SDL Kabel.....	261
SDL Kabel flex.....	267
SDL Kabel flex mit Extender.....	270
SDL Kabel mit 45° Stecker.....	264
USB Kabel.....	274
Konfiguration.....	19
Kühlkörper.....	18

L

Laufwerke.....	82
LED.....	48
LED-Anzeige.....	48
LEDs.....	48
Line IN.....	47
Line OUT.....	47
Link LED.....	48
Lüfterdrehzahl.....	31
Lüfterfilter.....	80
Lüfterfilter Tausch.....	141
Lüfter Kit.....	80
Lüfter Kit Tausch.....	140
Lüfterregelung.....	31

M

Mechanische Eigenschaften.....	22
MIC.....	47
MIC, Line IN, Line OUT.....	110
Monitor / Panel Anschluss.....	43
Montage	
AC Netzteil.....	130
Batterieeinheit.....	149
Buseinheit.....	142
CPU Board & Systemeinheit.....	128
Hauptspeicher.....	132
Interface Option.....	134
Lüfterfilter.....	141
Lüfter Kit.....	140
Panel PC 900.....	125
PCI / PCIe Karten.....	144
Slide-in compact Laufwerk.....	138
Slide-in Laufwerk.....	147
Montage des AC Netzkabels.....	151
Montage des DC Netzkabels.....	150
Montage Interface Option.....	134

Multitouch.....	156
-----------------	-----

N

Netzteil Einbau.....	130
Niederspannungsrichtlinie.....	248

P

Panel PC	
Abmessungen.....	22
Blockschaltbild.....	37
Einbaulagen.....	25
Einbauzeichnungen.....	23
Gewichtsangaben.....	26
Leistungskalkulation.....	35
Lüfterregelung.....	31
Luftfeuchte.....	32
Luftzirkulationsabstände.....	24
Maximale Umgebungstemperatur Betrieb.....	28
Minimale Umgebungstemperatur Betrieb.....	30
Schock.....	33
Schutzart.....	33
Temperatur.....	27
Temperatursensoren.....	31
Umgebungstemperatur Lagerung und Transport.....	30
Vibration.....	33
PCI / PCIe Karten Montage.....	144
Pixelfehler.....	281
Power Button.....	49
Power LED.....	48
Pufferdauer.....	50

Q

QM77 Chipsatz.....	69
--------------------	----

R

RAID Verbund.....	158
RAM-Adressbelegung.....	230
Recovery Volume Options.....	162
Regelung der Displayhelligkeit.....	157
Reinigung.....	280
Relative Luftfeuchtigkeit.....	32
Reset Button.....	49
Reset Disks to Non-RAID.....	161
Ressourcenaufteilung.....	230
Richtlinien.....	13
Richtlinien und Erklärungen.....	248
RS232	
Buslänge.....	103
Kabeltyp.....	103
RS232/422/485 Schnittstelle.....	102
RS232 Kabel.....	275
RS422	
Buslänge.....	103
Kabeltyp.....	104
RS485	
Buslänge.....	104
Kabeltyp.....	104
RS485-Schnittstelle.....	104

Run LED.....	48
--------------	----

S

S.M.A.R.T.....	30
SATA RAID Verbund.....	158
Schnittstellen.....	38
CFast Slot.....	47
Erdung.....	40
Ethernet 1.....	45
Ethernet 2.....	45
Monitor / Panel Anschluss.....	43
Spannungsversorgung +24 VDC.....	34, 40
Spannungsversorgung VAC.....	34, 41
USB.....	46
SDL Kabel.....	261
SDL Kabel flex.....	267
SDL Kabel flex mit Extender.....	270
SDL Kabel mit 45° Stecker.....	264
Serielle Schnittstelle.....	42, 42, 103
Sicherheitshinweise.....	10
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	10
Betrieb.....	11
Montage.....	11
Schutz vor elektrostatischen Entladungen.....	10
Transport und Lagerung.....	11
Umgebungsbedingungen.....	11
Umweltgerechte Entsorgung.....	12
Vorschriften und Maßnahmen.....	10
Werkstofftrennung.....	12
Singletouch.....	156
Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch.....	138
Slide-in compact Slot.....	51
Slide-in Laufwerkseinbau.....	147
Slide-in Slot.....	51
Spannungsversorgung.....	34, 34, 40, 41, 153
Spannungsversorgungsstecker.....	250
Status LEDs.....	48
Störfestigkeit.....	153
Störungsableitung.....	153
Systemeinheit.....	18
Systemeinheiten.....	75

T

Temperaturangaben.....	27
Temperatursensorpositionen.....	31
Temperaturüberwachung.....	30
Touchkalibrierung.....	156

U

UL Haz. Loc. Zulassung.....	249
UL Zulassung.....	249
Umwelt Eigenschaften.....	27
Unterbrechungsfreie Stromversorgung.....	111
Upgrade	
BIOS.....	233
Firmware.....	235
Upgradeinformationen.....	233
USB 3.0.....	46
USB Kabel.....	274

USB Memory Stick.....	256
USB Schnittstellen.....	46
USV.....	111, 111
USV IF Option.....	111
USV Schnittstelle.....	113, 115
USV Verbindungskabel.....	111, 122

V

Verdrahtung.....	150, 151
Videosignal.....	43

W

WES2009.....	246
WES7.....	242
Windows 7.....	240
Windows Embedded Standard 2009.....	246
Windows Embedded Standard 7.....	242
Windows XP Professional.....	244

Z

Zubehör.....	250
Zulassungen.....	249
GOST-R.....	249
UL.....	249
UL Haz. Loc.....	249